

科创板投资风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

KINGSEMI Co., Ltd.

(辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号)



首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书

(申报稿)

本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

声明及承诺

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人第一大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟公开发行股票数量不超过 2,100 万股，占发行后公司股份总数的比例不低于 25%，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不低于 8,400 万股
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【 】年【 】月【 】日

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策前，请认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素：

（一）技术开发风险

公司所处的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，涉及电子、机械、化工、材料、信息等多学科领域，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。经过多年的技术研发与积累，公司已成功掌握所在细分领域多项核心技术。虽然公司拥有相关核心关键技术的自主知识产权，但技术水平与国际知名企业相比仍然存在一定差距，特别是在集成电路制造前道晶圆加工环节涂胶显影设备及清洗设备领域，公司与国际龙头日本东京电子及日本迪恩士的技术差距仍然较大。公司只有持续保持技术开发和创新，才能不断缩小与包括日本东京电子及日本迪恩士等在内的国际知名企业的差距。如果不能紧跟国内外半导体设备制造技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，或者后续研发投入不足，公司将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

（二）核心技术人员流失或不足的风险

作为典型的技术密集型行业，半导体设备行业对于专业人才尤其是研发人员的依赖程度较高，核心技术人员是公司生存和发展的重要基石。公司自成立以来十分注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬管理体系，并且通过核心技术人员持股等方式，有效提升了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力。但随着市场需求的不断增长和行业竞争的日益激烈，半导体设备行业对于专业技术人才的竞争不断加剧，若公司不能提供更好的发展平台、更具市场竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍不排除核心技术人员流失的风险；同时，随着公司募集资金投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩张，对于专业技术

人才的需求也将有所提升，公司将面临核心技术人才不足的风险。

（三）知识产权争议风险

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及非专利技术，出于长期发展的战略考量，公司一直坚持自主创新的发展战略，积极做好自身知识产权的申报和保护，但未来仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷或公司的知识产权被侵犯的风险，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。此外，半导体产业链上下游供应商与客户的经营也可能会受知识产权争议、诉讼等因素的影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

（四）市场竞争风险

半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，经过多年的技术积累和品牌建设，公司在半导体设备领域建立了一定的品牌知名度。目前公司的竞争对手主要为日本、德国、美国、中国台湾等国家或地区企业，如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品，或者提供更好的价格或服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

（五）产品质量纠纷风险

公司所处的半导体设备行业作为半导体产业链中至关重要的环节，产品质量尤为重要。半导体产业对设备质量有着严苛的要求，不排除可能出现因公司产品质量缺陷导致客户产生损失而被客户退货或索赔等不利后果，将对公司的经营业绩和市场声誉等产生不利影响。

（六）经营业绩大幅波动甚至上市当年亏损的风险

随着公司对新产品、新技术研发的持续投入以及可能承担包括 02 重大专项等在内的重大科研项目，未来公司研发投入可能会出现阶段性的大幅增长，这将对公司的经营业绩造成较大冲击；半导体设备行业受下游半导体市场及终端消费市场波动的影响较大，如果未来终端消费市场需求尤其是增量需求下滑，半导体制造厂商可能会削减资本性支出规模，将会对包括公司在内的半导体设备行业企业的经营业绩造成较大不利影响；此外，如果公司新产品（包括前道涂胶显

影设备等)商业化推广不及预期,也会对公司业绩产生较大不利影响。在上述各项影响因素综合作用下,不排除未来公司经营业绩出现大幅波动甚至上市当年亏损的风险。

(七) 财务风险

1、税收优惠风险

报告期内,公司享受的税收优惠政策包括软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。最近三年,公司各年税收优惠金额合计数分别为 392.13 万元、1,376.16 万元和 1,512.49 万元,占当期利润总额的比例分别为 81.97%、45.95%和 46.02%。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整,或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠,将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、政府补助政策风险

最近三年,公司计入其他收益或营业外收入的政府补助金额分别为 820.99 万元、2,235.36 万元和 2,123.22 万元,占当期利润总额的比例分别为 171.62%、74.63%和 64.61%,占比较高。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱,或者其他补助政策发生不利变化,公司取得的政府补助金额将会有所减少,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、毛利率波动的风险

公司主要为下游集成电路、LED 芯片等半导体制造厂商提供半导体专用设备,产品呈现较为显著的定制化特征,不同客户的产品配置及性能要求以及议价能力可能会有所不同,从而导致毛利率存在一定差异。报告期各期,公司主营业务毛利率分别为 41.25%、41.79%、46.27%和 36.18%,存在一定的波动。如果公司未来不能持续提升技术创新能力并保持技术优势,或者行业竞争加剧导致产品价格下降,或者公司未能有效控制产品成本,都将可能导致公司毛利率水平出现波动,给公司的经营带来一定风险。

(八) 供应商供货不稳定风险

半导体设备属于高精密的自动化装备,研发和生产均需使用高精度元器件,

对产品机械结构的精度和材质要求较高，而我国与此相关的产业配套环境依然不够成熟，相关核心关键零部件仍然有赖于进口。报告期内，公司以机械臂为代表的部分核心零部件大部分采购自日本等国外核心供应商，虽然公司与其建立了长期稳定的供货关系，但未来下游半导体制造业对半导体设备需求不排除会出现爆发式增长，进而对公司产品生产造成一定的压力，而公司上游核心供应商短期供货能力不足可能会在一定程度上约束公司的生产能力，进而对公司的经营产生不利影响。此外，随着国际贸易摩擦的加剧，不排除相关国家贸易政策变动影响发行人上游供应商的供货稳定性。

（九）发行失败风险

根据相关法规的要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将导致本次发行失败的风险。

（十）无控股股东、无实际控制人风险

公司股权较为分散，截至本招股说明书签署日，公司单个股东单独或合计持有的股份数量均未超过公司总股本的 30%，单个股东均无法决定董事会多数席位，公司无控股股东及实际控制人，公司经营方针及重大事项的决策均由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能，但不排除存在因无控股股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。此外，由于公司股权较为分散，未来不排除公司存在控制权发生变动的风险，可能会导致公司正常经营活动受到影响。

二、本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及相关责任主体承诺事项的约束措施，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、发行人的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以

及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”。

目 录

重大事项提示	4
一、特别风险提示	4
二、本次发行相关主体作出的重要承诺	7
第一节 释义	14
一、基本术语	14
二、专业术语	16
第二节 概览	20
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况	20
二、本次发行概况	20
三、发行人的主要财务数据及财务指标	22
四、发行人主营业务经营情况	22
五、公司的技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略	24
六、发行人选择的具体上市标准	28
七、发行人公司治理的特殊安排	28
八、募集资金用途	28
第三节 本次发行概况	29
一、本次发行的基本情况	29
二、本次发行的相关机构	30
三、发行人与本次发行有关中介机构的关系	31
四、本次发行上市有关的重要日期	32
第四节 风险因素	33
一、技术风险	33
二、法律风险	34
三、经营风险	34
四、内控风险	35
五、财务风险	36
六、发行失败风险	37

七、募集资金投资项目风险	38
八、其他风险	38
第五节 发行人基本情况	40
一、发行人基本情况	40
二、发行人设立情况	40
三、发行人报告期内的重大资产重组情况	58
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况	58
五、发行人的股权结构图	58
六、发行人对外股权投资情况	59
七、发行人持股 5% 以上股份的主要股东的基本情况	59
八、发行人股本情况	65
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	69
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况	74
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的重大协议及其履行情况	77
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况、原因及对公司的影响	78
十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况	79
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人业务相关的对外投资情况	81
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬及员工激励情况 ..	81
十六、发行人员工情况	83
第六节 业务和技术	86
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况	86
二、发行人所处行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响	100
三、发行人所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势	102

四、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况	114
五、发行人市场地位及竞争情况	134
六、发行人销售情况及主要客户	144
七、发行人采购情况及主要供应商	147
八、发行人主要固定资产及无形资产	151
九、发行人技术与研发情况	162
十、发行人境外经营情况	170
第七节 公司治理与独立性	171
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员的运作及履职情况	171
二、特别表决权股份或类似安排情况	173
三、协议控制架构情况	173
四、管理层对内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见	173
五、发行人报告期内的规范运作情况	174
六、报告期内发行人持股 5% 以上股东及其控制的其他企业占用发行人资金和由发行人提供担保的情况	174
七、发行人独立运营情况	174
八、同业竞争	176
九、关联方和关联关系	178
十、发行人关联交易情况	179
十一、关联交易制度的执行情况	184
十二、报告期内关联方的变化情况	184
第八节 财务会计信息与管理层分析	186
一、经审计的财务报表	186
二、注册会计师的审计意见	191
三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险	193
四、重大影响的会计政策和会计估计	197

五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策	216
六、分部信息	218
七、经注册会计师核验的非经常性损益情况	218
八、主要财务指标	219
九、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项	221
十、经营成果分析	222
十一、财务状况分析	253
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析	278
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项	284
十四、盈利预测	284
第九节 募集资金运用与未来发展规划	286
一、募集资金运用概况	286
二、募集资金投资项目具体情况	290
三、公司未来发展战略规划	294
第十节 投资者保护	298
一、投资者权益保护情况	298
二、公司发行上市后股利分配政策	299
三、本次发行前滚存利润的处理	302
四、股东投票机制	302
五、关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况	303
六、发行人、发行人的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及 未能履行承诺的约束措施	304
第十一节 其他重要事项	320
一、重大合同	320
二、对外担保情况	321
三、诉讼或仲裁事项	321
四、发行人控股股东、实际控制人最近三年内重大违法情况	322
第十二节 有关声明	323

一、附件	332
二、查阅时间及地点	332

第一节 释义

除非本招股说明书另有所指，下列词语具有的含义如下：

一、基本术语

发行人/公司/本公司/股份公司/芯源/沈阳芯源	指	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
芯源有限	指	沈阳芯源微电子设备有限公司，系公司前身
芯源半导体	指	沈阳芯源先进半导体技术有限公司，系芯源有限前身
先进制造	指	沈阳先进制造技术产业有限公司，系公司第一大股东
韩国 STL	指	Silicon Tech Limited (Korea)，系芯源半导体原外资股东
科发实业	指	辽宁科发实业有限公司，系公司持股 5% 以上股东
中科院沈自所	指	中国科学院沈阳自动化研究所，系公司持股 5% 以上股东
国科投资	指	中国科技产业投资管理有限公司，系公司持股 5% 以上股东
国科瑞祺	指	国科瑞祺物联网创业投资有限公司，系公司持股 5% 以上股东
沈阳科投	指	沈阳科技风险投资有限公司，系公司其他股东
国科正道	指	北京国科正道投资中心（有限合伙），系公司其他股东
富创精密	指	沈阳富创精密设备有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司及其下属企业
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司及其下属企业
通富微电	指	通富微电子股份有限公司及其下属企业
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司及其下属企业
华灿光电	指	华灿光电股份有限公司及其下属企业
乾照光电	指	厦门乾照光电股份有限公司及其下属企业
澳洋顺昌	指	江苏澳洋顺昌股份有限公司及其下属企业
三安光电	指	三安光电股份有限公司及其下属企业
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司
上海华力	指	上海华力集成电路制造有限公司
日本东京电子、TEL	指	東京エレクトロン株式会社（Tokyo Electron Ltd.）
日本迪恩士、DNS	指	株式会社 SCREEN ホールディングス（SCREEN Holdings Co., Ltd.）
德国苏斯微、SUSS	指	SÜSS MicroTec
台湾亿力鑫、ELS	指	亿力鑫系统科技股份有限公司
韩国 CND	指	CNDPLUS CO., LTD.

美国固态半导体、SSEC	指	Solid State Holdings Equipment LLC
美国维易科、Veeco	指	Veeco Instruments Inc.
盛美半导体、ACM Research	指	ACM Research, Inc.
荷兰阿斯麦、ASML	指	Advanced Semiconductor Material Lithography
美国泛林集团、LAM	指	Lam Research Corporation
美国科天、KLA	指	KLA-Tencor Corporation
新松机器人	指	沈阳新松机器人自动化股份有限公司
晶方科技	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司
硕贝德	指	惠州硕贝德无线科技股份有限公司
东莞中图	指	东莞市中图半导体科技有限公司
大连德豪	指	大连德豪光电科技有限公司
海思微电子	指	海思光电子有限公司
华为海思	指	深圳市海思半导体有限公司
上海微电子	指	上海微电子装备（集团）股份有限公司
北方华创	指	北方华创科技集团股份有限公司
中微半导体	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
沈阳拓荆	指	沈阳拓荆科技有限公司
中科信	指	北京中科信电子装备有限公司
凯世通	指	上海凯世通半导体股份有限公司
上海睿励	指	睿励微电子设备（上海）有限公司
东方晶源	指	东方晶源微电子科技（北京）有限公司
至纯科技	指	上海至纯洁净系统科技股份有限公司
华海清科	指	天津华海清科机电科技有限公司
中电四十五所	指	中国电子科技集团公司第四十五研究所
精测电子	指	武汉精测电子集团股份有限公司
Nikon	指	尼康株式会社（Nikon Corporation）
Canon	指	佳能株式会社（Canon Inc.）
美国应用材料、AMAT	指	Applied Materials, Inc.
Axcelis	指	Axcelis Technologies, Inc.
日立	指	株式会社日立製作所（Hitachi, Ltd.）
Ebara	指	Ebara Corporation
泰瑞达	指	美国 Teradyne 公司
爱德万	指	爱德万测试股份有限公司

VLSI	指	VLSI Research Inc.
保荐人/保荐机构、主承销商	指	国信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
发行人会计师、审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），简称“华普天健”）
评估机构	指	同致信德（北京）资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	发行人现行公司章程
《公司章程（草案）》	指	发行人上市后将适用的公司章程
报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月
元，万元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元

二、专业术语

半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，执行特定功能的电路或系统，可进一步细分为逻辑电路、存储器、微处理器、模拟电路四种
芯片	指	集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果
光刻	指	利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将电路图形传递到单晶表面或介质层上，形成有效图形窗口或功能图形的工艺技术
刻蚀	指	用化学或物理方法有选择地在硅表面去除不需要的材料的过程，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造工艺的关键步骤
涂胶	指	将光刻胶均匀涂覆到晶圆表面的过程
显影	指	将曝光完成的晶圆进行成像的过程，通过这个过程，成像在光阻上的图形被显现出来

传统封装	指	先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列直插封装(SIP)、双列直插封装(DIP)、小外形封装(SOP)、小晶体管外形封装(SOT)、晶体管外形封装(TO)等封装形式
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片(FC)结构的封装、圆片级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D封装、3D封装等均被认为属于先进封装范畴
圆片级封装(WLP)	指	Wafer Level Packaging, 在晶圆上封装芯片, 而不是先将晶圆切割成单个芯片再进行封装。这种方案可实现更大的带宽、更高的速度与可靠性以及更低的功耗, 并为用于移动消费电子产品、高端超级计算、游戏、人工智能和物联网设备的多晶片封装提供了更广泛的形状系数
3D封装	指	在不改变封装体尺寸的前提下, 在同一个封装体内于垂直方向叠放两个以上芯片的封装技术
测试	指	把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认, 以保证半导体元件符合系统的需求
摩尔定律	指	当价格不变时, 集成电路上可容纳的元器件的数目, 约每隔18-24个月便会增加一倍, 性能也将提升一倍, 由英特尔创始人之一的戈登·摩尔提出
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System, 微机电系统
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International, 国际半导体设备与材料产业协会
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics, 世界半导体贸易统计协会
IC Insights	指	国外知名的半导体行业研究机构
NAND 闪存	指	快闪记忆体/资料储存型闪存
分立器件、分立元件	指	单一封装的半导体组件, 具备电子特性功能, 常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等
技术节点	指	泛指在集成电路制造过程中的“特征尺寸”, 尺寸越小, 表明工艺水平越高, 如130nm、90nm、28nm、14nm、7nm等
nm、纳米	指	1 纳米=10 ⁻⁹ 米
μm、微米	指	1 微米=10 ⁻⁶ 米
mm、毫米	指	1 毫米=10 ⁻³ 米
LED	指	Light-Emitting-Diode, 发光二极管
Mini LED	指	次毫米发光二极管, 其晶粒尺寸约在 100 微米, 介于传统 LED 与 Micro LED 之间
Micro LED	指	LED 微缩化和矩阵化技术, 将 LED 背光源进行薄膜化、微小化、阵列化, 可以将 LED 单元小于 50 微米, 与 OLED 一样能够实现每个像素单独定址, 单独驱动发光
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode, 有机发光二极管。OLED 显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点

CVD	指	Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积，是一种在晶圆表面发生化学反应来产生沉积薄膜的技术。
晶圆	指	用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
机械手、机械臂	指	一种能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置，特点是可以编程来完成各种预期的作业，构造和性能上兼有人和机械手机器各自的优点
光刻胶	指	微电子术中微细图形加工的关键材料之一。根据其化学反应机理和显影原理，可分负性胶和正性胶两类。光照后形成不可溶物质的是负性胶；反之，对某些溶剂是不可溶的，经光照后变成可溶物质的即为正性胶
离子注入	指	离子束射到固体材料以后，受到固体材料的抵抗而速度慢慢减低下来，并最终停留在固体材料中
Fanout、扇出式	指	基于晶圆重构技术，将芯片重新埋置到晶圆上，然后按照与标准 WLP 工艺类似的步骤进行封装，得到的实际封装面积要大于芯片面积，在面积扩展的同时也可以增加其它有源器件及无源元件形成 SiP
02 重大专项	指	《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目，因次序排在国家重大专项所列 16 个重大专项的第 2 位，在行业内被称为“02 重大专项”
Bumping 制备工艺	指	一种在晶圆上形成微小的焊球或铜柱的制造工艺
WLCSP 封装工艺	指	Wafer Level Chip Scale Packaging，晶圆片级芯片规模封装，即晶圆级芯片封装方式，不同于传统的芯片封装方式（先切割再封测，而封装后至少增加原芯片 20% 的体积），此种最新技术是先在整个晶圆上进行封装和测试，然后才切割成一个个的 IC 颗粒，因此封装后的体积即等同 IC 裸晶的原尺寸
3D-TSV	指	Through Silicon Vias，穿过硅片通道，通过硅通孔（TSV）铜互连的立体（3D）垂直整合，目前被认为是半导体行业最先进的技术之一
Track	指	涂胶/显影机，又称涂布/显影机、匀胶/显影机
iPhone	指	iPhone 是美国苹果公司研发的智能手机系列，搭载苹果公司研发的 iOS 操作系统
GDP	指	Gross Domestic Product，国内生产总值指一个国家或地区所有常驻单位，在一定时期内，生产的全部最终产品和服务价值的总和，常被认为是衡量国家或地区经济状况的指标
电力电子	指	是一门新兴技术，它是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而成的，涉及由半导体开关启动装置进行电源的控制与转换领域
I-line	指	一种以紫外光（汞灯）为光源、光波长为 365nm、应用技术节点为 0.35~0.25 μ m 的光刻工艺

KrF	指	一种以深紫外（DUV）为光源、光波长为 248nm、应用技术节点为 0.25~0.13 μ m 的光刻工艺
ArF	指	一种以深紫外（DUV）为光源、光波长为 193nm、应用技术节点为 0.13 μ m~7nm 的光刻工艺
凸块下金属、UBM	指	UBM 是焊盘和焊球之间的金属过渡层，位于圆片钝化层的上部。UBM 与圆片上的金属化层有着非常好的粘附特性，与焊料球之间也有着良好的润湿特性，在焊球与 IC 金属焊盘之间作为焊料的扩散层。UBM 作为氧化阻挡层还起着保护芯片的作用。
Foundry	指	集成电路领域中专门负责生产、制造芯片的厂家
Fabless	指	即无制造半导体，是“没有制造业务，只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式

注：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	有限公司成立日期	2002年12月17日
英文名称	KINGSEMI Co., Ltd.	股份公司成立日期	2019年3月29日
注册资本	63,000,000元	法定代表人	宗润福
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号	主要生产经营地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号
控股股东	无	实际控制人	无
行业分类	专用设备制造业(C35)	在其他交易所(申请)挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	国信证券股份有限公司	主承销商	国信证券股份有限公司
发行人律师	北京市中伦律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	保荐人(主承销商)律师	北京市天元律师事务所
评估机构	同致信德(北京)资产评估有限公司		

二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股(A股)		
每股面值	1.00元		
发行股数	不超过2,100万股(含2,100万股,以中国证监会同意注册后的数量为准)	占发行后总股本比例	不低于25%
其中:发行新股数量	2,100万股(不考虑超额配售选择权)	占发行后总股本比例	不低于25%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	不超过8,400万股(不考虑超额配售选择权)		
每股发行价格	【】元		

发行市盈率	【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元（按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元（按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按照发行前每股净资产计算） 【】倍（按照发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用网下对投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外）		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	无		
发行费用的分摊原则	/		
募集资金总额	【】		
募集资金净额	【】		
募集资金投资项目	高端晶圆处理设备产业化项目		
	高端晶圆处理设备研发中心项目		
发行费用概算	【】		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】		
开始询价推介日期	【】		
刊登定价公告日期	【】		
申购日期和缴款日期	【】		
股票上市日期	【】		

三、发行人的主要财务数据及财务指标

项目	2019.3.31/2019 年 1-3 月	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度	2016.12.31/ 2016 年度
资产总额（万元）	34,946.61	37,970.28	33,513.85	29,732.71
归属于母公司所有者权 益（万元）	21,085.17	21,987.69	19,317.90	14,635.25
资产负债率（母公司） （%）	39.66	42.09	42.36	50.78
营业收入（万元）	1,030.53	20,999.05	18,988.50	14,760.31
净利润（万元）	-902.52	3,047.79	2,626.81	492.85
归属于母公司所有者的 净利润（万元）	-902.52	3,047.79	2,626.81	492.85
扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润（万元）	-1,048.65	2,009.82	1,549.32	35.18
基本每股收益（元）	-0.14	0.48	0.44	0.08
稀释每股收益（元）	-0.14	0.48	0.44	0.08
加权平均净资产收益率 （%）	-4.19	14.80	15.91	3.43
经营活动产生的现金流 量净额（万元）	-2,051.97	-2,831.55	4,246.40	6,687.18
现金分红（万元）	-	378.00	291.53	-
研发投入占营业收入的 比例（%）	57.77	16.29	10.41	11.24

四、发行人主营业务经营情况

（一）公司主要业务或产品

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于 6 英寸及以下单晶圆处理（如 LED 芯片制造环节）及 8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）。



公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，其中在 LED 芯片制造及集成电路制造后道先进封装等环节，作为国内厂商主流机型已成功实现进口替代；在集成电路制造前道晶圆加工环节，公司成功突破了前道涂胶显影设备关键技术，成型产品目前正在长江存储、上海华力等前道芯片制造厂商进行工艺验证。

作为公司标杆产品，光刻工序涂胶显影设备系集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备，主要与光刻机（芯片生产线上最庞大、最精密复杂、难度最大、价格最昂贵的设备）配合进行作业，通过机械手使晶圆在各系统间传输和处理，从而完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程。作为光刻机的输入（曝光前光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影），涂胶/显影机的性能不仅直接影响到细微曝光图案的形成，其显影工艺的图形质量和缺陷控制对后续诸多工艺（诸如蚀刻、离子注入等）中图形转移的结果也有着深刻的影响。

公司的产品、技术领先性主要体现在：

1、自 2008 年我国启动实施“02 重大专项”以来，公司作为项目牵头单位承担并完成了两项与所处涂胶显影设备领域相关的“02 重大专项”项目，分别是“凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备的开发与产业化”项目和“300mm 晶圆匀胶显影设备研发”项目。

2、截至 2019 年 3 月 31 日，公司已获得专利授权 145 项，其中发明专利 127 项；拥有软件著作权 37 项。此外，公司还先后主持制定了喷胶机、涂胶机两项行业标准，其中喷胶机行业标准已正式颁布实施，涂胶机行业标准目前正在审核

中。

3、公司先后荣获“国家级知识产权优势企业”、“国内先进封装领域最佳设备供应商”、“2018年中国半导体设备五强企业”等多项殊荣，公司产品先后获得“国家战略性创新产品”、“国家重点新产品”等多项荣誉。

（二）公司主要经营模式

公司所采取的主要经营模式参见本招股书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“（四）主要经营模式”。

（三）公司产品市场竞争地位

根据中国半导体行业协会发布的2018年中国半导体设备行业数据，公司2018年位列国产半导体设备厂商五强。

公司产品已实现批量销售，截至2019年3月31日，已累计销售680余台套，目前作为主流机型已成功打入包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌等在内的多家国内知名一线大厂；公司集成电路制造前道晶圆加工环节用涂胶显影设备已开发完成，正在长江存储、上海华力等前道芯片制造厂商进行工艺验证，目前国内该类设备主要被日本东京电子（TEL）所垄断。此外，公司集成电路制造前道晶圆加工环节用清洗机产品目前已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并成功实现销售。

五、公司的技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

（一）技术先进性及产业化情况

成立以来，公司十分重视核心技术的自主研发，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，并广泛应用于公司产品的批量生产中。最近三年，公司分别实现主营业务收入14,350.63万元、18,353.16万元和20,096.97万元，净利润492.85万元、2,626.81万元和3,047.79万元，呈现良好发展势头。

公司核心技术先进性的具体表征如下：

类别	核心技术名称	技术来源	具体表征
光刻工序涂胶显影设备	光刻工艺胶膜均匀涂敷技术	自主研发	针对前道光刻涂胶显影工艺，公司的低粘度超薄光刻胶涂布技术，需要对腔体环境温度精度控制在 0.1℃ 内，湿度精度控制在 0.5% 内，各个运动部件控制精度在 0.1mm 内，再通过专门硬件对温湿度、时序等工艺参数的精确控制，实现超薄胶膜（膜厚约为工艺线宽的 3-5 倍；28nm 节点的膜厚约为 100nm）的高均匀性涂敷，偏差要求在 1% 以内，并可降低客户成本；针对超厚胶涂敷工艺中的普遍问题，公司创新设计腔体结构和热盘单元并通过独特的打胶方式提高超厚胶膜的均匀性。
	不规则晶圆表面喷涂技术	自主研发	针对晶圆表面已带有图形而需要涂敷光刻胶或阻挡层的场景应用，采用超细雾化与喷涂技术，实现深宽比 3: 1 难点突破，喷胶头运动路径优化与控制技术，以及喷涂同步加温固化技术，沿细微图形表面形成均匀覆盖的胶膜；可加热式旋转承片台可以按工艺需求精确旋转相应角度喷涂，保证各个方向侧壁的膜厚均匀性和拐角膜厚厚度，实现槽中槽和 90 度均匀涂覆。优化的管路设计和喷胶单元的防呆设计可提升产能及适用于大量产。
	精细化显影技术	自主研发	公司开发的扫描式显影喷嘴，通过对显影液温度/流量高精度控制技术在晶圆表面形成均匀完整的显影液膜，从而良好地控制 CD（线宽）均匀性；配合显影后冲洗喷嘴的高低流量切换功能和精确的扫描速度控制技术，可以满足各种不同精细化显影工艺需求。显影液/冲洗液温度可控制在 0.1℃ 内，流量精度可控制在 10ml/min 内，实现纳米级线宽显影工艺的精确控制。
	高产能设备架构及机械手优化调度技术	自主研发	前道涂胶/显影机因为要与光刻机联线生产，对其产能要求高于光刻机，公司最先进的机型具有超百个工艺单元。为使产能最大化，新平台架构将工艺单元最小化设计并优化排布，利用多机械手多通道并行技术，对晶圆在不同工艺单元之间进行快速传送；在平台系统软件方面，通过采用 Robot Arm 快速交换、增加 Foup 缓冲功能、智能化优化调度来实现设备高产能。
	内部微环境精确控制技术	自主研发	利用高精度温湿度控制技术对进入设备的空气进行精确控制（温度控制精度 $\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$ ，湿度控制精度 $\leq \pm 0.1\%$ ），并使用高效化学过滤装置控制微环境气体成分。通过数值仿真技术优化整机结构设计以保证设备内部气流的有效合理分布以保持设备高稳定性和洁净度；采用多分区热板设计和创新的制造方法和新材料，实现晶圆温度的高均匀性（全晶圆温度均匀性标准偏差 $\leq 0.07\%$ ），可满足客户严格的技术要求，并降低制造成本。

类别	核心技术名称	技术来源	具体表征
	光刻机联机调度技术	自主研发	前道涂胶/显影机在生产线上多与光刻机联机运行,公司的联机技术硬件设计灵活,一个硬件接口单元即可对应各种主流光刻机,软件设计实现通信对接,具有通信可视界面和日志在线查看功能。
单片式湿法设备	工艺单元参数精确控制技术	自主研发	利用高精度运动控制技术并配合传感器技术及软件技术,实现承片台和化学品摆臂位置与速度的精确控制,在 100~3000rpm 转速范围内,精度可达 $\pm 1\text{rpm}$ 以内,可适用诸如去胶、刻蚀和颗粒清洗等多种清洗工艺;同时,摆臂变速扫描技术可在不同晶圆区域喷洒不同量化学品,从而减少化学品用量,降低客户成本。
	高产能设备架构及机械手优化调度技术	自主研发	在公司通用架构的基础上,为了达到产能最大化,在硬件方面利用高速高精度的机械手技术,对晶圆在设备内的多个工艺单元之间进行快速传送;在平台系统软件方面,通过调度优化技术对传送过程实时进行最优化,实现设备的高产能,对于 LED 制造领域中 4 寸晶圆的 Lift Off 工艺,产能高于 80pcs/h,对于前道清洗工艺,产能高于 340pcs/h。
	晶圆正反面颗粒清洗技术	自主研发	为去除晶圆表面(正反两面)颗粒污染物,公司新开发的二流体喷嘴技术可将晶圆表面的细微颗粒污染物去除,同时确保不损伤晶圆表面的图形;对于微米级别大颗粒,公司的毛刷清洗技术采用特殊材料的毛刷对晶圆进行擦洗去除。配合特有的晶圆翻转装置和夹持式承片台,可在同一台设备中对晶圆的正反两面进行清洗,清洗效果为 120nm 以上颗粒去除率高于 95%。
	化学药品精确供给及回收技术	自主研发	利用高精度的流量检测和控制技术、多级稳压技术、在线温度检测及控制技术,对工艺所用的化学品流量、压力及温度等参数进行精准控制以满足多种清洗工艺要求,流量控制精度可达 $\pm 2\% \text{FS}$ 以内,对于低温段(室温~40℃)温控精度可控制在 $\pm 1^\circ\text{C}$ 以内,对于高温段(40℃~80℃)温控精度可控制在 $\pm 2^\circ\text{C}$ 以内,对于高压压力可控制在 $\pm 0.1\text{MPa}$ 以内;同时,通过内外 Cup 升降配合药液阀切换等方式实现药液的分类回收,其中 8 寸工艺中药液回收率高于 97%,12 寸工艺中药液回收率高于 95%,有效降低客户成本。
	内部微环境精确控制技术	自主研发	为保证晶圆处理微环境的洁净和稳定一致,利用高精度温湿度控制技术对进入设备的空气进行精确控制,并使用高效化学过滤装置控制机器内气体成分。通过数值仿真技术优化整机结构设计以保证设备内部气流的有效合理分布,并运用层流气流排布和下排风方式保持设备内部环境始终处于高洁净度的状态,避免晶圆出现颗粒污染。

类别	核心技术名称	技术来源	具体表征
	不同尺寸晶圆兼容高效能浸泡单元技术	自主研发	针对不同尺寸晶圆的浸泡单元，公司采用创新的兼容设计，实现了无需更换浸泡单元内置片盒即可兼容两种不同尺寸的晶圆，同时在浸泡单元内引入了鼓泡技术、溢流技术等，提升了去胶效率和工艺效果。

公司核心技术产业化情况如下：

类别	核心技术名称	核心技术产业化情况		
		LED 芯片制造等领域	集成电路后道先进封装领域	集成电路前道晶圆加工领域
光刻工序涂胶显影设备	光刻工艺胶膜均匀涂敷技术	已量产	已量产	正在工艺验证，尚未量产
	不规则晶圆表面喷涂技术	/	已量产	/
	精细化显影技术	已量产	/	正在工艺验证，尚未量产
	高产能设备架构及机械手优化调度技术	已量产	已量产	正在工艺验证，尚未量产
	内部微环境精确控制技术	已量产	已量产	正在工艺验证，尚未量产
	光刻机联机调度技术	/	/	正在工艺验证，尚未量产
单片式湿法设备	工艺单元参数精确控制技术	已量产	已量产	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
	高产能设备架构及机械手优化调度技术	已量产	已量产	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
	晶圆正反面颗粒清洗技术	/	/	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
	化学药品精确供给及回收技术	已量产	已量产	/
	内部微环境精确控制技术	已量产	已量产	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
	不同尺寸晶圆兼容高效能浸泡单元技术	/	已量产	/

（二）未来发展战略

未来，公司将紧紧抓住半导体产业发展的机遇，不断提升现有产品的技术水平和市场竞争力，持续深化并拓展与境内外客户的合作，努力为客户提供更加高品质及高性价比的产品及服务；公司将继续推进包括集成电路前道晶圆加工领域在内的新产品、新技术的研发与推广，深入挖掘潜在的目标市场，努力提升市场份额。

六、发行人选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

七、发行人公司治理的特殊安排

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排等重要事项。

八、募集资金用途

经公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准，本次股票发行后，扣除发行费用后的募集资金净额，将投资以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	高端晶圆处理设备产业化项目	23,860.73	23,860.73
2	高端晶圆处理设备研发中心项目	13,918.24	13,918.24
合计		37,778.97	37,778.97

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数及比例	本次公开发行股票数量不超过2,100万股，占发行后公司股份总数的比例不低于25.00%。
每股发行价格	【】元
发行人高管、员工拟参与战略配售情况	公司高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，在中国证监会履行完本次发行的注册程序后，公司将召开董事会审议相关事项，并在启动发行后根据相关法律法规的要求，将高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的具体情形在招股说明书中进行详细披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
发行市盈率	【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按照发行前每股净资产计算） 【】倍（按照发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）

发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外）
承销方式	余额包销
发行费用概算	<p>发行费用总额为【】万元，其中：</p> <p>承销和保荐费用【】万元</p> <p>审计及验资费用【】万元</p> <p>律师费用【】万元</p> <p>用于本次发行的信息披露费用【】万元</p> <p>发行手续费用【】万元</p> <p>以上金额均为不含税金额。</p>

二、本次发行的相关机构

1、保荐人（主承销商）：	国信证券股份有限公司
法定代表人	何如
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
保荐代表人	谭杰伦、李大林
项目协办人	刘书杰
项目组其他联系人	敖振力、张程程
电话	010-88005104
传真	010-66211974
2、律师事务所：	北京市中伦律师事务所
负责人	张学兵
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 33、36、37 层
经办律师	贾琛、魏海涛、赵海洋
电话	010-59572288
传真	010-65681838
3、会计师事务所：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	肖厚发

住所	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
经办注册会计师	吴宇、冯颖、董博佳
电话	024-22533738
传真	024-22533738
4、资产评估机构：	同致信德（北京）资产评估有限公司
法定代表人	杨鹏
住所	北京市西城区西直门外大街 110 号 8 层
经办注册评估师	宋皖阳、韩旭
电话	024-31077664
传真	024-31077664
5、保荐人（主承销商） 律师：	北京市天元律师事务所
住所	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 10 层
负责人	朱小辉
经办律师	李静娴、徐梦磊
联系电话	010-57763888
6、股票登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电话	021-68870587
传真	021-58754185
7、主承销商收款银行：	中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
户名	国信证券股份有限公司
账号	4000029119200021817

三、发行人与本次发行有关中介机构的关系

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市有关的重要日期

(一) 刊登发行公告的日期：【】年【】月【】日

(二) 开始询价推介日期：【】年【】月【】日

(三) 刊登定价公告日期：【】年【】月【】日

(四) 网下、网上申购日期：【】年【】月【】日

(五) 网下、网上缴款日期：【】年【】月【】日

(六) 预计股票上市日期：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易。

第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素按照不同类型进行归类,同类风险根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。

一、技术风险

(一) 技术开发风险

公司所处的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业,涉及电子、机械、化工、材料、信息等多学科领域,是多门类跨学科知识的综合应用,具有较高的技术门槛。经过多年的技术研发与积累,公司已成功掌握所在细分领域多项核心关键技术。虽然公司拥有相关核心关键技术的自主知识产权,但技术水平与国际知名企业相比仍然存在一定差距,特别是在集成电路制造前道晶圆加工环节用涂胶显影设备及清洗设备领域,公司与国际龙头日本东京电子及日本迪恩士的技术差距仍然较大。公司只有持续保持技术开发和创新,才能不断缩小与包括日本东京电子及日本迪恩士等在内的国际知名企业的差距。如果不能紧跟国内外半导体设备制造技术的发展趋势,充分关注客户多样化的个性需求,或者后续研发投入不足,公司将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

(二) 核心技术人员流失或不足的风险

作为典型的技术密集型行业,半导体设备行业对于专业人才尤其是研发人员的依赖程度较高,核心技术人员是公司生存和发展的重要基石。公司自成立以来十分注重人力资源的科学管理,制定了较为合理的员工薪酬管理体系,并且通过核心技术人员持股等方式,有效提高了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力。但随着市场需求的不断增长和行业竞争的日益激烈,半导体设备行业对于专业技术人才的竞争不断加剧,若公司不能提供更好的发展平台、更具市场竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件,仍不排除核心技术人员流失的风险;同时,随着公司募集资金投资项目的实施,公司资产和经营规模将迅速扩张,对于专业技术

人才的需求也将有所提升，公司将面临核心技术人才不足的风险。

（三）核心技术失密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司掌握了一系列核心技术，这些核心技术是公司业务保持持续发展的重要推动力。自成立以来，公司高度重视对核心技术的保护，采取了较为严格的核心技术保密措施，除了及时通过专利申请、计算机软件著作权申请等方式对核心技术进行有效保护外，还与相关技术人员签署了《保密协议》和《竞业禁止协议》，对其个人行为进行了有效约束。但仍不排除因核心技术人员流失、员工个人工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术失密的风险，这可能会导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展产生不利影响。

二、法律风险

（一）知识产权争议风险

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，涉及到较多专利及非专利技术，出于长期发展的战略考量，公司一直坚持自主创新的发展战略，积极做好自身知识产权的申报和保护，但未来仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷或公司的知识产权被侵权的风险，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。此外，半导体产业链上下游供应商与客户的经营也可能会受知识产权争议、诉讼等因素的影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

（二）产品质量纠纷风险

公司所处的半导体设备行业作为半导体产业链中至关重要的环节，产品质量尤为重要。半导体产业对设备质量有着严苛的要求，但不排除可能出现因公司产品质量缺陷导致客户产生损失而被客户退货或索赔等不利后果，将对公司的经营业绩和市场声誉等产生不利影响。

三、经营风险

（一）经营业绩大幅波动甚至上市当年亏损的风险

随着公司对新产品、新技术研发的持续投入以及可能承担包括 02 重大专项等在内的重大科研项目，未来公司研发投入可能会出现阶段性的大幅增长，这将对公司的经营业绩造成较大冲击；半导体设备行业受下游半导体市场及终端消费市场波动的影响较大，如果未来终端消费市场需求尤其是增量需求下滑，半导体制造厂商可能会削减资本性支出规模，将会对包括公司在内的半导体设备行业企业的经营业绩造成较大不利影响；此外，如果公司新产品（包括前道涂胶显影设备等）商业化推广不及预期，也会对公司业绩产生较大不利影响。在上述各项影响因素综合作用下，不排除未来公司经营业绩出现大幅波动甚至上市当年亏损的风险。

（二）市场竞争风险

半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，经过多年的技术积累和品牌建设，公司在半导体设备领域建立了一定的品牌知名度。目前公司的竞争对手主要为日本、德国、美国、中国台湾等国家或地区企业，如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品，或者提供更好的价格或服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

（三）供应商供货不稳定风险

半导体设备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用高精度元器件，对产品机械结构的精度和材质要求较高，而我国与此相关的产业配套环境依然不够成熟，相关核心关键零部件仍然有赖于进口。报告期内，公司以机械臂为代表的部分核心零部件大部分采购自日本等国外核心供应商，虽然公司与其建立了长期稳定的供货关系，但未来下游半导体制造业对半导体设备需求不排除会出现爆发式增长，进而对公司产品生产造成一定的压力，而公司上游核心供应商短期供货能力不足可能会在一定程度上约束公司的生产能力，进而对公司的经营产生不利影响。此外，随着国际贸易摩擦的加剧，不排除相关国家贸易政策变动影响发行人上游供应商的供货稳定性。

四、内控风险

报告期内，公司营业收入和资产规模持续增长，营业收入由 2016 年的 14,760.31 万元增长至 2018 年的 20,999.05 万元，资产总额由 2016 年的 29,732.71 万元增长至 2018 年的 37,970.28 万元。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司的业务和资产规模将进一步扩张，相应的在研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂程度也将不断上升。如果公司的组织模式和经营管理制度未能随着公司规模扩大及时调整与完善，管理水平未能适应规模扩张的需要，公司将面临规模扩张导致的管理和内控风险。

五、财务风险

（一）税收优惠风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策包括软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。最近三年，公司各年税收优惠金额合计数分别为 392.13 万元、1,376.16 万元和 1,512.49 万元，占当期利润总额的比例分别为 81.97%、45.95%和 46.02%。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）政府补助政策风险

最近三年，公司计入其他收益或营业外收入的政府补助金额分别为 820.99 万元、2,235.36 万元和 2,123.22 万元，占当期利润总额的比例分别为 171.62%、74.63%和 64.61%，占比较高。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）毛利率波动的风险

公司主要为下游集成电路、LED 芯片等半导体制造厂商提供半导体专用设备，产品呈现较为显著的定制化特征，不同客户的产品配置及性能要求以及议价能力可能会有所不同，从而导致毛利率存在一定差异。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 41.25%、41.79%、46.27%和 36.18%，存在一定的波动。如果公司未来不能持续提升技术创新能力并保持技术优势，或者行业竞争加剧导致产品

价格下降，或者公司未能有效控制产品成本，都将可能导致公司毛利率水平出现波动，给公司的经营带来一定风险。

（四）应收账款回收的风险

报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款规模整体呈现增长趋势。报告期各期末，公司应收账款净额分别为 3,223.34 万元、2,433.16 万元、5,352.03 万元及 4,079.02 万元，占当期流动资产的比例分别为 14.42%、10.08%、18.35% 及 15.65%。如果未来公司应收账款管理不当或客户自身经营发生重大困难，可能会导致公司应收账款无法及时收回，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）经营活动现金流量净额波动的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,687.18 万元、4,246.40 万元、-2,831.55 万元及-2,051.97 万元，呈现下降趋势。未来，随着公司经营规模的不断扩大，营运资金需求日益增加，如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，可能导致公司出现流动性风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）存货金额较大、存货周转率较低的风险

报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司存货规模有所增长，各期末存货净额分别为 9,745.63 万元、8,854.43 万元、14,365.26 万元和 15,805.37 万元，占总资产的比例分别为 32.78%、26.42%、37.83% 和 45.23%，存货周转率分别为 0.83 次、1.13 次、0.93 次和 0.04 次，较大的存货规模存在减值风险，而较低的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

六、发行失败风险

根据相关法规的要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将

导致本次发行失败的风险。

七、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金投资项目包括高端晶圆处理设备产业化项目和高端晶圆处理设备研发中心项目。虽然公司本次发行前已经对募投项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，但该可行性研究均系基于当前产业政策、市场环境和发展趋势等因素作出。考虑到上述募集资金投资项目的实施均存在一定周期，若未来产业政策、市场环境、产品技术变革等发生不利变化，将可能对公司募投项目的按期实施及正常运转造成不利影响，存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司业绩下滑的风险。

（二）折旧增加导致业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将显著增加，导致折旧费用相应增加。如果未来行业或市场环境等因素发生重大不利变化，公司募集资金投资项目不能如期产生经济效益或实际收益不能达到预期，则存在固定资产折旧增加导致业绩下滑的风险。

（三）财务费用增加导致业绩下降的风险

本次募集资金投资项目预计总投资额为 37,778.97 万元，若本次募集资金到位时间与资金需求时间不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，由于总投资金额较大，公司部分投资款预计将采取银行借款的形式，由此带来的财务费用的增加将可能导致公司业绩水平出现下滑。

八、其他风险

（一）无控股股东及实际控制人风险

公司股权较为分散，截至本招股说明书签署日，公司单个股东单独或合计持有的股份数量均未超过公司总股本的 30%，单个股东均无法决定董事会多数席位，公司无控股股东及实际控制人，公司经营方针及重大事项的决策均由股东大

会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能，但不排除存在因无控股股东及实际控制人导致公司决策效率低下的风险。此外，由于公司股权较为分散，未来不排除公司存在控制权发生变动的风险，可能会导致公司正常经营活动受到影响。

（二）股票价格波动风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票市场投资收益与投资风险并存，投资者对此应有充分准备，为此，公司特别提醒投资者必须具备风险意识，以便作出正确的投资决策。公司未来将继续以股东利益最大化为最终目标，加强内部管理，努力降低成本，积极拓展市场，提高盈利水平，并将严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。

（三）本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行后，公司资本实力将得到增强，净资产大幅增加，但由于募集资金投资项目具有一定的投入周期，在短期内难以完全产生效益，因此，公司在发行当年每股收益及净资产收益率将受股本摊薄影响出现下降，从而导致公司即期回报被摊薄。

（四）不可抗力风险

公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害、战争以及突发性事件等其他不可控因素给公司经营带来不利影响。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称	(中文) 沈阳芯源微电子设备股份有限公司
	(英文) KINGSEMI Co., Ltd.
住所	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
法定代表人	宗润福
注册资本	6,300 万元
有限公司成立日期	2002 年 12 月 17 日
股份公司设立日期	2019 年 3 月 29 日
通讯地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
邮编	110168
电话	024-23826299
传真	024-23826200
互联网网址	http://www.kingsemi.com
电子邮箱	lifl@kingsemi.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责人	李风莉
电话号码	024-23826230

二、发行人设立情况

(一) 芯源有限设立情况

2002 年 12 月 1 日, 先进制造、韩国 STL 签订《中外合资经营沈阳芯源先进半导体技术有限公司合同》、《中外合资经营沈阳芯源先进半导体技术有限公司章程》, 约定共同出资设立芯源半导体, 投资总额为 840 万美元, 注册资本为 420 万美元。

2002 年 12 月 3 日, 沈阳市工商局出具《企业名称预先核准通知书》((辽沈) 名称预核外字[2002]第 0808 号), 核准企业名称为“沈阳芯源先进半导体技术有限公司”。同日, 沈阳高新技术产业开发区管委会出具《关于中外合资“沈阳芯源先进半导体技术有限公司”可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(沈

高新外字[2002]238号)、《关于中外合资“沈阳芯源先进半导体技术有限公司”合同、章程及设立企业的批复》(沈高新外字[2002]239号),同意先进制造、韩国 STL 在沈阳市投资设立芯源半导体。

2002年12月11日,沈阳市人民政府向芯源半导体核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸沈府资字[2002]0212号)。

2002年12月17日,芯源半导体在沈阳市工商行政管理局办理了设立登记,芯源半导体设立时股东的出资情况及出资比例为:

序号	股东名称	出资金额(万美元)	持股比例
1	先进制造	300.00	71.43%
2	韩国 STL	120.00	28.57%
合计		420.00	100.00%

(二) 沈阳芯源设立情况

1、设立方式

公司系经芯源有限整体变更设立的股份有限公司,芯源有限前身芯源半导体成立于2002年12月17日。

2019年2月28日,华普天健出具了会审字[2019]1250号《沈阳芯源微电子设备有限公司审计报告》,截至2018年12月31日,芯源有限经审计的账面净资产值为21,987.69万元。

2019年3月1日,同致信德(北京)资产评估有限公司出具了同致信德评报字[2019]第070001号《沈阳芯源微电子设备有限公司拟进行股份制改制涉及的股东全部权益价值资产评估报告》,经评估,截至2018年12月31日,芯源有限净资产值为人民币60,892万元。

2019年3月12日,芯源有限召开股东会并作出决议,一致同意公司名称由“沈阳芯源微电子设备有限公司”变更为“沈阳芯源微电子设备股份有限公司”,企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,以2018年12月31日为改制基准日整体变更为股份有限公司。

2019年3月27日,中国科学院出具了《中国科学院关于同意沈阳芯源微电

子设备有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（科发函字[2019]105号），同意芯源有限整体变更方案。

2019年3月27日，芯源有限全体股东作为发起人签署了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司发起人协议》，约定将芯源有限整体变更设立为股份有限公司，股份总额为6,300万股。同日，公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，审议并通过了公司整体改制相关议案。

2019年3月29日，华普天健对整体变更后的股份公司注册资本实收情况进行了审验，并出具了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司验资报告》（会验字[2019]5951号），确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2019年3月29日，公司取得沈阳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9121011274273568XC）。

2019年4月19日，中国科学院对同致信德出具的《沈阳芯源微电子设备有限公司拟进行股份制改制涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（同致信德评报字[2019]第070001号）的评估结果予以备案。

2、发起人

公司共有49名发起人，包括42名自然人股东，7名法人股东。公司设立时各发起人持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	先进制造	1,433.24	22.75%
2	中科院沈自所	1,050.00	16.67%
3	科发实业	993.28	15.77%
4	国科投资	682.00	10.83%
5	国科瑞祺	450.00	7.14%
6	沈阳科投	150.00	2.38%
7	国科正道	16.00	0.25%
8	周冰冰	419.48	6.66%
9	宗润福	265.00	4.21%
10	李风莉	140.00	2.22%
11	王绍勇	90.00	1.43%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
12	林顺富	65.00	1.03%
13	徐春旭	53.00	0.84%
14	汪 涛	45.00	0.71%
15	张怀东	40.00	0.63%
16	张 宇	40.00	0.63%
17	苗 涛	35.00	0.56%
18	孙东丰	35.00	0.56%
19	王永斌	35.00	0.56%
20	谷德君	32.00	0.51%
21	郑右非	23.00	0.37%
22	崔晓微	17.00	0.27%
23	袁幼零	13.00	0.21%
24	季 刚	12.00	0.19%
25	程 虎	12.00	0.19%
26	张浩渊	10.00	0.16%
27	朴勇男	10.00	0.16%
28	李迎辉	10.00	0.16%
29	顾永田	10.00	0.16%
30	周 爽	10.00	0.16%
31	邱 立	8.00	0.13%
32	陈兴隆	8.00	0.13%
33	张 恒	7.00	0.11%
34	康 宁	6.00	0.10%
35	汪明波	5.00	0.08%
36	蒲凤鸣	5.00	0.08%
37	赵乃霞	5.00	0.08%
38	张 军	5.00	0.08%
39	田广霖	5.00	0.08%
40	王 一	5.00	0.08%
41	王继周	5.00	0.08%
42	苗 阵	5.00	0.08%
43	王 玲	5.00	0.08%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
44	李文韬	5.00	0.08%
45	李守川	5.00	0.08%
46	孙元斌	5.00	0.08%
47	许凯	5.00	0.08%
48	李泽	5.00	0.08%
49	洪旭东	5.00	0.08%
合计		6,300.00	100.00%

（三）报告期内股本和股东的变化情况

报告期内，发行人股本及股东变化情况如下：

1、2016年9月，股权转让

本次股权转让的背景为：徐春旭、郑右非、蒲凤鸣、宗润福、郑春海因个人资金需要转让其所持芯源有限部分股权，王冲、汪钢因离职转让其所持芯源有限全部股权。本次股权转让的价格参照2015年12月增资的价格确定为3.31元/一元注册资本。

2016年9月1日，芯源有限召开股东会，会议同意徐春旭将其持有的芯源有限2万元出资额转让给股东张宇；郑右非将其持有的芯源有限2万元出资额转让给谷德君；郑春海、蒲凤鸣分别将其持有的芯源有限1万元出资额转让给张瑜；王冲将其持有的芯源有限5万元出资额转让给周鹏；汪钢分别将其持有的芯源有限10万元出资额转让给王绍勇、5万元出资额转让给魏猛、5万元出资额转让给程虎、5万元出资额转让给顾永田；宗润福分别将其持有的5万元出资额转让给李迎辉、5万元出资额转让给田广霖、5万元出资额转让给张恒、5万元出资额转让给王一。其他股东放弃优先购买权，并修改公司章程相应条款。

2016年9月1日，上述股权转让双方分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。本次股权转让价款均已支付完毕，转让明细如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	徐春旭	张宇	2.00	6.62

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
2	郑右非	谷德君	2.00	6.62
3	郑春海	张 瑜	1.00	3.31
4	蒲凤鸣		1.00	3.31
5	王 冲	周 鹏	5.00	16.55
6	汪 钢	王绍勇	10.00	33.10
		魏 猛	5.00	16.55
		程 虎	5.00	16.55
		顾永田	5.00	16.55
7	宗润福	李迎辉	5.00	16.55
		田广霖	5.00	16.55
		张 恒	5.00	16.55
		王 一	5.00	16.55
合计			56.00	185.36

2016年9月2日，芯源有限就本次股权转让事宜在工商主管部门办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，芯源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	先进制造	1,433.243	24.58%
2	中科院沈自所	1,050.00	18.01%
3	科发实业	993.282	17.04%
4	国科投资	682.00	11.70%
5	国科瑞祺	450.00	7.72%
6	沈阳科投	150.00	2.57%
7	国科正道	16.00	0.27%
8	宗润福	257.00	4.41%
9	李风莉	120.00	2.06%
10	王绍勇	100.00	1.72%
11	林顺富	55.00	0.94%
12	徐春旭	53.00	0.91%
13	张怀东	40.00	0.69%
14	苗 涛	40.00	0.69%
15	胡延兵	40.00	0.69%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
16	张宇	37.00	0.63%
17	汪涛	35.00	0.60%
18	谷德君	32.00	0.55%
19	汪明波	30.00	0.51%
20	孙东丰	30.00	0.51%
21	王永斌	25.00	0.43%
22	郑右非	23.00	0.39%
23	崔晓微	20.00	0.34%
24	张瑜	12.00	0.21%
25	张浩渊	10.00	0.17%
26	朴勇男	10.00	0.17%
27	刘正伟	10.00	0.17%
28	高侃	10.00	0.17%
29	郑春海	6.00	0.10%
30	康宁	6.00	0.10%
31	蒲凤鸣	5.00	0.09%
32	赵乃霞	5.00	0.09%
33	张军	5.00	0.09%
34	顾永田	5.00	0.09%
35	魏猛	5.00	0.09%
36	程虎	5.00	0.09%
37	周鹏	5.00	0.09%
38	李迎辉	5.00	0.09%
39	田广霖	5.00	0.09%
40	张恒	5.00	0.09%
41	王一	5.00	0.09%
合计		5,830.525	100.00%

2、2017年3月，股权转让

本次股权转让的背景为：胡延兵、郑春海、魏猛因离职转让其所持芯源有限全部股权。本次股权转让的价格参照2015年12月增资的价格确定为3.31元/一元注册资本。

2017年3月10日，芯源有限召开股东会，会议同意胡延兵分别将其持有的芯源有限13万元出资额转让给袁幼零、10万元出资额转让给汪涛、5万元出资额转让给汪明波、5万元出资额转让给孙东丰、5万元出资额转让给李迎辉、2万元出资额转让给邱立；郑春海将其持有的芯源有限6万元出资额转让给邱立；魏猛将其持有的芯源有限5万元出资额转让给齐志崴。其他股东放弃优先购买权，并修改公司章程相应条款。

2017年3月10日，上述转让双方分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。本次股权转让价款已经支付完毕，转让明细如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	胡延兵	袁幼零	13.00	43.03
		汪涛	10.00	33.10
		汪明波	5.00	16.55
		孙东丰	5.00	16.55
		李迎辉	5.00	16.55
		邱立	2.00	6.62
2	郑春海	邱立	6.00	19.86
3	魏猛	齐志崴	5.00	16.55
合计			51.00	168.81

2017年3月31日，芯源有限就本次股权转让事宜在工商主管部门办理了工商变更登记手续。本次股权转让事宜完成后，芯源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	先进制造	1,433.243	24.58%
2	中科院沈自所	1,050.00	18.01%
3	科发实业	993.282	17.04%
4	国科投资	682.00	11.70%
5	国科瑞祺	450.00	7.72%
6	沈阳科投	150.00	2.57%
7	国科正道	16.00	0.27%
8	宗润福	257.00	4.41%
9	李风莉	120.00	2.06%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
10	王绍勇	100.00	1.72%
11	林顺富	55.00	0.94%
12	徐春旭	53.00	0.91%
13	汪 涛	45.00	0.77%
14	张怀东	40.00	0.69%
15	苗 涛	40.00	0.69%
16	张 宇	37.00	0.63%
17	汪明波	35.00	0.60%
18	孙东丰	35.00	0.60%
19	谷德君	32.00	0.55%
20	王永斌	25.00	0.43%
21	郑右非	23.00	0.39%
22	崔晓微	20.00	0.34%
23	袁幼零	13.00	0.22%
24	张 瑜	12.00	0.21%
25	张浩渊	10.00	0.17%
26	朴勇男	10.00	0.17%
27	刘正伟	10.00	0.17%
28	高 侃	10.00	0.17%
29	李迎辉	10.00	0.17%
30	邱 立	8.00	0.14%
31	康 宁	6.00	0.10%
32	蒲凤鸣	5.00	0.09%
33	赵乃霞	5.00	0.09%
34	张 军	5.00	0.09%
35	顾永田	5.00	0.09%
36	程 虎	5.00	0.09%
37	周 鹏	5.00	0.09%
38	田广霖	5.00	0.09%
39	张 恒	5.00	0.09%
40	王 一	5.00	0.09%
41	齐志崑	5.00	0.09%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
	合计	5,830.525	100.00%

3、2017年8月，增资（注册资本由5,830.525万元增至6,300.00万元）

本次增资的背景为：因公司业务发展需要补充流动资金，经宗润福引荐，周冰冰看好公司发展前景，作为财务投资者与宗润福等8名公司核心员工对芯源有限进行增资。本次增资价格参照经备案的评估结果确定为5元/一元注册资本。

2017年4月15日，辽宁元正资产评估有限公司出具《沈阳芯源微电子设备有限公司拟增资项目资产评估报告》（元正评报字[2017]第047号），经评估，截至评估基准日2016年12月31日，芯源有限净资产账面价值为15,553.84万元，评估价值为28,112.54万元，每股评估值为4.82元。

2017年7月27日，中国科学院对辽宁元正资产评估有限公司出具的《沈阳芯源微电子设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（元正评报字[2017]第047号）的评估结果予以备案。

2017年7月29日，芯源有限召开股东会会议，同意注册资本由5,830.525万元增至6,300万元，新增加的469.475万元注册资本由周冰冰、宗润福等9名自然人认购，本次增资价格为5元/一元注册资本，并修改公司章程相应条款。

2017年8月31日，芯源有限就本次增资事宜在工商主管部门办理了工商变更登记手续。

2019年6月3日，华普天健对芯源有限截至2017年8月31日止新增注册资本和实收资本情况进行了审验，并出具了《沈阳芯源微电子设备有限公司验资报告》（会验字[2019]6013号），确认周冰冰、宗润福等9名自然人缴纳的新增出资已按时足额缴纳。

本次增资事宜完成后，芯源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	先进制造	1,433.24	22.75%
2	中科院沈自所	1,050.00	16.67%
3	科发实业	993.28	15.77%

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
4	国科投资	682.00	10.83%
5	国科瑞祺	450.00	7.14%
6	沈阳科投	150.00	2.38%
7	国科正道	16.00	0.25%
8	周冰冰	419.48	6.66%
9	宗润福	262.00	4.16%
10	李凤莉	135.00	2.14%
11	王绍勇	100.00	1.59%
12	林顺富	65.00	1.03%
13	徐春旭	53.00	0.84%
14	汪 涛	45.00	0.71%
15	张怀东	40.00	0.63%
16	苗 涛	40.00	0.63%
17	张 宇	40.00	0.63%
18	汪明波	35.00	0.56%
19	孙东丰	35.00	0.56%
20	谷德君	32.00	0.51%
21	王永斌	25.00	0.40%
22	崔晓微	25.00	0.40%
23	郑右非	23.00	0.37%
24	袁幼零	13.00	0.21%
25	张 瑜	12.00	0.19%
26	张浩渊	10.00	0.16%
27	朴勇男	10.00	0.16%
28	刘正伟	10.00	0.16%
29	高 侃	10.00	0.16%
30	李迎辉	10.00	0.16%
31	程 虎	10.00	0.16%
32	邱 立	8.00	0.13%
33	张 恒	7.00	0.11%
34	康 宁	6.00	0.10%
35	蒲凤鸣	5.00	0.08%

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
36	赵乃霞	5.00	0.08%
37	张 军	5.00	0.08%
38	顾永田	5.00	0.08%
39	周 鹏	5.00	0.08%
40	田广霖	5.00	0.08%
41	王 一	5.00	0.08%
42	齐志崴	5.00	0.08%
43	周 爽	5.00	0.08%
合计		6,300.00	100.00%

4、2018年6月，股权转让

本次股权转让的背景为：汪明波、崔晓微、王绍勇、苗涛因个人资金需要转让其所持芯源有限部分股权，高侃、周鹏、齐志崴因离职转让其持有芯源有限的全部股权。本次股权转让的价格参照2017年8月增资的价格确定为5元/一元注册资本。

2018年6月15日，芯源有限股东会做出决议，同意高侃分别将其持有的芯源有限5万元出资额转让给顾永田、5万元出资额转让给苗阵；汪明波分别将其持有的芯源有限10万元出资额转让给王永斌、5万元出资额转让给周爽、5万元出资额转让给陈兴隆、5万元出资额转让给李文韬、5万元出资额转让给李守川；崔晓微分别将其持有的芯源有限5万元出资额转让给王玲、3万元出资额转让给宗润福；王绍勇将其持有的芯源有限5万元人民币出资额转让给孙元斌；苗涛将其持有的芯源有限5万元人民币出资额转让给王继周；周鹏将其持有的芯源有限5万元出资额转让给许凯；齐志崴将其持有的芯源有限5万元出资额转让给李泽。其他股东放弃优先购买权，并修改公司章程相应条款。

2018年6月15日，上述转让双方分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。本次股权转让价款已经支付完毕，转让明细如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	高 侃	顾永田	5.00	25.00
		苗 阵	5.00	25.00

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
2	汪明波	王永斌	10.00	50.00
		周 爽	5.00	25.00
		陈兴隆	5.00	25.00
		李文韬	5.00	25.00
		李守川	5.00	25.00
3	崔晓微	王 玲	5.00	25.00
		宗润福	3.00	15.00
4	王绍勇	孙元斌	5.00	25.00
5	苗 涛	王继周	5.00	25.00
6	周 鹏	许 凯	5.00	25.00
7	齐志崑	李 泽	5.00	25.00
合计			68.00	340.00

2018年6月19日，芯源有限就本次股权转让事宜在工商主管部门办理了工商变更登记手续。本次股权转让事宜完成后，芯源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	先进制造	1,433.24	22.75%
2	中科院沈自所	1,050.00	16.67%
3	科发实业	993.28	15.77%
4	国科投资	682.00	10.83%
5	国科瑞祺	450.00	7.14%
6	沈阳科投	150.00	2.38%
7	国科正道	16.00	0.25%
8	周冰冰	419.48	6.66%
9	宗润福	265.00	4.21%
10	李凤莉	135.00	2.14%
11	王绍勇	95.00	1.51%
12	林顺富	65.00	1.03%
13	徐春旭	53.00	0.84%
14	汪 涛	45.00	0.71%
15	张怀东	40.00	0.63%
16	张 宇	40.00	0.63%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
17	苗涛	35.00	0.56%
18	孙东丰	35.00	0.56%
19	王永斌	35.00	0.56%
20	谷德君	32.00	0.51%
21	郑右非	23.00	0.37%
22	崔晓微	17.00	0.27%
23	袁幼零	13.00	0.21%
24	张瑜	12.00	0.19%
25	张浩渊	10.00	0.16%
26	朴勇男	10.00	0.16%
27	刘正伟	10.00	0.16%
28	李迎辉	10.00	0.16%
29	程虎	10.00	0.16%
30	顾永田	10.00	0.16%
31	周爽	10.00	0.16%
32	邱立	8.00	0.13%
33	张恒	7.00	0.11%
34	康宁	6.00	0.10%
35	汪明波	5.00	0.08%
36	蒲凤鸣	5.00	0.08%
37	赵乃霞	5.00	0.08%
38	张军	5.00	0.08%
39	田广霖	5.00	0.08%
40	王一	5.00	0.08%
41	陈兴隆	5.00	0.08%
42	王继周	5.00	0.08%
43	苗阵	5.00	0.08%
44	王玲	5.00	0.08%
45	李文韬	5.00	0.08%
46	李守川	5.00	0.08%
47	孙元斌	5.00	0.08%
48	许凯	5.00	0.08%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
49	李 泽	5.00	0.08%
	合计	6,300.00	100.00%

5、2018年12月，股权转让

本次股权转让的背景为：因芯源有限股东张瑜于2017年9月15日去世，根据沈阳市皇姑区人民法院于2018年12月25日作出的《民事判决书》（[2018]辽0105民初5139号），股东张瑜所持芯源有限股权由其女儿张瑾毅继承，鉴于张瑾毅为公务员身份，故将所继承股权无偿转让给其配偶季刚。本次股权转让为直系亲属间的继承及转让，不涉及价款支付。

2018年12月28日，张瑾毅与季刚签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。芯源有限召开股东会做出决议，同意股东张瑜的股权继承及继承人张瑾毅将其所继承的芯源有限12万元人民币出资额转让给其配偶季刚。

2018年12月28日，芯源有限就本次股权转让事宜在工商主管部门办理了工商变更登记手续。本次股权转让事宜完成后，芯源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	先进制造	1,433.24	22.75%
2	中科院沈自所	1,050.00	16.67%
3	科发实业	993.28	15.77%
4	国科投资	682.00	10.83%
5	国科瑞祺	450.00	7.14%
6	沈阳科投	150.00	2.38%
7	国科正道	16.00	0.25%
8	周冰冰	419.48	6.66%
9	宗润福	265.00	4.21%
10	李凤莉	135.00	2.14%
11	王绍勇	95.00	1.51%
12	林顺富	65.00	1.03%
13	徐春旭	53.00	0.84%
14	汪 涛	45.00	0.71%
15	张怀东	40.00	0.63%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
16	张宇	40.00	0.63%
17	苗涛	35.00	0.56%
18	孙东丰	35.00	0.56%
19	王永斌	35.00	0.56%
20	谷德君	32.00	0.51%
21	郑右非	23.00	0.37%
22	崔晓微	17.00	0.27%
23	袁幼零	13.00	0.21%
24	季刚	12.00	0.19%
25	张浩渊	10.00	0.16%
26	朴勇男	10.00	0.16%
27	刘正伟	10.00	0.16%
28	李迎辉	10.00	0.16%
29	程虎	10.00	0.16%
30	顾永田	10.00	0.16%
31	周爽	10.00	0.16%
32	邱立	8.00	0.13%
33	张恒	7.00	0.11%
34	康宁	6.00	0.10%
35	汪明波	5.00	0.08%
36	蒲凤鸣	5.00	0.08%
37	赵乃霞	5.00	0.08%
38	张军	5.00	0.08%
39	田广霖	5.00	0.08%
40	王一	5.00	0.08%
41	陈兴隆	5.00	0.08%
42	王继周	5.00	0.08%
43	苗阵	5.00	0.08%
44	王玲	5.00	0.08%
45	李文韬	5.00	0.08%
46	李守川	5.00	0.08%
47	孙元斌	5.00	0.08%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
48	许凯	5.00	0.08%
49	李泽	5.00	0.08%
合计		6,300.00	100.00%

6、2019年3月，股权转让

本次股权转让的背景为：王绍勇因个人资金需要转让其所持芯源有限部分股权，刘正伟因离职转让其持有芯源有限的全部股权。本次股权转让的价格为股权转让双方参照2017年8月增资价格及公司发展预期协商确定为7.5元/一元注册资本。

2019年3月1日，芯源有限股东会做出决议，同意王绍勇将其持有的芯源有限5万元出资额转让给洪旭东；刘正伟分别将其持有的芯源有限2万元出资额转让给程虎、3万元出资额转让给陈兴隆、5万元出资额转让给李风莉。其他股东放弃优先购买权，并修改公司章程相应条款。

2019年3月11日，上述转让双方分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。本次股权转让价款已经支付完毕，转让明细如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	王绍勇	洪旭东	5.00	37.50
2	刘正伟	程虎	2.00	15.00
		陈兴隆	3.00	22.50
		李风莉	5.00	37.50
合计			15.00	112.50

2019年3月12日，芯源有限就本次股权转让事宜在工商主管部门办理了工商变更登记手续。本次股权转让事宜完成后，芯源有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	先进制造	1,433.24	22.75%
2	中科院沈自所	1,050.00	16.67%
3	科发实业	993.28	15.77%
4	国科投资	682.00	10.83%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
5	国科瑞祺	450.00	7.14%
6	沈阳科投	150.00	2.38%
7	国科正道	16.00	0.25%
8	周冰冰	419.48	6.66%
9	宗润福	265.00	4.21%
10	李凤莉	140.00	2.22%
11	王绍勇	90.00	1.43%
12	林顺富	65.00	1.03%
13	徐春旭	53.00	0.84%
14	汪 涛	45.00	0.71%
15	张怀东	40.00	0.63%
16	张 宇	40.00	0.63%
17	苗 涛	35.00	0.56%
18	孙东丰	35.00	0.56%
19	王永斌	35.00	0.56%
20	谷德君	32.00	0.51%
21	郑右非	23.00	0.37%
22	崔晓微	17.00	0.27%
23	袁幼零	13.00	0.21%
24	季 刚	12.00	0.19%
25	程 虎	12.00	0.19%
26	张浩渊	10.00	0.16%
27	朴勇男	10.00	0.16%
28	李迎辉	10.00	0.16%
29	顾永田	10.00	0.16%
30	周 爽	10.00	0.16%
31	邱 立	8.00	0.13%
32	陈兴隆	8.00	0.13%
33	张 恒	7.00	0.11%
34	康 宁	6.00	0.10%
35	汪明波	5.00	0.08%
36	蒲凤鸣	5.00	0.08%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
37	赵乃霞	5.00	0.08%
38	张 军	5.00	0.08%
39	田广霖	5.00	0.08%
40	王 一	5.00	0.08%
41	王继周	5.00	0.08%
42	苗 阵	5.00	0.08%
43	王 玲	5.00	0.08%
44	李文韬	5.00	0.08%
45	李守川	5.00	0.08%
46	孙元斌	5.00	0.08%
47	许 凯	5.00	0.08%
48	李 泽	5.00	0.08%
49	洪旭东	5.00	0.08%
合计		6,300.00	100.00%

7、2019年3月整体变更为股份公司

本次整体变更的具体情况详见本节之“二、发行人设立情况”之“（二）沈阳芯源设立情况”。

三、发行人报告期内的重大资产重组情况

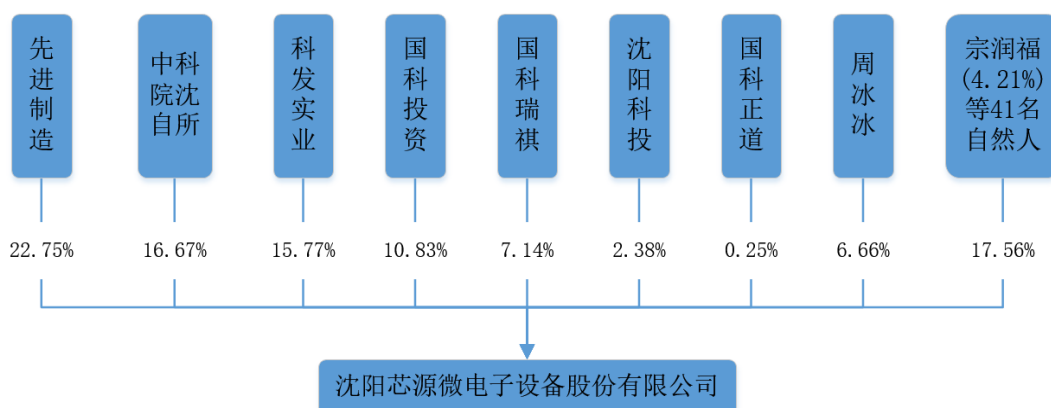
报告期内，公司未发生重大资产重组。

四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况

公司自设立以来不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。

五、发行人的股权结构图

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：



六、发行人对外股权投资情况

截至本招股说明书签署日，公司无控股子公司或参股子公司。

七、发行人持股5%以上股份的主要股东的基本情况

（一）公司第一大股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，发行人股权较为分散，无单一股东通过直接或间接的方式持有公司股权比例或控制其表决权超过 30% 的情形，各方股东无法决定董事会多数席位或对公司进行实际控制，公司无控股股东和实际控制人。

截至本招股说明书签署日，发行人第一大股东先进制造的基本情况如下：

公司名称	沈阳先进制造技术产业有限公司
登记机关	沈阳市浑南区市场监督管理局
统一社会信用代码	91210112738689238K
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	1,750 万元
法定代表人	郑广文
经营范围	高新技术项目投资与管理；房屋开发，物业管理、房屋租赁、仓储（易燃易爆等危险品除外）服务；基础设施工程、建筑工程、装饰工程设计、施工，机电设备（特种设备除外）安装、调试；机电设备研发、生产；机电设备、建筑材料销售；科技开发、技术转让、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家法律、行政法规限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与发行人主营业务的关系	与发行人业务不存在同业竞争
公司住所及主要生产经营地	沈阳市浑南新区飞云路 18 号

成立日期	2002年7月22日		
经营期限	2022年7月21日		
主要财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2018年度/2018年12月31日（经辽宁银泰会计师事务所有限责任公司审计）	23,804.84	2,109.57	-503.73
2019年1-3月/2019年3月31日（未经审计）	23,605.74	2,021.97	-87.60

先进制造的实际控制人为郑广文，先进制造的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郑广文	1,450.00	82.86
2	沈阳天广投资有限公司	300.00	17.14
合计		1,750.00	100.00

沈阳天广投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	郑广文	700.00	70.00
2	郑广忠	150.00	15.00
3	郑广良	150.00	15.00
合计		1,000.00	100.00

注：郑广忠、郑广良均为郑广文兄弟。

（二）其他持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除公司第一大股东先进制造外，其他持有公司5%以上股份的主要股东如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	中科院沈自所	1,050.00	16.67%
2	科发实业	993.28	15.77%
3	国科投资	682.00	10.83%
4	国科瑞祺	450.00	7.14%
5	周冰冰	419.48	6.66%

1、中科院沈自所

截至本招股说明书签署日，中科院沈自所的基本情况如下：

名称	中国科学院沈阳自动化研究所		
企业类型	事业单位		
登记机关	国家事业单位登记管理局		
统一社会信用代码	12100000400012449R		
开办资金	人民币 11,170 万元		
经费来源	财政补助、事业、附属单位上缴收入		
举办单位	中国科学院		
法定代表人	于海斌		
宗旨和业务范围	开展自动化技术研究，促进科技发展。先进制造模式与系统管理技术研究开发；智能机器与系统研究开发；工业自动化技术研究；系统工程与成套装备研究；模式识别与图象处理技术研究开发；工业和 underwater 机器人研制、特种机器人研制 相关检测、认证和培训；相关学历教育、技术服务与学术交流；《信息与控制》和《机器人》出版		
与发行人主营业务的关系	与发行人业务不存在同业竞争		
住所	辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114 号		
成立日期	1958 年 11 月		
事业单位法人证书有效期	自 2018 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日		
主要财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	结余（万元）
2018 年度/2018 年 12 月 31 日（经辽宁中鼎盛华会计师事务所有限公司审计）	323,837.70	198,897.76	115,316.57
2019 年 1-3 月/2019 年 3 月 31 日（未经审计）	334,959.31	210,802.29	0.00

中科院沈自所为中国科学院举办的事业单位。

2、科发实业

截至本招股说明书签署日，科发实业的基本情况如下：

公司名称	辽宁科发实业有限公司
登记机关	辽宁省市场监督管理局
统一社会信用代码	91210000117577057E
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	44,836 万元
法定代表人	赵庆党
经营范围	高新技术产业项目投资；创业投资及咨询；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；为创业企业提供创业管理

	服务；科技发展基金项目咨询服务；高科技产品开发、试产试销。房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
与发行人主营业务的关系	与发行人业务不存在同业竞争		
公司住所及主要生产经营地	沈阳市皇姑区昆山中路2号		
成立日期	1993年02月23日		
经营期限	长期		
主要财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2018年度/2018年12月31日（经中勤万信会计师事务所辽宁分所审计）	77,477.87	66,495.38	97.43
2019年1-3月/2019年3月31日（未经审计）	50,574.28	43,249.56	-51.09

科发实业股东及股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	辽宁省工程咨询集团有限责任公司	44,836.00	100.00
	合计	44,836.00	100.00

辽宁省工程咨询集团有限责任公司为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会投资的国有独资公司。

3、国科投资

截至本招股说明书签署日，国科投资的基本情况如下：

公司名称	中国科技产业投资管理有限公司
登记机关	北京市工商行政管理局海淀分局
统一社会信用代码	911101081000066881
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	11,000万元
法定代表人	孙华
经营范围	项目投资；资产管理；投资咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

	策禁止和限制类项目的经营活动。)		
与发行人主营业务的关系	与发行人业务不存在同业竞争		
公司住所及主要生产经营地	北京市海淀区北四环西路 58 号 16 层 1601 室		
成立日期	1987 年 10 月 17 日		
经营期限	2037 年 10 月 16 日		
主要财务数据	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
2018 年度/2018 年 12 月 31 日 (经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计)	53,149.85	27,845.88	1,267.07
2019 年 1-3 月/2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	52,799.42	28,584.15	738.27

国科投资股东及股权结构如下:

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国科学院控股有限公司	4,307.62	39.16
2	北京国科才俊咨询有限公司	4,000.51	36.37
3	国务院院国有资产监督管理委员会机关服务中心	1,076.90	9.79
4	星星集团有限公司	614.97	5.59
5	共青城中实科技产业投资有限公司	550.00	5.00
6	北京国科启航咨询中心 (有限合伙)	450.00	4.09
	合计	11,000.00	100.00

4、国科瑞祺

截至本招股说明书签署日, 国科瑞祺的基本情况如下:

公司名称	国科瑞祺物联网创业投资有限公司
登记机关	无锡市新吴区市场监督管理局
统一社会信用代码	91320214560328987T
企业类型	有限责任公司
注册资本	38,144.8801 万元
法定代表人	孙华
经营范围	创业投资, 创业投资咨询, 为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
与发行人主营业务的关系	与发行人业务不存在同业竞争

公司住所及主要生产经营地	无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国微纳传感网国际创新园 B 楼		
成立日期	2010 年 07 月 22 日		
经营期限	2020 年 07 月 21 日		
主要财务数据	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
2018 年度/2018 年 12 月 31 日 (经北京智富会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计)	43,170.88	39,964.11	19,316.90
2019 年 1-3 月/2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	33,596.57	31,089.62	370.93

国科瑞祺股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	无锡市国联发展 (集团) 有限公司	10,770.32	28.24
2	中国科学院控股有限公司	4,487.63	11.76
3	浙江屹男房地产开发有限公司	3,141.34	8.24
4	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2,916.96	7.65
5	中泰恒业 (北京) 投资有限公司	2,692.58	7.06
6	杭州金德投资管理有限公司	2,692.58	7.06
7	义乌文森纺织品有限公司	2,692.58	7.06
8	北京国科才俊咨询有限公司	2,131.63	5.58
9	国科投资	1,907.24	5.00
10	绍兴市柯桥区齐贤热电有限公司	1,795.05	4.71
11	上海亚采企业管理事务所	1,121.91	2.94
12	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司	897.53	2.35
13	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	897.53	2.35
合计		38,144.88	100.00

国科瑞祺的管理人国科投资已按照《私募投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，办理了私募投资基金管理人登记，国科瑞祺已办理了私募投资基金备案，基金类型为创业投资基金。

6、周冰冰

周冰冰先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 360203197001****，住所为沈阳市东陵区。

（三）发行人持股 5%以上股东持有发行人股份的质押或争议情况

截至本招股说明书签署日，发行人持股 5%以上股东持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

公司本次发行前的总股本为 6,300 万股，本次公开发行股票数量不超过 2,100 万股，全部为公司公开发行新股。本次发行完成后公司总股本为 8,400 万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25.00%。

本次发行前后公司股本变化情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
1	先进制造	1,433.24	22.75%	1,433.24	17.06%
2	中科院沈自所（SS）	1,050.00	16.67%	1,050.00	12.50%
3	科发实业（SS）	993.28	15.77%	993.28	11.82%
4	国科投资（CS）	682.00	10.83%	682.00	8.12%
5	国科瑞祺	450.00	7.14%	450.00	5.36%
6	沈阳科投（SS）	150.00	2.38%	150.00	1.79%
7	国科正道	16.00	0.25%	16.00	0.19%
8	周冰冰	419.48	6.66%	419.48	4.99%
9	宗润福	265.00	4.21%	265.00	3.15%
10	李风莉	140.00	2.22%	140.00	1.67%
11	王绍勇	90.00	1.43%	90.00	1.07%
12	林顺富	65.00	1.03%	65.00	0.77%
13	徐春旭	53.00	0.84%	53.00	0.63%
14	汪 涛	45.00	0.71%	45.00	0.54%
15	张怀东	40.00	0.63%	40.00	0.48%
16	张 宇	40.00	0.63%	40.00	0.48%
17	苗 涛	35.00	0.56%	35.00	0.42%
18	孙东丰	35.00	0.56%	35.00	0.42%
19	王永斌	35.00	0.56%	35.00	0.42%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
20	谷德君	32.00	0.51%	32.00	0.38%
21	郑右非	23.00	0.37%	23.00	0.27%
22	崔晓微	17.00	0.27%	17.00	0.20%
23	袁幼零	13.00	0.21%	13.00	0.15%
24	季刚	12.00	0.19%	12.00	0.14%
25	程虎	12.00	0.19%	12.00	0.14%
26	张浩渊	10.00	0.16%	10.00	0.12%
27	朴勇男	10.00	0.16%	10.00	0.12%
28	李迎辉	10.00	0.16%	10.00	0.12%
29	顾永田	10.00	0.16%	10.00	0.12%
30	周爽	10.00	0.16%	10.00	0.12%
31	邱立	8.00	0.13%	8.00	0.10%
32	陈兴隆	8.00	0.13%	8.00	0.10%
33	张恒	7.00	0.11%	7.00	0.08%
34	康宁	6.00	0.10%	6.00	0.07%
35	汪明波	5.00	0.08%	5.00	0.06%
36	蒲凤鸣	5.00	0.08%	5.00	0.06%
37	赵乃霞	5.00	0.08%	5.00	0.06%
38	张军	5.00	0.08%	5.00	0.06%
39	田广霖	5.00	0.08%	5.00	0.06%
40	王一	5.00	0.08%	5.00	0.06%
41	王继周	5.00	0.08%	5.00	0.06%
42	苗阵	5.00	0.08%	5.00	0.06%
43	王玲	5.00	0.08%	5.00	0.06%
44	李文韬	5.00	0.08%	5.00	0.06%
45	李守川	5.00	0.08%	5.00	0.06%
46	孙元斌	5.00	0.08%	5.00	0.06%
47	许凯	5.00	0.08%	5.00	0.06%
48	李泽	5.00	0.08%	5.00	0.06%
49	洪旭东	5.00	0.08%	5.00	0.06%
50	本次发行的股份	-	-	2,100.00	25.00%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
	合计	6,300.00	100.00%	8,400.00	100.00%

SS是State-owned Shareholder的缩写，表示国有股东；CS是Controlling State-owned Shareholder的缩写，表示国有实际控制股东。根据财政部于2019年7月3日核发的《财政部关于批复沈阳芯源微电子设备股份有限公司国有股权管理方案的函》（财教函〔2019〕8号），本公司总股本为6,300万股，其中中科院沈自所、科发实业、沈阳科投分别持有1,050.00万股、993.282万股和150.00万股，占总股本的16.67%、15.77%和2.38%，如公司在境内发行股票并上市，上述国有股东在证券登记结算公司登记的证券账户应标注“SS”标识；国科投资持有682.00万股，占总股本的10.83%，如公司在境内发行股票并上市，上述国有实际控制股东在证券登记结算公司登记的证券账户应标注“CS”标识。

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司前十名股东的情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	先进制造	1,433.24	22.75%
2	中科院沈自所	1,050.00	16.67%
3	科发实业	993.28	15.77%
4	国科投资	682.00	10.83%
5	国科瑞祺	450.00	7.14%
6	周冰冰	419.48	6.66%
7	宗润福	265.00	4.21%
8	沈阳科投	150.00	2.38%
9	李风莉	140.00	2.22%
10	王绍勇	90.00	1.43%
	合计	5,673.00	90.06%

（三）国有股东或外资股东持股情况

公司国有股东持股情况详见本节之“八、发行人股本情况”之“（一）本次发行前后的股本情况”。

公司不存在外资股东的情形。

（四）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

本次发行前，公司共有 42 名自然人股东，其中前 10 名自然人股东在本公司任职情况如下：

序号	股东姓名	在公司任职
1	周冰冰	—
2	宗润福	董事长兼总经理
3	李凤莉	副总经理、董事会秘书、财务总监
4	王绍勇	FT 事业部总监
5	林顺富	计划财务部部长、证券事务代表
6	徐春旭	技术管理部总监
7	汪 涛	市场发展部副部长
8	张怀东	产品设计部总监
9	张 宇	运行保障部副部长
10	苗 涛	控制系统部总监

（五）最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况

最近一年新增股东均系通过股权转让的方式成为发行人股东，具体情况如下：

转让时间	转让方	受让方 (新增股东)	转让出资额 (万元)	转让总价款 (万元)	定价依据
2018 年 6 月	高侃	苗阵	5	25	2017 年 8 月 增资价格
	汪明波	陈兴隆	5	25	
		李文韬	5	25	
		李守川	5	25	
		崔晓微	王玲	5	
	王绍勇	孙元斌	5	25	
	苗涛	王继周	5	25	
	周鹏	许凯	5	25	
	齐志崴	李泽	5	25	

转让时间	转让方	受让方 (新增股东)	转让出资额 (万元)	转让总价款 (万元)	定价依据
2018年12月	张瑜/张瑾毅	季刚	12	-	系继承或直系亲属间转让, 不涉及价款支付
2019年3月	王绍勇	洪旭东	5	37.5	协商确定

(六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

单位/个人	任职	关联情况	持有发行人股份情况
国科投资	/	1、国科投资持有国科瑞祺 5% 的股权, 同时担任国科瑞祺的基金管理人; 2、国科正道为国科投资的员工持股平台; 3、国科投资董事长孙华, 同时担任国科瑞祺董事长; 4、国科投资董事兼总经理刘千宏同时担任国科瑞祺董事兼总经理; 5、国科投资董事李晔, 同时担任国科瑞祺董事	国科投资持有发行人 10.83% 股权; 国科瑞祺持有发行人 7.14% 股权; 国科正道持有发行人 0.25% 股权
宗润福	发行人董事长 兼总经理	发行人股东李文韬系宗润福姐姐的儿子	宗润福持有发行人 4.21% 股权; 李文韬持有发行人 0.08% 股权

除上述情况外, 其他公司股东之间不存在关联关系。

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

(一) 董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成, 其中 3 名为独立董事, 情况如下:

姓名	在发行人任职	提名人	任期
宗润福	董事长、总经理	宗润福	2019年3月至2022年3月
郑广文	董事	先进制造	2019年3月至2022年3月
王蓉辉	董事	中科院沈自所	2019年3月至2022年3月
赵庆党	董事	科发实业	2019年3月至2022年3月
孙 华	董事	国科投资	2019年3月至2022年3月

姓名	在发行人任职	提名人	任期
陈兴隆	董事、副总经理、首席技术官	宗润福	2019年3月至2022年3月
朱煜	独立董事	董事会	2019年4月至2022年3月
宋雷	独立董事	董事会	2019年4月至2022年3月
张宏斌	独立董事	董事会	2019年4月至2022年3月

公司董事简历如下：

1、宗润福先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，曾获得国家科技重大专项突出贡献奖、辽宁省优秀新产品奖励一等奖、辽宁省科学技术奖励二等奖、辽宁省优秀专家等多项殊荣。宗润福先生自2002年12月至2019年3月，任芯源有限总经理、董事、董事长；自2019年3月至今，任公司董事长兼总经理。

2、郑广文先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2009年11月至今，于沈阳富创精密设备有限公司担任董事长；自2015年6月至今，于先进制造担任执行董事兼总经理；自2006年5月至2019年3月，任芯源有限董事、董事长；2019年3月至今，任公司董事。

3、王蓉辉女士，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。现任中科院沈自所总会计师、中科新宇空间智能装备有限公司监事、沈阳新合物业有限责任公司董事等。2019年3月至今，担任公司董事。

4、赵庆党先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任科发实业董事长兼总经理、沈阳高精数控智能技术股份有限公司董事、沈阳富创精密设备有限公司董事、沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事、辽宁联合航空发展有限公司董事等。2016年9月至2019年3月，担任芯源有限董事；2019年3月至今，担任公司董事。

5、孙华先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。现任国科投资董事长、国科瑞祺董事长、国科瑞华创业投资企业负责人兼投资委员会主任委员、北京国科才俊咨询有限公司执行董事、贵银中科产业投资基金管理（贵州）有限公司董事长、中科院资本管理有限公司董事、深圳吉阳智能科技有限公司董事、北京中科科仪股份有限公司董事等。2015年

12月至2019年3月，担任芯源有限董事；2019年3月至今，担任公司董事。

6、陈兴隆先生，1976年8月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历，获博士学位，高级工程师，入选辽宁省“兴辽英才计划”创新领军人才。2005年10月至2014年1月，于美国应用材料担任资深工程经理；2014年3月至2017年3月，于韩国三星电子公司生产技术研究担任首席工程师；2017年5月至2018年1月，于SEMES America Inc.担任技术创新官；2018年3月至2019年3月，担任芯源有限副总经理、首席技术官；2019年3月至今，担任公司董事、副总经理、首席技术官。

7、朱煜先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，获博士学位，清华大学教授。现任清华大学机械电子工程研究所所长，北京华卓精科科技股份有限公司创始人、董事、首席科学家，北京钢研新冶精特科技有限公司董事，北方华创科技集团股份有限公司独立董事等；2019年4月至今，担任公司独立董事。

8、宋雷先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。现任辽宁中水工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、中天证券股份有限公司独立董事、北京国融兴华矿业权评估有限责任公司辽宁分公司负责人、北京国融兴华资产评估有限责任公司辽宁分公司负责人等；2019年4月至今，担任公司独立董事。

9、张宏斌先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年9月至2008年7月，于金诚同达律师事务所担任律师；2008年6月至2015年7月，于北京市中伦律师事务所任律师；2015年6月至今，于环球律师事务所担任律师/合伙人；2019年4月至今，担任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中梁倩倩、史晓欣由股东大会选举产生，苗涛由公司职工代表大会选举产生，情况如下：

姓名	在发行人任职	提名人	任期
梁倩倩	监事会主席	先进制造	2019年3月至2022年3月
史晓欣	监事	中科院沈自所	2019年3月至2022年3月

姓名	在发行人任职	提名人	任期
苗涛	职工监事、控制系统部总监	职工代表大会	2019年3月至2022年3月

公司监事简历如下：

1、梁倩倩女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任沈阳天广和美汽车销售服务有限公司会计，现任沈阳盛之瑞工业智能科技发展有限公司监事、沈阳富创精密设备有限公司资本部副部长。2019年3月至今，担任公司监事。

2、史晓欣女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任中科院沈自所科技处投资管理业务主管、财务处会计，沈阳新松医疗科技股份有限公司监事，沈阳中科博微科技股份有限公司监事，苏州沈苏自动化技术开发有限公司监事等。2015年12月至2019年3月，担任芯源有限监事；2019年3月至今，担任公司监事。

3、苗涛先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，曾获得辽宁省优秀新产品奖励一等奖、沈阳市科学技术进步二等奖等多项殊荣。2003年4月至2019年3月，历任芯源有限电气工程师、部门部长、部门总监、职工监事；2019年3月至今，担任公司控制系统部总监、职工监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。具体情况如下：

姓名	在发行人任职	任期
宗润福	董事长、总经理	2019年3月至2022年3月
陈兴隆	董事、副总经理、首席技术官	2019年3月至2022年3月
李风莉	副总经理、财务总监、董事会秘书	2019年3月至2022年3月
顾永田	副总经理	2019年3月至2022年3月

公司高级管理人员简历如下：

1、宗润福先生，个人简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核

心技术人员”之“（一）董事会成员”。

2、陈兴隆先生，个人简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事会成员”。

3、李风莉女士，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2003年1月至2019年3月，历任芯源有限财务部部长、副总经理；2019年3月至今，担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

4、顾永田先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2008年6月至2015年6月，于三一集团有限公司担任制造部长助理、研究所所长、商务部长；2015年7月至2019年3月，历任芯源有限产品实现部部长、部门总监、副总经理；2019年3月至今，担任公司副总经理。

（四）核心技术人员

公司核心技术人员具体情况如下：

1、宗润福先生，个人简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事会成员”。

2、陈兴隆先生，个人简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事会成员”。

3、苗涛先生，个人简历详见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）监事会成员”。

4、王绍勇先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾获得辽宁省优秀新产品奖励一等奖、辽宁省科学技术奖励二等奖等多项殊荣。2003年3月至2019年3月，历任芯源有限技术部设计师、生产部部长、先进封装事业部总监、工艺部部长、研发部总监；2019年3月至今，担任公司 FT 事业部总监。

5、张怀东先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾获得辽宁省优秀新产品奖励一等奖、辽宁省优秀新产品二等奖、沈阳市科学技术振兴奖。2003年3月至2019年3月，历任芯源有限技术员、

部门副部长、部门部长、部门总监；2019年3月至今，担任公司产品设计部总监。

6、谷德君先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，曾荣获辽宁省科学技术二等奖。2009年1月至2019年3月，历任芯源有限机械工程师、中级机械工程师、高级机械工程师；2019年3月至今，任公司FT事业部高级机械工程师。

7、郑右非女士，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，曾荣获辽宁省优秀新产品奖励一等奖、辽宁省科学技术奖励二等奖等多项殊荣。2006年3月至2019年3月，担任芯源有限软件工程师；2019年3月至今，担任公司控制系统部软件工程师。

8、程虎先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾荣获辽宁省科学技术二等奖。2012年6月至2019年3月，历任芯源有限机械工程师、部长助理、产品设计部副部长；2019年3月至今，担任公司产品设计部副部长。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
郑广文	董事	沈阳天广和美汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	发行人关联方
		沈阳先进制造技术产业有限公司	执行董事兼总经理	发行人股东
		辽宁天广汽车服务有限公司	执行董事兼总经理	发行人关联方
		沈阳天广投资有限公司	执行董事兼总经理	发行人关联方

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
		宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	发行人关联方
		宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	发行人关联方
		宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	发行人关联方
		北京亦盛精密半导体有限公司	董事长兼总经理	发行人关联方
		鞍山市诚达广汽车销售服务有限公司	执行董事兼经理	发行人关联方
		稻盛和夫（北京）管理顾问有限公司沈阳分公司	负责人	发行人关联方
		北京美桥电子设备有限公司	执行董事兼经理	发行人关联方
		沈阳天广盛和文化传播有限公司	执行董事兼总经理	发行人关联方
		沈阳富创精密设备有限公司	董事长	发行人关联方
		铁岭天广吉祥汽车销售服务有限公司	执行董事	发行人关联方
		丹东客来多购物广场有限公司	监事	/
		铁岭利丰达汽车销售服务有限公司	董事长	发行人关联方
		智慧狮（上海）文化科技有限公司	董事长	发行人关联方
		上海广川科技有限公司	董事长	发行人关联方
赵庆党	董事	科发实业	董事长兼总经理	发行人股东
		沈阳新松机器人自动化股份有限公司	董事	发行人关联方
		沈阳高精数控智能技术股份有限公司	董事	发行人关联方
		沈阳富创精密设备有限公司	董事	发行人关联方
		辽宁联合航空发展有限公司	董事	发行人关联方
孙华	董事	北京国科才俊咨询有限公司	执行董事、总经理	发行人间接股东
		国科瑞华创业投资企业	负责人、投资委员会主任委员	发行人关联方
		国科瑞祺	董事长	发行人股东

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
		国科投资	董事长	发行人股东
		贵银中科产业投资基金管理（贵州）有限公司	董事长	发行人关联方
		中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人代表	发行人关联方
		陕西中科纳米材料股份有限公司	董事	发行人关联方
		哈尔滨城林科技股份有限公司	副董事长	发行人关联方
		北京中通经合投资管理有限公司	董事	发行人关联方
		广州南方测绘科技股份有限公司	董事	发行人关联方
		北京中科科仪股份有限公司	董事	发行人关联方
		青岛酷特智能股份有限公司	董事	发行人关联方
		深圳吉阳智能科技有限公司	董事	发行人关联方
		武汉中科创新技术股份有限公司	董事	发行人关联方
		北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人代表	发行人关联方
		中科院资本管理有限公司	董事	发行人关联方
史晓欣	监事	沈阳新松医疗科技股份有限公司	监事	发行人关联方
		无锡中科泛在信息技术研发中心有限公司	监事	发行人关联方
		沈阳中科博微科技股份有限公司	监事	发行人关联方
		沈阳中科天盛自动化技术有限公司	监事	发行人关联方
		沈阳聚德视频技术有限公司	监事	发行人关联方
		苏州沈苏自动化技术开发有限公司	监事	/
		中科院沈自所	科技处投资管理业务主管、财务处会计	发行人股东
王蓉辉	董事	沈阳新合物业有限责任公司	董事	发行人关联方
		沈阳中科新宇空间智能装备有限公司	监事	发行人关联方
		中科院沈自所	总会计师	发行人股东
梁倩倩	监事	沈阳盛之瑞工业智能科技发展有限公司	监事	/
		沈阳富创精密设备有限公司	资本部副部长	发行人关联方

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
李风莉	副总经理、 董事会秘书	沈阳三甲和广告有限公司	监事	发行人关联方
宋雷	独立董事	北京国融兴华资产评估有限责任公司辽宁分公司	总经理	/
		辽宁中水工程造价咨询有限公司	执行董事兼 总经理	发行人关联方
		中天证券股份有限公司	独立董事	/
		北京国融兴华矿业权评估有限责任公司辽宁分公司	负责人	/
朱煜	独立董事	清华大学机械电子工程研究所	所长	/
		北京华卓精科科技股份有限公司	董事	发行人关联方
		北京艾西众创科技发展中心（有限合伙）	执行事务合 伙人	发行人关联方
		北京钢研新冶精特科技有限公司	董事	/
		北方华创科技集团股份有限公司	独立董事	/
		北京华卓精密科技有限公司	执行董事、 经理	发行人关联方
		北京艾西精创科技有限公司	执行董事、 经理	发行人关联方
张宏斌	独立董事	北京市环球律师事务所	律师/合伙人	/

注：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条的规定，发行人董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，需认定为公司关联方。

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的重大协议及其履行情况

（一）增资协议及股权转让协议

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在获得公司股份时均签订了增资协议或股权转让协议。报告期内，前述董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均严格履行协议的约定，遵守相关承诺。

（二）劳动合同、保密协议或竞业禁止协议

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签订了劳动合同、

保密协议或竞业禁止协议。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行协议约定的义务和职责，遵守相关承诺。

（三）重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员有关本次发行的承诺函详见本招股说明书“第十节 投资者保护”有关内容。

十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况、原因及对公司的影响

（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况

1、公司董事的变动情况及原因

变动时间	变动前人员	变动后人员	变动原因
2016年9月	郑广文、宗润福、吕孝普、王小刚、孙海涛、孙华、高海彬	郑广文、宗润福、赵庆党、王小刚、孙海涛、孙华、高海彬	董事吕孝普退休，由赵庆党接任（注1）
2018年6月	郑广文、宗润福、赵庆党、王小刚、孙海涛、孙华、高海彬	郑广文、宗润福、赵庆党、孙海涛、孙华	董事会人数调整，董事王小刚、高海彬卸任（注2）
2019年3月	郑广文、宗润福、赵庆党、孙海涛、孙华	宗润福、郑广文、赵庆党、陈兴隆、孙华、王蓉辉	公司整体变更设立股份公司，孙海涛调整为王蓉辉（注3），同时增选公司副总经理陈兴隆为公司内部董事
2019年4月	宗润福、郑广文、赵庆党、陈兴隆、孙华、王蓉辉	宗润福、郑广文、赵庆党、陈兴隆、孙华、王蓉辉、朱煜、宋雷、张宏斌	进一步完善公司治理结构，增选3名独立董事朱煜、宋雷和张宏斌

注1：公司原董事吕孝普之前的主要任职为科发实业总经理，公司现任董事赵庆党主要任职为科发实业董事长兼总经理。

注2：公司原董事王小刚主要任职经历为：曾任中科院沈自所副所长及先进制造董事长，2007、2008年先后从沈自所和先进制造卸任，改任广州中科院工业技术研究院院长。公司原董事高海彬曾在沈阳天广任职，2018年离职。

注3：公司原董事孙海涛主要任职为中科院沈自所研究员，公司董事王蓉辉主要任职为中科院沈自所总会计师。

2、公司监事的变动情况

变动时间	变动前人员	变动后人员	变动原因
2019年3月	史晓欣、苗涛、王永斌、蒋和娟、蒋小军	梁倩倩、苗涛、史晓欣	公司整体变更设立股份公司，改选监事会并调整监事会人数，同时先进制造委派监事由蒋和娟变更为梁倩倩

3、公司高级管理人员的变动情况

变动时间	变动前人员	变动后人员	变动原因
2017年7月	宗润福、李风莉	宗润福、李风莉、顾永田	根据公司生产经营的需要，增聘顾永田任副总经理
2018年3月	宗润福、李风莉、顾永田	宗润福、李风莉、顾永田、陈兴隆	增聘陈兴隆为公司副总经理

4、公司核心技术人员的变动情况

变动时间	变动前人员	变动后人员	变动原因
2018年3月	宗润福、苗涛、王绍勇、张怀东、谷德君、郑右非、程虎	宗润福、陈兴隆、苗涛、王绍勇、张怀东、谷德君、郑右非、程虎	陈兴隆作为核心技术人员入职公司

(二)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内变动对公司的影响

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动主要因完善公司治理结构、董事退休及新增管理人员，公司核心管理团队始终保持稳定，上述人员变动对公司生产经营不产生重大不利影响，不影响公司的持续经营。

综上，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内未发生重大变化。

十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职	持有股份（万股）	持股比例（%）	质押或冻结情况
----	----	----	----------	---------	---------

序号	姓名	任职	持有股份（万股）	持股比例（%）	质押或冻结情况
1	宗润福	董事长、总经理	265.00	4.21	—
2	陈兴隆	董事、副总经理	8.00	0.13	—
3	李凤莉	副总经理、财务总监、董事会秘书	140.00	2.22	—
4	苗涛	职工监事、控制系统部总监	35.00	0.56	—
5	顾永田	副总经理	10.00	0.16	—
6	王绍勇	FT事业部总监	90.00	1.43	—
7	张怀东	产品设计部总监	40.00	0.63	—
8	谷德君	FT事业部机械工程师	32.00	0.51	—
9	郑右非	控制系统部软件工程师	23.00	0.37	—
10	程虎	产品设计部副部长	12.00	0.19	—
合计			655.00	10.41	—

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职	直接持股的公司名称	间接持有股份（万股）	间接持股比例（%）	质押或冻结情况
1	郑广文	董事	先进制造	1,359.53	21.58	—
2	孙华	董事	国科投资	42.54	0.68	—
			国科瑞祺	5.71	0.09	—
			国科正道	1.54	0.02	—
合计				1,409.32	22.37	—

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有发行人股份的情形。

公司股东李文韬系公司董事长兼总经理宗润福姐姐的儿子，其持有公司0.08%股份。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份不存在质押或冻结的情况，也不存在任何争议。

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除本节“十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况”披露的持有公司股份外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司业务相关的或存在利益冲突的其他对外投资。

十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬及员工激励情况

（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序

1、薪酬组成、确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。公司独立董事领取独立董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。

2、所履行的程序

根据《公司章程》，公司董事、监事的报酬事项由股东大会审议决定，公司高级管理人员的报酬事项和奖惩事项由董事会审议决定。根据《薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提出建议。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内薪酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及占

各期公司利润总额比重情况如下：

年度	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
薪酬总额（万元）	158.84	575.36	456.33	271.04
利润总额（万元）	-1,121.69	3,286.30	2,995.13	478.39
薪酬总额占当年利润总额比重	-14.16%	17.51%	15.24%	56.66%

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及关联企业领取收入的情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2018 年度从发行人及关联企业领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	现任职务/身份	2018年度从公司领取的薪酬/津贴（万元）	是否在关联企业领薪
1	宗润福	董事长、总经理、核心技术人员	137.11	否
2	郑广文	董事	-	否
3	赵庆党	董事	-	否
4	陈兴隆	董事、副总经理、核心技术人员	118.70	否
5	孙 华	董事	-	否
6	王蓉辉	董事	-	否
7	朱 煜	独立董事	-	否
8	宋 雷	独立董事	-	否
9	张宏斌	独立董事	-	否
10	苗 涛	监事、核心技术人员	48.10	否
11	史晓欣	监事	-	否
12	梁倩倩	监事	-	否
13	李风莉	副总经理、财务总监、董事会秘书	81.08	否
14	顾永田	副总经理	40.27	否
15	王绍勇	核心技术人员	44.28	否
16	张怀东	核心技术人员	38.29	否
17	谷德君	核心技术人员	24.64	否
18	郑右非	核心技术人员	16.97	否

序号	姓名	现任职务/身份	2018 年度从公司领取的薪酬/津贴 (万元)	是否在关联企业领薪
19	程 虎	核心技术人员	25.90	否
合计			575.36	-

注：(1) 王蓉辉自 2019 年 3 月起任公司董事，其为股东委派董事，未在公司领取薪酬；朱煜、宋雷、张宏斌自 2019 年 4 月起任公司独立董事，2018 年度没有在公司领取津贴。(2) 上表中“是否在关联企业领薪”不包括从委派股东处领薪，以及因担任公司董事形成的其他关联方处领薪的情况。

除上述薪酬外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他特殊待遇和退休金计划。

(三) 发行人已制定或实施的股权激励情况

本次公开发行前，公司未制定或实施股权激励及相关安排。

十六、发行人员工情况

(一) 员工人数及变化情况

报告期各期末，公司所有签订劳动合同的在岗员工人数分别为 202 人、221 人、250 人和 250 人。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司员工专业结构如下：

专业结构	人数	占员工总数比例 (%)
管理人员	64	25.60
技术人员	86	34.40
生产人员	65	26.00
销售及售后支持人员	35	14.00
合计	250	100.00

(二) 社会保险和住房公积金缴纳情况

报告期内，发行人为公司员工缴纳社会保险和住房公积金的具体情况如下：

1、执行社会保险和住房公积金的起始时间

发行人自 2003 年 1 月起执行社会保险制度，自 2005 年 10 月起执行住房公

积金制度。截至 2019 年 3 月 31 日，发行人已为符合条件的员工缴纳了社会保险和住房公积金。

2、缴纳比例

项目	2019年1-3月		2018年		2017年		2016年	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	20%	8%	20%	8%	20%	8%	20%	8%
医疗保险	8%	2%	8%	2%	8%	2%	8%	2%
失业保险	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
工伤保险	0.45%	-	0.45%	-	0.90%	-	0.90%	-
生育保险	0.60%	-	0.60%	-	0.60%	-	0.60%	-
住房公积金	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%

注：根据人力资源和社会保障部、财政部联合发布的《关于调整工伤保险费率政策的通知》（人社部发[2015]71号）及沈阳市人力资源和社会保障局、沈阳市财政局和沈阳市地方税务局发布的《关于印发〈沈阳市工伤保险费率浮动管理暂行办法〉的通知》（沈人社发[2017]97号），沈阳市人力资源和社会保障局从 2018 年 1 月 1 日起，工伤保险经办机构在用人单位按行业基准费率缴纳工伤保险费的基础上，根据用人单位在上两个自然年度内的工伤保险费使用情况（支缴率），对用人单位在两个自然年度工伤保险缴费费率重新确定，其中，沈阳芯源下浮二档为本行业基准费率的 50%。

3、缴纳人数

根据发行人提供的资料及说明，发行人报告期各期末社保及住房公积金缴纳的具体情况如下：

社会保险缴纳情况				
项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
公司在职员工人数	250	250	221	202
公司社保缴纳人数 ^{注1}	244	250	220	206 ^{注2}
未缴纳人数 ^{注3}	6	-	1	-
住房公积金缴纳情况				
公司在职员工人数	250	250	221	202
公司住房公积金缴纳人数	244	250	220	204 ^{注2}
未缴纳人数 ^{注3}	6	-	1	-

注 1：2019 年 3 月前，公司将宗润福的社会保险相关费用支付给中科院沈自所，由中科院沈自所为其代缴社会保险；2019 年 4 月起，由公司直接为宗润福缴纳社会保险。

注 2：公司有 3 名员工及 1 名退休返聘人员于 2016 年 12 月离职，公司当月仍为上述 4 人缴纳了社会保险，为 3 名离职员工缴纳了住房公积金。

注 3：公司未缴纳社保和住房公积金人员为当月入职新员工。

4、主管部门出具的证明

根据沈阳市浑南区人力资源和社会保障局出具的证明，公司报告期内遵守国家人力资源和社会保障法律法规，执行人力资源和社会保障政策，没有发现违反人力资源和社会保障法律法规的情形和受到该局行政处罚的记录。

根据沈阳住房公积金管理中心出具的单位住房公积金缴存证明，公司报告期内未因违反住房公积金管理法律、法规和规章而受到行政处罚。

5、发行人第一大股东承诺

公司第一大股东先进制造承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴社会保险及住房公积金，或发行人因未为员工缴纳社会保险及住房公积金而承担任何罚款或损失，承诺人承诺在不需发行人支付对价的情况下将承担所有相关赔偿责任或缴纳义务。”

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况

（一）发行人主营业务

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），产品可用于 6 英寸及以下单晶圆处理（如 LED 芯片制造环节）及 8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）。作为与光刻机配合进行作业的关键处理设备，公司生产的涂胶/显影机成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，其中在 LED 芯片制造及集成电路制造后道先进封装等环节，作为国内厂商主流机型已成功实现进口替代；通过多年的技术研发、实践应用积累以及持续承担国家 02 重大专项，公司成功突破了应用于集成电路制造前道晶圆加工环节的涂胶显影设备技术，成型产品目前正在长江存储、上海华力等前道芯片制造厂商进行工艺验证。成立以来，公司先后荣获“国家级知识产权优势企业”、“国内先进封装领域最佳设备供应商”、“2018 年中国半导体设备五强企业”等多项殊荣，公司产品先后获得“国家战略性创新产品”、“国家重点新产品”等多项荣誉。

自 2008 年我国启动实施“02 重大专项”以来，公司作为项目责任单位承担并完成了两项与所处涂胶显影设备领域相关的“02 重大专项”项目，分别是“凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备的开发与产业化”项目和“300mm 晶圆匀胶显影设备研发”项目，成功突破了包括凸点封装工艺相关的超厚光刻胶膜的涂覆、显影、单片湿法多工艺药液同腔分层刻蚀以及 193nm（ArF）光刻工艺超薄胶膜均匀涂敷、精细化显影、精密温控热处理等在内的多项核心关键技术，开发出国产涂胶显影设备并实现量产，成功打破国外厂商垄断，大大降低了国内客户采购成本和对国外设备的依赖。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司已获得专利授权 145 项，其中发明专利 127 项（中国大陆地区发明专利 116 项，中国台湾地区发明专利 9 项，美国发明专利 2 项），实用新型专利 6 项，外观设计专利 11 项；拥有软件著作权 37 项。同时，

公司也是国家集成电路产业技术创新联盟及集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事单位，并先后主持制定了喷胶机、涂胶机两项行业标准，其中喷胶机行业标准《喷雾式涂覆设备通用规范》（SJ/T 11576-2016）已正式颁布实施，涂胶机行业标准《旋转式涂覆设备通用规范》正在审核中。


公司产品已实现批量销售，截至 2019 年 3 月 31 日，已累计销售 680 余台套，目前作为主流机型已成功打入包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌等在内的多家国内知名一线大厂；公司集成电路制造前道晶圆加工环节用涂胶显影设备已开发完成，正在长江存储、上海华力等前道芯片制造厂商进行工艺验证，目前国内该类设备主要被日本东京电子（TEL）所垄断；公司集成电路制造前道晶圆加工环节用清洗机产品目前已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并成功实现销售。




公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）发行人主要产品及服务


公司主要为下游集成电路、LED 芯片等半导体产品制造企业提供光刻工序涂胶显影设备或单片式湿法设备等产品，详情如下：


1、光刻工序涂胶显影设备

产品类别	图示	应用领域
6 英寸及以下单晶圆处理设备		
涂胶/显影机		可用于 LED 芯片制造、MEMS 芯片制造、化合物芯片制造及功率器件制造等领域的光刻工序
8/12 英寸单晶圆处理设备		

产品类别	图示	应用领域
涂胶/显影机 (集成电路制造后道先进封装)		可用于集成电路制造后道先进封装的 Bumping 制备工艺、WLCSP 封装工艺、Fanout 封装工艺等领域的光刻工序
涂胶/显影机 (集成电路制造前道晶圆加工)		可用于集成电路制造前道晶圆加工环节的光刻工序
喷胶机		可用于集成电路制造后道先进封装的圆片级封装(WLP)、3D-TSV 工艺及 MEMS 芯片制造等领域的光刻工序

2、单片式湿法设备

产品类别	图示	应用领域
6 英寸及以下单晶圆处理设备		
去胶机		可用于 LED 芯片制造、MEMS 芯片制造、通讯芯片制造等领域
8/12 英寸单晶圆处理设备		

产品类别	图示	应用领域
去胶机		可用于集成电路制造后道先进封装的 Bumping 制备工艺、WLCSP 封装工艺、Fanout 封装工艺及新型显示 OLED 制造等领域
湿法刻蚀机		可用于集成电路制造后道先进封装的 Bumping 制备工艺、WLCSP 封装工艺、Fanout 封装工艺等领域
清洗机 (集成电路制造后道先进封装)		可用于集成电路制造后道先进封装的 Bumping 制备工艺、WLCSP 封装工艺、Fanout 封装工艺等领域
清洗机 (集成电路制造前道晶圆加工)		可用于集成电路制造前道晶圆加工领域

(三) 主营业务收入构成

报告期内，发行人按产品分类的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

产品类别	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
光刻工序涂胶显影设备	597.98	61.73%	12,883.64	64.11%	15,649.76	85.27%	14,125.56	98.43%

产品类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其中：涂胶/显影机	597.98	61.73%	12,037.49	59.90%	13,977.81	76.16%	12,979.40	90.44%
喷胶机	-	-	846.15	4.21%	1,671.95	9.11%	1,146.15	7.99%
单片式湿法设备	370.69	38.27%	7,213.33	35.89%	2,703.39	14.73%	138.75	0.97%
其中：清洗机	370.69	38.27%	2,208.55	10.99%	1,180.01	6.43%	138.75	0.97%
去胶机	-	-	2,541.45	12.65%	531.65	2.90%	-	-
湿法刻蚀机	-	-	2,463.33	12.26%	991.73	5.40%	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-	86.32	0.60%
总计	968.67	100.00%	20,096.97	100.00%	18,353.15	100.00%	14,350.64	100.00%

（四）主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务，通过向下游集成电路、LED 芯片等领域公司销售光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售，其他业务收入来源于设备相关配件销售及维修服务。

2、采购模式

为保证公司产品的质量和性能，公司采购供应部会同质量计划部共同对供应商进行遴选和评估，主要考察供应商的资质实力、产品及合作情况、售后服务等方面，并经外部供方调查、样品试用或非标准部件定制加工验证通过后确定合格供应商名录，并持续更新及跟踪评级。目前，公司已与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系。

公司采取与供应商单签合同或签订年度框架合同等方式开展采购，采购供应部根据各生产或研发部门提交并经公司批准的采购信息文件（如生产明细表、采购申请单等），综合考虑公司现有生产安排、销售订单、原料库存情况等安排采购计划，按要求在《合格供应商名录》中选择供方并进行采购。采购物资送达后，质量计划部进行到货检验，检验合格后由仓库保管员办理入库手续，完成采购。

3、研发模式

公司以自主研发为主，建立了多部门协同配合的自主创新机制。公司技术管理部是研发项目的归口管理部门，负责组织项目立项、编制公司研发计划、下达

设计与开发任务、跟进设计和试制过程、组织评审和验收等管理工作，研发的具体工作由 FT 事业部、技术中心、控制系统部等负责，其中 FT 事业部主要负责前道新产品的导入设计开发，技术中心主要针对公司的核心基础技术进行前瞻性研究，控制系统部主要负责产品电气、软件系统的研发与设计。公司市场及研发部门可根据市场需求及技术进步的短、中、长期需要（如客户端新产品、新工艺需求，国际光刻技术、先进封装工艺等前沿技术发展需求，关键核心部件国产化替代需求等）提出研发项目的建议，技术管理部组织召开项目立项评审会，对研发项目的意义、市场推广预期效果、技术路线的可行性以及经费预算的合理性等进行分析、论证并提出评审意见，并报财务部门及总经理审批。

公司的研发流程主要包括研发项目立项、研发项目执行、研发项目结题与验收三个阶段，研发项目实行项目组长负责制。项目组长对项目全面负责，管理权限包括技术方案制定、项目进度、经费及人员调配、材料领用、项目组人员绩效评价等。项目研发完成后，由研发团队开展全面的项目总结，并由技术管理部组织相关部门审查验收项目并完成资料归档。

4、生产模式

公司主要实行订单式生产的生产模式，在与客户签订订单或确定意向后，由质量计划部下达生产计划，根据客户需求进行产品定制化设计及生产制造，以满足客户差异化需求。公司建立了多维度的生产管理制度和考核机制，以产品合格率和交付及时率作为核心考核指标，并根据达成情况不断调整、优化生产过程，确保公司产品质量和交付及时率持续提升。公司生产环节主要包括准备阶段、计划阶段和实施阶段。

（1）准备阶段

公司市场发展部负责确定客户需求并将其反馈至产品设计部，产品设计部根据客户需求制定解决方案和确定产品配置，并进行相关技术验证。质量计划部负责确定产品所需生产周期并反馈至市场发展部，由市场发展部将产品解决方案及交货周期反馈至客户。

（2）计划阶段

在项目具备实施条件后，由市场发展部提交正式立项申请。质量计划部在与各部门沟通后制定公司级项目计划，明确各时间节点并下发至相关部门。采购供应部、产品实现部及产品计划部根据项目所制定的时间节点制定部门子计划并明确负责人及实施团队。

(3) 实施阶段

产品设计部按照排产计划实施产品设计并进行相关技术评审和验证，按计划提交物料清单（BOM）及技术文档；采购供应部按照排产计划实施物料采购，质量计划部负责对采购物料进行质量检测；产品实现部按照排产计划实施产品装配及调试，并在产品装配、调试完毕后开展运行测试，产品稳定运行后由质量计划部进行产品的入库和发货检验。

5、销售模式

公司主要采取“直销为主”的销售模式，通过商务谈判、委托代理商销售或招投标等方式获取订单。公司市场发展部配备了专业的销售与服务团队，主要负责售前客户需求分析、商务谈判或招投标环节及销售设备的安装、调试、保修、维修、技术咨询及客户端人员培训等售后工作。公司销售程序一般包括市场调查与推介、客户需求及产品配置指标确认、售前工艺测试、产品报价、投标操作与管理（如适用）、合同评审、合同执行、合同回款、产品安装调试及售后服务等步骤。公司始终秉承“客户第一，为客户创造价值”的营销理念，致力于为客户提供“专业精品”的产品及服务。

报告期内，公司不同销售模式下的销售情况如下：

单位：万元

销售模式	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	1,030.53	100.00%	20,781.33	98.96%	18,988.50	100.00%	6,660.52	45.12%
代销	-	-	217.72	1.04%	-	-	8,099.79	54.88%
合计	1,030.53	100.00%	20,999.05	100.00%	18,988.50	100.00%	14,760.31	100.00%

注：2016年公司产品代销规模较大，主要系当年台积电通过公司在中国台湾地区代理商辛耘企业股份有限公司向公司大批量采购涂胶/显影机所致。

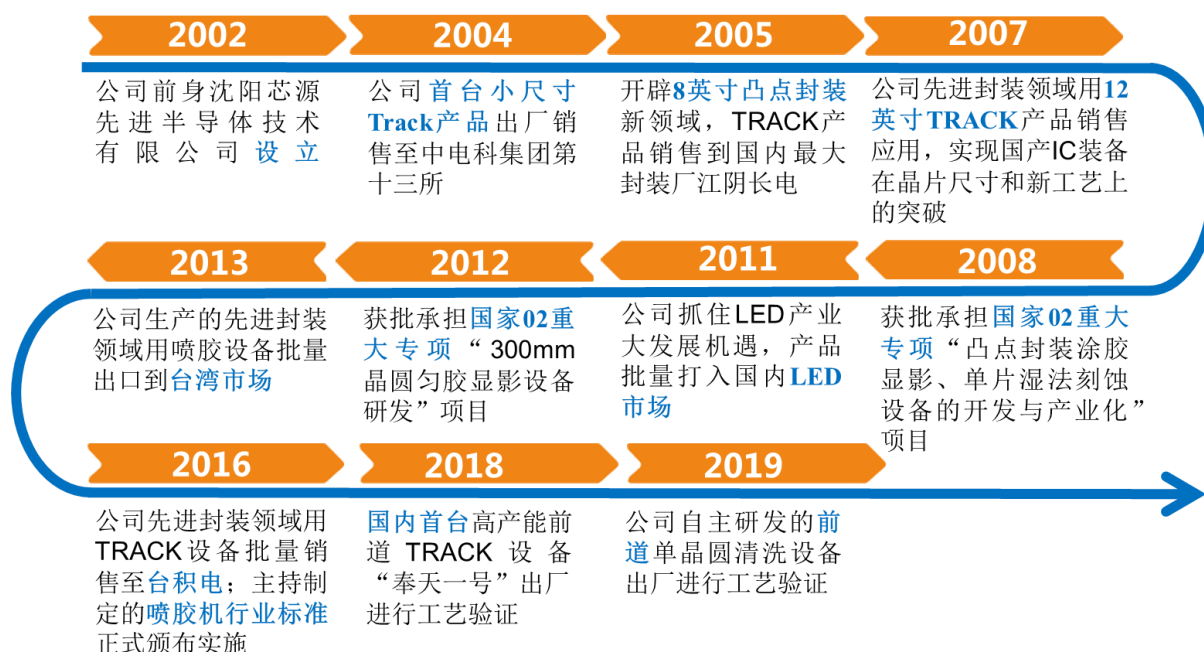
6、公司采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

公司结合国家产业政策、上下游发展状况、市场供需情况、自身主营业务及发展阶段等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，公司现有经营模式取得了良好的效果，产品和业务快速发展，公司经营模式未发生重大变化，在可预见的未来也不会发生重大变化。

（五）发行人主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

自设立以来，公司一直从事半导体专用设备的研发、生产和销售，公司主营业务、主要经营模式等均未发生重大变化。

公司主要产品演变和技术发展情况如下：



2004年，公司首台小尺寸涂胶显影设备出厂，并销售至中国电子科技集团公司第十三研究所。

2005年，公司成功突破包括高粘厚胶膜涂覆技术、渐进式烘烤技术、胶丝控制技术等关键技术，自主研发生产的8英寸先进封装领域用涂胶设备产品成功销售至江阴长电先进封装有限公司，开辟了8英寸先进封装凸点工艺国产化新领域。

2007年，公司自主研发生产的12英寸先进封装涂胶/显影设备产品成功销售

至江阴长电先进封装有限公司，并荣获“2007 年中国半导体协会创新产品和技术奖”，实现了国产 IC 装备在晶圆尺寸和新工艺应用上的突破。

2008 年，公司承担的国家“十一五”国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》“凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备的研发与产业化”项目获得立项批复，项目执行期 2009-2012 年，项目执行期内公司成功突破凸点封装工艺相关的超厚光刻胶膜的涂覆、显影、单片湿法多工艺药液同腔分层刻蚀等多项核心关键技术。

2011 年，公司抓住国内 LED 产业快速发展的机遇，推出 LED 芯片制造领域用涂胶/显影机等半导体专用设备，凭借产品在省胶、高产能等方面的良好性能批量销售至三安光电、华灿光电等国内一线大厂。

2012 年，公司承担的国家“十二五”国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》“300mm 晶圆匀胶显影设备研发”项目获得立项批复，项目执行期为 2012-2015 年，项目执行期内公司成功突破集成电路前道晶圆加工领域光刻工艺超薄胶膜均匀涂敷、精细化显影、精密温控热处理等多项核心技术。

2013 年，公司自主研发的先进封装领域用喷雾式涂胶设备成功打入台湾市场，批量销售至全球最大的晶圆代工企业台积电子公司台湾精材，用于 iPhone 手机指纹识别器件的生产。

2016 年，公司生产的先进封装领域用涂胶/显影设备批量销售至台积电，用于 iPhone7 手机 A10 处理器的生产；同年，公司主持制定的行业标准《喷雾式涂覆设备通用规范》（SJ/T11576-2016）正式颁布实施。

2018 年，公司自主研发的首台国产高产能前道涂胶设备“奉天一号”出厂并在上海华力进行设备工艺验证，正式进军市场空间更加广阔的集成电路制造前道晶圆加工环节用涂胶显影设备领域。

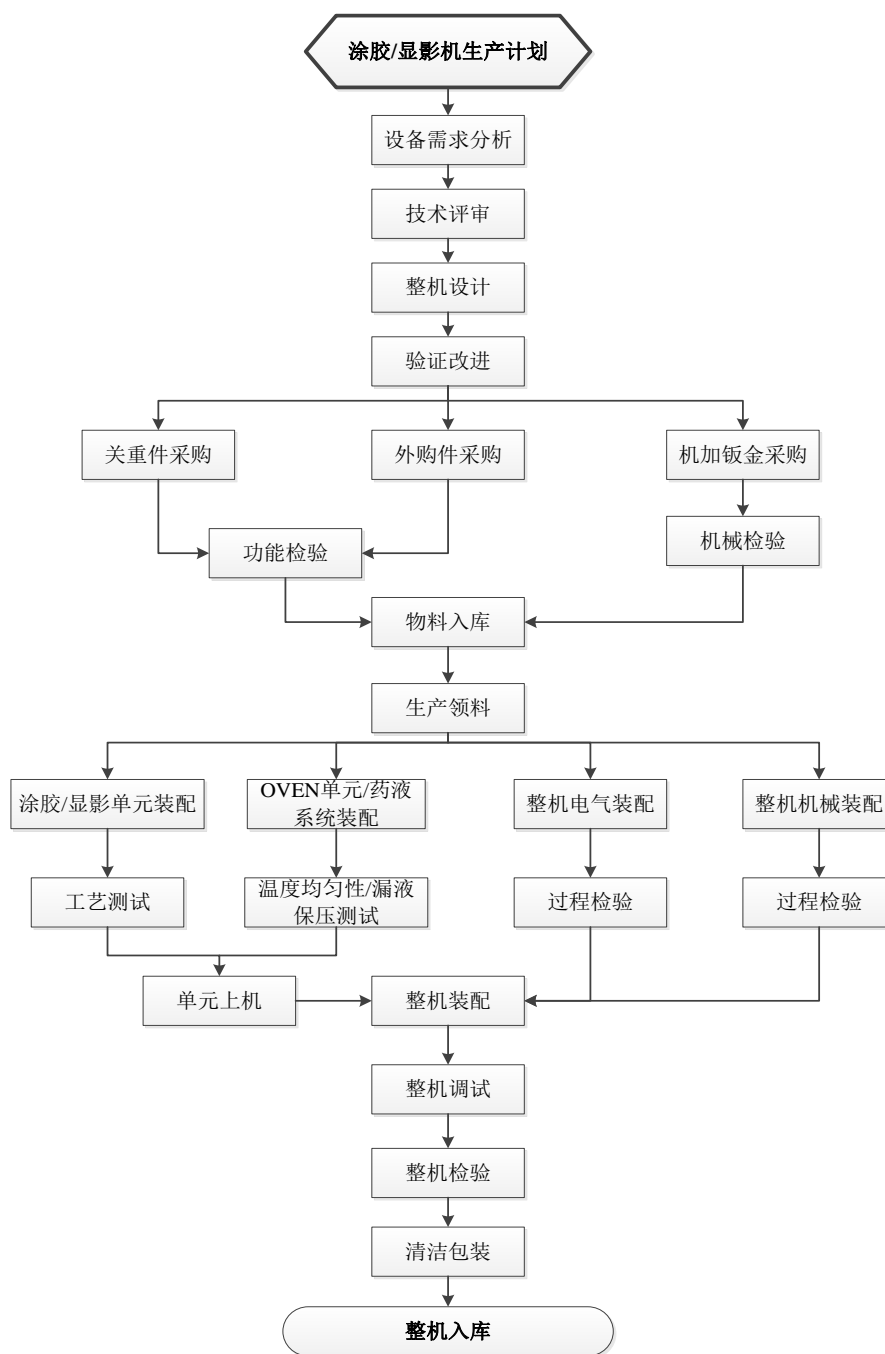
2019 年，公司自主研发的集成电路制造前道晶圆加工环节用单片式清洗设备出厂并在中芯国际（深圳厂）进行设备工艺验证。

(六) 主要产品的工艺流程图或服务的流程图

1、光刻工序涂胶显影设备生产流程图

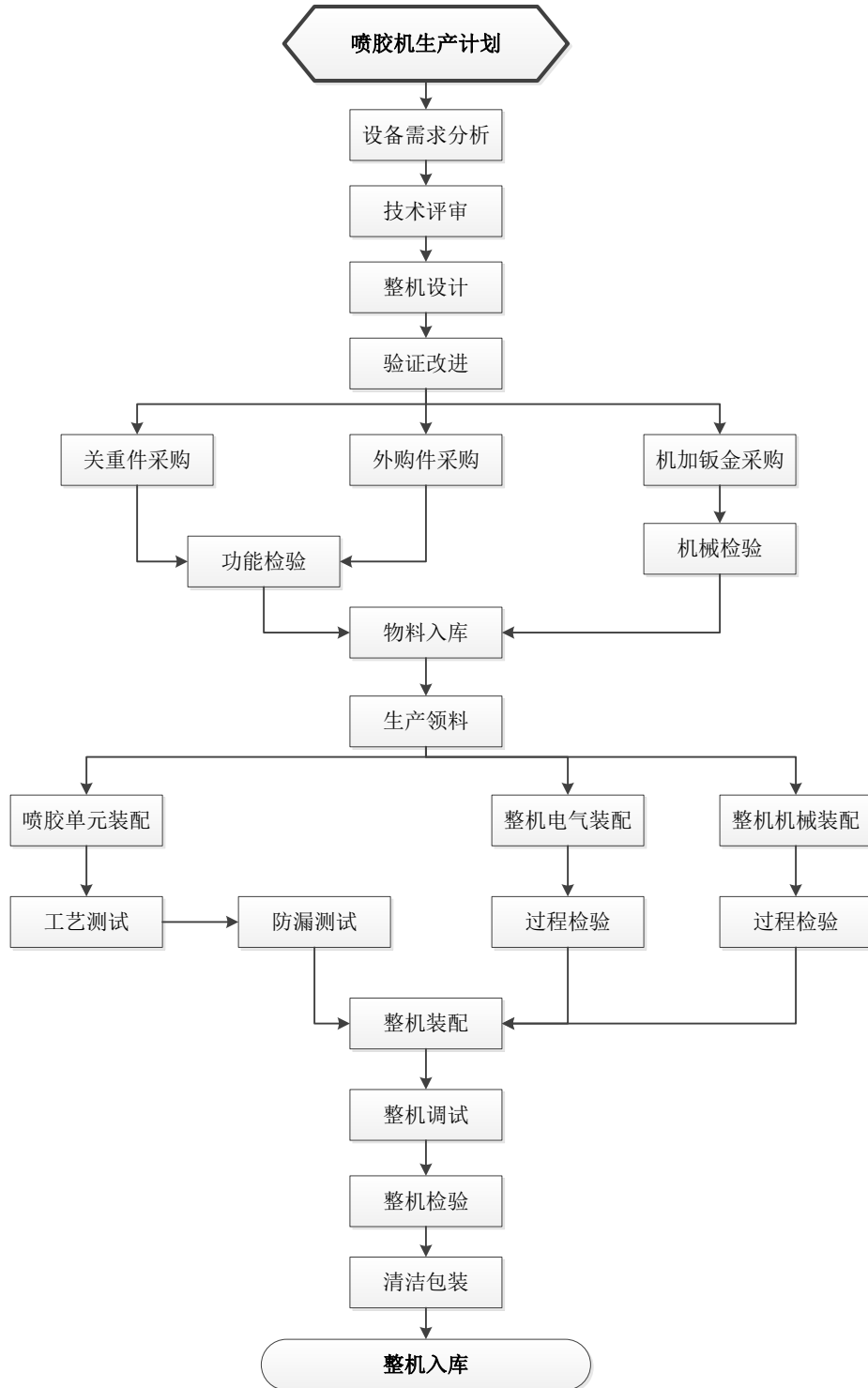
(1) 涂胶/显影机生产工艺流程

公司涂胶/显影机生产流程主要包括客户需求对接、整机设计（包括机械、电气、软件系统等）、生产零部件采购、业务单元装配及调试、整机装配及调试、检验入库等环节，具体如下：



(2) 喷胶机生产工艺流程

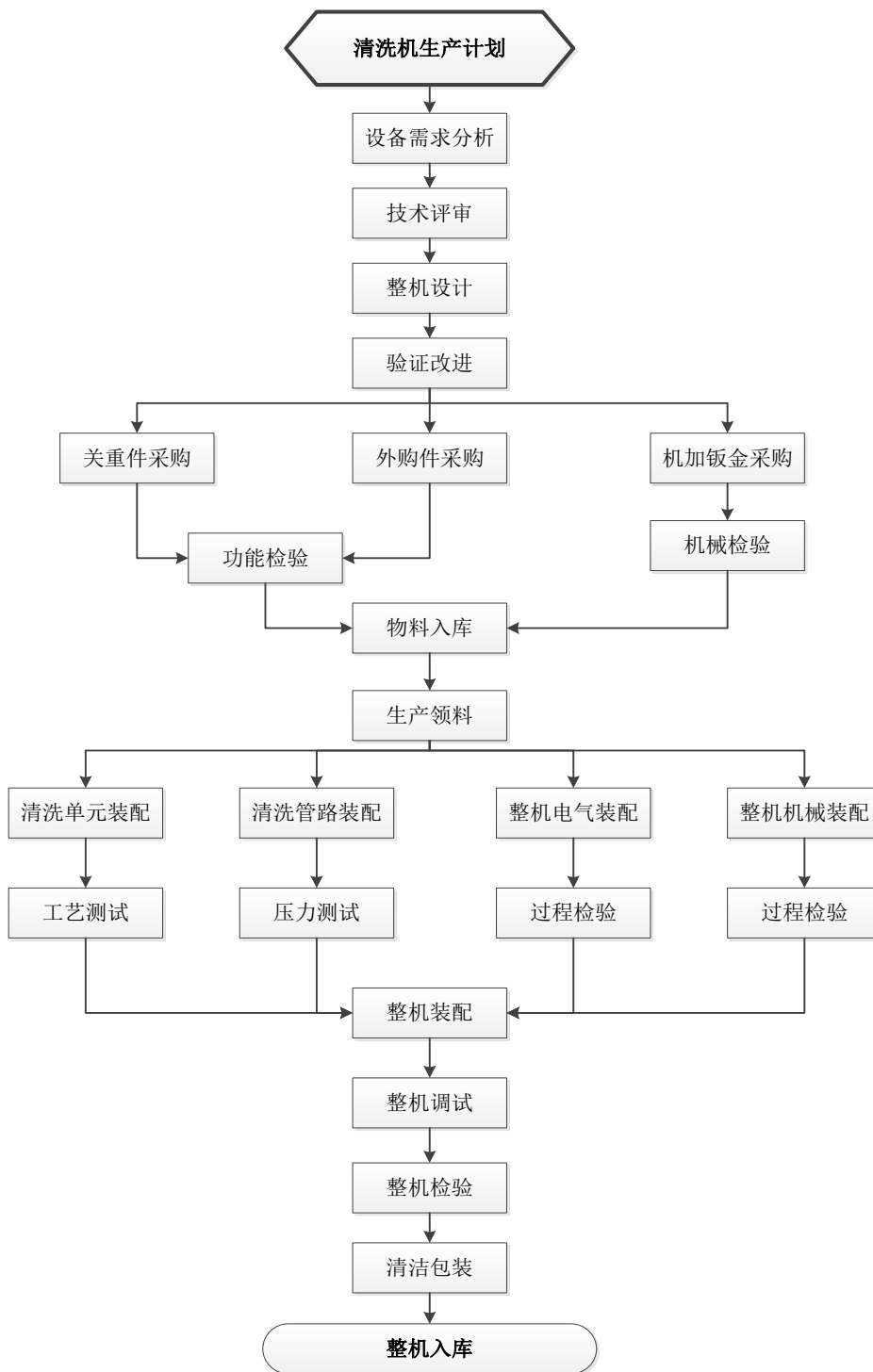
公司喷胶机生产流程主要包括客户需求对接、整机设计（包括机械、电气、软件系统等）、生产零部件采购、业务单元装配及调试、整机装配及调试、检验入库等环节，具体如下：



2、单片式湿法设备生产流程图

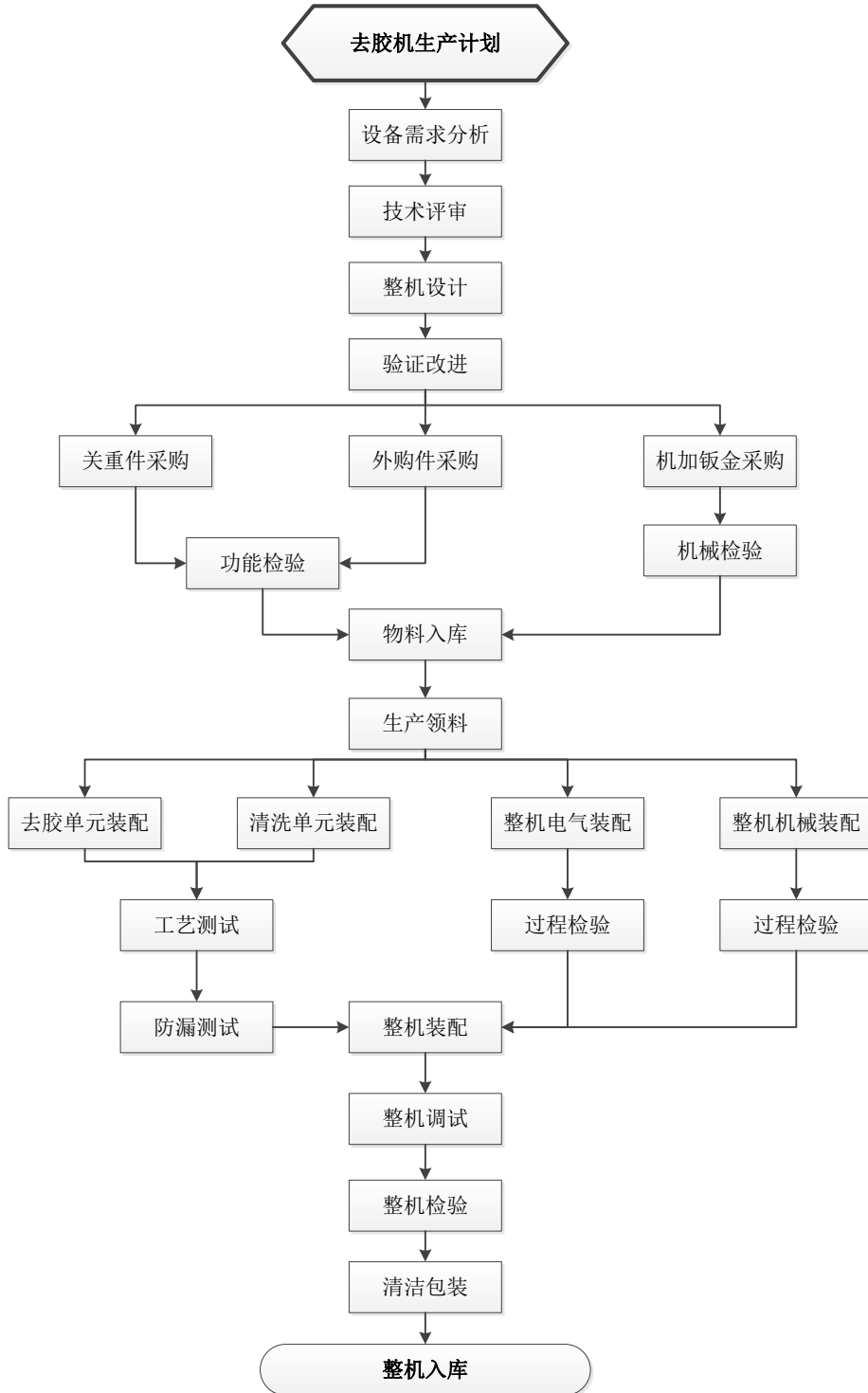
(1) 清洗机生产工艺流程

公司清洗机生产流程主要包括客户需求对接、整机设计（包括机械、电气、软件系统等）、生产零部件采购、业务单元装配及调试、整机装配及调试、检验入库等环节，具体如下：



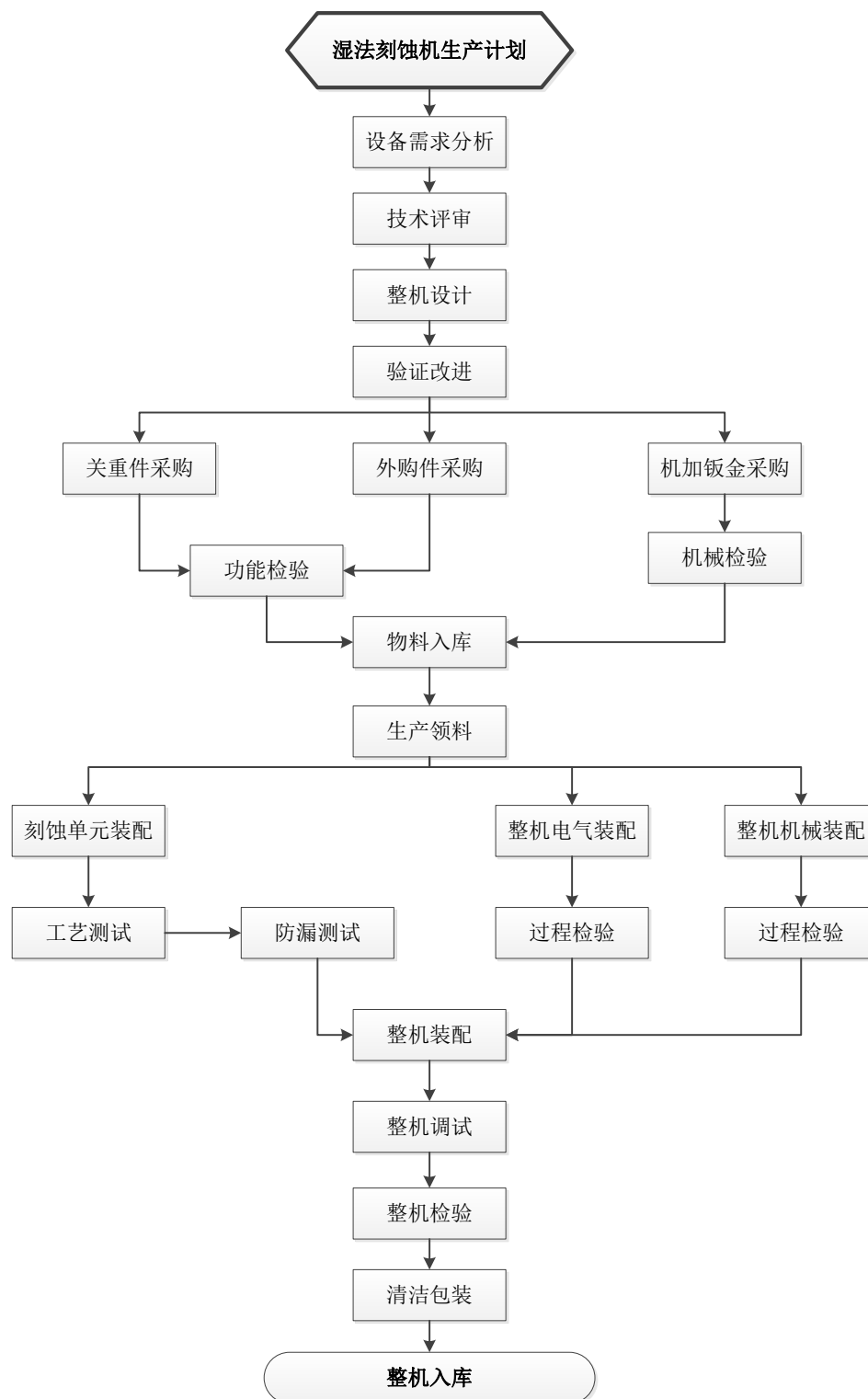
(2) 去胶机生产工艺流程

公司去胶机生产流程主要包括客户需求对接、整机设计（包括机械、电气、软件系统等）、生产零部件采购、业务单元装配及调试、整机装配及调试、检验入库等环节，具体如下：



(3) 湿法刻蚀机生产工艺流程

公司湿法刻蚀机生产流程主要包括客户需求对接、整机设计（包括机械、电气、软件系统等）、生产零部件采购、业务单元装配及调试、整机装配及调试、检验入库等环节，具体如下：



（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要生产工序为机器设备的组装、检测和调试等，不存在高危险、重污染的情形。

在从事研发工作时，公司存在产生少量污染物的情形：1、在极少数情况下，经客户提请（通常涉及特殊工艺要求），公司会使用极少量光刻胶、显影液等化学品进行工艺试验，涉及的污染物主要为显影液、光刻胶等废弃化学品；2、在公司前道涂胶显影设备研发中会使用一定数量的 OK73（一种去除基板边缘光刻胶的化学溶剂），涉及的污染物为 OK73 废弃物。针对上述污染物，公司已聘请有资质的第三方废弃物处置公司进行处置。

二、发行人所处行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响

（一）发行人所处的行业及确定所属行业的依据

发行人主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”（C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”（C3562）。

（二）行业监管体制与政策法规及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所处半导体设备行业的政府主管部门为工信部和科技部，行业自律性组织为中国半导体行业协会和中国电子专用设备工业协会。

工信部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

科技部主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智

力规划和政策并组织实施；牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施；编制国家重大科技项目规划并监督实施；牵头国家技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施等。

中国半导体行业协会和中国电子专用设备工业协会主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

工信部、科技部和行业协会构成了半导体设备行业的管理体系，各企业在主管部门产业宏观调控、行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、行业主要法律法规和政策

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国近年来推出了一系列鼓励和支持半导体产业发展的政策，为半导体产业的发展营造了良好的政策环境，主要包括：

图表 1 行业主要法律法规和政策

序号	文件名	时间	相关内容
1	《战略性新兴产业分类（2018）》	2018.11	将集成电路制造中的半导体器件专用设备制造列为战略性新兴产业。
2	《政府工作报告》	2018.03	推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推动智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造 2025 示范区”。
3	《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》	2017.04	优化产业结构，推进集成电路和专用装备关键核心技术突破和应用。
4	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	2017.04	面向宽禁带半导体器件、光通讯器件、MEMS（微机电系统）器件、功率电子器件、新型显示、半导体照明、高效光伏等泛半导体产业领域的巨大市场需求，开展关键装备与工艺的研究，重点解决电子器件关键材料装备、器件制造装备等高端装备缺乏关键技术、可靠性低、工艺开发不足等问题，推动新技术研发与关键装备研发的协同发展，构建高端电子制造装备自主创新体系。

序号	文件名	时间	相关内容
5	《国家科技重大专项“十三五”发展规划》	2016.12	要求瞄准全球科技前沿，聚焦产业升级、民生改善、生态治理等重大需求，强化资源集成和协同创新，动员社会资本等各方力量参与，加快推进集成电路装备、新药创制等重大专项，推动我国科技实力和竞争力整体跃升。
6	《信息产业发展指南》	2016.12	掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，探索新型材料产业化应用，提升封装测试产业发展能力；以生产线建设带动关键装备和材料配套发展，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。
7	《国家信息化发展战略纲要》	2016.07	构建先进技术体系，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
8	《国家科技重大专项》	/	将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”和“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”列为国家重点科技专项。
9	《中国制造 2025》	2015.05	将集成电路及专用设备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造设备供货能力。
10	《国家集成电路产业发展推进纲要》	2014.06	到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，封装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。

3、对发行人经营发展的影响

上述政策和法规的发布和落实，为半导体及其专用设备制造行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好经营环境，有力促进了本土半导体及其专用设备行业的发展。公司所处行业为国家鼓励发展的产业，具备良好的政策环境，有利于公司发展经营。

三、发行人所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势

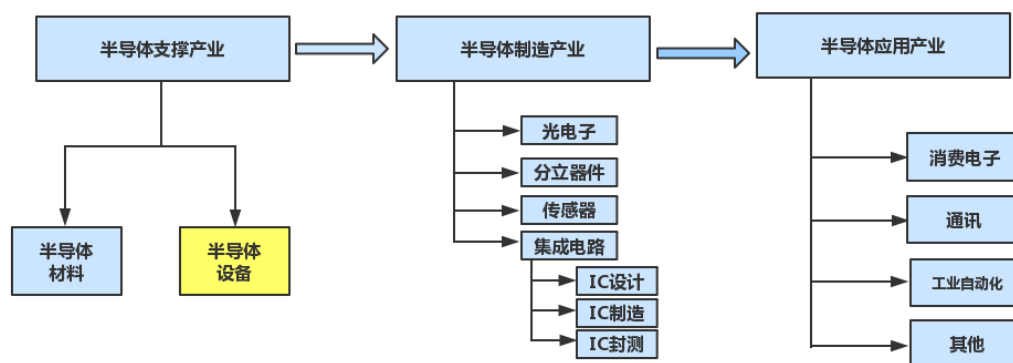
半导体被称为制造业皇冠上的明珠，半导体产业是信息技术产业的核心，是

支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。作为“工业粮食”，半导体芯片被广泛地应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子、物联网等产业，是绝大多数电子设备的核心组成部分。根据国际货币基金组织测算，每 1 美元半导体芯片的产值可带动相关电子信息产业 10 美元产值，并带来 100 美元的 GDP，这种 100 倍价值链的放大效应奠定了芯片行业在国民经济中的重要地位。

作为半导体产业的核心，集成电路占据半导体行业规模的八成以上，其细分领域包括逻辑电路、存储器、微处理器和模拟电路等四类。从产业链的角度看，以集成电路为代表的半导体产品被广泛用于消费电子、通讯、工业自动化等下游电子信息产业中，同时也受到下游终端应用结构发展的推动，下游应用是半导体产业发展的核心驱动力。

发行人所处的半导体装备产业是半导体产业链的上游核心环节，涉及电子、机械、化工、材料、信息等学科领域，行业技术门槛高，通常是一代器件、一代设备、一代工艺。

图表 2 半导体产业链



（一）半导体行业发展状况

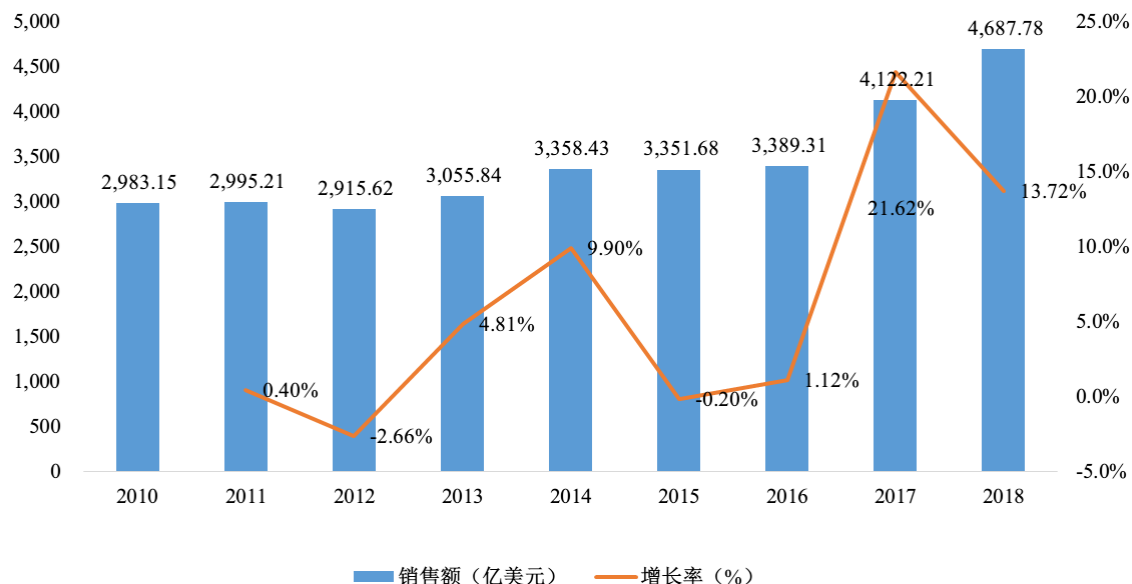
1、全球半导体产业状况

（1）全球半导体市场规模保持稳定增长

伴随全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展以及半导体下游应用领域的不断拓展，近年来全球半导体销售额保持稳定增长。根据世界半导体贸易统计协

会（WSTS）统计数据，全球半导体销售额由 2010 年的 2,983.15 亿美元增长至 2018 年的 4,687.78 亿美元，年复合增长率达 5.81%。

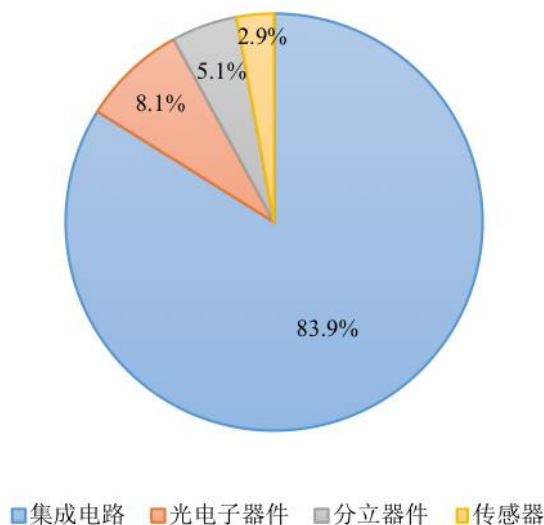
图表 3 2010-2018 年全球半导体销售额及增长率



数据来源：WSTS

从产品类型看，半导体主要由集成电路、光电子器件、分立器件和传感器组成。根据 WSTS 2018 年统计数据，2018 年集成电路销售额为 3,932.88 亿美元，占比 83.90%，同比增长 14.60%，是全球半导体产业增长的主要动力；光电子器件销售额为 380.32 亿美元，占比 8.1%，同比增长 9.25%；分立器件销售额为 241.02 亿美元，占比 5.1%，同比增长 11.32%；传感器销售额为 133.56 亿美元，占比 2.9%，同比增长 6.24%。

图表 4 2018 年全球半导体构成

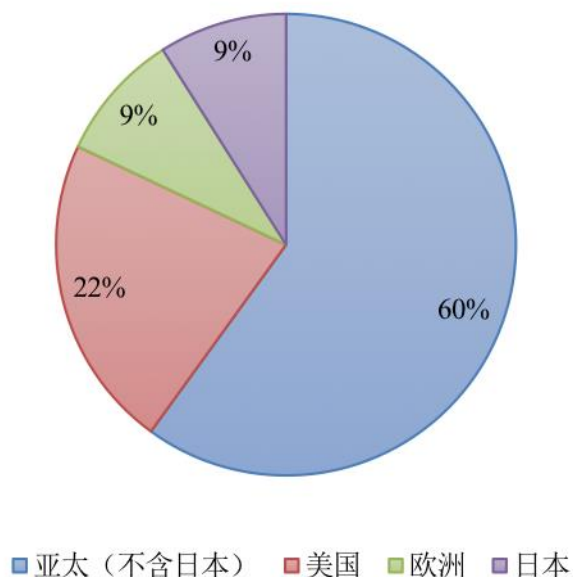


数据来源：WSTS

(2) 以我国为核心的亚太地区已成为全球半导体市场中心

根据 WSTS 统计，自 2001 年亚太地区（不含日本）半导体市场规模超过其他地区以来，该地区市场规模已由 398.20 亿美元大幅增长至 2018 年 2,828.63 亿美元。2018 年亚太地区（不含日本）、美国、欧洲、日本半导体市场规模全球占比分别为 60%、22%、9%、9%。随着我国半导体市场的快速增长，其全球地位也在快速提升。2017 年我国成为亚太地区（不含日本）最大的半导体市场，占亚太地区（不含日本）半导体市场规模的 53%，占全球半导体市场规模的 32%。

图表 5 2018 年全球半导体市场区域分布



数据来源：WSTS

（3）半导体产业分工不断细化

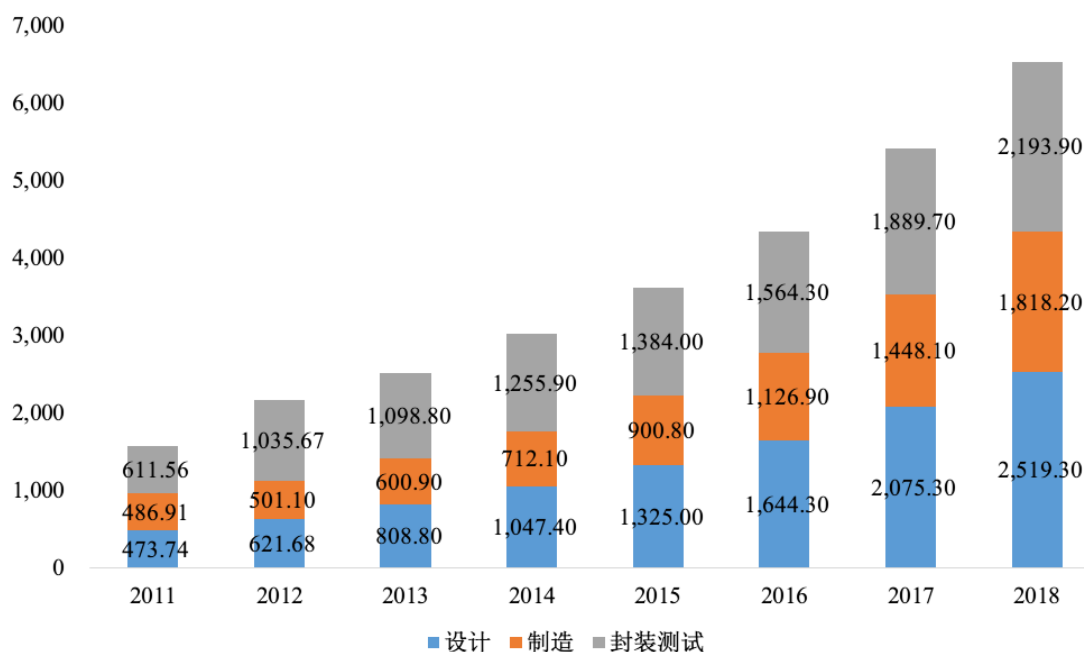
早期的半导体企业实行 IDM（整合器件制造商）模式即企业自行设计、生产加工、封装、测试和销售。随着加工技术的日益成熟和标准化程度的不断提高，半导体产业链开始向专业化分工方向发展，逐步形成了独立的半导体设计企业、晶圆制造代工企业、封装测试企业，并形成了新的产业模式-垂直分工，在该模式下，设计、制造和封装测试分离成半导体产业链中各自独立的一环。虽然目前三星、英特尔、德州仪器、东芝等全球半导体厂商仍为 IDM 厂商，但由于近年来半导体技术研发成本以及晶圆生产线投资成本呈指数级上扬，更多的 IDM 厂商开始采用轻晶圆制造模式，即将晶圆委托晶圆制造代工企业厂商（Foundry）制造，甚至直接变成独立的半导体设计企业（Fabless），垂直分工已成为半导体行业经营模式的发展方向。

2、我国半导体产业状况

（1）我国半导体产业规模持续快速增长

在下游应用行业快速发展的推动下，我国半导体产业规模持续快速增长。根据 WSTS 统计数据，我国半导体（包括集成电路）的销售额由 2016 年的 1,075 亿美元增长到 2018 年的 1,584 亿美元，三年间增加了 509 亿美元。特别是集成电路产业，在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，实现了快速发展。根据中国半导体行业协会的统计，我国集成电路产业销售额 2011-2018 年的年复合增长率为 22.56%，销售额已由 2011 年的 1,572.21 亿元扩大到 2018 年的 6,532 亿元。其中集成电路设计业销售规模从 2011 年的 473.74 亿元增长至 2018 年的 2,519.30 亿元，年复合增长率达到 26.96%；集成电路制造业销售规模由 2011 年的 486.91 亿元增长至 2018 年的 1,818.20 亿元，年复合增长率达到 20.71%；集成电路封装测试业销售额由 2011 年的 611.56 亿元增长至 2018 年的 2,193.90 亿元，年复合增长率达到 20.02%。

图表 6 2011-2018 年我国集成电路各产业销售额（亿元）



数据来源：中国半导体行业协会

(2) 我国半导体产业聚集效应日趋明显

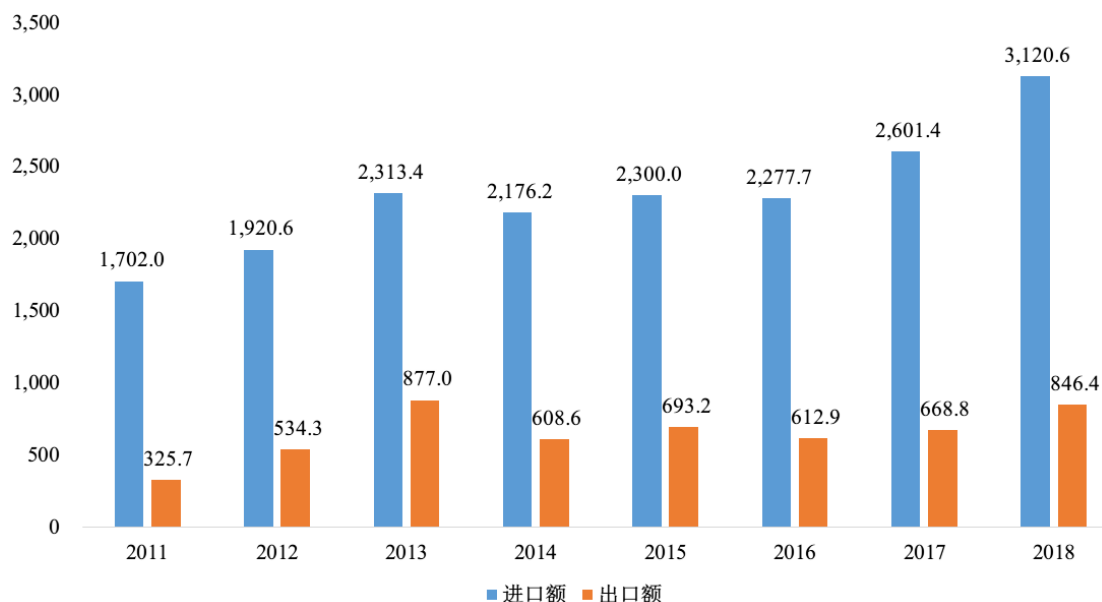
近年来我国半导体产业整体实力显著提升，半导体设计、晶圆制造加工与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键设备被国内外生产线采用。同时，我国也涌现出一批具有一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。华为海思、紫光集团作为行业重点企业，均已进入全球 Fabless 企业前十名；中芯国际等制造企业在 28nm 工艺领域取得突破，逐步拉近与国际制造巨头的技术差距；长电科技、华天科技、通富微电等封测厂商通过外延并购与内在发展，快速提升自身实力以及国际竞争力，目前均已进入全球封测企业前十名；北方华创、中微半导体等半导体关键设备企业作为国产装备的领军“旗手”，在先进工艺制程相继取得重大突破。

(3) 我国半导体国产化需求紧迫

虽然我国半导体需求庞大，并且在快速增长，但国内产值远低于市场需求，尤其是集成电路领域的贸易逆差仍在持续快速扩大。2017 年全球集成电路市场规模近 3,400 亿美元，全球 54% 的芯片都出口到中国，但国产芯片的市场份额只占 10%。我国芯片产业长期被国外厂商控制，已超过了石油和大宗商品，成为第一大进口商品。根据中国海关统计数据，2011 年我国集成电路进出口额的逆差

额 1,376.3 亿美元，到 2018 年贸易逆差扩大到 2,274.2 亿美元，年复合增长率为 6.48%。可见，目前国内集成电路市场需求严重依赖进口的局面仍未得到改善，摆脱我国在半导体产业上的对外依赖，半导体尤其是半导体设备国产化已经成为当务之急。

图表 7 2011-2018 年我国集成电路进出口额（亿元）



数据来源：中国海关

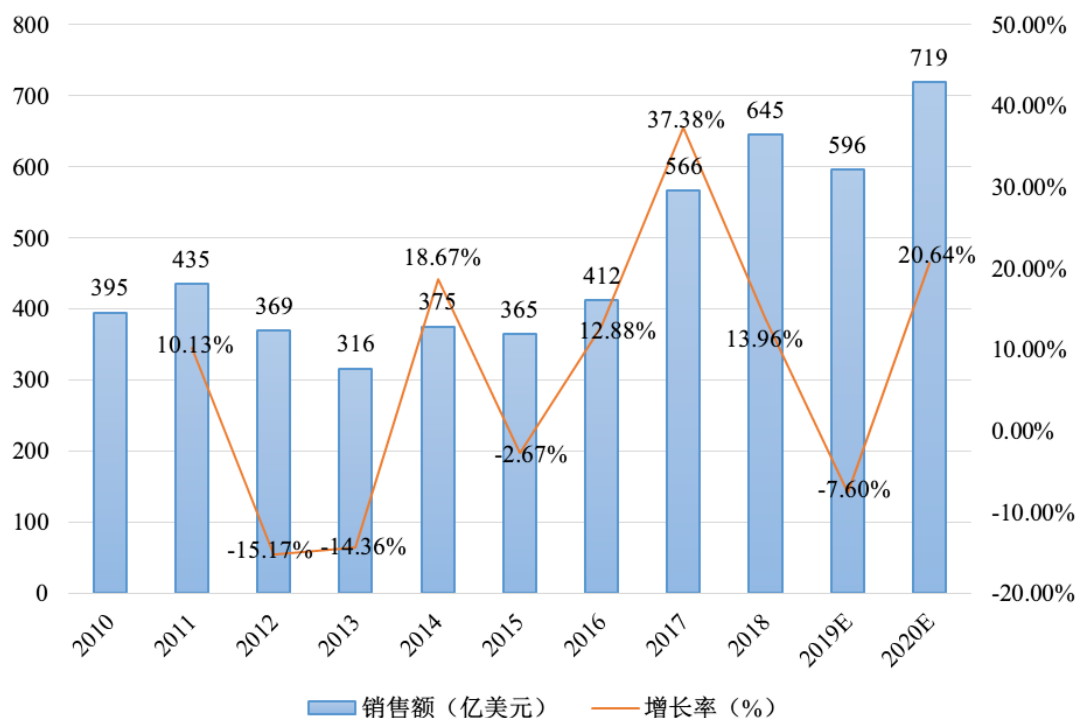
（二）半导体设备行业发展状况

1、全球半导体设备行业

（1）全球半导体市场需求带动全球半导体设备规模扩大

半导体设备市场与半导体产业景气状况紧密相关，2012 年，受全球宏观经济影响，半导体行业发展有所减缓，设备市场增长相应受到抑制，2014 年以来全球半导体市场开始复苏。据国际半导体设备材料产业协会（SEMI）统计，2014 年全球半导体设备销售规模为 375 亿美元，2018 年全球半导体设备销售额达到 645 亿美元，年均复合增长率达 14.52%。随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片或先进制程的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。SEMI 预计 2019 年全球半导体设备市场销售规模将有所下降，但 2020 年仍会有 20.7% 的增长，达到 719 亿美元，创历史新高。

图表 8 2010-2018 年全球半导体设备销售额及增长率



数据来源：SEMI

(2) 全球半导体设备市场目前主要由国外厂商主导

半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业起步较早，经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场的主要份额。根据 VLSI Research 统计，2018 年全球半导体设备系统及服务销售额为 811 亿美元，其中前五大半导体设备制造商占据了全球半导体设备市场 65% 的市场份额。其中，美国在等离子刻蚀设备、离子注入机、外延生长系统、化学气相沉积设备、溅射设备、退火设备、镀铜设备、去胶设备、掩膜版制造设备、工艺检测设备、圆片清洗设备、部分测试设备等方面占据优势，日本在光刻机、涂胶设备、显影设备、封装及测试设备、氧化/LPCVD 设备、等离子刻蚀设备、化学气相沉积设备、检测设备、传送装置等方面具有优势，荷兰则在高端光刻机方面居于国际领先地位。

图表 9 2018 年全球半导体制造设备前五强

排名	公司名称	2018 年销售额 (亿美元)	全球市场占有率
1	美国应用材料	140.16	17.27%
2	荷兰阿斯麦	127.72	15.74%
3	日本东京电子	109.15	13.45%
4	美国泛林集团	108.71	13.40%
5	美国科天	42.10	5.19%
合计		527.84	65.05%

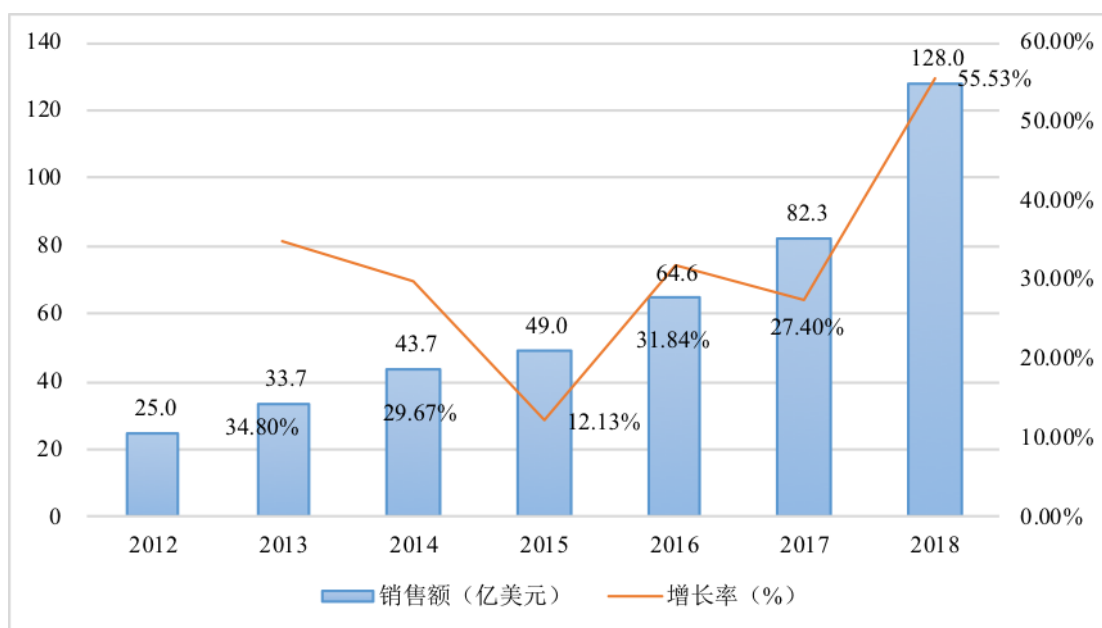
资料来源：VLSI Research

2、我国半导体设备行业

(1) 我国半导体设备需求旺盛

随着国际产能不断向我国大陆地区转移，英特尔（Intel）、三星（Samsung）等国际大厂陆续在我国大陆地区投资建厂，同时在集成电路产业投资基金的引导下，我国大陆集成电路生产线建设热情高涨，我国大陆地区对半导体设备的需求巨大。根据 SEMI 统计，2018 年我国大陆地区半导体专用设备销售规模达到 128 亿美元，超过中国台湾地区成为全球第二大市场，SEMI 预计未来我国大陆地区半导体专用设备市场仍将保持增长态势，2020 年市场规模将达 170.6 亿美元。

图表 10 2012-2018 年我国大陆地区半导体专用设备销售额及增长率



数据来源：SEMI

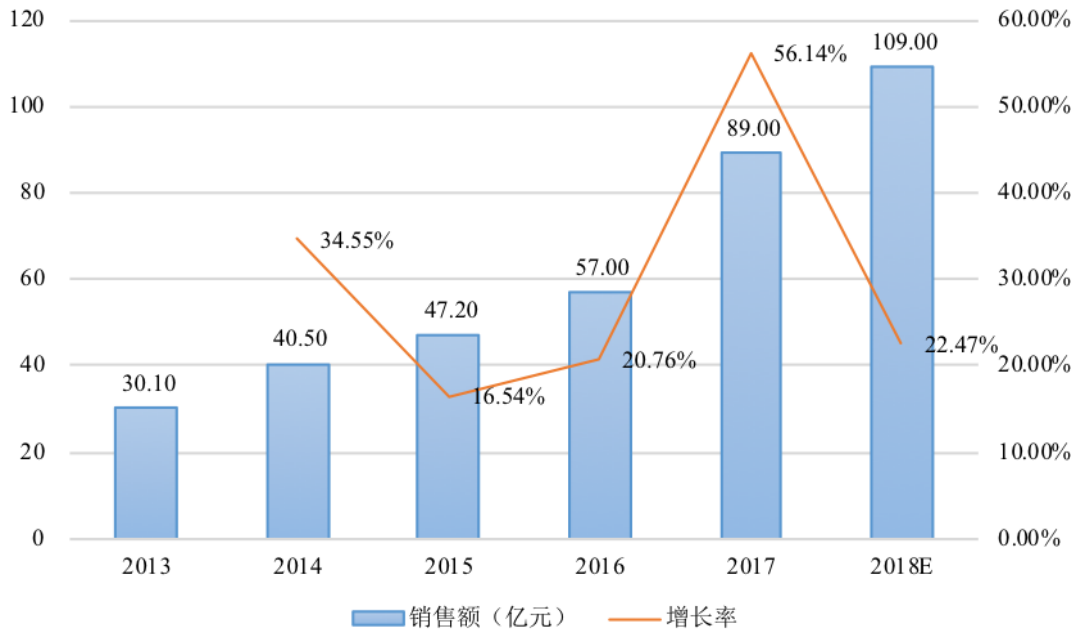
(2) 细分领域涌现一批优秀本土半导体设备厂商

近年来随着国家对半导体产业的持续投入及部分民营企业的兴起，我国半导体装备实现了从无到有、由弱到强的巨大转变，填补了产业链空白，使我国半导体制造体系和产业生态得以建立和完善。在硅单晶炉、刻蚀机、封装设备、测试设备等壁垒相对低的领域，国产设备已达到或接近国外先进水平，且成本优势明显。例如晶盛机电生产的单晶硅长晶炉，其在投料量、自动化程度和晶棒尺寸等指标方面均已处于国际领先水平；中微半导体生产的 16nm 刻蚀机实现了商业化量产，并已进入台积电 5 条生产线；北方华创生产的 CVD 设备已进入中芯国际 28nm 生产线，14nm 设备处于验证期；硅刻蚀机已突破 14nm 技术，金属刻蚀方面 14nm 技术成熟，目前已经进入 8 英寸主流硅晶圆厂。发行人生产的应用于 LED 芯片制造、集成电路后道先进封装等领域的光刻工序涂胶显影设备已在台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电等国内一线大厂广泛应用；发行人生产的集成电路前道晶圆加工领域用涂胶显影设备也正在长江存储、上海华力等国内一线大厂进行工艺验证。

（3）我国半导体设备大量依赖进口

在需求拉动和国家支持下，我国半导体产业链得以不断完善，但目前我国半导体设备还主要依赖进口。根据中国电子专用设备工业协会的统计数据，2018 年国产半导体设备销售额预计为 109 亿元，自给率约为 13%。中国电子专用设备工业协会统计的数据包括集成电路、LED、面板、光伏等设备，实际上国内集成电路设备的国内市场自给率仅有 5% 左右，在全球市场仅占 1-2%，技术含量最高的集成电路前道设备市场自给率更低。半导体设备是半导体产业发展的基石，半导体设备的大量依赖进口不仅严重影响我国半导体的产业发展，也对我国电子信息安全造成重大隐患。

图表 11 国产半导体装备产业销售额及增长率



数据来源：中国电子专用设备工业协会

3、半导体设备行业发展趋势

(1) 设备将向高精度化与高集成化方向发展

随着半导体技术的不断进步，半导体器件集成度不断提高。一方面，芯片特征尺寸不断缩小，由 12 微米-0.35 微米(1965 年-1995 年)到 65 纳米-22 纳米(2005 年-2015 年)，且还在向更小的方向发展；另一方面硅片尺寸却不断扩大，主流产品硅片尺寸已经从 4 英寸、6 英寸，发展到现阶段的 8 英寸、12 英寸。此外，半导体器件的结构也趋于复杂，例如存储器领域的 NAND 闪存已进入 3D 时代。3D NAND 制造工艺中，增加集成度的方法不再是缩小单层上线宽而是增加堆叠层数，堆叠层数也从 32 层、64 层量产向 128 层发展。这些对半导体设备的精度与稳定性的要求越来越高，未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展。

(2) 各类技术等级设备并存发展

虽然半导体技术持续迅猛发展，未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展，但是由于芯片的用途极其广泛，性能要求及技术参数等差异较大，各类性能、用途芯片大量并存并应用，这也决定了不同的芯片产线需配置相匹配的、

技术等级及性价比相当的半导体设备。即使在同一产线上，复杂程度不同的工艺环节也是根据其实际需要搭配使用各类技术等级的设备。因此，高、中、低各类技术等级的生产设备均有其对应市场空间，并存发展。

（3）国产化进程加快

近年来，在国家政策的拉动和支持下，我国半导体产业快速发展，整体实力显著提升，设计、制造能力与国际先进水平不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，但半导体基础材料研究和先进设备制造仍然相对薄弱。中国半导体行业要实现从跟踪走向引领的跨越，装备产业将是重要环节。发展国产半导体装备具有重要战略意义，半导体设备国产化将大幅降低我国芯片制造商的投资成本，提高我国芯片制造竞争力。《中国制造 2025》对于半导体设备国产化提出明确要求：在 2020 年之前，90-32 nm 工艺设备国产化率达到 50%，实现 90nm 光刻机国产化，封测关键设备国产化率达到 50%。在 2025 年之前，20-14nm 工艺设备国产化率达到 30%，实现浸没式光刻机国产化。为推动我国半导体产业的发展，国家先后设立国家重大专项和国家集成电路基金，国家集成电路基金首期计划募资 1,200 亿元，实际募资 1,387 亿元。目前，国家集成电路基金二期方案已上报国务院并获批，计划募资 1,500 亿元至 2,000 亿元。以 1:3 的撬动比例测算，所撬动的社会资本规模在 4,500 亿元至 6,000 亿元，加上首期的 1,387 亿元及所撬动的 5,145 亿元社会资本，资金总额将超过万亿元。此外地方政府也推出地方版集成电路投资基金，为半导体产业发展破解融资瓶颈提供了保障，有力促进了半导体行业的可持续发展。伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，本土半导体及其设备制造业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国半导体设备行业技术水平提高和行业的快速发展，从而进一步加快我国半导体设备的国产化进程。

4、半导体设备行业竞争格局及市场化情况

（1）行业竞争格局

目前，我国半导体设备行业市场份额仍主要由国外知名企业所占据，凭借较强的技术、品牌优势，在高端市场占据领先地位，面对我国巨大的市场需求和相对较低的生产成本，纷纷通过在我国建立独资企业、合资建厂等方式占领大部分

国内市场。本土企业中，包括本公司在内的行业内少数半导体设备制造商通过多年的研发和积累，已掌握了相关核心技术，拥有自主知识产权，具备一定品牌知名度，占据了一定市场份额，奠定了一定的市场地位。与国外知名企业相比，国内优势企业对客户需求的理解更加到位，服务方式更为灵活，产品性价比更高，具有一定的本土优势。

图表 12 半导体设备竞争格局

类别	外资品牌	国产品牌
光刻设备 (含涂胶显影)	ASML、Nikon、Canon、TEL、DNS	上海微电子（光刻机）、发行人（涂胶/显影机）
刻蚀设备	LAM、TEL、AMAT	中微半导体、北方华创
薄膜设备	AMAT、LAM、TEL	北方华创、沈阳拓荆
离子注入	AMAT、Axcelis	中科信、凯世通
过程控制	KLA、AMAT、日立	上海睿励、东方晶源
清洗设备	DNS、TEL、KLA、LAM	盛美半导体、北方华创、至纯科技、发行人
化学机械研磨	AMAT、Ebara	华海清科、中电四十五所
测试设备	泰瑞达、爱德万	长川科技、精测电子等

资料来源：Gartner 2017

（2）行业市场化程度

半导体设备制造业属于战略性新兴产业，其发展受到国家和各级政府的鼓励和支持，市场化程度较高，不存在行业限制或市场准入方面的行政管理。但半导体设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术含量高、技术研发周期较长以及产品工艺和制造技术难度大等特点，需要以高级专业技术人员和高水平研发手段为基础。上述特性使得该行业具有较高的技术壁垒。

四、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

发行人生产的产品主要包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，可用于集成电路、LED 芯片、化合物半导体、功率器件、圆片级 OLED 等半导体产品的制造，其与所处产业深度融合情况如下：

（一）发行人产品介绍

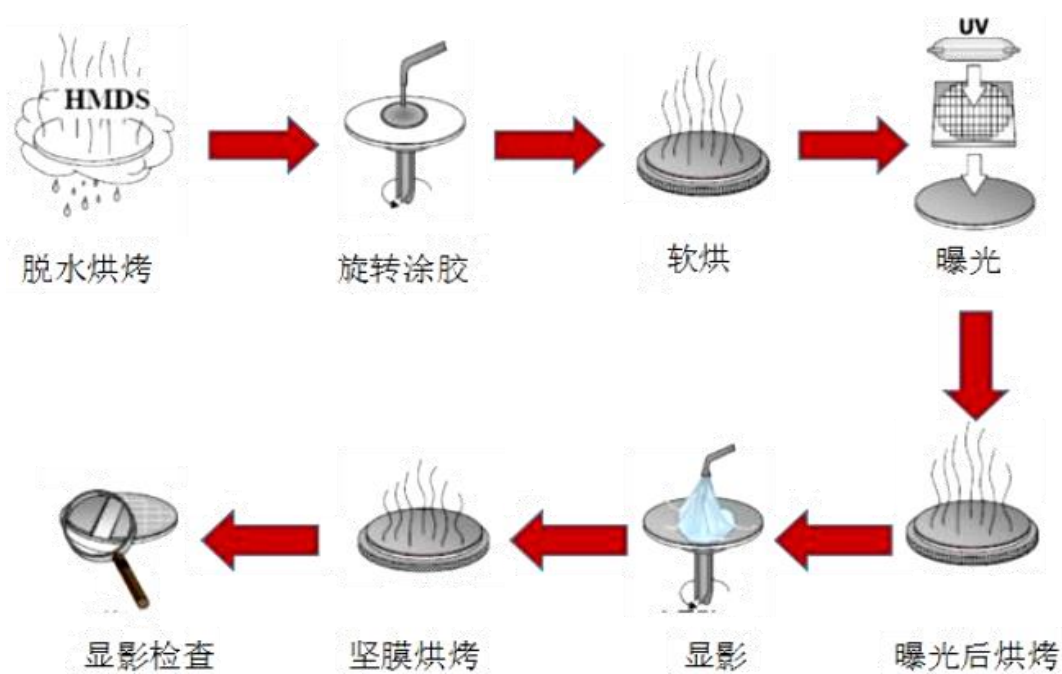
1、光刻工序涂胶显影设备

涂胶显影设备（又称 Track 或 Coater&Developer）是光刻工序中与光刻机配套使用的涂胶、烘烤及显影设备，包括涂胶机（又称涂布机、匀胶机，英文简称 Spin Coater）、喷胶机（适用于不规则表面晶圆的的光刻胶涂覆，英文简称 Spray Coater）和显影机（英文简称 Developer）。在早期的集成电路和较低端的半导体制造工艺中，此类设备往往单独使用（Off Line）。随着集成电路制造工艺自动化程度及客户对产能要求的不断提升，在 200mm（8 英寸）及以上的大型生产线上，此类设备一般都与光刻设备联机作业（In Line），组成配套的圆片处理与光刻生产线，与光刻机配合完成精细的光刻工艺流程。

（1）涂胶/显影机

涂胶/显影机作为光刻机的输入（曝光前光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影），主要通过机械手使晶圆在各系统之间传输和处理，从而完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程，其不仅直接影响到光刻工序细微曝光图案的形成，显影工艺的图形质量对后续蚀刻和离子注入等工艺中图形转移的结果也有着深刻的影响，是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备。

图表 13 光刻工艺流程



发行人生产的涂胶/显影机可与光刻机设备联机作业或者独立作业，工艺范围涵盖 LED 芯片制造、集成电路制造后道先进封装制程以及前道的 I-line、KrF、ArF 等制程工艺，根据不同工艺需求，可搭载不同的温湿度控制模块以及相应的

涂胶和显影模块。同时，根据客户对产能要求的高低，发行人开发出了单机械手平台和多机械手平台，可以根据客户需求灵活配置，从而提高产品性价比。

（2）喷胶机

喷胶机是一种能够覆盖不规则表面晶圆的光刻胶涂覆设备，可以有效、均匀地涂覆带有沟槽图形的晶片表面。该设备主要应用于厚胶膜的涂覆工艺，通过将光刻胶雾化成雾滴，再由氮气（N₂）将光刻胶雾滴吹出并喷涂到衬底或晶圆表面，承载晶圆的热板通过加热将光刻胶溶剂蒸发，使得有用的树脂留在衬底或晶圆表面，形成相对均匀的光刻胶覆盖。

发行人生产的喷胶机可应用于圆片级封装（WLP）、3D 封装及 MEMS 芯片制造等领域，适合于高深宽比尺寸的沟槽图形表面涂覆，可保证沟槽台阶表面涂覆的均匀性。独特的喷涂工艺可以处理特殊形状（如长方形、菱形等）的衬底，针对某些轻薄易碎的衬底，喷胶机在处理时也有其优势，可以保证衬底完整不碎裂。

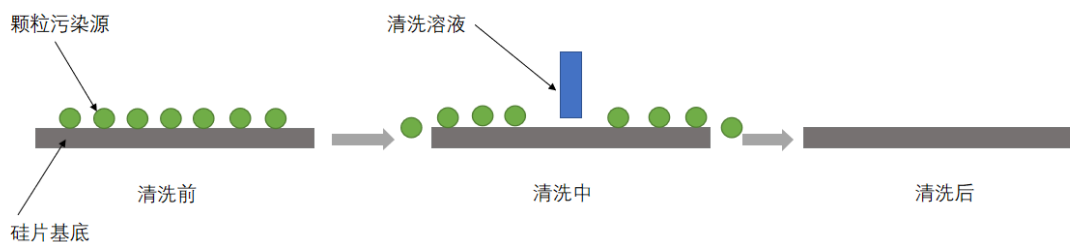
2、单片式湿法设备

湿法设备是一种集合了流体力学、化学工程、材料科学、精密加工、电子控制、计算机软件等多学科的高科技产品，是集成电路制造过程中使用比例最高的核心生产设备。湿法设备可分为槽式湿法设备与单片式湿法设备，随着集成电路线宽的不断缩小，对颗粒大小及数量、刻蚀速率及均匀性、金属污染控制、表面粗糙度、圆片单面工艺等的要求越来越严格，单片式湿法设备正越来越多地使用到集成电路的制造中来。公司生产的单片式湿法设备主要由清洗机、去胶机和湿法刻蚀机构成。

（1）清洗机

清洗机是将晶圆表面上产生的颗粒、有机物、自然氧化层、金属杂质等污染物去除，以获得所需洁净表面的工艺设备。从工艺应用上来说，清洗机目前已广泛应用于集成电路制造工艺中的成膜前/成膜后清洗、等离子刻蚀后清洗、离子注入后清洗、化学机械抛光后的清洗和金属沉积后清洗等各个环节。

图表 14 清洗原理示意图

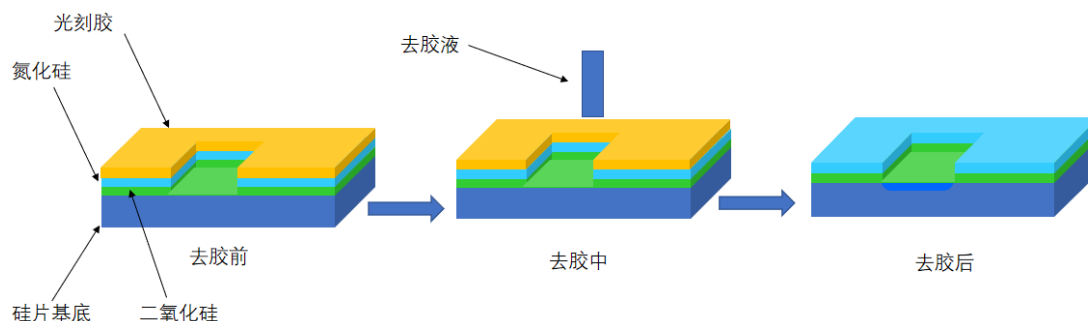


发行人生产的清洗机可搭载高压喷嘴、超/兆声波喷嘴、二流体喷嘴、化学品喷嘴、毛刷等多种清洗方式，能够满足集成电路制造前道晶圆加工环节 90nm 以上工艺制程的清洗要求以及后道先进封装环节绝大部分清洗工艺的要求。

(2) 去胶机

在半导体制造工艺中，光刻胶只是起到图形转移的媒介作用，因此在完成图形转移后，需要将光刻胶完全去除，以避免残留的光刻胶影响后续工艺质量。去胶机主要用于圆片刻蚀后其表面作为阻挡层的光刻胶的去除，适用于 50-300mm 圆片的处理。

图表 15 去胶原理示意图



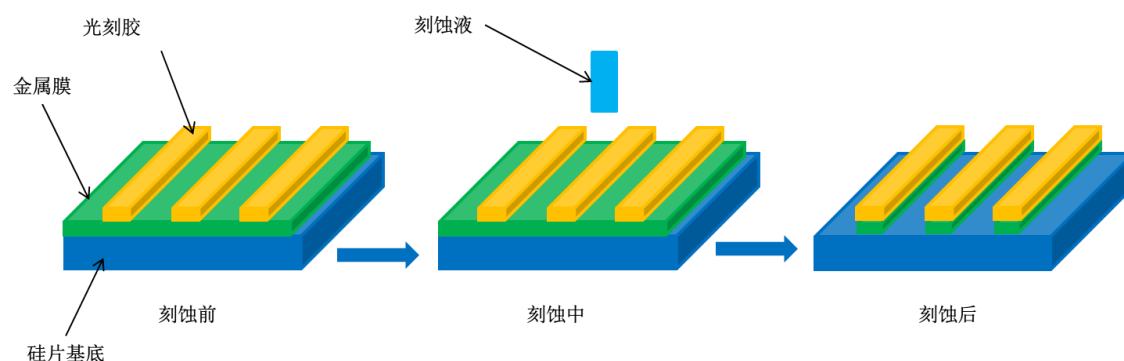
发行人生产的单片式去胶机，主要应用于集成电路制造后道先进封装 Bumping、OLED 等领域，同时也可用于 LED 芯片制造中蒸镀工艺后的金属剥离及回收等工艺，设备主要采用高温、高压化学液喷淋的方式，适用于膜厚 1-130 μm 各种品牌型号的正负性光刻胶的去除，具备化学品喷嘴变速扫描、去胶液回收循环过滤再使用、金属回收等功能。为了配合厚胶的去除，单片处理机台一般也配有浸泡单元，可以同时多个圆片同时浸泡，以提高设备产能。

(3) 湿法刻蚀机

刻蚀是半导体制造工艺中相当重要的步骤，是与光刻相联系的图形化处理的

一种主要工艺。湿法刻蚀主要是利用溶液与预刻蚀材料之间的化学反应来去除未被掩蔽膜材料掩蔽的部分而达到刻蚀目的。湿法刻蚀机是湿法刻蚀工序运用的主要设备，其质量状况直接关系到刻蚀的效果。

图表 16 刻蚀原理示意图



发行人生产的单片式湿法刻蚀机，主要应用于集成电路制造后道先进封装 Bumping、MEMS、OLED 等领域的刻蚀制程，可对 50-300mm 尺寸晶圆中的凸块下金属（UBM）及扇出式再分布层（RDL）等图形进行处理，刻蚀目标材料包括铜（Cu）、钛（Ti）、钨化钛（TiW）、银（Ag）、铝（Al）、钼（Mo）、氧化铟锡（ITO）、氧化铟镓锌（IGZO）等，具备化学品喷嘴变速扫描、刻蚀液回收循环过滤再使用等功能，刻蚀均匀性优于 3%，侧蚀可小于 0.75 μm 。

（二）发行人产品与产业深度融合情况

根据适用晶圆尺寸的不同，发行人产品可进一步细分为 6 英寸及以下单晶圆处理设备（如 LED 芯片制造环节）及 8/12 英寸单晶圆处理设备（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节），其与产业的深度融合情况如下：

1、6 英寸及以下单晶圆处理设备

（1）公司产品在下游产业的应用情况

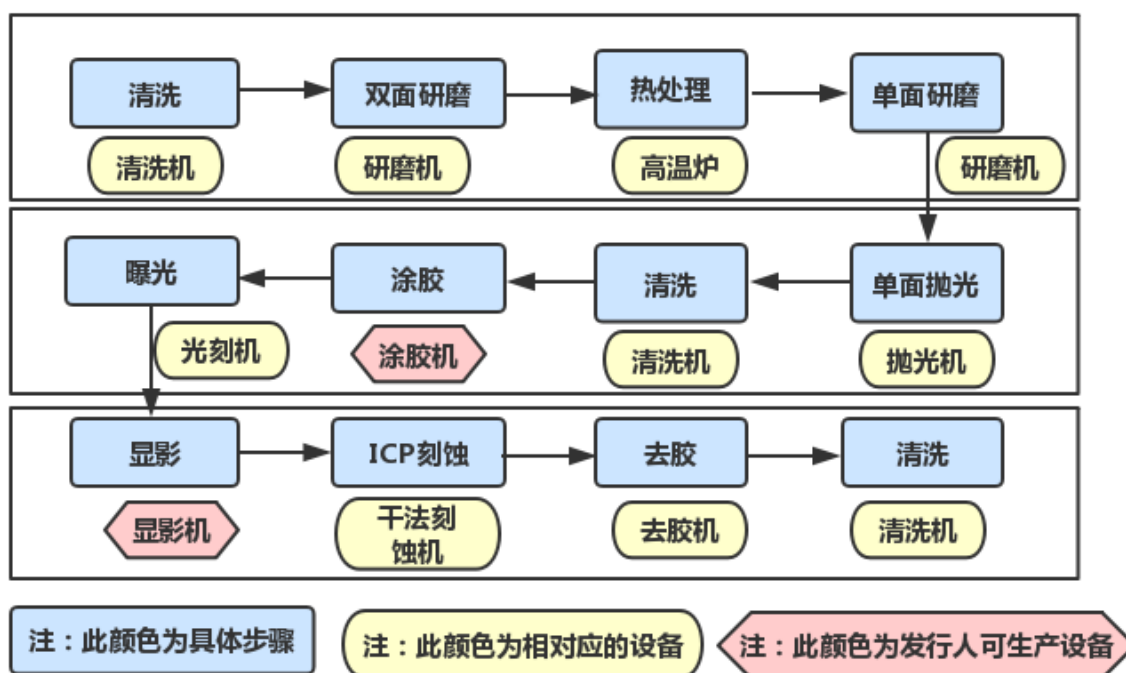
发行人 6 英寸及以下单晶圆处理设备主要用于 LED 芯片制造（包括 LED 芯片图形化蓝宝石（PSS）衬底制备和 LED 芯片晶圆处理）、化合物半导体制造以及功率器件制造。

①LED 芯片 PSS 衬底制备

图形化蓝宝石（PSS）衬底是在蓝宝石衬底上生长干法刻蚀用掩膜，用标准

的光刻工艺将掩膜刻出图形，利用 ICP 刻蚀技术刻蚀蓝宝石，并去掉掩膜，再在其上生长 GaN 材料，使 GaN 材料的纵向外延变为横向外延。其制备流程涵盖涂胶、光刻、显影、蚀刻等环节，需要众多的半导体设备。发行人生产的涂胶/显影机主要用于 PSS 制备中的涂胶/显影环节，具体应用如下图所示：

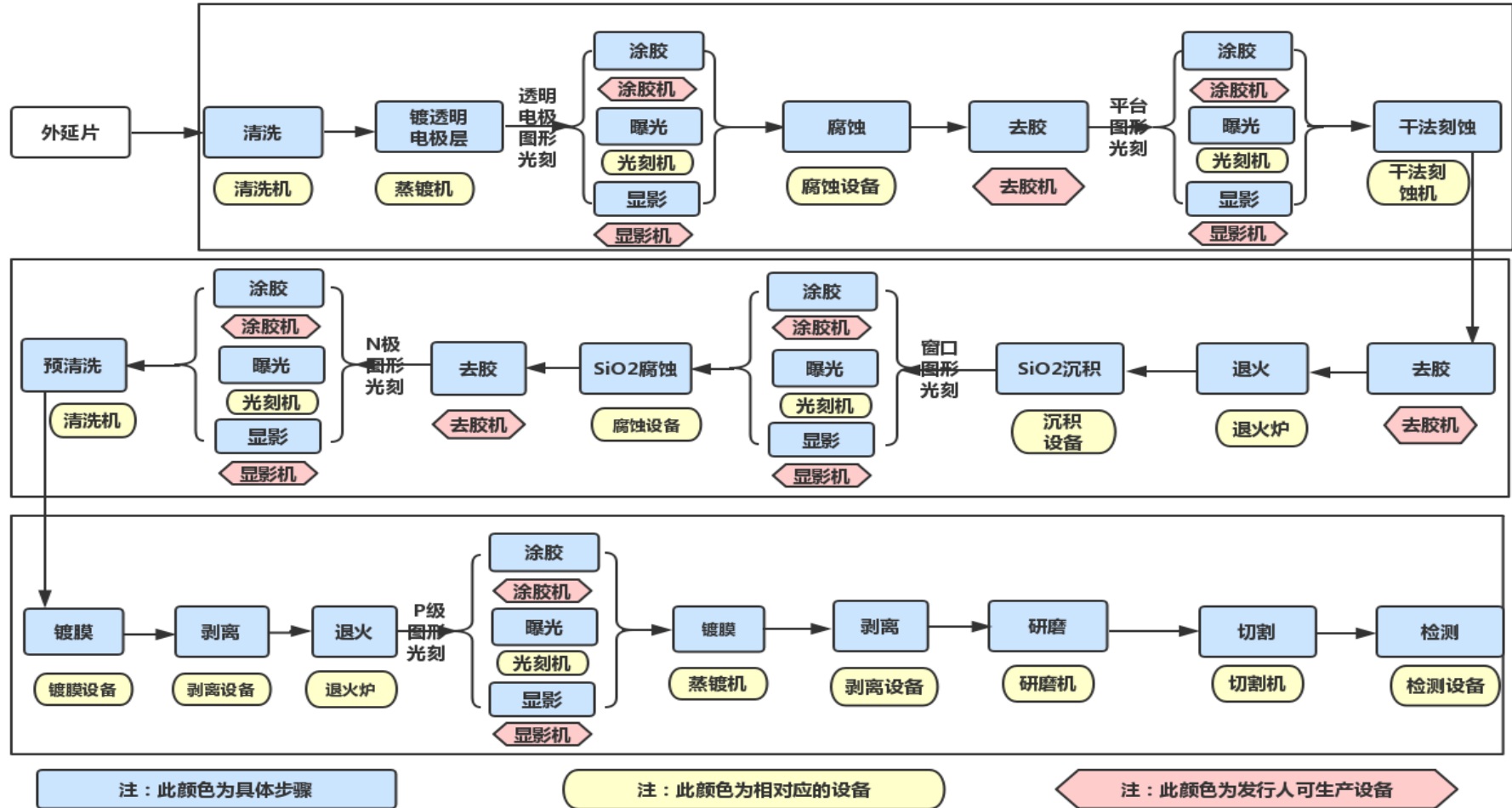
图表 17 公司产品在 LED 芯片 PSS 衬底制备制程中的应用



②LED 芯片晶圆处理

LED 芯片晶圆处理主要是在晶圆上制作电路及电子元件，其处理程序通常与产品种类和所使用的技术有关，但一般基本步骤是先将外延后晶片适当清洗，再在其表面进行氧化及化学气相沉积，然后进行涂膜、曝光、显影、蚀刻、离子注入、金属溅镀等反复步骤，最终在晶圆上完成数层电路及元件加工与制作。发行人生产的涂胶/显影机、去胶机主要应用于 LED 芯片晶圆处理的涂胶/显影以及去胶环节，具体应用如下图所示：

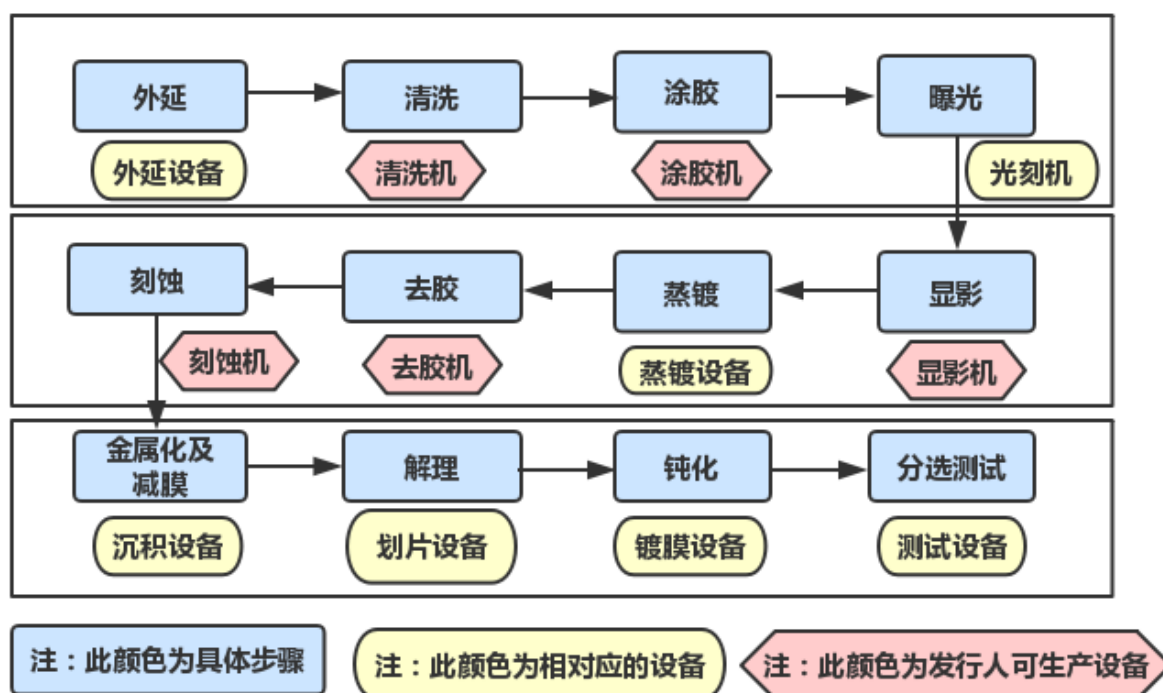
图表 18 公司产品在 LED 芯片晶圆处理中的应用



③化合物半导体与功率器件制造

砷化镓/氮化镓等化合物半导体主要用于 5G、新能源汽车等新兴领域，其制造流程和功率器件制造流程大致相同：先将衬底材料纯化、拉晶、切片后在某种衬底上形成外延层，然后进行清洗、涂胶、曝光、显影、蒸镀等，最后进行分选测试。发行人生产的涂胶/显影机、清洗机、去胶机、湿法刻蚀机主要应用于化合物半导体与功率器件制造的涂胶/显影、清洗、去胶及刻蚀环节。

图表 19 公司产品在化合物半导体和功率器件制造中的应用



(2) 公司产品的市场前景

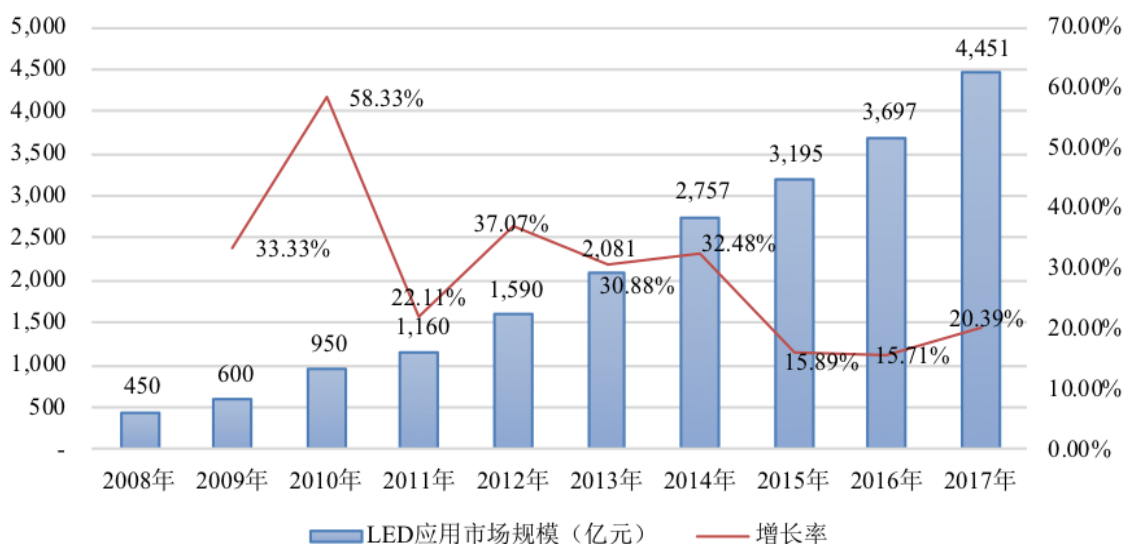
公司 6 英寸及以下单晶圆处理设备市场前景与下游应用领域的发展状况密切相关。

①LED 行业

近年来，随着 LED 产品在各种下游应用领域渗透率的不断提升，我国 LED 应用市场规模持续提升。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）数据，2017 年我国 LED 应用市场规模 4,451 亿元，相比较 2008 年 450 亿元，规模增加近 10 倍，年均复合增长率高达 25.8%。随着 LED 下游行业需求的持续增长，对 LED 芯片的需求也持续增长，根据高工产研 LED 研究所(GGII)的数据，2018 年

我国 LED 芯片行业产值规模（不包括中国台湾地区）达到 191 亿元，同比增长 1.6%，占全球 LED 芯片产值比例为 39.8%。2019 年，随着乾照光电、兆驰半导体、华灿光电产能持续释放，我国 LED 芯片行业产值及市场占比将进一步提高，GGII 预计 2019 年中国 LED 芯片产值规模将达到 200 亿元，全球 LED 芯片市场将进一步向中国集中，这将为我国 LED 芯片制造设备行业带来新的市场机遇。

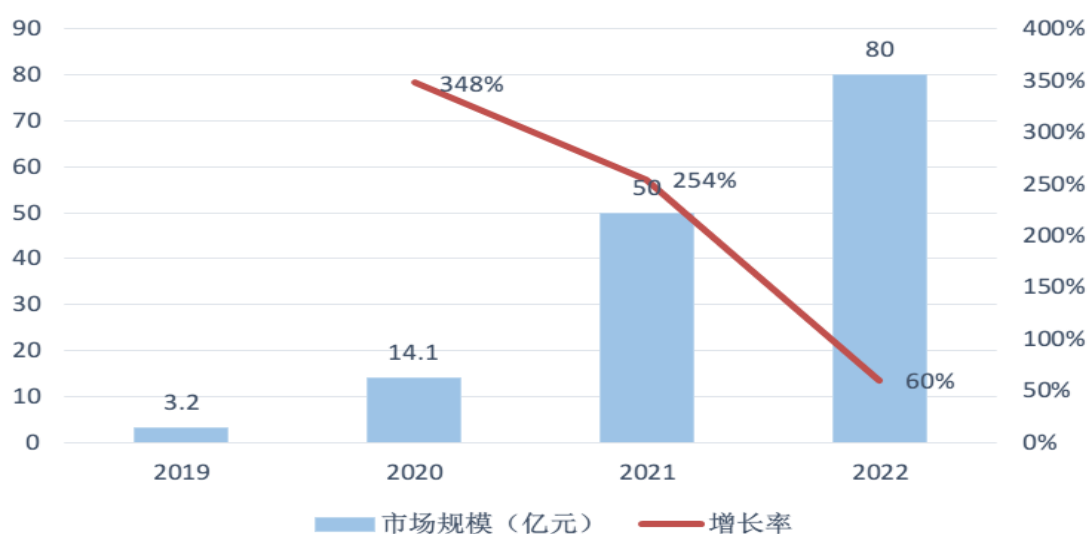
图表 20 2008-2017 年我国 LED 应用行业市场规模及增长率



数据来源：CSA，天风证券研究所

此外，作为显示技术和 LED 发光技术结合的复合集成技术，Micro LED 拥有自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性等诸多优点，具有广阔的市场前景，被视为可能颠覆产业的新一代显示技术。近年来国内外科技企业、LED 企业、面板厂等纷纷加大对 Micro LED 的布局，Micro LED 的技术、市场有望迎来快速发展。据 GGII 预计，Micro LED 将在 2020 年迎来爆发性增长，2020 年全球市场规模有望达到 14.1 亿元，2022 年将达到 80 亿元。

图表 21 2019-2022 年全球 Micro LED 市场规模与增速预测



数据来源：高工产研 LED 研究所(GGII)

②化合物半导体行业

化合物半导体因其在射频电子和电力电子方面的优良性能，以及在 5G 通信和新能源汽车等新兴市场的价值，被认为是半导体行业的重要发展方向。根据美国市场研究机构 Strategic Analytics 预测，2020 年全球化合物半导体的市场规模将达 440 亿美元，年复合增速达 12.9%，增速大幅超过整个半导体产业。目前我国已成为全球最大的化合物半导体应用市场。我国已建成全球最大的 4G 通信网络，基站数量超过 200 万，并计划在 2019 年开始启用 5G 通信，华为、OPPO、小米、vivo 是全球前六大的智能手机企业，每年出货量近 5 亿部。2017 年国内新能源汽车产销分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比增长 53.8% 和 53.3%，比亚迪、北汽、上汽、吉利、蔚来等在新能源汽车领域开始发力，比亚迪和北汽的两款车型包揽了 2017 年全球新能源汽车销量的前 2 名。随着化合物半导体在 5G、物联网、能源、国防军工等领域发展不断加速，在国内发展集成电路的背景下，化合物半导体受到地方政府和产业资本的热捧，为我国化合物半导体设备行业的发展提供契机。

③功率器件行业

功率器件是电子装置电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电压和频率，或将直流转换为交流，交流转换为直流等的电力转换，也可精准地将发动机

从低速到高速的循环运转，或用于太阳能电力转送至电站，或给各家电、电器等提供安定的电源，同时具有节能的功效。因此，功率器件可用于几乎所有的电子制造业，涵盖新能源（风电、光伏、电动汽车）、消费电子、智能电网、轨道交通等行业领域。近年来，我国功率器件市场规模不断扩大。根据赛迪顾问统计数据显示，2016年我国功率器件（包括功率 IC 和功率模组）的市场规模为 1,494.5 亿元，2017 年市场规模达到 1,611.1 亿元，同比增长 7.80%，我国已成为全球最大的功率器件市场。赛迪预计我国功率器件市场规模未来三年复合增长率达到 7.83%，高于全球平均增速。随着功率器件在电源管理行业应用越来越广泛以及在数据中心、5G、新能源等领域的应用拓展，未来我国功率器件市场前景广阔。

2、8/12 英寸单晶圆处理设备

（1）公司产品在下游产业的应用情况

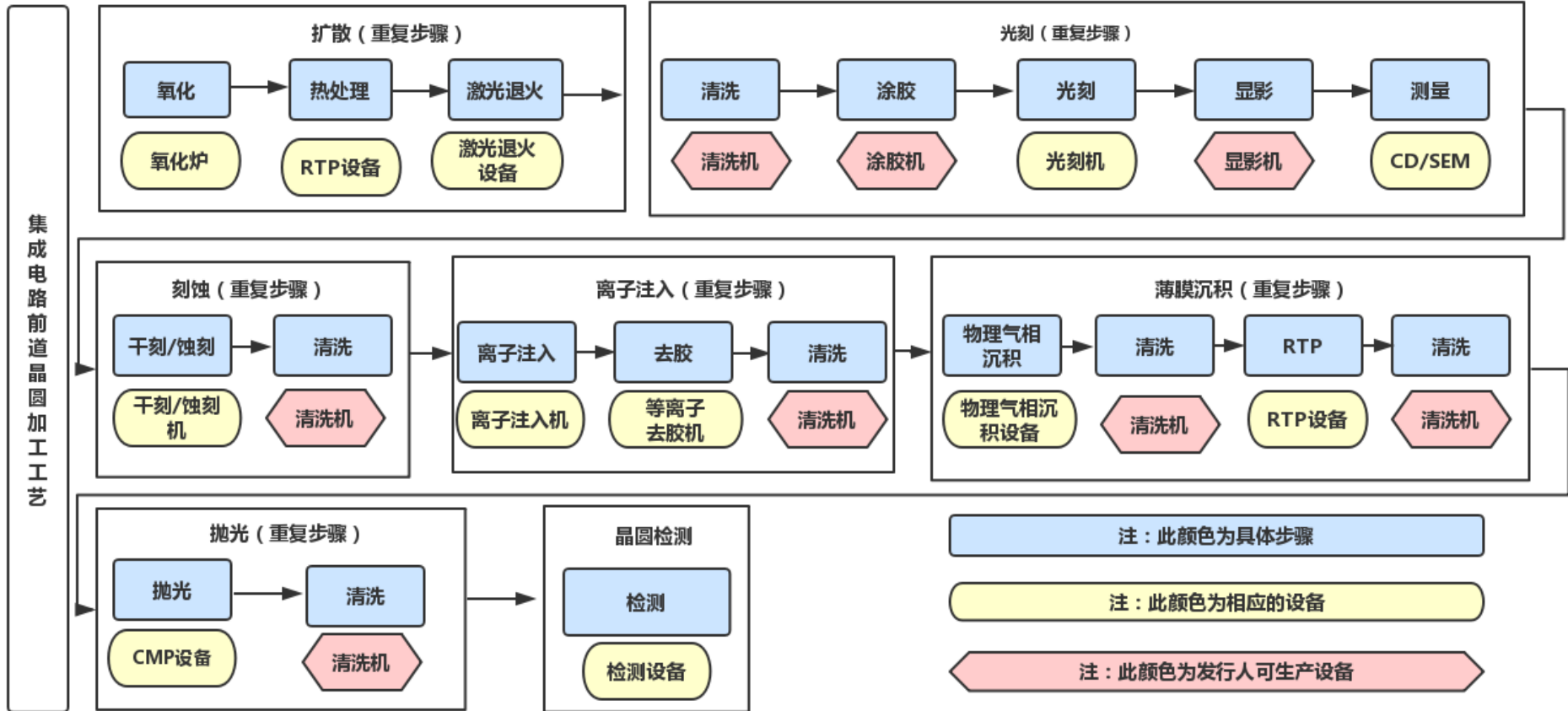
集成电路制造需要上千道工序，可以分为前道工艺和后道工艺。前道工艺以单晶硅片的加工为起点，以在单晶硅片上制成各种集成电路元件为终点；后道工艺即封装测试环节，以最终制成集成电路产品为终点。

①公司产品在集成电路制造前道晶圆加工工艺中的应用

集成电路制造前道晶圆加工工艺较为复杂，其主要工艺流程包括氧化、清洗、涂胶、光刻、显影洗胶、刻蚀、去胶、离子注入、薄膜沉积、化学机械研磨等，晶圆处理精度一般在几纳米至几微米，对加工设备精度要求极高，其中部分工序需要循环进行多次，需要用到大量的半导体设备。

发行人作为我国主要的半导体设备制造商之一，生产的前道产品涵盖涂胶/显影、清洗环节，其中前道 I-line 涂胶显影机已在国内知名晶圆厂长江存储上线进行工艺验证，可满足客户 0.18 μm 技术节点加工工艺；前道 Barc（抗反射层）涂胶设备已在上海华力上线测试应用，可满足客户 28nm 技术节点加工工艺；前道单片式清洗机已通过中芯国际（深圳厂）的技术测试验证，目前已经上线应用。

图表 22 公司产品在集成电路制造前道晶圆加工工艺中的应用

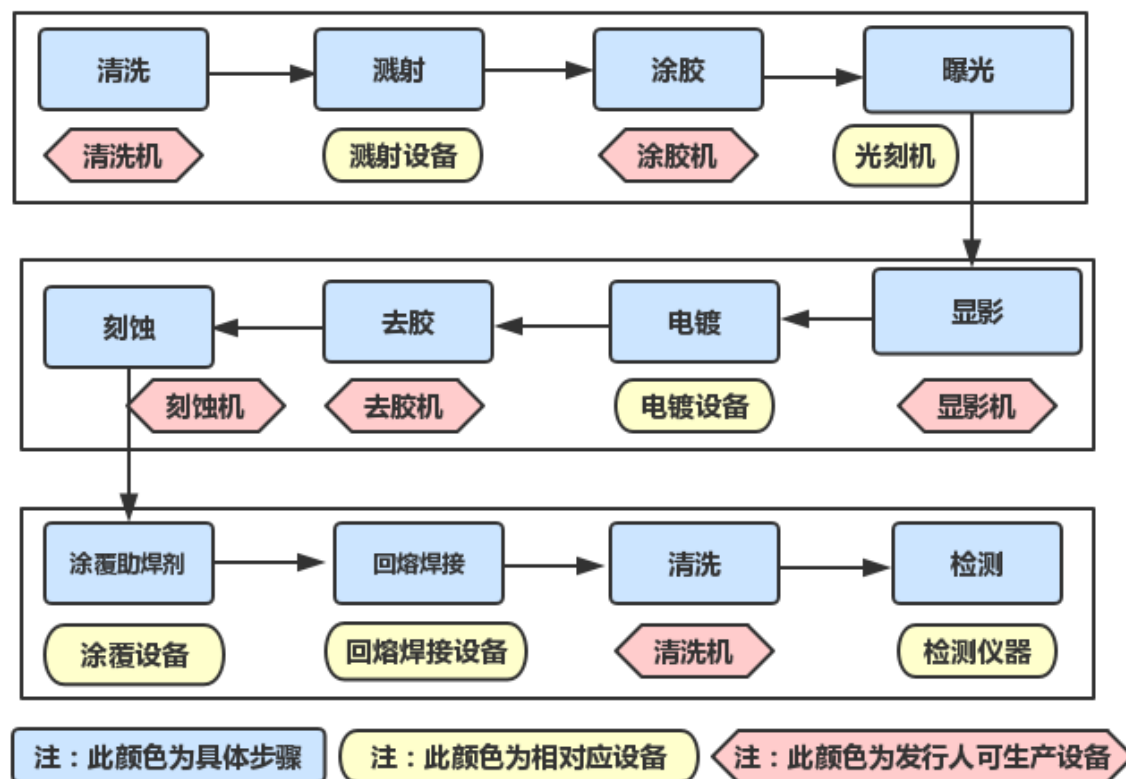


②公司产品在集成电路制造后道先进封装工艺中的运用

封装是集成电路生产的重要组成部分，主要起着安放、固定、密封、保护芯片以及确保电路性能和热性能等作用。从技术层面看，封装可分为传统封装和先进封装。传统封装主要包括单列直插封装（SIP）、双列直插封装（DIP）、小外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形式，先进封装涵盖带有倒装芯片结构的封装（FC）、圆片级封装（WLP）、2.5D 封装、3D 封装等。在摩尔定律发展脚步迟缓的情况下，传统封装已无法满足现代集成电路应用需求。随着电子产品趋向于功能化、轻型化、小型化、低功耗和异质集成，先进封装技术正被越来越多地应用到电子产品，下游芯片生产厂商对先进封装设备的需求正不断增强。

发行人作为我国主要的半导体设备制造商之一，其生产的涂胶/显影机、湿法刻蚀机、去胶机、清洗机已成功应用于 Bumping、WLCSP、Fanout 等集成电路制造后道先进封装工艺的涂胶、显影、刻蚀、去胶以及清洗环节。

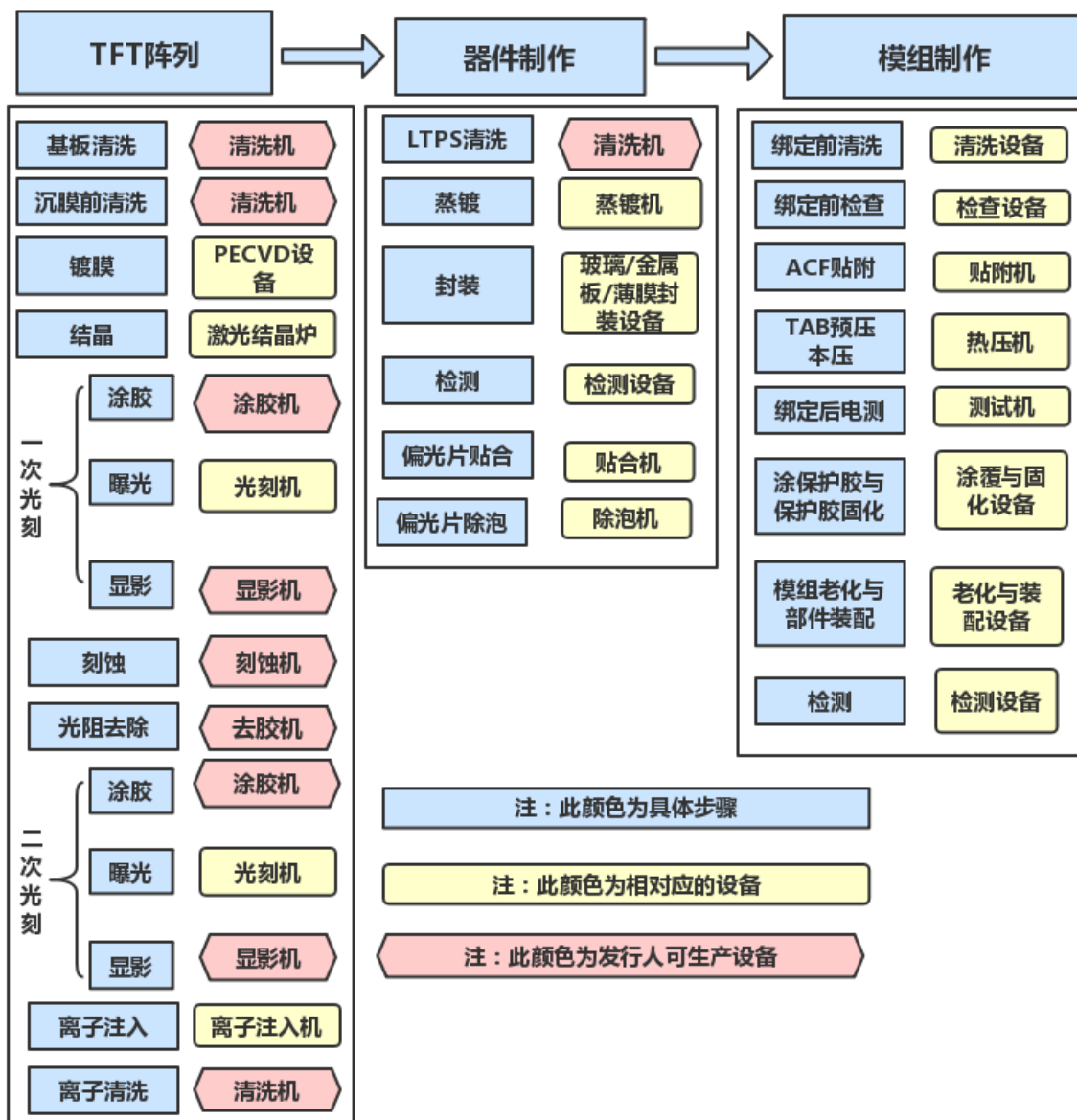
图表 23 公司产品在集成电路后道先进封装工艺中的应用



③公司产品在圆片级 OLED 制造工艺中的应用

OLED 制造工艺可分为三个步骤：TFT 阵列、器件制作、模组制作，整个制造过程需要配套众多的半导体设备。发行人作为我国主要的半导体设备制造商之一，其生产的清洗机、涂胶/显影机、去胶机、湿法刻蚀机可应用于 OLED 制造工艺的清洗、涂胶/显影、去胶、刻蚀环节，未来还可用于硅基 OLED 制造领域。

图表 24 公司产品在 OLED 制造工艺中的应用



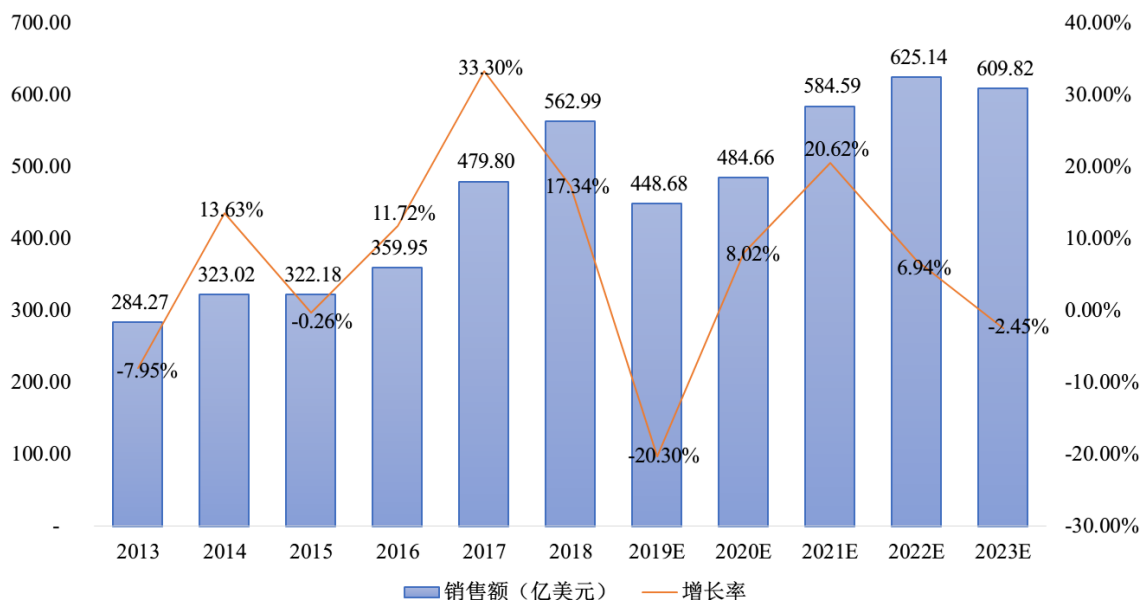
(2) 公司产品的市场前景

A、8/12 英寸单晶圆处理设备市场规模

随着 AI 芯片、5G 芯片、汽车电子、物联网等下游应用领域的兴起，全球半导体行业重回景气周期，下游半导体制造厂商对半导体设备的需求不断增长。根

据 VLSI 提供的行业数据，全球晶圆厂设备销售额由 2013 年的 284.27 亿美元增长到 2018 年的 562.99 亿美元，年复合增长率达 14.64%，预计 2023 年全球晶圆厂设备销售额将达到 609.82 亿美元。

图表 25 2013-2023 年全球晶圆厂设备销售额

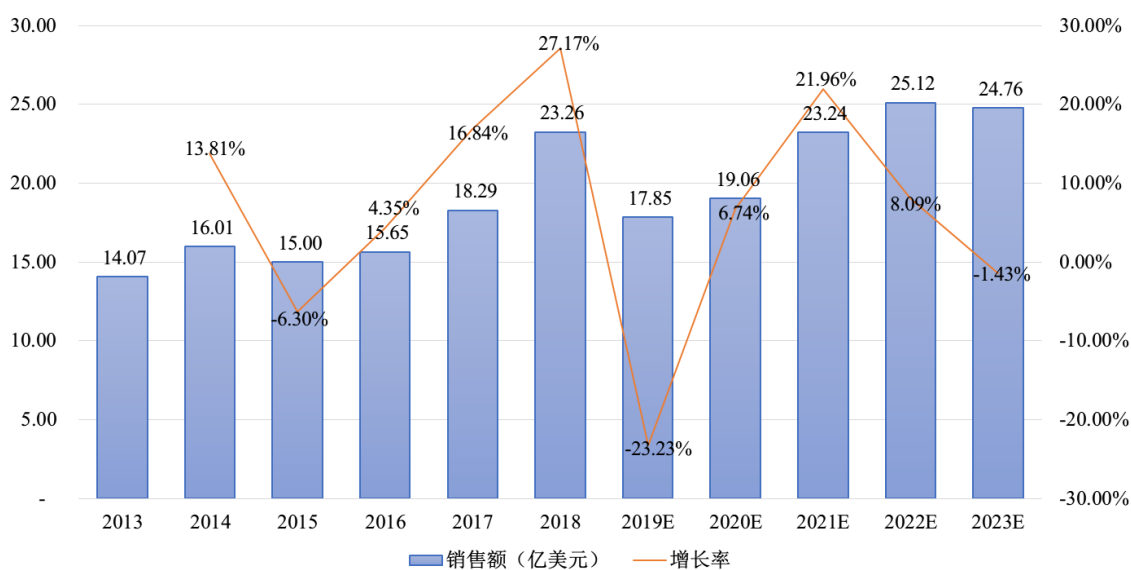


数据来源：VLSI

a) 集成电路制造前道涂胶显影及单片式清洗设备市场规模

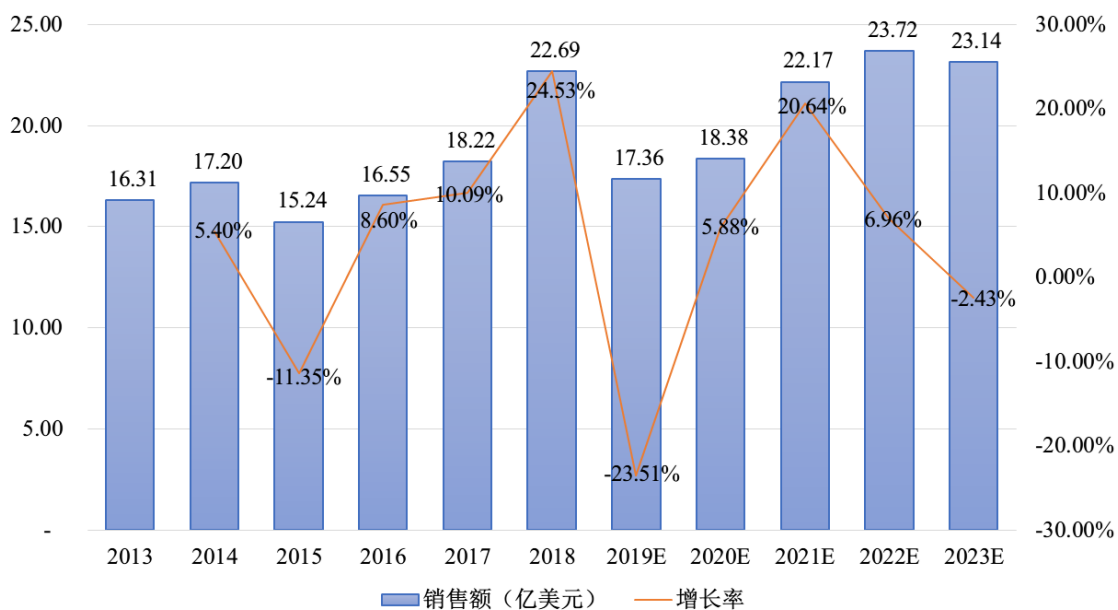
作为集成电路制造前道晶圆加工环节的重要工艺设备，前道涂胶显影设备及前道单片式清洗设备在晶圆厂设备采购中占有十分重要的地位。近年来随着全球晶圆厂设备采购的不断推进，全球前道涂胶显影设备及单片式清洗设备销售额整体呈现增长态势。根据 VLSI 提供的行业数据，全球前道涂胶显影设备销售额由 2013 年的 14.07 亿美元增长至 2018 年的 23.26 亿美元，年均复合增长率达 10.58%，预计 2023 年将达到 24.76 亿美元；全球前道单片式清洗设备销售额由 2013 年的 16.31 亿美元增长至 2018 年的 22.69 亿美元，年均复合增长率达 6.83%，预计 2023 年将达到 23.14 亿美元。

图表 26-1 2013-2023 年全球前道涂胶显影设备销售额



数据来源: VLSI

图表 26-2 2013-2023 年全球前道单片式清洗设备销售额



数据来源: VLSI

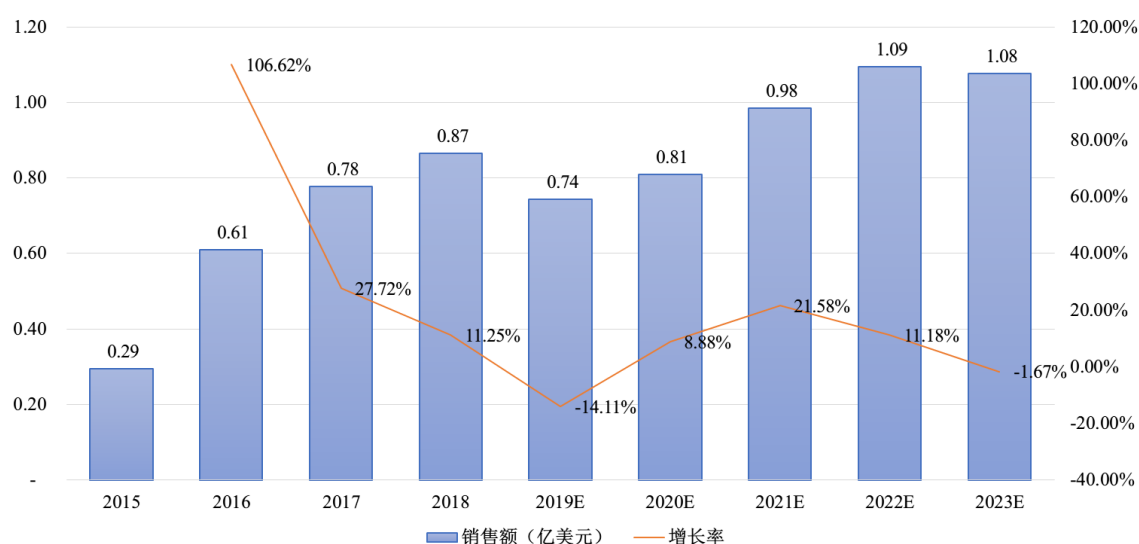
根据 VLSI 提供的行业数据, 中国大区(含中国台湾地区)前道涂胶显影设备销售额由 2016 年的 8.57 亿美元增长到 2018 年的 8.96 亿美元, 预计 2019 年将有所下降, 2020 年重回上升轨道, 2023 年将将达到 10.26 亿美元; 中国大区(含中国台湾地区)前道单片式清洗设备销售额已经由 2016 年的 6.14 亿美元增长至 2018 年的 7.54 亿美元, 年均复合增长率达 10.86%, 预计 2019 年将有所下降, 2020 年重回上升轨道, 2023 年将将达到 8.26 亿美元。

b) 集成电路制造后道先进封装环节用涂胶显影设备市场规模

随着电子产品趋向于功能化、轻型化、小型化、低功耗和异质集成，先进封装技术正被越来越多地应用到电子产品，下游芯片生产厂商对先进封装设备的需求正不断增强。根据 VLSI 提供的行业数据，全球集成电路后道先进封装类设备销售额由 2015 年的 12.63 亿美元增长到 2018 年的 16.10 亿美元，年复合增长率达 8.42%，预计 2023 年将达到 20.21 亿美元。

作为集成电路制造后道先进封装环节不可或缺的重要工艺设备，全球后道涂胶显影设备销售额整体呈现增长态势。根据 VLSI 提供的行业数据，全球后道涂胶显影设备销售额由 2015 年的 0.29 亿美元增长至 2018 年的 0.87 亿美元，年均复合增长率达 43.19%，预计 2023 年将达到 1.08 亿美元。

图表 27 2013-2023 年全球后道涂胶显影设备销售额



数据来源：VLSI

根据 VLSI 提供的行业数据，中国大区（含中国台湾地区）后道涂胶显影设备销售额已经由 2016 年的 0.45 亿美元增长到 2018 年的 0.61 亿美元，年均复合增长率达 17.23%，预计 2019 年中国大区（含中国台湾地区）后道涂胶显影设备销售额将有所下降，2020 年重回上升轨道，2023 年将将达到 0.81 亿美元。

B、8/12 英寸单晶圆处理设备市场前景

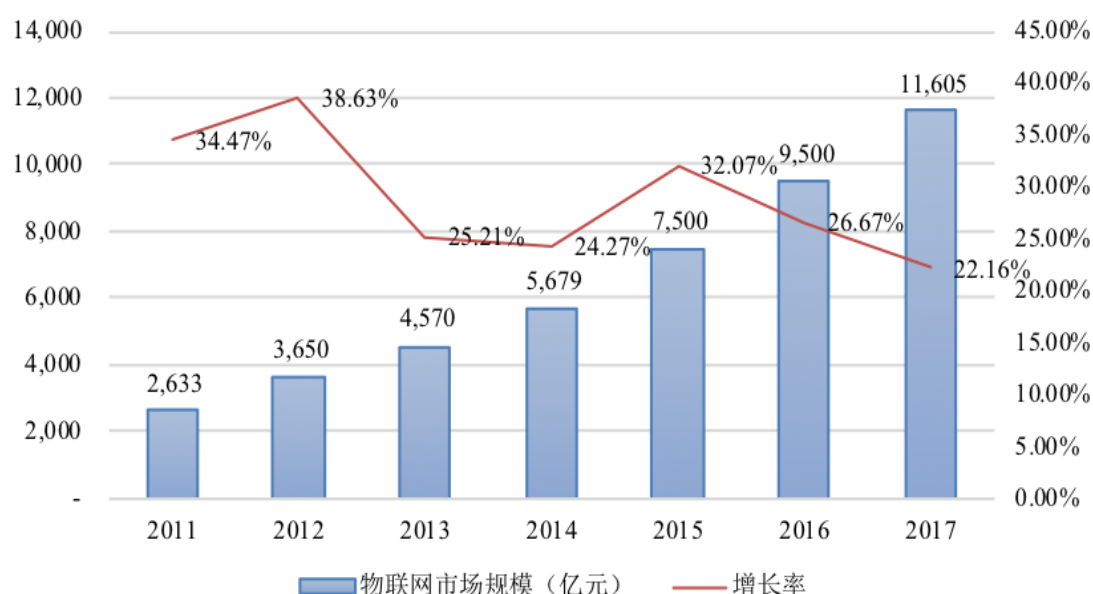
下游晶圆厂作为半导体设备的需求方，其发展依赖半导体的终端市场应用状况。未来半导体主要应用于物联网、人工智能、5G、OLED、汽车电子等新兴领

域，因此下游应用领域的发展状况在一定程度上代表了半导体设备的市场前景。

a) 物联网领域

物联网是以互联网为基础实现的物物相息，智能感知、智能识别等技术是实现物物相息的基础，与之相对应的安全芯片、通讯射频芯片、身份识别芯片、移动支付芯片等半导体器件需求量大。自政府将物联网作为首批加快培育战略性新兴产业以来，我国物联网发展迅速。2011年-2017年我国物联网市场规模自2,633亿元迅速增加至11,605亿元。根据《信息通信行业“十三五”发展规划物联网分册》，预计2020年国内物联网总体产业规模将突破1.5万亿，公众网络M2M连接数将突破17亿。

图表 28 2011-2017 年我国物联网市场规模（亿元）



数据来源：wind 资讯、国海证券研究所

b) 人工智能领域

人工智能是用计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为，人工智能可以处理复杂的数据，但需要众多芯片的支持。近年来，在国家政策的支持与推动下，我国人工智能市场规模不断扩大。根据中国信息通信研究院发布的《2017年中国人工智能产业数据报告》，2017年我国人工智能市场规模达到216.9亿元，比2016年增长52.8%，预计2018年市场规模有望达到339亿元，增速达到56.3%。国务院和工信部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020

年)的通知》提出：2020年我国人工智能核心产业规模超过1,500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。

c) 5G 领域

5G网络的变革在进一步提高通讯传输速度的同时，更加强调连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠和低功率大连接等场景下的技术需求，需要海量的新型半导体产品支撑。近年来国家大力支持5G产业发展。工信部印发的《信息通信行业发展规划（2016-2020）》明确提出5G是我国信息通信行业“十三五”期间重点研发和规划工程，将在“十三五”期间构建5G试商用网络，打造系统、芯片、终端、仪表等完整产业链。同时国家发改委发布《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》进一步为推进5G商用加码。中国移动、中国联通和中国电信则紧跟规划脚步，计划将于2018年在上海、杭州、深圳等16城市进行试点商用。目前联发科、台积电等均在推进5G芯片研发，5G的应用推进将在移动智能设备端带来革命性的更新需求。根据英飞凌预测，到2020年，全球将500亿台设备进行5G连接。

图表 29 国内 5G 试点商用城市

运营商	试点城市
中国移动	北京、青岛、天津、福州、杭州、武汉、南京、贵阳、沈阳、郑州
中国联通	北京、青岛、天津、福州、杭州、武汉、南京、贵阳、沈阳、郑州、兰州、上海、雄安、深圳、成都、广州
电信	雄安、深圳、上海、兰州、成都、苏州

资料来源：中国移动、中国联通、中国电信官网、国海证券研究所整理

d) OLED 领域

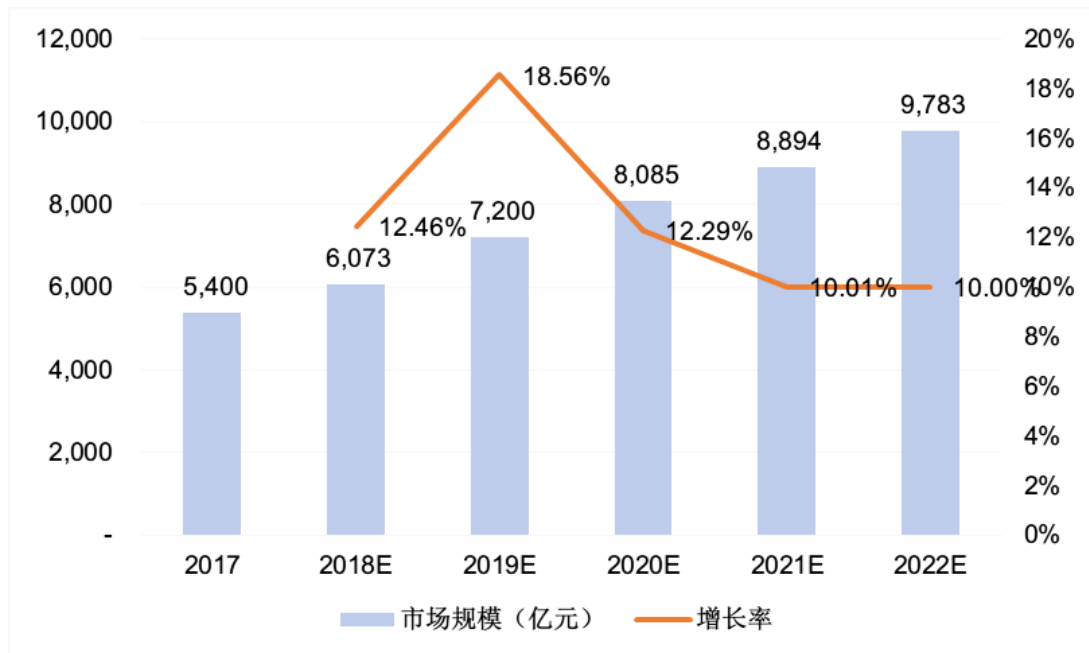
OLED作为新一代显示技术，显示结构简单、耗材环保，且OLED显示具有柔性可卷曲的特点，规模化量产后更有可能具备低成本普及的优势，逐步得到越来越多生产商的青睐。作为OLED产业的重要发展方向，OLED微型显示正越来越多地被应用于以智能穿戴设备为代表的新兴显示领域。相较于普通OLED显示器件以玻璃为背板，OLED微显示器件采用单晶硅晶圆为背板，除具有OLED自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高等特性外，更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼镜式显示器等智能穿戴设备领域。

根据 IDC 提供的数据显示, 2018 年全球智能穿戴设备出货量预计将达 1.253 亿部, 较上一年增长约 8.5%。同时, IDC 预测, 新兴市场对智能穿戴设备的消费将越来越多, 智能穿戴设备未来 5 年年复合增长速度将达到 11%, 2022 年出货量将跃升至 1.8990 亿部。据中商产业研究院发布的《2018-2023 年中国可穿戴产业市场前景及投资机会研究报告》数据显示, 2017 年中国智能可穿戴市场规模达到 352.6 亿元, 增长率达到 35.7%。随着可穿戴行业技术的逐步成熟、产业的推广普及, 预计 2018 年中国可穿戴市场将进一步扩大, 市场规模达到 446.0 亿元, 增长率为 26.5%。IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告, 2018 年第一季度》显示, 2018 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 1,200 万台, 同比增长 15.9%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长 5.5%, 而智能可穿戴设备同比增长高达到 105.5%。未来, 随着 AI(人工智能)、VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等技术的逐渐成熟和普及, 智能穿戴设备将探索全新的人机交互方式, 未来市场前景广阔。

e) 汽车电子领域

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称, 由传感器、微处理器 MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成电控系统, 其最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。近年来, 随着我国汽车销量的不断提升以及汽车电子的渗透率持续提升, 国内汽车电子市场持续快速发展。根据 choice 统计数据显示, 2010 年-2016 年我国汽车电子市场规模从 328 亿美元快速增长至 740.6 亿美元, 年复合增长率为 14.54%。随着互联网、计算机和智能机器人等各种新技术不断渗透及融合于汽车领域, 汽车将不断地往智能化方向发展, 这必将给汽车电子产业带来更加广阔的发展空间。根据盖世汽车研究院预测, 2017 年-2022 年我国汽车电子市场将以 10.6% 速度增长, 增速超过全球, 2020 年我国汽车电子市场规模将超过 8,000 亿元。

图表 30 2017-2022 年我国汽车电子市场规模及增长率



数据来源：中国产业信息，盖世汽车研究院综合整理

五、发行人市场地位及竞争情况

(一) 发行人产品技术水平和技术特点

1、光刻工序涂胶显影设备

公司生产的光刻工序涂胶显影设备可与光刻机设备联机作业或者独立作业，工艺范围涵盖 LED 芯片制造、集成电路制造后道先进封装环节以及前道晶圆加工环节的 I-line、KrF、ArF 等制程工艺。根据不同工艺需求，可搭载不同的温湿度控制模块以及相应的涂胶和显影模块，同时，根据客户对产能要求的高低，公司开发出了单机械手平台和多机械手平台，可以根据客户需求灵活配置，从而提高产品性价比。

作为国产光刻工序涂胶显影设备的代表，在集成电路制造后道先进封装领域和 LED 芯片制造等领域，公司涂胶显影设备技术相对成熟，已批量应用于公司现有产品，并作为主流机型成功打入包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌等在内的多家国内知名一线大厂；在集成电路制造前道晶圆加工领域，公司已开发出成型产品并在长江存储（0.18 μm In Line）、上海华力（28nm Off Line）等国内一线大厂进行工艺验证。

但仍应看到，目前国内集成电路制造前道涂胶显影设备技术水平与国外相比仍有较大差距，该类设备的市场和工艺技术长期以来均被国外厂商如日本东京电子所把持，特别是 28nm 及以下节点的 ArFi 浸没式涂胶显影设备，我国目前尚未掌握此项技术。

2、单片式湿法设备

单片式湿法设备包含的范畴比较广，包括刻蚀机、去胶机、清洗机等，市场中各个技术等级的产品繁多。

(1) 刻蚀机

随着超大规模集成电路的器件特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，对刻蚀工艺的控制及其工艺结果的精确度提出了更高的要求。利用刻蚀技术形成各种刻蚀图案，如接触孔、通孔图形、沟槽隔离图形或栅极图形，如果因控制不当使刻蚀图形的特征尺寸出现偏差，则将直接影响到电路的性能，降低产品的成品率。刻蚀工艺通常位于光刻工艺之后，有图形的光刻胶层在刻蚀中不会受到腐蚀源的显著侵蚀，从而完成图形转移的工艺步骤。

刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀，湿法刻蚀通过化学试剂去除晶圆表面材料，通常用于工艺尺寸较大的应用，或用于干法刻蚀后清洗残留物等。湿法刻蚀已成为现代半导体制造中不可或缺的一道工艺。湿法刻蚀在芯片制造过程中主要作用是非选择性刻蚀某些特定的薄膜以及清洗晶圆，以减少晶圆的污染和缺陷。

发行人生产的单片式湿法刻蚀机采用可变速摆臂喷洒化学液，同时利用高精度的流量检测和控制技术、多级稳压技术以及在线温度检测及控制技术，对工艺所用的化学品流量、压力及温度等参数进行精准控制以满足多种刻蚀工艺要求，进而有效地提高刻蚀均匀性，降低侧蚀效应；通过分层式反应腔体设计以及内外 Cup 升降配合阀切换等方式实现药液的分类，可实现在同一腔体中喷洒多种化学液，节约化学液。目前广泛应用于集成电路后道先进封装制程中的湿法刻蚀环节。

(2) 去胶机

在半导体制造工艺中，光刻胶只是起到图形转移的媒介作用，因此在完成图形转移后，需要将光刻胶完全去除，以避免残留的光刻胶影响后续工艺的质量。

发行人在利用已掌握的刻蚀设备相关成熟技术的基础上，开发出适合膜厚1-130微米各种正负性光刻胶去除及适用于金属剥离的去胶机，在研发过程中，解决了浸泡单元技术，在浸泡单元中引入了鼓泡技术、化学液溢流技术以及片盒垂直翻转等关键技术，达到了提高光刻胶去除效率和晶圆安全性的效果，提升了去胶机的整体性能，得到了客户认可。

（3）清洗机

半导体制造中不可避免会引入一些颗粒、有机物、金属和氧化物等污染物，随着芯片特征尺寸的不断缩小，半导体对杂质含量越来越敏感，因此对晶圆清洗的要求不断提高。

目前晶圆清洗技术大致可分为湿式与干式两大类，仍以湿式清洗法为主流，主要是通过去离子水、清洗剂（如有机溶剂与去离子水之混合物）等清洗晶圆表面，随后加以湿润再干燥的程序。

目前行业内先进单片式颗粒清洗技术主要集中在高压喷淋、多流体喷嘴和兆声波清洗方面。高压喷淋清洗技术，是利用增压泵对去离子水或其他相关清洗液进行增压，通过增压后液体的较大冲击力克服晶圆表面污染物的附着力，从而将污染物剥离、冲走，并在高速旋转晶圆离心力作用下被液体甩出晶圆表面，达到清洗目的；多流体喷射技术是通过生成粒径分布集中的液体微滴并能够以可控的速度喷向晶圆表面，以便通过动能转换将晶圆表面的颗粒污染物冲击松动并通过晶圆旋转将颗粒随着液体甩出晶圆表面，以此达到清洁晶圆的效果；单片式兆声波清洗技术通过喷嘴形成从喷嘴到晶圆表面的连续液流，兆声波使得晶圆与喷嘴间的液体产生“空化效应”，形成大量微小气泡，气泡的爆炸对液体产生瞬间加速，被加速的液体冲击晶圆表面颗粒，通过声压波动的物理方法使颗粒污染物从晶圆表面脱离并通过晶圆旋转将颗粒随着液体甩出晶圆表面，以此达到清洁晶圆的效果。

发行人生产的清洗机通过自主研发的二流体喷嘴技术可将附着在晶圆表面的细微颗粒污染物去除，去除率超过95%，通过大量仿真与工艺试验相结合，优化出最佳的清洗工艺参数，确保不损伤晶圆表面的图形；对于微米级别大颗粒，采用特殊材料的毛刷或高压喷淋对晶圆进行擦洗去除，配合特有的晶圆翻转装置

和夹持式承片台，可在同一台设备中实现对晶圆的正反两面进行清洗。此外针对不同晶圆尺寸，采用创新的兼容设计，实现工艺腔体、晶圆承载平台（chuck）、对中等核心单元在少更换甚至不更换硬件的情况下迅速满足客户的兼容性。

（二）发行人同行业竞争对手

在光刻工序涂胶显影设备领域，除发行人外，主要企业还有日本东京电子（TEL）、日本迪恩士（DNS）、德国苏斯微（SUSS）、台湾亿力鑫（ELS）、韩国CND等；在单片式湿法设备领域，除发行人外，主要企业还有日本迪恩士（DNS）、美国固态半导体（SSEC）、盛美半导体（ACM Research）等，具体情况如下：

1、涂胶/显影设备领域

日本东京电子（TEL）：该公司成立于1963年，系东京证券交易所上市公司（股票代码：8035），主要从事半导体设备的研发、生产和销售，其主要产品包括涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备及测试设备等。

日本迪恩士（DNS）：该公司成立于1868年，系东京证券交易所上市公司（股票代码：7735），主要从事半导体制造设备、图像情报处理机器、液晶制造设备及印刷电路板设备的研发、生产和销售业务，其半导体制造设备主要包括清洗设备、涂布/显影设备、退火设备等。

德国苏斯微（SUSS）：该公司成立于1949年，系德国证券交易所上市公司（股票代码：SMH），核心业务是光刻解决方案及晶圆片键合，主要产品包括高精度光刻设备（如光刻机、旋涂机、喷胶机等）及大规模封装市场用键合机等。

台湾亿力鑫 ELS：该公司成立于2005年，专注于制造小尺寸全自动黄光制程量产设备，主要产品包括光阻涂布设备、曝光设备、光罩清洗设备、显影设备、金属/光阻剥离设备等。

韩国CND：该公司成立于2005年，专注于设计制造全自动黄光设备，主要产品包括涂胶/显影设备、喷胶设备等。

2、湿法设备领域

日本迪恩士（DNS）：简介见上文。

日本东京电子（TEL）：简介见上文。

美国固态半导体（SSEC）：主要为先进封装（包含 2.5D 及 3D-ICs）、MEMS 及化合物半导体等领域提供单晶圆湿法处理设备，2014 年被美国纳斯达克上市公司美国维易科（Veeco）收购，美国维易科（Veeco）主要从事薄膜加工设备的设计、制造和销售，其主要产品包括 MOCVD、先进封装领域光刻设备、晶圆检测系统等。

盛美半导体（ACM Research）：该公司成立于 2005 年，位于上海，系美国纳斯达克股票交易所上市公司（股票代码：ACMR），主要从事单晶片湿式清洗设备的研发、生产和销售业务。

（三）发行人优势与劣势

1、发行人优势

（1）优秀的研发技术团队与完善的专业平台

发行人建有较为完善的人才培养体系，通过承担国家重大专项及地方重大科研任务、开展专题技术培训等方式培养了半导体设备的设计制造、工艺制程、软件开发与应用等多种学科人才。公司以宗润福董事长兼总经理为技术带头人，立足自主培养并积极引进国内外高级技术人才，核心研发技术团队经验较为丰富，技术水平较高，能紧密跟踪国际先进技术发展趋势，具备较强的持续创新能力。

此外，为推动技术研发与创新，发行人设置有专业的集成电路工艺开发和检测实验室，引进国内外先进研发设备与软件，聘请高端半导体专业技术人才，已初步形成较为完善的专业平台进行产品工艺研发与测试，为公司深入了解下游行业的需求，紧密把握下游应用产业技术发展的最新动向和发展趋势，保持技术领先优势奠定坚实的基础。

（2）丰富的技术储备

发行人高度重视新技术、新产品和新工艺的研发工作，近几年，发行人研发

费用投入一直处在较高水平，报告期各期，发行人研发投入金额分别为 1,659.24 万元、1,975.81 万元、3,421.45 万元和 595.32 万元，分别占当期营业收入的 11.24%、10.41%、16.29%和 57.77%。

通过多年的技术积累以及承担国家 02 重大专项，发行人已经成功掌握包括光刻工艺胶膜均匀涂敷技术、不规则晶圆表面喷涂技术、精细化显影技术、内部微环境精确控制技术、晶圆正反面颗粒清洗技术、化学药品精确供给及回收技术等在内的多种半导体设备产品核心技术，并拥有多项自主知识产权。截至 2019 年 3 月 31 日，发行人共获得专利授权 145 项，其中发明专利 127 项（其中中国大陆地区发明专利 116 项，中国台湾地区发明专利 9 项，美国发明专利 2 项），实用新型专利 6 项，外观设计专利 12 项；拥有软件著作权 37 项。

（3）优质的客户资源

发行人专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，致力于为客户提供半导体装备与工艺整体解决方案。公司自主开发的光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备已成为半导体生产线上的主力设备。

截至 2019 年 3 月 31 日，发行人产品已累计销售 680 余台套，下游客户覆盖国内主要 LED 芯片制造企业和集成电路制造后道先进封装企业，与包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电等在内的多家优质客户保持着长期稳定的合作关系；公司集成电路制造前道晶圆加工环节用涂胶显影设备和清洗设备也已开发完成，其中，前道涂胶显影设备正在长江存储、上海华力等前道芯片制造厂商进行工艺验证，前道清洗设备已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并成功实现销售。同时，发行人以沈阳为销售总部，并在苏州、昆山、台湾、武汉、上海等地设有办事处，销售网络覆盖长三角、珠三角及台湾地区等产业重点区域，建立了快速响应的销售和技术服务团队。

（4）领先的行业地位

发行人是国家集成电路产业技术创新联盟及集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事单位，并先后主持制定了喷胶机、涂胶机两项行业标准，其中喷胶机行业标准《喷雾式涂覆设备通用规范》（SJ/T 11576-2016）已正式颁布实施，

涂胶机行业标准《旋转式涂覆设备通用规范》正在审核中

发行人先后荣获“国家级知识产权优势企业”、“2018 年中国半导体设备五强企业”、“国内先进封装领域最佳设备供应商”等多项殊荣，公司产品先后获得“国家战略性创新产品”、“国家重点新产品”等多项荣誉，充分体现了发行人的技术水平和管理能力，奠定了发行人在行业内的领先地位。

（5）高效的质量管控与服务保障能力

公司自成立以来一直专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，以高效的质量管控、全面优质的客户服务以及快速灵活的售后响应赢得市场。公司坚持“质量为上”的经营理念，建立了完整的质量控制制度，实行严格的质量控制手段，以保证产品质量的稳定性和一致性。目前公司应用于集成电路制造后道先进封装领域的喷胶机、涂胶/显影机和清洗机等产品已通过 SEMI S2 国际安规认证，为公司进入国际半导体设备供应商体系奠定了良好的基础。同时公司坚持以用户需求为中心，高度重视客户服务能力建设，已形成对客户需求的快速反应机制，以保证及时、迅速、有效地解决客户在产品后续使用过程中遇到的相关问题。此外，公司研发人员会定期进行客户拜访以收集产品需求，并根据客户及市场需求进行产品的升级或更新换代，以保持产品的持续竞争力。

（6）完善的供应链

半导体设备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用大量的高精度元器件，对产品机械结构的精度和材质要求也很高。经过多年的沉淀，发行人与国内外供应商建立了较为稳定的合作关系，培育与建设成了较为完善的原材料供应链，有利于保证公司产品原料来源的稳定性及可靠性。

2、发行人劣势

（1）资金实力相对薄弱

目前，发行人正处于快速成长阶段，在研发投入、人才引进、厂房建设、设备购置等方面均迫切需要大量资金的支持，但是发行人目前主要外部资金来源为股东投资，资金来源有限，既不利于发行人把握外部环境如半导体设备行业技术水平及市场的快速变化，又不利于发行人自身保持快速发展的势头，对发行人完

善和实现产品战略布局造成不利影响。因此，扩大融资渠道，筹集充足的发展资金，对于发行人未来发展具有至关重要的作用。

（2）知名度有待进一步提升

近年来，发行人产品凭借质量稳定可靠、性价比高等优势已逐步进入多家国内外知名企业的生产线。随着发行人持续的研发创新投入及市场开拓，未来发行人知名度将持续提升，但与具有先发优势的国外知名企业相比，发行人知名度的提升空间仍然较大。

（四）影响发行人发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家对半导体设备行业的政策支持

公司所处半导体设备行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。近年来，为推动我国半导体产业的发展和加速国产化进程，国家先后出台《科技部重点支持集成电路重点专项》、《集成电路产业“十三五”发展规划》等鼓励政策，特别是《国家集成电路产业发展推进纲要》提出：“到 2020 年，集成电路与国际先进水平差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%，企业可持续发展能力不断增强，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。”我国半导体设备行业迎来了前所未有的政策契机，有助于我国半导体设备行业技术水平的提高和行业的快速发展。

（2）市场需求长期保持增长

近年来，电子信息技术发展迅速，各类智能化、网络化和移动化的便携消费电子产品层出不穷，而新一代网络通信、物联网、云计算、节能环保等新兴产业更成为半导体产业发展的新动力，共同推动全球半导体行业持续快速蓬勃发展。随着我国成为世界电子信息产品最重要的生产基地之一，越来越多的国际半导体企业向我国转移产能，持续的产能转移不仅带动了国内半导体整体产业规模和技术水平的提高，为半导体设备制造业提供了巨大的市场空间，也促进了我国半导

体产业专业人才的培养及配套行业的发展,半导体产业环境的良性发展为我国半导体设备制造业产业的扩张和升级提供了机遇。

(3) 半导体国产设备进口替代趋势日趋明显

我国半导体消费需求增长以及国产化进程有力推动了我国半导体产业快速发展,然而与我国快速增长的半导体产业不相匹配的却是我国半导体设备市场大量依赖进口,极大影响了我国半导体产业的可持续良性发展。近来在国家科技重大专项和集成电路产业投资基金的支持下,我国半导体产业链不断完善,特别是国内半导体设备制造业技术水平的不断提高,并涌现一批优秀的半导体设备制造企业。未来半导体的国产化势必向着设备国产化方向传导,国产设备进口替代趋势将越趋明显,国产替代空间巨大。此外随着我国半导体产业发展阶段逐步走向成熟,很多半导体厂商开始考虑在设备上节约成本,此时,采用产品性价比高、能满足特定类型产品个性化需求并能够提供及时、快速售后服务的国产半导体设备已成为各大半导体厂商的重要选择。

(4) 全球半导体产能向我国大陆地区转移

全球半导体产业向中国大陆地区转移趋势明显,我国大陆地区迎来建厂潮。根据 SEMI 预测,2017-2020 年全球将有 62 座晶圆厂投产,其中 26 座晶圆厂来自于中国大陆地区,占比约 42%。根据 SEMI 2018 年中国半导体硅晶圆展望报告,中国大陆地区的 Fab 厂产能预计将从 2015 年的每月 230 万片到 2020 年的 400 万片,年复合增长率为 12%,增速高于其他所有地区。此外,根据 IC Insights 预测,由于“中国效应”,2018 年全球半导体资本支出将首次突破 1,000 亿美元,中国企业半导体资本支出达 110 亿美元,将超过欧洲和日本企业半导体资本支出之和的 107 亿美元。全球半导体产业向中国大陆地区转移,为国内上游半导体设备行业带来了强劲的需求。

2、不利因素

(1) 融资环境仍不成熟

半导体设备行业具有投资周期长、研发投入大等特点,属于典型的资本密集型行业,为保持公司的技术优势,需要长期、持续不断的研发投入。目前行业内

企业主要资金来源于股东投入，融资渠道单一一定程度上限制了国内产业的发展。

（2）高端技术人才相对缺乏

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及操作经验积累均有较高要求。人才的培养需要一定时间和相应环境，现有半导体设备行业的人才和技术水平难以满足行业内日益增长的人才需求，外部引进高端人才又需要支付较高的人力成本，因此行业内企业主要依靠内部培养形成人才梯队，制约了行业的快速发展。未来发行人将加大人才引进，为高端技术人才提供更加完善的技术创新平台。

（3）产业环境有待进一步改善

半导体设备属于高精度的自动化装备，研发和生产均需使用高精度元器件，对原材料机械结构的精度和材质要求很高，我国与此相关的核心原材料供应体系尚未完全建立，部分核心部件仍然依赖进口，其技术指标、交货周期、价格等均不可控，一定程度上限制了国产设备厂商的发展；此外，目前国内进口二手半导体设备存量较大，价格较低，深受下游客户的青睐，这在一定程度上都制约了国产半导体设备的推广与应用。

（4）地理位置与客户距离较远

目前公司下游客户在地理位置上相对集中，主要集中在长三角一带，与发行人总部沈阳距离较远，不利于发行人及时了解与快速响应客户潜在需求。未来发行人计划在客户比较集中的地区设立区域服务中心或研发分部，以扩大发行人的服务半径，增强发行人的市场影响力。

（5）国外出口限制

作为战略性产业，全球主要发达国家越来越重视半导体产业的发展，为保持其领先地位，国际半导体巨头仍会严格控制关键技术设备、材料、高端设计和工艺技术向我国的出口，对高端技术转移的限制仍将继续，国内产业面临的技术挑战仍将长期存在，在一定程度上阻碍了我国半导体技术和市场的发展。

六、发行人销售情况及主要客户

(一) 主要产品销售情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分如下：

单位：万元

产品类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
光刻工序涂胶显影设备	597.98	61.73%	12,883.64	64.11%	15,649.76	85.27%	14,125.56	98.43%
其中：涂胶/显影机	597.98	61.73%	12,037.49	59.90%	13,977.81	76.16%	12,979.40	90.44%
喷胶机	-	-	846.15	4.21%	1,671.95	9.11%	1,146.15	7.99%
单片式湿法设备	370.69	38.27%	7,213.33	35.89%	2,703.39	14.73%	138.75	0.97%
其中：清洗机	370.69	38.27%	2,208.55	10.99%	1,180.01	6.43%	138.75	0.97%
去胶机	-	-	2,541.45	12.65%	531.65	2.90%	-	-
湿法刻蚀机	-	-	2,463.33	12.26%	991.73	5.40%	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-	86.32	0.60%
总计	968.67	100.00%	20,096.97	100.00%	18,353.15	100.00%	14,350.64	100.00%

报告期内，公司主营业务收入按销售模式划分如下：

单位：万元

销售模式	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	968.67	100.00%	19,879.25	98.92%	18,353.15	100.00%	6,250.85	43.56%
代销	-	-	217.72	1.08%	-	-	8,099.79	56.44%
合计	968.67	100.00%	20,096.97	100.00%	18,353.15	100.00%	14,350.64	100.00%

报告期内，公司主营业务收入按销售地区划分如下：

单位：万元

销售地区	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
大陆地区	968.67	100.00%	18,891.01	94.00%	16,502.19	89.91%	5,896.87	41.09%
港澳台地区	-	-	1,205.95	6.00%	1,850.97	10.09%	8,453.76	58.91%

销售地区	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	968.67	100.00%	20,096.97	100.00%	18,353.15	100.00%	14,350.64	100.00%

报告期内，公司主要客户群体如下：

产品类别	重要代表客户
光刻工序涂胶显影设备	台积电（TSM.N）、华天科技（002185.SZ）、长电科技（600584.SH）、通富微电（002156.SZ）、晶方科技（603005.SH）、硕贝德（300322.SZ）、华灿光电（300323.SZ）、东莞中图、澳洋顺昌（002245.SZ）、乾照光电（300102.SZ）等
单片式湿法设备	华天科技（002185.SZ）、昆山国显、海思微电子、晶方科技（603005.SH）等

注：上述客户均为直接向发行人采购或通过其下属子公司向发行人采购相关设备，或通过发行人在台湾地区代理机构（如台积电2016年主要通过发行人在台湾地区代理商辛耘企业股份有限公司）向发行人采购相关设备。

（二）报告期内向前五大客户销售的情况

报告期内，发行人向前五大客户销售情况如下：

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例（%）
2019年1-3月			
1	江苏壹度科技股份有限公司	575.69	55.86
2	苏州能讯高能半导体有限公司	283.50	27.51
3	山东元旭光电股份有限公司	109.48	10.62
4	深圳市海思半导体有限公司	21.58	2.09
5	苏州科阳光电科技有限公司	15.48	1.50
合计		1,005.72	97.59
2018年度			
1	华天科技（昆山）电子有限公司	4,422.22	21.06
2	昆山国显光电有限公司	2,974.36	14.16
3	通富微电子股份有限公司及其下属企业	2,081.06	9.91
4	东莞市中图半导体科技有限公司	1,297.87	6.18
5	大连德豪光电科技有限公司	1,208.89	5.76
合计		11,984.41	57.07

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例（%）
2017 年度			
1	华天科技（昆山）电子有限公司	4,153.63	21.87
2	华灿光电股份有限公司及其下属企业	2,887.15	15.20
3	东莞市中图半导体科技有限公司	1,713.37	9.02
4	淮安澳洋顺昌光电科技有限公司	1,259.06	6.63
5	中国电子科技集团公司第五十八研究所	1,236.50	6.51
合计		11,249.71	59.24
2016 年度			
1	辛耘企业股份有限公司	8,112.26	54.96
2	苏州晶方半导体科技股份有限公司	1,342.07	9.09
3	华天科技（昆山）电子有限公司	943.59	6.39
4	苏州科阳光电科技有限公司	941.45	6.38
5	通富微电子股份有限公司及其下属企业	483.87	3.28
合计		11,823.23	80.10

注：上表系按同一实际控制人合并口径统计，其中通富微电子股份有限公司及其下属企业包括通富微电子股份有限公司、南通通富微电子有限公司两家主体，华灿光电股份有限公司及其下属企业包括华灿光电股份有限公司、华灿光电（浙江）有限公司、华灿光电（苏州）有限公司三家主体。

2016 年，公司向辛耘企业股份有限公司销售比例超过当期营业收入的 50%，主要系当年台积电通过公司在中国台湾地区代理商辛耘企业股份有限公司向公司大批量采购涂胶/显影机所致；2019 年 1-3 月，公司向江苏壹度科技股份有限公司销售比例超过当期营业收入的 50%，主要系当期公司确认收入整体金额较小所致。除此之外，公司不存在向单一客户销售比例超过 50% 或严重依赖少数客户的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东或其他关联方在上述销售客户中未占有任何权益。

（三）产能、产量及产能利用率情况

公司主要实行订单式生产的生产模式，主要生产资料包括人工、厂房、原材

料及各类组装、质量检测设备等。公司产能具有一定弹性，能够根据订单情况灵活地安排人工、原材料采购等完成生产任务。下游半导体制造企业产能扩张，可能会导致公司面临设备订单快速增长的局面，公司短期生产人员配备及上游供应商原材料的短期供货能力等因素会在一定程度约束公司的生产能力。

报告期内，公司主要产品的产销量情况如下：

产品	项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
光刻工序 涂胶显影 设备	产量（台套）	4	81	96	77
	销量（台套）	4	61	110	57
	产销率	100.00%	75.31%	114.58%	74.03%
单片式湿 法设备	产量（台套）	5	28	16	15
	销量（台套）	2	21	16	2
	产销率	40.00%	75.00%	100.00%	13.33%

七、发行人采购情况及主要供应商

（一）主要原材料采购情况

报告期内，发行人采购的原材料主要包括机电一体类、机械类、气动液压系统类、电器类、仪器仪表类、传感器类等，其具体构成情况如下：

序号	类别	具体内容
1	机电一体类	机械手、温湿度控制器、电机、电缸、片盒装载站、光学对中、空气净化单元、恒温槽、消防报警灭火装置等
2	机械类	工艺腔体、防溅杯、承片台、化学液喷洒摆臂、陶瓷手指、设备支撑框架、钣金外壳及内衬钣金、紧固件、标准件等
3	气动液压系统类	阀门、接头、管道、气动隔膜泵、气动增压泵、光刻胶泵、压力罐、过滤器、滤芯等
4	电器类	工业电脑、电机驱动器、电缸驱动器、胶泵控制器、电源箱、I/O 模块、AC 模块、DC 模块、加热器、热盘、线缆等
5	仪器仪表类	排风压力表、液体压力表、气体流量计、液体流量计、温度控制表等
6	传感器类	流量传感器、漏液传感器、温度传感器、光电传感器、接近开关等
7	其他	光刻胶、丁腈手套、特氟龙胶带、万用表、内六角扳手、活动扳手、切管器、扩管器等

报告期内，公司各类原材料采购金额及其占当期原材料采购总额的比例如下：

单位：万元

原材料类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机电一体类	401.80	17.23%	6,257.34	31.53%	3,000.05	23.09%	4,165.10	41.23%
机械类	825.93	35.41%	5,609.47	28.27%	4,778.80	36.78%	3,456.38	34.21%
气动液压系统类	489.97	21.01%	3,764.07	18.97%	2,728.29	21.00%	1,261.66	12.49%
电器类	435.99	18.69%	2,998.60	15.11%	1,654.68	12.74%	777.67	7.70%
仪器仪表类	27.54	1.18%	597.41	3.01%	505.30	3.89%	207.83	2.06%
传感器类	82.77	3.55%	427.62	2.15%	204.56	1.57%	121.45	1.20%
其他	68.17	2.92%	190.56	0.96%	120.35	0.93%	111.90	1.11%
总计	2,332.16	100.00%	19,845.08	100.00%	12,992.02	100.00%	10,101.99	100.00%

报告期内，公司原材料采购总额逐年上升，与公司营业收入增长趋势相匹配。

（二）能源采购情况

发行人生产过程中所需水电耗用较少，所用水电均来源于本地给水及电网，供应稳定。报告期内，公司生产过程中水电消耗情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
水电费金额	39.26	169.13	162.66	131.92

（三）报告期内前五大供应商采购情况

报告期内，发行人向前五大供应商采购情况如下：

序号	客户	金额（万元）	占当期采购总额比例
2019年1-3月			
1	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	163.17	7.00%
2	SMC(中国)有限公司	152.74	6.55%
3	乐孜贸易（上海）有限公司	111.83	4.79%
4	沈阳新隆轩自动化设备有限公司	104.47	4.48%
5	MORAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	103.66	4.44%
合计		635.86	27.26%
2018年度			
1	NIDEC SANKYO CORPORATION	2,378.44	11.98%
2	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	1,257.02	6.33%
3	乐孜贸易（上海）有限公司	1,171.93	5.90%

序号	客户	金额（万元）	占当期采购总额比例
4	沈阳市南峰精密机械厂	1,100.98	5.55%
5	SMC(中国)有限公司	1,082.30	5.45%
合计		6,990.67	35.23%
2017 年度			
1	NIDEC SANKYO CORPORATION	1,509.61	11.62%
2	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	1,496.34	11.52%
3	沈阳艾斯利德机电设备有限公司	1,152.46	8.87%
4	沈阳市南峰精密机械厂	913.44	7.03%
5	SMC(中国)有限公司	861.09	6.63%
合计		5,932.95	45.67%
2016 年度			
1	沈阳拓荆科技有限公司	1,500.00	14.85%
2	NIDEC SANKYO CORPORATION	1,082.09	10.71%
3	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	1,077.10	10.66%
4	乐孜贸易（上海）有限公司	763.34	7.56%
5	沈阳市南峰精密机械厂	419.88	4.16%
合计		4,842.42	47.94%

公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东或其他关联方在上述销售供应商中未占有任何权益。

（四）外协采购情况

报告期内，发行人存在外协采购的情形，主要为机械零件采购（包括金属件、塑料件、钣金件、陶瓷件等），公司向外协厂商提供图纸或技术资料，由外协厂商自主采购原材料并按照公司的技术要求加工成型，公司向其支付采购费用。报告期各期，公司外协采购金额占当期采购总额的比例分别为 26.17%、33.34%、25.32%和 31.98%，其中，前五大外协厂商采购金额占各期外协采购金额的比例均在 60%以上，详情如下：

单位：万元

报告期	外协厂商	外协内容	外协采购金额	占当期外协采购总额的比例
2019年 1-3月	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	钣金件	163.17	21.88%
	沈阳市南峰精密机械厂	塑料件、金属件	91.11	12.21%
	苏州市兆恒众力精密机械有限公司	塑料件、金属件	89.32	11.97%
	昆山科迪特精密工业有限公司	塑料件、金属件	86.52	11.60%
	沈阳晨宇自动化设备制造有限公司	金属件	71.38	9.57%
	合计			501.49
2018年 年度	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	钣金件	1,257.02	25.01%
	沈阳市南峰精密机械厂	塑料件、金属件	1,100.98	21.91%
	沈阳晨宇自动化设备制造有限公司	金属件	991.26	19.73%
	沈阳航飞仓储设备工程有限公司	金属件	648.80	12.91%
	鞍山宏源环能科技有限公司	钣金件	267.66	5.33%
	合计			4,265.73
2017年 年度	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	钣金件	1,496.34	34.54%
	沈阳市南峰精密机械厂	塑料件、金属件	913.44	21.09%
	沈阳晨宇自动化设备制造有限公司	金属件	763.48	17.63%
	沈阳航飞仓储设备工程有限公司	金属件	402.97	9.30%
	宁波启雄精密机械科技有限公司	金属件	227.87	5.26%
	合计			3,804.10
2016年 年度	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂	钣金件	1,077.10	40.74%
	沈阳市南峰精密机械厂	塑料件、金属件	419.88	15.88%
	沈阳晨宇自动化设备制造有限公司	金属件	260.21	9.84%
	宁波启雄精密机械科技有限公司	金属件	246.33	9.32%

报告期	外协厂商	外协内容	外协采购金额	占当期外协采购总额的比例
	沈阳航飞仓储设备工程有限公司	金属件	175.48	6.64%
	合计		2,179.00	82.41%

公司不存在向单个外协供应商采购金额超过采购总额 50% 或严重依赖少数外协供应商的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东或其他关联方在上述外协供应商中未占有任何权益。

八、发行人主要固定资产及无形资产

（一）固定资产

公司拥有的固定资产主要是房屋建筑物、设备、运输工具，目前使用状况良好，发生重大固定资产报废的可能性较小。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

资产类别	原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	5,004.14	1,772.40	3,231.74
机器设备	6,051.63	1,768.15	4,283.48
运输工具	184.16	105.21	78.95
电子设备	1,466.00	1,075.89	390.11
办公设备	40.24	37.27	2.97
合计	12,746.17	4,758.92	7,987.25

截至 2019 年 3 月 31 日，公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	证号	房屋坐落	面积 (平方米)	用途
1	沈房权证浑南新区字第 005637 号	浑南新区飞云路 16-1 号	3,103.40	办公楼
2	沈房权证浑南新区字第 005638 号	浑南新区飞云路 16-2 号	2,241.96	厂房
3	沈房权证东陵区字第 N100090493 号	浑南新区飞云路 16-3 号(全部)	7,256.36	厂房

公司所拥有的上述房屋所有权均未设定抵押。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司拥有的主要研发和生产设备情况如下：

序号	设备名称	数量(台/套)	原值(万元)	净值(万元)	成新率
1	测试用前道匀胶显影设备	1	1,425.47	1,256.19	88.12%
2	300MM 光刻机	1	1,117.58	754.87	67.55%
3	光刻机配套系统	1	500.00	337.73	67.55%
4	膜厚测量仪	1	454.94	375.71	82.58%
5	净化间控制系统	1	431.84	363.45	84.16%
6	扫描电镜	1	349.57	332.96	95.25%
7	自动湿式刻蚀设备	1	160.18	109.47	68.34%
8	温湿度控制器	1	158.50	139.68	88.12%
合计		8	4,598.08	3,670.06	79.82%

目前公司主要研发和生产设备使用状态良好，总体成新率为 79.82%，不存在周期性进行的设备大修或技术改造，设备的日常维护、保养、更新和报废等对公司生产经营不会造成重大影响。

(二) 无形资产

1、土地使用权

截至 2019 年 3 月 31 日，公司拥有的土地情况如下：

土地证号	坐落位置	土地用途	取得方式	面积(平方米)	终止日期
沈南国用(2003)第 041 号	沈阳市浑南新区飞云路 16 号	工业用地	出让	18,630.00	2053-7-2

公司所拥有的上述土地使用权未设定抵押。

2、商标权

截至本招股说明书签署日，公司拥有注册商标情况如下：

序号	注册号	商品类别	有效期
1	5928651	第 7 类	2010 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日
2	14642973	第 7 类	2015 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日
3	15732200	第 7 类	2016 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日
4	15732224	第 7 类	2016 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日

3、专利权

截至 2019 年 3 月 31 日，公司拥有境内专利权情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
1	一种承载翘曲晶圆的装置及其承载方法	2015102832469	发明专利	2019.03.15	发行人
2	一种带孔方形基片的夹持传送装置	2015105196200	发明专利	2019.02.26	发行人
3	半导体接口单元的接口密封装置	2015102974968	发明专利	2019.02.15	发行人
4	一种晶圆撕金去胶清洗装置	2015104512535	发明专利	2019.01.11	发行人
5	一种液体均匀喷洒处理系统及其处理方法	2015103867573	发明专利	2018.11.27	发行人
6	一种自动清洗晶圆时夹持晶圆边缘的装置及其夹持方法	2014107987279	发明专利	2018.10.26	发行人
7	一种工艺单元排废积液检测装置	201510411467X	发明专利	2018.10.09	发行人
8	一种去胶液恒温系统	201510297453X	发明专利	2018.09.28	发行人
9	一种半导体设备用分流增压装置及其控制方法	201410479987X	发明专利	2018.08.14	发行人
10	一种防止晶圆滑动的升降盘体装置	2014104668074	发明专利	2018.08.14	发行人
11	一种微环境控制系统	2014107144136	发明专利	2018.08.07	发行人
12	PSS 良率在线监测方法	2013105549114	发明专利	2018.07.13	发行人
13	一种热盘工艺腔气流均布装置	2014103840504	发明专利	2018.07.03	发行人
14	一种半导体设备用滤风整流装置	2014103239599	发明专利	2018.06.19	发行人
15	一种排风稳压器及其排风稳压方法	201410539827X	发明专利	2018.04.24	发行人
16	一种防止高压水雾喷溅的 CUP 结构	2014102203513	发明专利	2018.04.24	发行人
17	一种晶片背面清洗装置	2014102204056	发明专利	2018.03.20	发行人
18	一种热盘工艺密闭腔自动调整装置	2014102933198	发明专利	2018.02.13	发行人
19	一种废液收集装置	2014105537037	发明专利	2018.02.06	发行人
20	一种半导体热盘上的陶瓷球微调装置	2014104627303	发明专利	2018.02.06	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
21	一种能够形成密闭腔室的半导体热盘结构	2014104660354	发明专利	2018.02.06	发行人
22	一种半导体制成厚胶膜涂覆装置及其使用方法	2014108035935	发明专利	2018.02.02	发行人
23	一种提升晶圆受热均匀性的装置	2014105321174	发明专利	2018.02.02	发行人
24	一种防止晶圆背面污染的机构	2014104865617	发明专利	2018.02.02	发行人
25	一种晶圆表面撕金去胶方法	2014101655710	发明专利	2017.12.26	发行人
26	一种 TRACK 机台匀胶单元的防回溅与防粘附型工艺腔体	2014101483339	发明专利	2017.12.15	发行人
27	一种半导体设备用冷却盘装置	201510424217X	发明专利	2017.12.08	发行人
28	用于半导体设备内的晶圆缓存装置	2014102869967	发明专利	2017.11.28	发行人
29	一种废液收集装置	2014102529448	发明专利	2017.11.03	发行人
30	一种不同尺寸基板喷涂用支撑加热装置	2014103239014	发明专利	2017.10.20	发行人
31	一种管路一致性校验器及其使用方法	2014101483818	发明专利	2017.10.20	发行人
32	一种夹持晶圆的承片台装置	201310525986X	发明专利	2017.10.03	发行人
33	一种化学液供给系统	2013105448946	发明专利	2017.09.29	发行人
34	一种液体定量供给装置	2013104695113	发明专利	2017.09.29	发行人
35	一种化学液供给装置及其供给方法	2014101438070	发明专利	2017.09.26	发行人
36	一种自动清除半导体生产过程中废液排放管路堵塞的装置	201410240506X	发明专利	2017.09.22	发行人
37	一种方形基片和圆形基片兼容的定位结构	2013105420226	发明专利	2017.09.15	发行人
38	一种测温晶圆微调装置	201410281209X	发明专利	2017.07.28	发行人
39	一种全自动清洗晶圆边缘夹持机构	2014101467976	发明专利	2017.07.28	发行人
40	晶圆浸泡装置	201410143157X	发明专利	2017.07.07	发行人
41	一种紧凑型片针升降机机构	2013105078239	发明专利	2017.07.07	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
42	一种废液废固分离回收系统	2014102566752	发明专利	2017.06.30	发行人
43	一种基板烘烤支承装置	2013105288345	发明专利	2017.06.30	发行人
44	配置涂胶显影机内工艺模块数量及机器人速度的方法	2013105262881	发明专利	2017.06.06	发行人
45	对收集杯实现自动清洗的热盘结构	2014104410274	发明专利	2017.05.10	发行人
46	用于半导体设备内的晶圆缓存装置	2013105537297	发明专利	2017.05.10	发行人
47	一种用于化学液喷洒的摆臂装置及其喷洒方法	2013105243363	发明专利	2017.04.19	发行人
48	一种单电机驱动双摆臂转动的装置	2013105538730	发明专利	2017.02.22	发行人
49	方形基片的气流引导装置	2013105248193	发明专利	2017.02.08	发行人
50	一种半导体处理系统中流体除气泡装置及其除气泡方法	2014101461715	发明专利	2017.01.25	发行人
51	一种带清洗部件的液体喷洒装置	2013105228433	发明专利	2017.01.18	发行人
52	显影方法	2012104386261	发明专利	2016.12.21	发行人
53	光刻胶涂胶喷嘴定位拾取装置	2012104395491	发明专利	2016.11.30	发行人
54	一种化学液供给装置	2012104607226	发明专利	2016.09.28	发行人
55	光刻胶与显影液的恒温控制系统	2012104245102	发明专利	2016.09.14	发行人
56	一种方型晶片对中结构	2012104546449	发明专利	2016.09.07	发行人
57	一种显影喷头	2012104567905	发明专利	2016.08.31	发行人
58	一种胶杯自动清洗的方法	2013105362663	发明专利	2016.08.17	发行人
59	一种半导体制造设备的自动移动装置	201210460563X	发明专利	2016.08.03	发行人
60	一种适用于方形基板的化学液回收装置	2012103842375	发明专利	2016.08.03	发行人
61	一种用真空实现不同浓度液体的分离回收装置	2013104815844	发明专利	2016.06.29	发行人
62	一种多尺寸晶圆对中装置	2012103914354	发明专利	2016.06.29	发行人
63	一种液体涂敷切边装置	2012104457892	发明专利	2016.06.15	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
64	一种基板翻转对中装置	2012104552026	发明专利	2016.06.01	发行人
65	片盒倾斜及归位装置	2012104394200	发明专利	2016.06.01	发行人
66	一种生产使用过程中化学品自动供给的管路系统	201210393826X	发明专利	2016.05.25	发行人
67	一种机械手碰撞保护装置	2013104370658	发明专利	2016.05.11	发行人
68	超声波喷嘴排风装置	2012104484279	发明专利	2016.05.11	发行人
69	光刻机对接接口模块的可抽拉式水平调节装置	2013105288769	发明专利	2016.04.13	发行人
70	一种晶圆浸泡装置	2012104391791	发明专利	2016.03.23	发行人
71	一种掩模板清洗机的夹持机构	2012102923178	发明专利	2016.03.23	发行人
72	一种半导体处理系统中的流体脱泡装置和方法	201310368461X	发明专利	2016.03.16	发行人
73	一种晶片清洗装置	2012104551733	发明专利	2016.02.17	发行人
74	基板冷热处理装置	2012101641070	发明专利	2016.02.03	发行人
75	一种低冲击力均布流量的湿法处理工艺喷嘴	2012104623638	发明专利	2015.11.18	发行人
76	全自动胶膜涂覆、显影装置	2012100010470	发明专利	2015.10.14	发行人
77	光刻胶管路套管保温装置	2012104391804	发明专利	2015.09.09	发行人
78	一种可兼容不同尺寸晶圆的伯努利承片台	2012100010466	发明专利	2015.09.09	发行人
79	一种光刻胶收集杯自动清洗系统	2012104546453	发明专利	2015.08.26	发行人
80	一种化学液回收装置	2011103325798	发明专利	2015.07.22	发行人
81	一种磁悬浮晶圆旋转系统	2011103319871	发明专利	2015.06.17	发行人
82	一种双喷嘴清洗装置	2011103322111	发明专利	2015.06.17	发行人
83	一种旋转气流降温热板	201110332092X	发明专利	2015.04.22	发行人
84	一种液体涂敷装置	201110332215X	发明专利	2015.04.22	发行人
85	一种换向倒极装置	2011103325656	发明专利	2015.04.22	发行人
86	旋转显影真空管路中的简易气液分离装置	2012103808815	发明专利	2015.03.18	发行人
87	真空边缘夹持机构	2010101832261	发明专利	2013.06.19	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
88	带升降式对中装置的离心机	2010105656447	发明专利	2013.05.22	发行人
89	半导体封装用厚胶膜旋涂方法	2011100224507	发明专利	2013.03.27	发行人
90	一种用于圆形薄片状物体进行化学液喷洒处理的装置	2009100134931	发明专利	2012.10.24	发行人
91	一种均匀喷涂光刻胶的方法	2010105248289	发明专利	2012.10.03	发行人
92	多种化学品分类排放回收系统	2009102200340	发明专利	2012.09.05	发行人
93	毛刷清洗装置及其使用方法	2010105661642	发明专利	2012.08.15	发行人
94	双整定精确定位硅片圆心的方法	2011100348340	发明专利	2012.07.04	发行人
95	光刻胶喷嘴更换辅助定位半自动固定装置	2011100213574	发明专利	2012.07.04	发行人
96	高精复合盘结构及其应用	2008102287161	发明专利	2012.07.04	发行人
97	带有可旋转底盘的化学液分类回收装置	2010105713223	发明专利	2012.06.27	发行人
98	内置可升降支柱的承片台装置	2010101832204	发明专利	2012.05.30	发行人
99	一种用于单面处理的夹持与保护装置	2009100111588	发明专利	2012.04.18	发行人
100	真空缓冲装置	2008102283743	发明专利	2012.04.18	发行人
101	可旋转加热的吸附装置	2010105556171	发明专利	2012.04.11	发行人
102	带有可升降挡板的多层腔体装置	2010102845979	发明专利	2012.04.11	发行人
103	高精持续供胶泵装置	2010102845907	发明专利	2012.02.01	发行人
104	一种提高涂胶产能的方法	2010102845875	发明专利	2012.01.11	发行人
105	真空显影机构	2009100118290	发明专利	2011.12.21	发行人
106	多种化学品药液分离、重复使用装置	2008102301027	发明专利	2011.07.20	发行人
107	晶片检测装置	2008102284799	发明专利	2011.06.01	发行人
108	方形基片涂胶单元中的自动扣盖机构	2007101586547	发明专利	2011.06.01	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
109	一种利用双绞线供电并实现多机数字通讯的装置	2007101588241	发明专利	2011.04.20	发行人
110	新型结构的涂胶显影设备	2008100120224	发明专利	2010.12.15	发行人
111	涂胶显影设备的工艺墙	2008100119918	发明专利	2010.12.01	发行人
112	涂胶显影设备及晶片透递传输工艺方法	2005100469392	发明专利	2010.09.01	发行人
113	一种晶圆传送过程中的对中单元	200810010218X	发明专利	2010.06.02	发行人
114	一种可以节约时间的匀胶显影加工工艺及设备的改进结构	2006101349227	发明专利	2010.05.12	发行人
115	晶片自动定位控制装置及其控制方法	200710010762X	发明专利	2010.04.07	发行人
116	柱状喷洒显影和雾状喷洒显影互换的显影装置	2004100828386	发明专利	2009.08.26	发行人
117	HMDS 喷涂装置及系统	2018214058919	实用新型	2019.03.12	发行人
118	晶圆光阻及金属剥离工艺金属回收和分类排废装置	2018211442432	实用新型	2019.03.01	发行人
119	剥离工艺后金属回收系统	2018211443238	实用新型	2019.02.01	发行人
120	晶圆光刻胶及金属剥离工艺中的防雾气外溢装置	2018211443242	实用新型	2019.01.29	发行人
121	一种示教清洗一体盘	2011204171970	实用新型	2012.05.30	发行人
122	用于半导体制成中的喷胶处理装置	2009202034473	实用新型	2010.05.19	发行人
123	全自动匀胶机	2017305560235	外观设计	2018.11.9	发行人
124	晶元涂胶显影机	2017306041870	外观设计	2018.10.30	发行人
125	匀胶显影机台	2017305562391	外观设计	2018.08.03	发行人
126	全自动显影机主机	2017305562372	外观设计	2018.06.26	发行人
127	全自动湿法设备	2017305561365	外观设计	2018.05.11	发行人
128	匀胶机台	2017305562476	外观设计	2018.04.20	发行人
129	全自动匀胶机(1)	2017305562461	外观设计	2018.04.13	发行人
130	全自动显影机	2017305560254	外观设计	2018.04.06	发行人
131	全自动双腔匀胶机	2017305561191	外观设计	2018.04.06	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
132	独立机台	2017305561204	外观设计	2018.03.30	发行人
133	全自动喷胶机	2017305562404	外观设计	2018.03.23	发行人

截至 2019 年 3 月 31 日，公司拥有境外专利权情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
1	一種可擴展連接多台光刻機的塗膠顯影設備系統	发明第 I648600	发明	2019.01.21	发行人
2	一種防止反濺液體污染晶片的裝置	发明第 I595584	发明	2017.08.11	发行人
3	堆疊式光阻塗布顯影系統	发明第 I587365	发明	2017.06.11	发行人
4	液體均勻噴灑處理系統及其處理方法	发明第 I569890	发明	2017.02.11	发行人
5	晶圓浸泡裝置	发明第 I544541	发明	2016.08.01	发行人
6	化學液供給裝置及其供給方法	发明第 I534387	发明	2016.05.21	发行人
7	一種半導體製成厚膠膜塗覆裝置及其使用方法	发明第 I515515	发明	2016.01.01	发行人
8	均勻噴塗光刻膠的方法	发明第 I453797	发明	2014.09.21	发行人
9	超微霧化噴塗方法	发明第 I445064	发明	2014.07.11	发行人
10	晶元塗膠顯影機	设计第 D194955	设计	2018.12.21	发行人
11	Method for Setting Coating Module Quantity and Robot Speed	US9443745B2	发明	2015.05.07	发行人
12	Adsorption Device for Rotatable Heating	US9666457B2	发明	2012.05.31	发行人

4、软件著作权

截至 2019 年 3 月 31 日，公司拥有软件著作权情况如下：

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期	到期日期
1	2019SR0232443	工厂自动化控制软件 V1.0	全部权利	2018/11/30	2068/12/31
2	2019SR0232471	基于 EasyCluster 平台的 PLC 上位机控制软件 V1.0	全部权利	2018/11/25	2068/12/31
3	2019SR0232338	前道热板单元 PLC 控制软件 V1.0	全部权利	2018/10/11	2068/12/31

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期	到期日期
4	2019SR0232461	半导体设备 LoadPort 模块软件 V1.0	全部权利	2018/11/26	2068/12/31
5	2019SR0147631	增粘模块 (ADB) PLC 控制软件 V1.0	全部权利	2018/9/27	2068/12/31
6	2019SR0147141	匀胶设备产能分析软件 V1.0	全部权利	2018/9/27	2068/12/31
7	2018SR128851	芯源 KS-L100-2C 匀胶系统控制软件 V1.0	全部权利	2017/10/27	2067/12/31
8	2018SR128844	胶泵控制器控制软件 V1.0	全部权利	2017/10/26	2067/12/31
9	2018SR128612	匀胶单元 PLC 控制软件 V1.0	全部权利	2017/9/27	2067/12/31
10	2018SR247362	芯源 KS-M200-1D 显影系统控制软件 V1.0	全部权利	2017/7/14	2067/12/31
11	2018SR128769	无线测温控制软件 V1.0	全部权利	2017/6/20	2067/12/31
12	2018SR247342	芯源 KS-S300-4D 显影系统控制软件 V1.0	全部权利	2017/6/10	2067/12/31
13	2017SR472951	兆声波功率检测系统控制软件 V1.0	全部权利	2017/5/27	2067/12/31
14	2017SR589400	四轴运动控制器控制软件 V1.0	全部权利	2017/5/27	2067/12/31
15	2018SR128856	芯源 KS-M200-1SP 喷胶系统控制软件 V1.0	全部权利	2016/12/27	2066/12/31
16	2017SR110620	基于 easycluster 的模块化 Track 控制系统 V1.0	全部权利	2016/7/27	2066/12/31
17	2017SR472895	芯源 KS-M175S-1CL 清洗系统控制软件 V1.0	全部权利	2016/7/27	2066/12/31
18	2017SR471587	芯源擦片涂胶系统控制软件 V1.0	全部权利	2016/4/20	2066/12/31
19	2018SR128082	芯源 KS-S150-3D 显影系统控制软件 V1.0	全部权利	2015/7/25	2065/12/31
20	2018SR128077	芯源 KS-S100-4D 显影系统控制软件 V1.0	全部权利	2015/4/27	2065/12/31
21	2018SR128597	芯源涂胶系统 KS-M200-1C 控制软件 V1.0	全部权利	2015/4/27	2065/12/31
22	2018SR128605	芯源匀胶系统 KS-S300-2C 控制软件 V1.0	全部权利	2015/4/27	2065/12/31
23	2018SR127674	芯源 KS-S100-3D 显影系统控制软件 V1.0	全部权利	2015/4/27	2065/12/31

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期	到期日期
24	2017SR585436	芯源 KS-C300-4D 显影系统控制软件 V1.0	全部权利	2015/2/20	2065/12/31
25	2015SR166655	涂胶显影机与光刻机连接的 Interface 软件	全部权利	2013/11/30	2063/12/31
26	2017SR351543	KingSEMI 去胶剥离系统操作软件 [简称: KSE]V1.0	全部权利	2013/10/20	2063/12/31
27	2014SR075920	基于 MFC 的半导体领域湿法处理独立台控制系统平台 V1.0	全部权利	2013/10/8	2063/12/31
28	2017SR398789	KingSEMI 湿法刻蚀 (湿刻) 系统操作软件 [简称: KSE]V1.0	全部权利	2012/10/20	2062/12/31
29	2018SR127904	芯源 KS-S300-3SP 喷胶系统控制软件 V1.0	全部权利	2012/10/20	2062/12/31
30	2018SR247145	芯源 KS-M300-1SP 喷胶系统控制软件 V1.0	全部权利	2012/10/20	2062/12/31
31	2011SR035085	KingSEMI 方片涂胶系统操作软件 [简称: KS-S150F]V1.0	全部权利	2010/11/30	2060/12/31
32	2017SR374886	芯源涂胶系统控制软件 V1.0	全部权利	2010/11/10	2060/12/31
33	2018SR128621	芯源 KS-S100-2C 匀胶系统控制软件 V1.0	全部权利	2010/6/28	2060/12/31
34	2010SR049391	KingSEMI 刻蚀系统操作软件 [简称: KSE]V1.0	全部权利	2010/3/16	2060/12/31
35	2010SR069096	KingSEMI 喷胶系统操作软件 [简称: KD-C300C1]V1.0	全部权利	2009/12/31	2059/12/31
36	2011SR022138	KingSEMI 清洗系统操作软件 [简称: KSE]V1.0	全部权利	2009/2/28	2059/12/31
37	2006SR17646	半导体设备匀胶显影系统操作软件 V1.0	全部权利	2004/7/31	2054/12/31

5、资质证书

截至 2019 年 3 月 31 日, 公司拥有的生产经营许可及资质证书情况如下:

序号	证书号	证书名称	有效期至
1	00855770	对外贸易经营者备案登记表	/
2	2101310044	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	长期有效
3	2103000266	自理报检企业备案登记证明书	/
4	EMS698400	环境管理体系-ISO14001:2015 证书	2021 年 9 月 14 日
5	M698399	质量管理体系-ISO9001:2015 证书	2021 年 9 月 14 日

序号	证书号	证书名称	有效期至
6	OHS698401	职业健康安全管理体系-BS OHSAS18001:2007/GB/T28001-2011 证书	2021年3月11日

6、特许经营权

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

（三）发行人与他人共享资源要素的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在与他人共享资源要素，或作为被许可方使用他人资源要素的情形。公司拥有或使用的资源要素不存在纠纷或潜在纠纷的情况。

九、发行人技术与研发情况

（一）主要产品的核心技术情况

公司产品主要分为两类，一类是光刻工序涂胶显影设备，另一类是单片式湿法设备。通过多年的技术研发，公司在上述产品领域均掌握了相关核心技术，并在持续提高设备工艺性能、产能，提升客户产品良率和降低客户成本（Cost of Ownership，以下简称“CoO”）等方面不断进行创新。这些核心技术都在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的竞争力。

1、光刻工序涂胶显影设备

（1）核心技术概况

序号	名称	技术来源	专利及其他保护措施	应用和贡献情况		
				LED芯片制造等领域	集成电路后道先进封装领域	集成电路前道晶圆加工领域
1	光刻工艺胶膜均匀涂敷技术	自主研发	已获授权专利10项	已量产	已量产	正在工艺验证，尚未量产
2	不规则晶圆表面喷涂技术	自主研发	已获授权专利7项	/	已量产	/
3	精细化显影技术	自主研发	已获授权专利8项	已量产	/	正在工艺验证，尚未量产
4	高产能设备架构及机械手优化调度技术	自主研发	已获授权专利10项；软著权18项	已量产	已量产	正在工艺验证，尚未量产

序号	名称	技术来源	专利及其他保护措施	应用和贡献情况		
				LED 芯片制造等领域	集成电路后道先进封装领域	集成电路前道晶圆加工领域
5	内部微环境精确控制技术	自主研发	已获授权专利 19 项	已量产	已量产	正在工艺验证, 尚未量产
6	光刻机联机调度技术	自主研发	已获授权专利 4 项	/	/	正在工艺验证, 尚未量产

(2) 核心技术先进性及具体表征

名称	具体说明
光刻工艺胶膜均匀涂敷技术	针对前道光刻涂胶显影工艺, 公司的低粘度超薄光刻胶涂布技术, 需要对腔体环境温度精度控制在 0.1℃ 内, 湿度精度控制在 0.5% 内, 各个运动部件控制精度在 0.1mm 内, 再通过专门硬件对温湿度、时序等工艺参数的精确控制, 实现超薄胶膜 (膜厚约为工艺线宽的 3-5 倍; 28nm 节点的膜厚约为 100nm) 的高均匀性涂敷, 偏差要求在 1% 以内, 并可降低客户的 CoO; 针对超厚胶涂敷工艺中的普遍问题, 公司创新设计腔体结构和热盘单元并通过独特的打胶方式提高超厚胶膜的均匀性。
不规则晶圆表面喷涂技术	针对晶圆表面已带有图形而需要涂敷光刻胶或阻挡层的场景应用, 采用超细雾化与喷涂技术, 实现深宽比 3: 1 难点突破, 喷胶头运动路径优化与控制技术, 以及喷涂同步加温固化技术, 沿细微图形表面形成均匀覆盖的胶膜; 可加热式旋转承片台可以按工艺需求精确旋转相应角度喷涂, 保证各个方向侧壁的膜厚均匀性和拐角膜厚厚度, 实现槽中槽和 90 度孔均匀涂覆。优化的管路设计和喷胶单元的防呆设计可提升产能及适用于大量产。
精细化显影技术	公司开发的扫描式显影喷嘴, 通过对显影液温度/流量高精度控制技术在晶圆表面形成均匀完整的显影液膜, 从而良好地控制 CD (线宽) 均匀性; 配合显影后冲洗喷嘴的高低流量切换功能和精确的扫描速度控制技术, 可以满足各种不同精细化显影工艺需求。显影液/冲洗液温度可控制在 0.1℃ 内, 流量精度可控制在 10ml/min 内, 实现纳米级线宽显影工艺的精确控制。
高产能设备架构及机械手优化调度技术	前道涂胶/显影机因为要与光刻机联线生产, 对其产能要求高于光刻机, 公司最先进的机型具有超百个工艺单元。为使产能最大化, 新平台架构将工艺单元最小化设计并优化排布, 利用多机械手多通道并行技术, 对晶圆在不同工艺单元之间进行快速传送; 在平台系统软件方面, 通过采用 Robot Arm 快速交换、增加 Foup 缓冲功能、智能化优化调度来实现设备高产能。
内部微环境精确控制技术	利用高精度温湿度控制技术对进入设备的空气进行精确控制 (温度控制精度 $\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$, 湿度控制精度 $\leq \pm 0.1\%$), 并使用高效化学过滤装置控制微环境气体成分。通过数值仿真技术优化整机结构设计以保证设备内部气流的有效合理分布以保持设备高稳定性和洁净度; 采用多分区热板设计和创新的制造方法和新材料, 实现晶圆温度的高均匀性 (全晶圆温度均匀性标准偏差 $\leq 0.07\%$), 可满足客户严格的技术要求, 并降低制造成本。

名称	具体说明
光刻机联机调度技术	前道涂胶/显影机在生产线上多与光刻机联机运行，公司的联机技术硬件设计灵活，一个硬件接口单元即可对应各种主流光刻机，软件设计实现通信对接，具有通信可视界面和日志在线查看功能。

2、单片式湿法设备

(1) 核心技术概况

序号	名称	技术来源	专利及其他保护措施	应用和贡献情况		
				LED 芯片制造等领域	集成电路后道先进封装领域	集成电路前道晶圆加工领域
1	工艺单元参数精确控制技术	自主研发	已获授权专利4项	已量产	已量产	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
2	高产能设备架构及机械手优化调度技术	自主研发	已获授权专利4项	已量产	已量产	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
3	晶圆正反面颗粒清洗技术	自主研发	已获授权专利3项	/	/	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
4	化学药品精确供给及回收技术	自主研发	已获授权专利9项	已量产	已量产	/
5	内部微环境精确控制技术	自主研发	已获授权专利2项	已量产	已量产	已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并实现销售
6	不同尺寸晶圆兼容高效能浸泡单元技术	自主研发	已获授权专利5项	/	已量产	/

(2) 核心技术先进性及具体表征

名称	具体说明
----	------

名称	具体说明
工艺单元参数精确控制技术	利用高精度运动控制技术并配合传感器技术及软件技术,实现承片台和化学品摆臂位置与速度的精确控制,在 100~3000rpm 转速范围内,精度可达±1rpm 以内,可适用诸如去胶、刻蚀和颗粒清洗等多种清洗工艺;同时,摆臂变速扫描技术可在不同晶圆区域喷洒不同量化学品,从而减少化学品用量,降低客户成本。
高产能设备架构及机械手优化调度技术	在公司通用架构的基础上,为了达到产能最大化,在硬件方面利用高速高精度的机械手技术,对晶圆在设备内的多个工艺单元之间进行快速传送;在平台系统软件方面,通过调度优化技术对传送过程实时进行最优化,实现设备的高产能,对于 LED 制造领域中 4 寸晶圆的 Lift Off 工艺,产能高于 80pcs/h,对于前道清洗工艺,产能高于 340pcs/h。
晶圆正反面颗粒清洗技术	为去除晶圆表面(正反两面)颗粒污染物,公司新开发的二流体喷嘴技术可将晶圆表面的细微颗粒污染物去除,同时确保不损伤晶圆表面的图形;对于微米级别大颗粒,公司的毛刷清洗技术采用特殊材料的毛刷对晶圆进行擦洗去除。配合特有的晶圆翻转装置和夹持式承片台,可在同一台设备中对晶圆的正反两面进行清洗,清洗效果为 120nm 以上颗粒去除率高于 95%。
化学药品精确供给及回收技术	利用高精度的流量检测和控制技术、多级稳压技术、在线温度检测及控制技术,对工艺所用的化学品流量、压力及温度等参数进行精准控制以满足多种清洗工艺要求,流量控制精度可达±2%FS 以内,对于低温段(室温~40℃)温控精度可控制在±1℃以内,对于高温段(40℃~80℃)温控精度可控制在±2℃以内,对于高压压力可控制在±0.1MPa 以内;同时,通过内外 Cup 升降配合药液阀切换等方式实现药液的分类回收,其中 8 寸工艺中药液回收率高于 97%,12 寸工艺中药液回收率高于 95%,有效降低客户成本。
内部微环境精确控制技术	为保证晶圆处理微环境的洁净和稳定一致,利用高精度温湿度控制技术对进入设备的空气进行精确控制,并使用高效化学过滤装置控制机器内气体成分。通过数值仿真技术优化整机结构设计以保证设备内部气流的有效合理分布,并运用层流气流排布和下排风方式保持设备内部环境始终处于高洁净度的状态,避免晶圆出现颗粒污染。
不同尺寸晶圆兼容高效能浸泡单元技术	针对不同尺寸晶圆的浸泡单元,公司采用创新的兼容设计,实现了无需更换浸泡单元内置片盒即可兼容两种不同尺寸的晶圆,同时在浸泡单元内引入了鼓泡技术、溢流技术等,提升了去胶效率和工艺效果。

(二) 核心技术产品占营业收入的比例

报告期内,公司核心技术产品收入占营业收入的比例如下:

单位:万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
核心技术产品收入	968.67	20,096.97	18,353.16	14,350.64
营业收入	1,030.53	20,999.05	18,988.50	14,760.31

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
占比	94.00%	95.70%	96.65%	97.22%

报告期各期，公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入分别为14,350.64万元、18,353.16万元、20,096.97万元和968.67万元，占当期营业收入的比重分别为97.22%、96.65%、95.70%和94.00%，占比较高。

（三）核心技术的科研实力和成果情况

1、公司获得的重要奖项

2002年成立至今，公司先后获得“2018年中国半导体设备五强企业”、“国家级知识产权优势企业”、“国家高技术产业化示范工程”、“国内先进封装领域最佳设备供应商”等多项殊荣，公司产品先后获得“国家战略性创新产品”、“国家重点新产品”等多项荣誉，具体情况如下：

序号	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
1	2018年中国半导体设备五强企业	中国半导体行业协会	2019年5月
2	2018年度中国半导体封测行业最佳设备供应商	中国半导体封测行业交流会	2018年10月
3	2017年中国半导体设备行业十强单位	中国电子专用设备工业协会	2018年5月
4	2017年度国家级知识产权优势企业	国家知识产权局	2017年12月
5	辽宁省科技进步二等奖	辽宁省人民政府	2017年2月
6	辽宁省企业重大研发成果奖	辽宁省科学技术奖励委员会	2014年11月
7	辽宁省优秀新产品一等奖	辽宁省人民政府	2014年8月
8	2014年辽宁省“专精特新”产品	辽宁省中小企业厅	发证日期：2014年7月，有效期：3年
9	辽宁省省级企业技术中心	辽宁省经信委、财政厅、地税局	2013年10月
10	辽宁省知识产权优势企业	辽宁省知识产权局、经信委、中小企业厅	2013年10月
11	国家战略性创新产品	科技部、环保部、商务部、国家质量监督检验检疫总局	发证日期：2012年5月，有效期：3年
12	国家高技术产业化示范工程	国家发展和改革委员会	2010年
13	辽宁省科学技术三等奖	辽宁省科学技术奖励委员会	2010年12月

序号	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
14	辽宁省优秀新产品二等奖	辽宁省人民政府	2010年8月
15	科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业	科技部、财政部	2009年12月
16	科技型中小企业创新基金创新项目立项	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2009年6月
17	辽宁省科学技术二等奖	辽宁省科学技术奖励委员会	2008年12月
18	2007年中国半导体协会创新产品和技术	中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会等	2008年2月
19	国家火炬计划项目证书	科技部火炬高技术产业开发中心	2007年12月
20	国家重点新产品	科技部、环保部、商务部、国家质量监督检验检疫总局	发证日期:2007年12月,有效期:3年
21	国家火炬计划项目证书	科技部火炬高技术产业开发中心	2005年5月

2、公司承担的重大科研项目

公司研发实力较为突出,承担了多项国家科技重大专项及其他省部级重大科研项目,具体情况如下:

序号	项目类别	重大科研项目名称	项目时间
1	国家发改委创新链整合项目	集成电路 300mm 晶圆单片处理设备研发及产业化项目	2016-2018 年
2	辽宁省科技重大专项	90nm 光刻工艺匀胶显影设备研发与应用	2014-2015 年
3	国家科技重大专项 (“十二五”02 重大专项)	300mm 晶圆匀胶显影设备研发	2012-2015 年
4	国家发改委重点产业振兴和技术改造专项	高端封装工艺喷涂胶、显影、单片湿法刻蚀设备研发与产业化	2010-2013 年
5	国家科技部国际合作项目	三维先进封装工艺单晶圆湿法处理技术合作研发	2009-2011 年
6	国家科技重大专项 (“十一五”02 重大专项)	凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备研发与产业化建设	2009-2012 年
7	国家发改委电子专用设备产业化专项	8-12 英寸集成电路制造匀胶显影设备产业化	2006-2008 年

(四) 正在从事的主要研发项目情况

截至本招股说明书披露日,公司正在从事的主要研发项目如下:

序号	研发项目名称	拟达目标	阶段及进展情况
1	前道 In line Track 研制与工艺验证	应用已掌握的单元技术，设计制造可与光刻机 Inline 运行的 12 寸前道涂胶显影设备，用于验证 90nm 及以下 I-line、KrF、ArF-dry 的工艺制程	已完成设计制造与调试，可用于相关的工艺试验与验证
2	六层架构前道涂胶显影机研制	设计开发可与国际主流 I-line 光刻机联机的涂胶显影设备，产能 240wph	样机试制阶段，样机装配调试中
3	Scrubber 清洗设备研制	研发、验证 Scrubber 双面清洗设备关键单元技术，设计并验证 8 腔 Scrubber 清洗机设备	完成 90nm 工艺验证，目前正在进行 48nm 及 28nm 工艺测试
4	前道机台单元技术优化与应用	针对已有机台在客户现场应用发现的问题，通过试验研究解决关键技术，制作单元样机进行工艺验证，进一步优化单元和整机设计，提高产品的可靠性、稳定性	已完成单元的试验研究及样机制造，正在客户现场进行工艺试验与验证
5	堆叠式 8 英寸前道设备设计开发	开发面向 8 英寸前道客户需求的堆叠式涂胶显影设备	产品设计已完成
6	晶圆传输机器人核心技术开发	掌握并验证机器人核心技术，为后续新产品开发提供技术储备	正在进行指标验证及马拉松测试
7	大角度翻转浸泡单元研发	研发新结构的翻转、浸泡单元，并搭建测试样机进行验证	完成方案设计，正在进行单元试制
8	WEE 单元国产化研发	完善 WEE 机械结构，满足多种工艺需求，完成电气及控制系统的国产化改造	完成样机装配，正在进行运行测试
9	胶泵及控制器国产化开发	研发适用于先进封装、LED 芯片制造等领域的胶泵及控制器，并实现进口替代	正在进行胶泵设计，控制器设计开发中

（五）研发投入情况

报告期内，公司研发投入逐年增加，主要包括工资薪金、研发材料费用、折旧及摊销费用等，研发投入占营业收入的比例较高，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发投入	595.32	3,421.45	1,975.81	1,659.24
营业收入	1,030.53	20,999.05	18,988.50	14,760.31
占比	57.77%	16.29%	10.41%	11.24%

（六）合作研发情况

报告期内，公司未开展合作研发项目。

（七）研发团队建设情况

公司的核心管理和技术团队具有多年半导体专用设备行业经验，截至 2019 年 3 月 31 日，公司共有技术人员 86 人，占员工总人数的比例为 34.40%，其中硕士研究生 47 人、本科 38 人，大学本科学历及以上人员占技术人员总数比例为 98.84%。

公司核心技术人员共有 8 人，分别为宗润福、陈兴隆、王绍勇、张怀东、苗涛、谷德君、郑右非、程虎，占员工总人数比例为 3.20%，上述核心技术人员简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。报告期内，除陈兴隆 2018 年 3 月作为核心技术人员入职公司外，公司其他核心技术人员未发生变动，公司对其实施了股权激励，同时其也适用于公司的绩效考核及其他激励制度。公司核心技术人员持有公司的股权有禁售期限限制，其已与公司签订竞业禁止协议、保密协议。

（八）保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

自成立以来，公司始终坚持以技术创新为核心发展目标，以质量保证为首要发展任务的经营理念，建立了较为完善的技术创新机制，对未来技术储备及技术创新作了合理安排，主要包括以下几个方面：

1、建立健全研发体系，推进自主研发

公司始终坚持自主研发、超越创新，通过建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，从严落实从研发立项、产品设计、功能测试、试生产等各个环节。

2、加大研发投入力度，保证创新机制运行

最近三年，公司研发投入金额分别为 1,659.24 万元、1,975.81 万元和 3,421.45 万元，呈现稳定上升趋势。未来，公司将根据自身发展情况，继续加大研发投入力度，为公司的技术创新、人才培养等创新机制营造良好的物质基础。

3、构建公平有效的激励机制，提升研发人员积极性

公司构建了公平有效的激励机制，深入了解员工需求，通过绩效评价等方式对员工特别是研发人员进行物质奖励和精神激励，拓宽研发人员晋升路线，使研发人员在创新实践的同时，能够得到持续创新的动力。同时，公司历史上通过对核心员工实施股权激励，进一步提升了员工特别是研发人员对于人力资本价值的认识，保证了核心研发团队的稳定。

4、强化人才培养制度，加强研发团队建设

公司高度重视人才培养和研发团队建设，一方面，通过校园招聘、社会招聘等方式引进优秀人才，不断壮大研发队伍，另一方面，公司会根据业务需求组织定期或不定期的内外部专业技能培训，通过全方位、有针对性、阶段性的培养，不断提升研发人员的创新能力，提升员工综合素质和技能水平，激发员工潜能。

十、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在中华人民共和国境外进行生产经营活动，未拥有境外资产。

第七节 公司治理与独立性

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员的运作及履职情况

（一）发行人股东大会制度的建立及其运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》，股东大会制度健全，运行情况良好。

自股份公司设立至本招股说明书签署之日，公司共召开了4次股东大会，相关股东依法出席了历次会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求规范运作，在会议召集、议事、表决及决议等方面均符合有关法律法规和公司章程的规定。

（二）发行人董事会的建立及其运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》，董事会制度健全，运行情况良好。

自股份公司设立至本招股说明书签署之日，公司共召开了7次董事会，相关董事依法出席了历次会议。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求规范运作，在会议召集、议事、表决及决议等方面均符合有关法律法规和公司章程的规定。

根据现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中设独立董事3名，董事长1名。董事由股东大会选举和更换，任期三年，可连选连任。

（三）发行人监事会的建立及其运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》，监事会制度健全，运行情况良好。

自股份公司设立至本招股说明书签署之日，公司共召开了4次监事会，相关

监事依法出席了历次会议。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的要求规范运作，在会议召集、议事、表决及决议等方面均符合有关法律法规和公司章程的规定。

根据现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会设监事主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。所有监事任期 3 年，可连选连任。

（四）发行人独立董事及其履职情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，公司建立了独立董事工作制度。《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件对公司独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、独立意见、行使职权的保障等均作出了明确详尽的规定。

2019 年 4 月 24 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，选举公司第一届董事会独立董事。

公司独立董事自当选以来，认真履行其作为独立董事的权利和义务，根据有关规定对公司相关议案发表了独立意见，维护了全体股东的利益，对于完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（五）发行人董事会秘书及其履职情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件，公司制定了《董事会秘书工作细则》。

股份公司设立以来，公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定开展工作，筹备并参与历次董事会会议和股东大会，较好地履行了自身职责，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会依法行使职权发挥了重要作用。

（六）发行人董事会专门委员会的设置及其运行情况

2019年4月9日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》，决定在董事会框架下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员/召集人，审计委员会中担任主任委员的独立董事宋雷是会计专业人士，各委员会组成情况如下：

委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	宗润福	宗润福、郑广文、孙华、朱煜
提名委员会	朱煜	朱煜、张宏斌、赵庆党
薪酬与考核委员会	宋雷	宋雷、郑广文、朱煜
审计委员会	宋雷	宋雷、张宏斌、王蓉辉

公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会自设立以来严格按照《公司章程》和《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定开展工作。

二、特别表决权股份或类似安排情况

公司不存在特别表决权股份或类似安排等相关情形。

三、协议控制架构情况

公司不存在协议控制架构相关情形。

四、管理层对内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见

（一）内部控制的自我评估意见

公司管理层对公司内部控制的自我评估意见为：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系

和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

发行人会计师出具了《内部控制鉴证报告》（会专字[2019]6269号），认为：发行人根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2019年3月31日在所有重大方面是有效的。

五、发行人报告期内的规范运作情况

发行人已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构，报告期内，发行人及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在受到相关主管机关重大处罚的情况。

六、报告期内发行人持股5%以上股东及其控制的其他企业占用发行人资金和由发行人提供担保的情况

1、资金占用

报告期内，除公司第一大股东先进制造控制的富创精密存在向发行人拆借资金情形外，不存在资金被持股5%以上的股东及其控制的其他企业占用的情形，详情参见本节之“十、发行人关联交易情况”之“（二）偶发性关联交易”。

2、对外担保

报告期内，公司不存在为持股5%以上股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

七、发行人独立运营情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公

公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东完全分开，具有完整的资产、研发、实施和销售业务体系，具备直接面向市场独立持续经营的能力。

1、资产独立情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在持股 5% 以上的股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在持股 5% 以上的股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在持股 5% 以上的股东及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

3、财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和财务管理制度；发行人未与持股 5% 以上的股东及其控制的其他企业共用银行账户。

公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与持股 5% 以上股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

4、机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，发行人建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。发行人的经营和办公场所与持股 5% 以上股东及其控制的其他企业严格分开，不存在与持股 5% 以上股东及其控制的其他企业

机构混同的情形。

5、业务独立情况

公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购所需原材料，独立组织项目实施，独立销售产品和提供售后服务，业务独立于持股 5%以上股东及其控制的其他企业；与持股 5%以上股东及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，或严重影响发行人独立性或显失公平的关联交易。

6、公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内公司主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；公司无控股股东及实际控制人，不存在最近 2 年内实际控制人发生变更的情形，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

7、公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，公司经营环境稳定，不存在已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

八、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备。

报告期内，公司无控股股东及实际控制人，持股 5%以上的股东的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人持股 5%以上股份的主要股东的基本情况”。

经核查，保荐机构认为：发行人持股 5%以上的股东及其所控制的企业实际从事的业务与发行人均存在明显差异，不存在同业竞争的情形。

综上，发行人与持股 5%以上的股东及其所控制企业不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，发行人第一大股东先进制造作出如下声明与承诺：

“一、截至本声明与承诺做出之日，发行人第一大股东不存在直接或间接控制的其他企业与发行人的业务存在直接或间接的同业竞争的情形。

二、为避免未来发行人第一大股东及其直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，发行人第一大股东承诺：

在作为发行人第一大股东期间，本声明承诺签署人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本声明承诺签署人亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

三、为了更有效地避免未来发行人第一大股东及其直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本声明承诺签署人还将采取以下措施：

（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（二）如本声明承诺签署人及其直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本声明承诺签署人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本声明承诺签署人及其直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；

（三）如本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本声明承诺签署人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本声明承诺签署人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。

（四）如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本声明承诺签署人将赔偿发行人因此受到的一切损失；如因违反本声明与承诺而从中受益，本声明承诺签署人同意将所得收益全额补偿给发行人。”

九、关联方和关联关系

依据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，截至本招股说明书签署日，发行人主要关联方和关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人

报告期内，发行人无控股股东、实际控制人。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东

序号	关联方名称	关联关系
1	先进制造	直接持有发行人 5%以上股份的股东
2	中科院沈自所	直接持有发行人 5%以上股份的股东
3	科发实业	直接持有发行人 5%以上股份的股东
4	国科投资	直接持有发行人 5%以上股份的股东
5	国科瑞祺	直接持有发行人 5%以上股份的股东
6	周冰冰	直接持有发行人 5%以上股份的股东

（三）董事、监事、高级管理人员

关联方名称	关联关系
宗润福、郑广文、孙华、赵庆党、王蓉辉、陈兴隆、朱煜、宋雷、张宏斌	董事
苗涛、梁倩倩、史晓欣	监事
李凤莉、顾永田	未同时担任董事、监事的其他高级管理人员
孙海涛、吕孝普、高海彬、王小刚、蒋和娟、蒋小军、王永斌	报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

（四）其他关联方

除前述关联方外，发行人其他关联方还包括：

1、上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，及其直接或者间接控制的、担任董事、高级管理人员的，除公司以外的法

人或者其他组织；

2、上述关联法人或关联自然人直接或间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的，除公司以外的法人或其他组织；

3、间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

4、根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织。

十、发行人关联交易情况

（一）经常性关联交易

1、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员发放薪酬情况如下：

单位：万元

交易内容	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
关键管理人员薪酬	126.91	377.17	289.65	116.90

2、购销商品、接受或提供劳务

报告期内，公司不存在购销商品、接受或提供劳务的经常性关联交易。

（二）偶发性关联交易

1、采购商品、接受劳务

（1）向新松机器人（为中科院沈自所控制的企业）采购商品及支付维修费

①2016年12月，公司与新松机器人签署合同，约定公司向新松机器人采购产品型号为PC104的板卡1个并由后者提供上门维修服务，合同总价款为0.85万元（不含增值税）。

②2017年6月，公司与新松机器人签署《采购合同》，约定公司向新松机器人采购产品型号为SRBJ1A-AD4551的机器人1台，合同总价款为10.68万元（不含增值税）。

(2) 向沈阳高精数控智能技术股份有限公司（以下简称“高精数控”，科发实业、沈阳科投分别持有高精数控 10.42%和 9.00%的股份，公司现任董事赵庆党同时担任高精数控董事）采购商品

2018 年 1 月，公司与高精数控签署《中空轴水冷电机驱动器合同》，约定公司向高精数控采购 6 台中空轴水冷电机驱动器，合同总价款 2.00 万元（不含增值税）。

(3) 向中科院沈自所采购商品

2018 年 8 月，公司与中科院沈自所签署《采购合同》，约定公司向中科院沈自所采购产品型号为 SIA NOZZLE V1.0 的胶嘴监测系统，合同总价款为 22.17 万元（不含增值税），目前已支付合同总价款 20%的订货款。

(4) 向富创精密（为先进制造控制的企业）采购商品

2019 年 1 月，公司与富创精密签署《采购合同》，约定公司向富创精密采购底板、安装板等，合同总价款为 16.82 万元（不含增值税）。

2、销售商品

2018 年 2 月，中科院沈自所及沈阳中科博微科技股份有限公司（以下简称“中科博微”，中科院沈自所、科发实业、沈阳科投分别通过直接及间接方式持有中科博微 31.68%、16.80%和 5.71%的股份，公司报告期内离任的董事孙海涛担任中科博微董事长）分别向公司采购标书，交易金额均为 0.03 万元（不含增值税）。

3、关联方资金拆借

报告期内，公司与关联方的资金拆借情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利息是否支付
2017 年度拆出				
富创精密	2,000.00	2017 年 3 月 14 日	2017 年 3 月 16 日	是
2016 年度拆出				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利息是否支付
富创精密	500.00	2016年3月30日	2016年9月18日	是
	300.00	2016年6月1日	2016年6月17日	是
	300.00	2016年6月17日	2016年6月30日	是

4、银行贷款受托支付

报告期内，关联方富创精密为了按照规定获取银行贷款，在银行为富创精密发放贷款时，由银行受托支付给公司，公司收到后于当日直接转入富创精密的银行账户，该等受托支付未对公司资金造成占用，具体情况如下：

单位：万元

贷款银行	金额	转入日期	转出日期
锦州银行股份有限公司	300.00	2016年9月14日	2016年9月14日
辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司	1,500.00	2017年1月16日	2017年1月16日
浙商银行股份有限公司沈阳分行	2,000.00	2017年6月1日	2017年6月1日

5、关联担保

2016年7月20日，宗润福与建设银行城内支行签订《最高额保证合同（自然人版）》（合同编号“2016043-1”），合同约定，建设银行城内支行将于2016年7月20日至2018年7月20日（债权确定时间）为沈阳芯源办理发放人民币/外币贷款授信业务，并签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律文件（以下简称“主合同”），宗润福为主合同项下的一系列债权提供最高额担保，最高限额为人民币6,000万元。2016年11月，沈阳芯源取得建设银行城内支行为其提供的借款1,000万元，2017年5月，沈阳芯源清偿该笔借款。

（三）关联方往来

报告期各期末，发行人与关联方或存在业务或资金往来需比照关联方披露的企业或人员的应收应付款项情况如下：

1、应收款项

单位：万元

关联方名称	项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中科院沈自所	预付款项	5.14	-	5.14	-	-	-	-	-
宗润福	其他应收款	-	-	-	-	0.17	0.01	0.11	0.01

2、应付款项

单位：万元

关联方名称	项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	应付账款	6.25	6.25	10.68	-
沈阳富创精密设备有限公司	应付账款	16.82	-	-	-
宗润福	其他应付款	1.17	0.92	-	-

(四) 报告期关联交易汇总简表

单位：万元

项目	2019年1-3月 /2019.3.31	2018年度 /2018.12.31	2017年度 /2017.12.31	2016年度 /2016.12.31
关键管理人员薪酬	126.91	377.17	289.65	116.90
向关联方采购商品	16.82	6.43	10.68	-
向关联方支付维修费	-	-	0.85	-
向关联方出售商品	-	0.06	-	-
关联方资金拆借	-	-	2,000.00	1,100.00
对关联方预付账款余额	5.14	5.14	-	-
对关联方应付账款余额	23.07	6.25	10.68	-
对关联方其他应收款余额	-	-	0.17	0.11
对关联方其他应付款余额	1.17	0.92	-	-

(五) 关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期公司与关联方之间产生的交易有必要的产生原因，依照公允原则确定

交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对发行人的财务状况和经营成果无重大影响。

（六）关于规范及减少关联交易的承诺

为规范及减少关联交易，发行人持股 5%以上的股东已作出声明与承诺，具体内容如下：

1、发行人第一大股东先进制造声明与承诺：

“（1）在本公司/本单位作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司的第一大股东期间，本公司/本单位及本公司/本单位控制的其他企业将尽量减少与沈阳芯源微电子设备股份有限公司及其子公司的关联交易；

（2）对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本单位及本公司/本单位控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与沈阳芯源微电子设备股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司/本单位保证不通过关联交易损害沈阳芯源微电子设备股份有限公司及其无关联关系股东的合法权益；

（3）如违反上述承诺，本公司/本单位愿意承担由此给沈阳芯源微电子设备股份有限公司造成的全部损失。

（4）上述承诺在本公司/本单位作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司第一大股东期间持续有效。”

2、发行人其他持股 5%以上的股东声明与承诺：

“（1）在本人/本企业/本单位作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司持股 5%以上的股东期间，本人/本企业/本单位及本人/本企业/本单位控制的其他企业将尽量减少与沈阳芯源微电子设备股份有限公司及其子公司的关联交易；

（2）对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业/本单位

及本人/本企业/本单位控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与沈阳芯源微电子设备股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人/本企业/本单位保证不通过关联交易损害沈阳芯源微电子设备股份有限公司及其无关联关系股东的合法权益；

(3) 如违反上述承诺，本人/本企业/本单位愿意承担由此给沈阳芯源微电子设备股份有限公司造成的全部损失。

(4) 上述承诺在本人/本企业/本单位作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司持股 5% 以上的股东期间持续有效。”

十一、关联交易制度的执行情况

2019 年 3 月股改完成后，公司制订了《关联交易管理办法》。公司尽量避免不必要的关联交易，对新发生的关联交易严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定进行。

2019 年 6 月 6 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于对公司 2016 年至 2019 年 3 月关联交易予以确认的议案》，独立董事对公司与关联方报告期内的关联交易发表意见认为：“公司在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1 月至 3 月内与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照沈阳芯源当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司 2016 年至 2019 年 3 月关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意董事会对该关联交易议案的表决结果，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议，且关联股东于股东大会审议该议案时亦应回避表决。”

十二、报告期内关联方的变化情况

报告期内，公司关联方的变化情况如下：

（一）关联法人的变化情况

公司报告期内，不存在由关联方变为非关联方而继续交易的情形。

（二）关联自然人的变化情况

报告期内，公司新增周冰冰为持股 5% 以上股份的自然人股东。公司董事、监事、高级管理人员的变化情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内的变动情况、原因及对公司的影响”。

第八节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司经审计的财务报表及附注。本节的财务会计数据及有关说明反映了公司报告期内经审计财务报告及附注的主要内容。公司提醒投资者阅读本公司的财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、经审计的财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产：				
货币资金	41,848,113.36	64,050,453.32	82,889,752.03	57,075,267.35
交易性金融资产	1,000,000.00	-	-	-
应收票据及应收账款	47,339,942.41	69,102,109.60	49,208,261.79	55,723,365.24
预付款项	5,561,794.44	3,732,031.50	2,882,293.77	2,022,672.39
其他应收款	1,411,923.90	5,570,210.11	2,254,924.90	253,365.56
存货	158,053,729.96	143,652,635.60	88,544,264.59	97,456,266.37
其他流动资产	5,369,274.05	5,527,323.40	15,660,288.62	10,959,683.05
流动资产合计	260,584,778.12	291,634,763.53	241,439,785.70	223,490,619.96
非流动资产：				
固定资产	79,872,536.29	81,310,737.78	83,941,122.39	63,680,649.98
在建工程	-	-	1,067,488.00	5,014,132.87
无形资产	4,965,393.64	5,114,288.74	4,270,206.46	3,861,579.05
递延所得税资产	3,409,482.94	1,217,833.07	1,245,225.69	1,180,114.58
其他非流动资产	633,872.79	425,193.55	3,174,660.65	100,000.00
非流动资产合计	88,881,285.66	88,068,053.14	93,698,703.19	73,836,476.48
资产总计	349,466,063.78	379,702,816.67	335,138,488.89	297,327,096.44
流动负债：				
短期借款	-	-	-	15,000,000.00
应付票据及应付账款	40,191,193.69	52,063,869.57	28,873,195.36	38,610,268.11

项目	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
预收款项	59,250,597.16	59,082,015.43	64,284,300.56	63,134,897.70
应付职工薪酬	-	7,430,838.00	6,254,235.00	4,074,982.00
应交税费	3,171,516.45	4,176,733.56	515,762.89	1,493,764.94
其他应付款	1,341,936.96	1,336,298.30	682,575.79	290,837.87
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	103,955,244.26	124,089,754.86	100,610,069.60	122,604,750.62
非流动负债：				
递延收益	34,659,119.72	35,736,133.58	41,349,404.15	28,369,881.81
非流动负债合计	34,659,119.72	35,736,133.58	41,349,404.15	28,369,881.81
负债合计	138,614,363.98	159,825,888.44	141,959,473.75	150,974,632.43
所有者权益：				
股本	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	58,305,250.00
资本公积	156,876,928.23	66,376,171.58	66,376,171.58	47,597,171.58
盈余公积	-	9,719,601.91	6,671,810.60	4,045,004.24
未分配利润	-9,025,228.43	80,781,154.74	57,131,032.96	36,405,038.19
所有者权益合计	210,851,699.80	219,876,928.23	193,179,015.14	146,352,464.01
负债和所有者权益总计	349,466,063.78	379,702,816.67	335,138,488.89	297,327,096.44

(二) 利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	10,305,301.61	209,990,524.25	189,885,024.08	147,603,129.93
减：营业成本	6,401,359.39	112,368,439.89	110,738,652.68	85,396,805.58
税金及附加	668,283.42	2,612,221.10	2,197,434.03	1,041,243.01
销售费用	4,605,420.83	17,292,679.76	20,046,579.66	19,608,659.83
管理费用	6,360,367.58	28,578,885.59	26,933,584.48	22,922,497.07
研发费用	5,953,162.22	34,214,481.65	19,758,056.84	16,592,372.47
财务费用	44,855.62	-743,319.58	1,608,884.16	-528,414.36
其中：利息费用	1,570.83	-	261,181.25	1,962,979.28
利息收入	202,013.07	177,631.68	126,208.82	139,389.22
资产减值损失	-	5,976,521.09	1,888,398.24	5,219,298.11

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
信用减值损失	-887,326.80	-	-	-
加：其他收益	1,577,013.86	21,232,240.63	22,353,574.93	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	37,928.49	1,852,265.61	898,195.89	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-13,920.32	-776,719.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,225,878.30	32,775,120.99	29,951,284.49	-3,426,051.40
加：营业外收入	9,000.00	94,019.06	-	8,209,943.24
减：营业外支出	-	6,179.32	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,216,878.30	32,862,960.73	29,951,284.49	4,783,891.84
减：所得税费用	-2,191,649.87	2,385,047.64	3,683,220.86	-144,565.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,025,228.43	30,477,913.09	26,268,063.63	4,928,457.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,025,228.43	30,477,913.09	26,268,063.63	4,928,457.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-9,025,228.43	30,477,913.09	26,268,063.63	4,928,457.22
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.14	0.48	0.44	0.08

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
(二) 稀释每股收益 收益(元/股)	-0.14	0.48	0.44	0.08

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	28,763,446.36	160,724,146.78	164,227,705.23	161,353,211.36
收到的税费返还	1,464,110.37	16,941,410.30	12,502,679.41	16,467,010.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,842,624.79	15,187,871.55	34,146,175.29	4,971,661.02
经营活动现金流入小计	36,070,181.52	192,853,428.63	210,876,559.93	182,791,883.17
购买商品、接受劳务支付的现金	25,348,585.70	125,464,302.14	84,057,263.33	62,312,627.15
支付给职工以及为职工支付的现金	17,624,195.44	40,712,168.71	35,031,811.23	28,354,853.19
支付的各项税费	7,334,032.95	14,476,113.85	16,980,323.71	5,659,346.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,283,085.78	40,516,390.65	32,343,120.32	19,593,238.22
经营活动现金流出小计	56,589,899.87	221,168,975.35	168,412,518.59	115,920,064.86
经营活动产生的现金流量净额	-20,519,718.35	-28,315,546.72	42,464,041.34	66,871,818.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	44,000,000.00	228,000,000.00	134,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	37,928.49	1,852,265.61	898,195.89	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	600.00	14,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	122,991.78	-	20,000,000.00	11,000,000.00

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
投资活动现金流入小计	44,160,920.27	229,852,265.61	155,398,795.89	11,014,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,640,974.78	4,236,842.28	15,827,256.45	2,784,565.86
投资支付的现金	45,000,000.00	218,000,000.00	144,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	20,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,640,974.78	222,236,842.28	180,327,256.45	13,784,565.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,480,054.51	7,615,423.33	-24,928,460.56	-2,770,285.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	23,473,750.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	23,473,750.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	15,000,000.00	54,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,780,000.00	3,176,443.75	1,962,979.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,780,000.00	18,176,443.75	56,362,979.28
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,780,000.00	5,297,306.25	-41,362,979.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,054.43	135,063.47	-849,120.15	1,743,398.48
五、现金及现金等价物净增加额	-23,145,827.29	-24,345,059.92	21,983,766.88	24,481,951.65
加：期初现金及现金等价物余额	54,713,974.31	79,059,034.23	57,075,267.35	32,593,315.70

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
六、期末现金及现金等价物余额	31,568,147.02	54,713,974.31	79,059,034.23	57,075,267.35

二、注册会计师的审计意见

（一）注册会计师审计意见类型

审计机构接受公司委托，对公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日的资产负债表，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计，并出具了会审字【2019】6268号标准无保留意见的审计报告。

发行人会计师认为：发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年3月31日、2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的财务状况以及2019年1-3月、2018年度、2017年度、2016年度的经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项是发行人会计师根据职业判断，认为分别对2019年1-3月、2018年度、2017年度、2016年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，发行人会计师不对这些事项单独发表意见。

发行人会计师在会审字【2019】6268号标准无保留意见审计报告中，就上述关键审计事项具体阐述如下：

1、营业收入的确认

（1）事项描述

发行人主要从事半导体专用设备的研发、生产与销售。根据合同约定，芯源公司于产品移交给客户并完成安装调试，验收合格后确认收入。发行人2019年1-3月、2018年度、2017年度和2016年度营业收入分别为1,030.53万元、20,999.05

万元、18,988.50 万元和 14,760.31 万元。

由于营业收入金额较大且为芯源公司重要的财务指标之一，从而存在发行人管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此发行人会计师将营业收入的确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

发行人会计师针对营业收入的确认执行的主要审计程序包括：

① 了解、评价和测试与营业收入确认相关的内部控制，复核相关内部控制设计的合理性以及执行的有效性。

② 对营业收入执行分析程序，包括对比分析报告期各年度、主要产品、综合毛利率的增减变动以及同行业上市公司毛利率等。

③ 从营业收入的会计记录中选取样本，与该笔销售相关的销售合同、验收报告书、发票等信息进行核对，结合应收账款函证、预收账款函证和实地走访程序，确认已入账收入的真实性和准确性。

④ 针对可能出现的完整性风险，以产品出库单为出发点，随机抽取出库单，延续经营链条对相关凭证进行检查，最终检查至记账凭证，以确认产品是否有发出未记录的情况。

⑤ 执行截止测试程序，选取资产负债表日前后记录的收入交易样本。国内销售，重点关注客户出具的产品验收报告书以及期后回款情况；国外销售，与海关报关系统记录数据进行核对，关注报关日期、结算方式、验收报告书以及期后回款等，以验证营业收入是否记录在恰当的会计期间。

通过执行上述审计程序，发行人会计师认为管理层对营业收入的确认是恰当的。

2、存货跌价准备

（1）事项描述

发行人存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货成本高于其可

变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2019年3月31日存货账面余额16,249.75万元、存货跌价准备444.38万元、存货账面价值15,805.37万元，2018年12月31日存货账面余额14,809.64万元、存货跌价准备444.38万元、存货账面价值14,365.26万元，2017年12月31日存货账面余额9,411.05万元、存货跌价准备556.62万元、存货账面价值8,854.43万元，2016年12月31日存货账面余额10,250.06万元、存货跌价准备504.43万元、存货账面价值9,745.63万元。

由于存货跌价准备对财务报表影响较为重大，因此发行人会计师将存货跌价准备识别为关键审计事项。

（2）审计应对

发行人会计师对存货跌价准备执行的主要审计程序包括：

① 了解、评价和测试与存货采购、仓储、生产相关的内部控制，复核相关内部控制设计的合理性以及执行的有效性。

② 取得发出商品清单，检查销售合同、产品出库单，对发出商品数量、状况、发货日期、验收状态等执行函证程序，选取样本到客户现场执行盘点程序。

③ 获取存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行复核，将管理层确定可变现净值时的售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理。

④ 结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注残次冷背的存货是否被识别，并对较长库龄的存货进行重点检查，分析其跌价准备计提的充分性。

⑤ 检查存货跌价准备期后的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。

通过执行上述审计程序，发行人会计师认为管理层对存货跌价准备的确认是恰当的。

三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险

（一）影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及其变化趋势

发行人主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务，通过向下游集成电路、LED 芯片等领域公司销售光刻工序涂胶显影设备及单片式湿法设备等产品实现收入和利润，对公司未来盈利能力或财务状况可能产生影响的因素主要有以下几个方面：

1、产品特点

（1）技术门槛高，性能持续提升

公司所处的半导体设备产业是半导体产业链的上游核心环节，涉及电子、机械、化工、材料、信息等学科领域，行业技术门槛高，通常是一代器件、一代设备、一代工艺。伴随着半导体技术的发展，芯片特征尺寸不断减小，光刻作为决定集成电路集成度的核心工序，其技术水平直接影响芯片的工艺精度及性能功耗。作为光刻工艺中与光刻机联系紧密的输入（曝光前光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影）设备，涂胶/显影设备直接影响细微曝光图案的形成，其显影工艺的图形质量和缺陷控制对后续蚀刻、离子注入等诸多工艺中图形转移的结果也有着深刻地影响，因此，光刻工艺的技术演进也会持续推动涂胶/显影设备的性能不断提升。

此外，随着半导体技术逐渐逼近硅工艺尺寸的极限，“后摩尔定律”时代，从过去着力于圆片制造技术节点的推进，转向系统级设计制造封装技术的创新，包括多芯片组件封装、系统级封装、3D 封装和芯片尺寸封装等在内的先进封装技术快速发展并广泛应用。同时，芯片级、MEMS 封装、硅通孔技术、凸点制作、表面活化温室链接等技术实现了新的突破，并已实现批量生产，这对包括单片湿法设备（如清洗设备、湿法刻蚀设备）等在内各类封装工艺设备性能也提出了更高要求。

（2）高、中、低各类技术等级的生产设备并存发展

虽然半导体技术持续迅猛发展，未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展，但是由于芯片的用途极其广泛，性能要求及技术参数等差异较大，各类性能、用途芯片大量并存并应用，决定了不同的芯片产线需配置相匹配的、技术

等级及性价比相当的半导体设备。即使在同一产线上，复杂程度不同的工艺环节也需根据其实际需要搭配使用各类技术等级的设备。因此，高、中、低各类技术等级的生产设备均有其对应市场空间，并存发展。

2、业务模式

公司所属的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，呈现较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，这对半导体设备制造企业的研发、采购、销售等业务管理能力提出了较高的要求。在研发环节，半导体设备企业只有持续加大研发投入并进行技术创新，才能准确把握新技术、新应用催生的市场机会；在采购环节，半导体设备企业需要根据订单情况，合理预计零部件采购总量、采购进度，并建立完善的供应链体系，保证关键零部件的稳定供应；在销售环节，半导体设备企业的产品需首先满足客制化要求并通过下游客户严格验证后才能建立合作关系并批量销售，与此同时，还需做好快速响应、支持等售后服务工作。

3、行业竞争

公司所属的半导体设备行业目前主要被国外少数几家巨头所垄断，市场新进入者通常需要相当长的时间才能通过下游企业的工艺验证。经过多年的技术积累，公司生产的集成电路制造后道先进封装、LED 芯片制造等领域用涂胶显影设备及单片式湿法设备均已实现量产并在客户端应用，生产的集成电路制造前道晶圆加工领域用涂胶显影设备也已在一线大厂上线进行技术验证。但是，公司生产的半导体设备产品与包括日本东京电子等在内的国际巨头相比在技术指标及全球市场占有率方面仍有较大差距，在未来行业竞争中可能会面临专利诉讼、价格竞争、人才竞争等挑战，可能会对公司未来经营业绩和发展产生不利影响。

4、外部市场环境

（1）整体行业呈现增长趋势

半导体设备行业是一个全球化程度较高的行业，受国际经济波动、半导体市场、终端消费市场需求影响，其发展往往呈现一定的周期性波动。在行业景气度提升过程中，半导体产业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求，但在行业景气度下降过程中，半导体产业则可能削减资本支出，从而对半导体设

备的需求产生不利影响。据 SEMI 统计，2014 年全球半导体设备销售规模为 375 亿美元，2018 年全球半导体设备销售额达到 645 亿美元，年均复合增长率达 14.52%。随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片或先进制程的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。SEMI 预计 2019 年全球半导体设备市场销售规模将有所下降，但 2020 年仍会有 20.7% 的增长，达到 719 亿美元，创历史新高。

（2）半导体产业向中国大陆转移趋势明显

近年来，全球半导体产业向中国大陆转移趋势明显，中国大陆迎来建厂潮。根据 SEMI 预测，2017-2020 年全球将有 62 座晶圆厂投产，其中 26 座晶圆厂来自于中国大陆，占比约 42%。根据 SEMI 2018 年中国半导体硅晶圆展望报告，中国的 Fab 厂产能预计将从 2015 年的每月 230 万片到 2020 年的 400 万片，每年 12% 的复合年增长率，比其他所有地区增长都要快。此外，根据 IC Insights 预测，由于“中国效应”，2018 年全球半导体资本支出将首次突破 1,000 亿美元。中国企业半导体资本支出 110 亿美元，将超过欧洲和日本企业半导体资本支出之和 107 亿美元。全球半导体产业向中国大陆的持续转移，将为国内半导体设备行业带来良好的发展契机，公司有望从中受益。

（二）上述影响因素对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险

上述影响因素对公司未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险如下：

1、营业收入

近年来，半导体下游应用市场需求总体保持增长趋势，国家对半导体设备行业的政策支持力度逐年加大，全球半导体产能向我国大陆地区转移，我国半导体设备进口替代趋势日益明显。得益于公司在技术研发、产品品质、客户服务等方面的多方面优势，报告期内公司主营业务收入保持了持续增长，近三年年均复合增长速度达到 18.34%。未来，随着公司技术研发及下游市场开拓水平的不断深

化，公司业务有望继续增长。

2、毛利率

公司所处的半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，得益于此，行业产品通常能保持较高的毛利率水平。报告期内，公司主要从事光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备的研发、生产和销售，主营产品毛利率分别为 41.25%、41.79%、46.27% 和 36.18%，总体保持稳定。未来，随着公司技术水平不断提升、产品结构变化不断优化、成本控制及商务谈判能力不断增强，公司有望进一步提升市场地位，保持乃至继续提高产品毛利率水平。

3、研发投入

公司所属的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，行业技术门槛高，需要不断保持较高的研发投入水平才能保证自身产品的技术优势或缩小与国际领先水平的差距。公司自成立以来研发投入处在较高水平。2016-2018 年公司研发投入占营业收入的比重分别为 11.24%、10.41% 和 16.29%。未来，公司研发投入预计将保持在较高水平，继续提升产品的市场竞争力。

三、财务报表的编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定编制。

公司财务报表以持续经营为基础列报。

四、重大影响的会计政策和会计估计

（一）外币业务和外币报表折算

1、外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

2、资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

3、外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；

（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”；

（4）外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（二）应收票据及应收账款减值测试方法及减值准备计提方法

1、以下自 2019 年 1 月 1 日起适用：

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据及应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据及应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收一般客户

应收账款组合 2 应收海外客户

应收账款组合 3 应收关联方客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、以下适用于 2016-2018 年度：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收账款、100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

账龄组合：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不

重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

账龄组合：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（三）其他应收款减值测试方法及减值准备计提方法

以下自 2019 年 1 月 1 日起适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 应收备用金

其他应收款组合 3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2016-2018 年度适用的会计政策见上文“（二）应收票据及应收账款减值测试方法及减值准备计提方法”。

（四）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、存货的计价方法

本公司购入原材料、包装材料等按实际成本入账，发出时的成本采用先进先出法核算；库存商品入库时按实际生产成本核算，发出时采用个别计价法核算；低值易耗品、包装材料领用时采用一次摊销法摊销。

3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格

作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

(3) 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

(2) 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

(五) 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的有形资产。

1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（六）在建工程

1、在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到

预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本

化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（八）无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利权	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专用技术	10-15 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件及其他	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

（3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定

的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、公司内部研究开发项目

公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，具体需经过调研、论证、立项、前期研究工作（包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等）、小试、中试、试产等若干阶段。公司以中试完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。

公司研究阶段基本上是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

研究阶段工作包括：将接收的技术开发建议整理汇总，根据市场需求初步筛选出具有开发价值的建议，进行调研与分析；讨论技术开发的技术协调性、技术先进性、经济合理性等；成立项目开发小组，制定项目开发计划；进行前期研究工作，包括配方和工艺设计、设备选型、制定成品质量标准（含规格、型号和包装等）和原材料质量标准等；进行小试，摸索出适合工业化生产的工艺路线；进行中试，模拟工业化生产的条件下进行的工艺研究，以验证放大生产后原工艺的可行性，保证研发和生产时工艺的一致性。中试成功后，正式进入开发阶段。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段支出。

开发阶段的主要工作为试产，在建成的生产线上，根据中试结果制定的生产工艺，进行一定批次的试生产，目的是在批量生产前，对生产线和生产工艺进一步完善。试产完成后，生产工艺和生产线已完善，并能进行批量生产，开发阶段结束。公司对同时满足下述五个条件的研发支出予以资本化，计入研发支出一资本化支出：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足前述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（九）长期资产减值

1、长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

3、固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

(1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

(2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

(3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

(4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

(5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

4、在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

(1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

5、无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

6、商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（十）预计负债

1、预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十一）收入确认原则和计量方法

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入的具体确认原则为：公司将产品移交给客户并完成安装调试，客户验收无误，取得验收报告后确认收入。

2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（十二）政府补助

1、政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）本公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）本公司能够收到政府补助。

2、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

(2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对财务报表项目的影 响如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	
	变更前	变更后
资产处置收益		-77.67
营业外支出	77.67	

2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账

款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关财务报表列报调整影响如下：

单位：万元

项 目	2017年12月31日/2017年度		2016年12月31日/2016年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收票据	2,487.67		2,348.99	
应收账款	2,433.16		3,223.34	
应收票据及应收账款		4,920.83		5,572.34
应付票据	582.79			
应付账款	2,304.53		3,861.03	
应付票据及应付账款		2,887.32		3,861.03
管理费用	4,669.16	2,693.36	3,951.49	2,292.25
研发费用		1,975.81		1,659.24

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金

融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理及财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

新金融工具准则规定，于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。根据此规定，本公司比较财务报表数据无调整。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、公司无首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况

4、公司无首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的情况

（1）于 2019 年 1 月 1 日，公司执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量无变化。

(2) 于 2019 年 1 月 1 日，公司无按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的情况。

(3) 于 2019 年 1 月 1 日，公司执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备无变化。

(4) 于 2019 年 1 月 1 日，公司无执行新金融工具准则对本公司期初未分配利润的影响事项。

五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策

(一) 发行人适用的主要税项及其税率

公司适用的主要税项及其税率（费率）如下：

税种	计税依据	税率
增值税	当期销售增值额	17%/16%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	自用房产按房屋建筑物原值扣除 30% 后余额	1.2%
土地使用税	土地面积	12 元/平方米

注：根据《财政部总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 17% 税率的，税率调整为 16%。

(二) 报告期内发行人享有的主要税收优惠

1、软件产品增值税即征即退

根据国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）及财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料和软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并经主管税务机关审批核准之日起，按 17% 税率

(2018年5月1日起调整为16%)征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内,公司符合条件的软件产品销售享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

2、高新技术企业税收优惠

2014年8月6日,公司获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201421000046),认定公司为高新技术企业,有效期3年。2017年8月8日,公司通过复审,再次获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201721000278),认定公司为高新技术企业,有效期3年。

根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局于2009年4月22日颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)的有关规定,公司自获得高新技术企业认定批准的有效期内,向主管税务机关申请办理减免税手续,高新技术企业可按15%的税率进行所得税申报。

3、研发费用加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)的规定,开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用按照实际发生额的50%在税前加计扣除。2018年9月20日,财政部、税务总局、科技部联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

(三) 各期税收优惠占利润总额的比例

报告期各期,公司各项税收优惠金额及占当期利润总额的比例如下:

单位:万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
软件产品增值税即征即退 a	910.86	966.34	204.89
所得税优惠 b	157.18	249.89	29.33
研发费用加计扣除对企业所得税的减少金额 c	444.45	159.93	157.91
税收优惠合计 d = a + b + c	1,512.49	1,376.16	392.13
利润总额 e	3,286.30	2,995.13	478.39
税收优惠占利润总额比例 f = d / e	46.02%	45.95%	81.97%

注：公司 2019 年一季度利润总额为负数，不进行计算。

最近三年，发行人税收优惠金额占税前利润的比重较高，这是由发行人所处的半导体专用设备行业的特殊性决定的。作为半导体制造的基础产业，半导体设备制造具有技术难度高、投资金额高、研发投入大周期长等特点，全球市场格局高度集中，主要掌握在欧美、日本等国企业手中。为了加快产业发展，培育掌握自主核心技术的国内企业，提升半导体专用设备国产化率，国家出台了相关税收优惠政策，对产业和符合条件的企业进行支持。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于软件产品增值税政策的通知》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关文件的规定，发行人享受的上述税收优惠政策具有长期性、一贯性，公司自身条件符合上述文件的要求，预计未来可以持续享受上述税收优惠政策。

六、分部信息

公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，属于单一经营分部，财务报表中未列报经营分部信息。

七、经注册会计师核验的非经常性损益情况

依据会计师出具的会专字【2019】6272 号《非经常性损益鉴证报告》，公司报告期各期非经常性损益情况如下：

单位：万元

内容	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益	-	-0.62	-1.39	-77.67

内容	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	157.70	1,212.36	1,269.02	616.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13.32	-	-	-
其他营业外收入和支出	0.90	9.40	-	-
小计	171.92	1,221.14	1,267.63	538.43
减: 所得税影响额	25.79	183.17	190.14	80.76
非经常性净损益合计	146.13	1,037.97	1,077.49	457.66

八、主要财务指标

(一) 报告期内主要财务指标

项目	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率	2.51	2.35	2.40	1.82
速动比率	0.99	1.19	1.52	1.03
资产负债率	39.66%	42.09%	42.36%	50.78%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	3.35	3.49	3.07	2.51
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次)	0.21	5.02	6.20	4.59
存货周转率(次)	0.04	0.93	1.13	0.83
息税折旧摊销前利润(万元)	-887.94	4,294.40	3,905.19	1,507.30
归属于发行人股东的净利润(万元)	-902.52	3,047.79	2,626.81	492.85
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-1,048.65	2,009.82	1,549.32	35.18
研发费用占营业收入的比例	57.77%	16.29%	10.41%	11.24%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.33	-0.45	0.67	1.15
每股净现金流量(元/股)	-0.37	-0.39	0.35	0.42

上述指标的计算公式如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人普通股股东净资产/期末普通股股本总额
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股本总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股本总额

(二) 报告期内净资产收益率及每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），报告期内公司净资产收益率及每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-3月	-4.19%	-0.14	-0.14
	2018年度	14.80%	0.48	0.48
	2017年度	15.91%	0.44	0.44
	2016年度	3.43%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年1-3月	-4.87%	-0.17	-0.17
	2018年度	9.76%	0.32	0.32
	2017年度	9.38%	0.26	0.26
	2016年度	0.24%	0.01	0.01

计算公式：

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 3 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

(三) 其他重要事项

截至 2019 年 3 月 31 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

(四) 重大担保、诉讼

截至本招股说明书签署日，公司不存在重大担保。公司未决诉讼情况如下：

2018 年 11 月 12 日，公司向大连经济技术开发区人民法院提交《民事起诉状》及《财产保全申请书》，诉称公司与大连德豪于 2017 年 6 月 20 日及 2017 年 8 月 1 日分别签订两份《国内设备采购合同》，合同编号分别为

HT-DL-3ES0170、HT-DL-3ES0174，合同总价款为 14,144,000 元。发行人已依约向大连德豪交付四台型号为 KS-S150-4ST 全自动去胶剥离机产品，该四台设备已经大连德豪验收合格并正常运行，根据双方合同约定，大连德豪应在设备验收合格后支付全部合同价款，现大连德豪尚欠 7,779,200 元货款未支付，请求：1、法院判令大连德豪支付拖欠货款 7,779,200 元并按银行同期贷款利率支付所欠货款的利息；2、依法冻结大连德豪银行存款 7,779,200 元或查封其相应价值的其他财产。

2018 年 11 月 19 日，大连经济技术开发区人民法院作出（2018）辽 0291 民初 7725 号、（2018）辽 0291 民初 7725 号之一号《民事裁定书》，对大连德豪 7,779,200 元银行存款进行了冻结。

本案已于 2018 年 12 月 5 日开庭审理，截至本招股说明书签署日，法院尚未作出判决。

十、经营成果分析

（一）报告期内主要经营成果变化情况

1、报告期内经营情况概览

报告期内，公司的具体经营情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	1,030.53	/	20,999.05	10.59%	18,988.50	28.65%	14,760.31
营业成本	640.14	/	11,236.84	1.47%	11,073.87	29.68%	8,539.68
营业毛利	390.39	/	9,762.21	23.34%	7,914.63	27.23%	6,220.63
营业利润	-1,122.59	/	3,277.51	9.43%	2,995.13	/	-342.61
计入当期损益的政府补助金额	157.70	/	2,123.22	-5.02%	2,235.36	172.28%	820.99
研发费用	595.32	/	3,421.45	73.17%	1,975.81	19.09%	1,659.24
利润总额	-1,121.69	/	3,286.30	9.72%	2,995.13	526.09%	478.39

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
净利润	-902.52	/	3,047.79	16.03%	2,626.81	432.99%	492.85

报告期内，公司营业收入和净利润持续增长。

2017年度，公司净利润同比增长2,133.96万元或432.99%，主要原因包括：

(1) 随着营业收入增长，公司营业毛利同比增长1,694.00万元或27.23%；(2) 公司当期收到的政府补助金额较2016年增长1,414.36万元或172.28%，主要增项为软件产品增值税退税及沈阳市高层次创新创业人才项目资助，二者合计金额同比增长1,258.47万元。

2018年度，公司净利润同比增长420.98万元或16.03%，主要原因为：在营业收入及产品毛利率同比提升的带动下，公司营业毛利同比增长1,847.58万元或23.34%。

2、报告期内经营成果逻辑分析

(1) 下游行业总体保持增长，营业收入持续增长

报告期内，公司营业收入保持增长，符合半导体产业的发展趋势。半导体设备市场与半导体产业景气状况紧密相关。据SEMI统计，2014年全球半导体设备销售规模为375亿美元，2018年全球半导体设备销售额达到645亿美元，年均复合增长率达14.52%。随着下游电子、汽车、通信等行业需求的增长，集成电路产业面临着新型芯片或先进制程的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。SEMI预计2019年全球半导体设备市场销售规模将有所下降，但2020年仍会有20.7%的增长，达到719亿美元，创历史新高。

(2) 半导体设备属于典型的高、精、尖高端装备，公司报告期内产品毛利率维持在较高水平

报告期内，公司主营业务毛利率分别为41.25%，41.79%，46.27%和36.18%，维持在较高水平，与行业平均水平相当。半导体设备是半导体产业链的上游核心环节，涉及电子、机械、化工、材料、信息等学科领域，属于典型的高、精、尖高端装备，行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒。上述产品和行

业特性决定了其具备相对较高的毛利率水平。

（3）政府补助金额较高

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 820.99 万元、2,235.36 万元、2,123.22 万元和 157.70 万元，其中，2016-2018 年计入经常性损益的软件产品增值税退税金额分别为 204.89 万元、966.34 万元和 910.86 万元。剔除软件产品增值税退税金额后，公司报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为 616.10 万元、1,269.02 万元、1,212.36 万元和 157.70 万元，仍保持在较高水平，主要是因为公司所处的半导体专用设备行业是国家大力鼓励和支持的产业，国内半导体设备行业公司北方华创 2016-2018 年计入当期损益的政府补助金额分别为 6.12 亿、3.88 亿、1.77 亿，中微半导体 2016-2018 年该数据分别为 1.16 亿、1.17 亿和 1.70 亿。综上，公司报告期内政府补助金额较高符合行业特性。

（4）研发投入保持在较高水平

报告期内，公司研发费用金额分别为 1,659.24 万元、1,975.81 万元、3,421.45 万元和 595.32 万元，占营业收入的比例分别为 11.24%、10.41%、16.29%和 57.77%，保持在较高水平。公司作为项目牵头单位承担并完成了两项与所处涂胶显影设备领域相关的“02 重大专项”项目，成功突破了包括凸点封装工艺相关的超厚光刻胶膜的涂覆、显影、单片湿法多工艺药液同腔分层刻蚀，以及 193nm 光刻工艺超薄胶膜均匀涂敷、精细化显影、精密温控热处理等在内的多项核心关键技术，开发出国产涂胶显影设备并实现量产，成功打破国外厂商垄断，大大降低了国内客户采购成本和对国外设备的依赖。作为科技创新企业，持续大量的研发投入是公司产品不断更新换代并追赶世界先进水平的重要推动力量，有助于增强公司市场竞争力，实现公司经营规模和经营效益的同步提升。

（二）营业收入分析

1、营业收入结构

报告期内，公司营业收入分别为 14,760.31 万元、18,988.50 万元、20,999.05 万元和 1,030.53 万元，其具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	968.67	94.00%	20,096.97	95.70%	18,353.16	96.65%	14,350.64	97.22%
其他业务收入	61.86	6.00%	902.08	4.30%	635.34	3.35%	409.68	2.78%
合计	1,030.53	100.00%	20,999.05	100.00%	18,988.50	100.00%	14,760.31	100.00%

报告期内，公司的主营业务收入占营业收入的比重一直保持在94%以上，主营业务表现突出。公司其他业务收入主要来自备件销售及提供售后服务等，收入占比较小。

2、主营业务收入产品构成及分析

(1) 总体分析

公司产品主要分为光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备两大类，主营业务收入波动主要受以下因素影响：下游行业景气度及客户资本性支出安排、市场竞争情况、公司产品的验收周期等。

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

产品类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
光刻工序涂胶显影设备	597.98	61.73%	12,883.64	64.11%	15,649.76	85.27%	14,125.56	98.43%
其中：涂胶/显影机	597.98	61.73%	12,037.49	59.90%	13,977.81	76.16%	12,979.40	90.44%
喷胶机	-	-	846.15	4.21%	1,671.95	9.11%	1,146.15	7.99%
单片式湿法设备	370.69	38.27%	7,213.33	35.89%	2,703.39	14.73%	138.75	0.97%
其中：清洗机	370.69	38.27%	2,208.55	10.99%	1,180.01	6.43%	138.75	0.97%
去胶机	-	-	2,541.45	12.65%	531.65	2.90%	-	-
湿法刻蚀机	-	-	2,463.33	12.26%	991.73	5.40%	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-	86.32	0.60%
总计	968.67	100.00%	20,096.97	100.00%	18,353.15	100.00%	14,350.64	100.00%

注：上表中“其它设备”指2016年公司销售给厦门乾照光电股份有限公司的1台星型全自动热板烘烤机。

由上表可见，公司主营业务收入主要由光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法

设备构成，报告期各期合计占比分别为 99.40%、100.00%、100.00% 和 100.00%。公司产品收入与下游 LED 芯片或集成电路制造商新建或扩张产能的投资强度、投资节奏和建设周期的关联性较强，收入波动主要受下游客户资本性支出安排影响较大。

2017 年度，公司实现主营业务收入 18,353.15 万元，同比 2016 年度的 14,350.64 万元增长 4,002.51 万元或 27.89%，主要是光刻工序涂胶显影设备收入同比增长 1,524.20 万元和单片式湿法设备收入同比增长 2,564.64 万元，二者合计增长 4,088.84 万元。

2018 年度，公司实现主营业务收入 20,096.97 万元，同比 2017 年度的 18,353.15 万元增长 1,743.82 万元或 9.50%，主要是单片式湿法设备收入同比增长 4,509.94 万元，抵消了光刻工序涂胶显影设备收入同比下降 2,766.12 万元的影响。

(2) 光刻工序涂胶显影设备收入变动分析

报告期内，公司光刻工序涂胶显影设备收入金额分别为 14,125.56 万元、15,649.76 万元、12,883.64 万元和 597.98 万元，占主营业务收入比重分别为 98.43%、85.27%、64.11% 和 61.73%。

公司产品可进一步细分为 6 英寸及以下单晶圆处理设备（如 LED 芯片制造环节）和 8/12 英寸单晶圆处理设备（如集成电路后道先进封装环节）。

报告期内，公司光刻工序涂胶显影设备的细分构成如下：

单位：万元

产品类别	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
涂胶/显影机 (6 英寸及以下)	392.98	65.72%	4,710.66	36.56%	8,145.45	52.05%	1,747.01	12.37%
涂胶/显影机 (8/12 英寸)	205.00	34.28%	7,326.83	56.87%	5,832.36	37.27%	11,232.40	79.52%
喷胶机 (8/12 英寸)	-	-	846.15	6.57%	1,671.95	10.68%	1,146.15	8.11%
总计	597.98	100.00%	12,883.64	100.00%	15,649.76	100.00%	14,125.56	100.00%

报告期内，公司光刻工序涂胶显影设备的销量及平均单价情况如下：

单位：台、万元

产品类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	销量	平均单价	销量	平均单价	销量	平均单价	销量	平均单价
涂胶/显影机（6英寸及以下）	3	130.99	42	112.16	75	108.61	15	116.47
涂胶/显影机（8/12英寸）	1	205.00	17	430.99	21	277.73	34	330.36
喷胶机（8/12英寸）	-	-	2	423.08	14	119.43	8	143.27
总计	4	149.49	61	211.21	110	142.27	57	247.82

报告期内，公司涂胶/显影机（6英寸及以下）、涂胶/显影机（8/12英寸）、喷胶机（8/12英寸）平均单价分别在109-131万元、205-431万元、119-423万元之间波动。上述设备价格主要受设备本身配置（包括处理单元数量、自动化程度、客户定制化要求等）和商务谈判结果影响。其中，2018年度喷胶机销售单价423.08万元显著高于其他年度，主要是因为该年度所销售喷胶机配置较高。

报告期内，公司各类设备销量波动较大，主要是因为公司下游客户以行业内少数几家知名企业为主，客户相对集中，同时此类客户的设备投资节奏、建设周期等受行业周期性波动、自身经营状况等因素影响较大，从而使得公司不同期间内销售产品的具体类别、型号和验收节奏等具有不均匀的特点。

2017年波动情况：

2017年度，公司光刻工序涂胶显影设备销售收入同比增长1,524.20万元或10.79%，主要是因为：2016年、2017年度国内LED芯片主要制造厂商大幅度扩建产线，其对公司涂胶/显影机（6英寸及以下）产品采购量大幅增长，并主要集中在2017年安装验收，使2017年实现销售收入的机台数量较2016年增幅较大，由15台增至75台；与此同时，公司涂胶/显影机（8/12英寸）产品销量从2016年的34台下降到2017年的21台，二者影响相抵后，公司2017年度光刻工序涂胶显影设备销售收入同比增长10.79%。

2018年波动情况：

2018年度，公司光刻工序涂胶显影设备销售收入同比下降2,766.12万元或17.68%，主要是因为公司2018年度涂胶/显影机（6英寸及以下）产品销量从2017

年的 75 台下降到了 42 台，收入同比下降了 3,434.79 万元或 42.17%。公司涂胶/显影机(6 英寸及以下)产品主要应用于 LED 芯片制造领域，而 2018 年国内 LED 行业整体增速放缓，芯片价格持续下滑，行业大环境形势较为严峻，公司下游主要客户包括华灿光电和澳洋顺昌等在 2018 年的经营效益均低于同期，其 2018 年净利润同比分别下降 51.43%和 36.35%。

(3) 单片式湿法设备收入变动分析

报告期内，公司单片式湿法设备收入占比分别为 0.97%、14.73%、35.89%和 38.27%，呈现逐年上升的趋势，主要原因系近年来公司积极开拓国内单片式湿法设备领域市场，销售实现较快增长所致。

报告期内公司单片湿法设备的细分构成如下：

单位：万元

产品类别	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
清洗机	370.69	100.00%	2,208.55	30.62%	1,180.02	43.64%	138.75	100.00%
去胶机	-	-	2,541.45	35.23%	531.66	19.67%	-	-
湿法刻蚀机	-	-	2,463.33	34.15%	991.72	36.69%	-	-
总计	370.69	100.00%	7,213.33	100.00%	2,703.39	100.00%	138.75	100.00%

注：上表“其他”主要指用于光掩模（Mask）或其他特殊尺寸晶圆材料的单片湿法设备，下同。

报告期内，公司单片式湿法设备的销量及平均单价情况如下：

单位：台、万元

产品类别	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	销量	平均单价	销量	平均单价	销量	平均单价	销量	平均单价
清洗机	2	185.34	6	368.09	10	118.00	2	69.38
去胶机	-	-	8	317.68	2	265.83	-	-
湿法刻蚀机	-	-	7	351.90	4	247.93	-	-
总计	2	185.34	21	343.49	16	168.96	2	69.38

报告期内，公司清洗机、去胶机、湿法刻蚀机平均单价分别在 69-368 万元、

265-318 万元、248-352 万元之间波动。上述设备价格主要受设备本身配置（包括处理单元数量、自动化程度、客户定制化要求等）和商务谈判结果影响。其中，2018 年度清洗机销售单价 368.09 万元显著高于其他年度，主要是因为该年度所销售清洗机产品以全自动、3-4 个处理单元的高配置版本为主，因此价格较高。

2017 年波动情况：

2016 年，公司单片式湿法设备仅销售 2 台，实现 138.75 万元收入。2017 年，公司单片式湿法设备销售收入同比增长 2,564.65 万元或 1,848.40%（增幅较大主要是因为 2016 年基数较小），主要系 2017 年度公司单片式湿法设备整体销量同比增长 14 台或 700%，同时清洗机平均单价增长 70.09%引起的。

2018 年波动情况：

2018 年度，公司单片式湿法设备销售收入同比增长 4,509.93 万元或 166.82%，主要系公司去胶机及湿法刻蚀机销量、清洗机平均单价及去胶机平均单价同比有较大幅度上升所致。2018 年，公司延续在单片湿法设备领域市场的良好发展态势，其中，去胶机及湿法刻蚀机合计销量同比增长 9 台或 150.00%。

3、主营业务收入按照销售区域划分

报告期内，公司主营业务收入的地区构成情况如下：

单位：万元

地区	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
东北地区	-	-	1,208.89	6.02%	-	-	-	-
华北地区	-	-	1,003.05	4.99%	972.98	5.30%	170.94	1.19%
华东地区	968.67	100.00%	13,050.11	64.94%	13,550.40	73.83%	5,394.31	37.59%
华南地区	-	-	1,181.20	5.88%	1,874.53	10.21%	203.42	1.42%
华中地区	-	-	1,041.36	5.18%	104.27	0.57%	128.21	0.89%
西北地区	-	-	1,406.41	7.00%	-	-	-	-
港澳台地区	-	-	1,205.95	6.00%	1,850.97	10.09%	8,453.76	58.91%
合计	968.67	100.00%	20,096.97	100.00%	18,353.16	100.00%	14,350.64	100.00%

报告期内，公司产品销售主要集中在华东地区和港澳台地区，这与我国半导

体生产企业在台湾及华东地区集中分布的现实情况相匹配。报告期各期，来自华东地区的销售收入占主营业务收入的比重分别为 37.59%、73.83%、64.94%和 100.00%；来自港澳台地区的销售收入占主营业务收入的比重分别为 58.91%、10.09%、6.00%和 0，2016 年占比较高主要系公司当年向台湾地区的台积电批量出口涂胶/显影机所致。

4、主营业务收入季节性波动情况

单位：万元

地区	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一季度	968.67	100.00%	1,615.71	8.04%	2,457.86	13.39%	2,698.13	18.80%
二季度	/	/	2,989.36	14.87%	6,248.02	34.04%	5,944.40	41.42%
三季度	/	/	5,260.44	26.18%	3,821.73	20.82%	835.27	5.82%
四季度	/	/	10,231.45	50.91%	5,825.54	31.74%	4,872.83	33.96%
合计	968.67	100.00%	20,096.97	100.00%	18,353.16	100.00%	14,350.64	100.00%

受下游半导体行业客户资本性支出波动的影响，公司主营业务收入呈现一定的季节性特征，每年二、四季度产品销售收入较高。

2019 年一季度收入同比 2018 年度下降 647.04 万元或 40.05%，主要是因为：公司部分下游客户项目建设进度延后，也相应推迟了公司设备的安装调试及验收时间。

5、主要客户销售情况分析

报告期内，公司对前五大客户的销售及占比情况具体如下：

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例（%）
2019 年 1-3 月			
1	江苏壹度科技股份有限公司	575.69	55.87
2	苏州能讯高能半导体有限公司	283.50	27.51
3	山东元旭光电股份有限公司	109.48	10.62
4	深圳市海思半导体有限公司	21.58	2.09
5	苏州科阳光电科技有限公司	15.48	1.50
合计		1,005.72	97.59
2018 年度			

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例（%）
1	华天科技（昆山）电子有限公司	4,422.22	21.06
2	昆山国显光电有限公司	2,974.36	14.16
3	通富微电子股份有限公司及其下属企业	2,081.06	9.91
4	东莞市中图半导体科技有限公司	1,297.87	6.18
5	大连德豪光电科技有限公司	1,208.89	5.76
合计		11,984.41	57.07
2017 年度			
1	华天科技（昆山）电子有限公司	4,153.63	21.87
2	华灿光电股份有限公司及其下属企业	2,887.15	15.20
3	东莞市中图半导体科技有限公司	1,713.37	9.02
4	淮安澳洋顺昌光电科技有限公司	1,259.06	6.63
5	中国电子科技集团公司第五十八研究所	1,236.50	6.51
合计		11,249.71	59.24
2016 年度			
1	辛耘企业股份有限公司	8,112.26	54.96
2	苏州晶方半导体科技股份有限公司	1,342.07	9.09
3	华天科技（昆山）电子有限公司	943.59	6.39
4	苏州科阳光电科技有限公司	941.45	6.38
5	通富微电子股份有限公司及其下属企业	483.87	3.28
合计		11,823.23	80.10

注：上表系按同一控制人合并口径统计，其中通富微电子股份有限公司及其下属企业包括通富微电子股份有限公司、南通通富微电子有限公司两家主体，华灿光电股份有限公司及其下属企业包括华灿光电股份有限公司、华灿光电（浙江）有限公司、华灿光电（苏州）有限公司三家主体。

报告期内，公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比重分别为 80.10%、59.24%、57.07%和 97.59%，其中，2016 年公司向辛耘企业股份有限公司销售比例超过当期营业收入的 50%，主要是公司通过台湾地区代理商辛耘企业股份有限公司向台积电批量销售涂胶/显影机所致；2019 年 1-3 月，公司向江苏壹度科技股份有限公司销售比例超过当期营业收入的 50%，主要系当期公司确认收入整体金额较小所致。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	618.23	96.58%	10,798.77	96.10%	10,683.01	96.47%	8,430.64	98.72%
其他业务成本	21.90	3.42%	438.07	3.90%	390.86	3.53%	109.05	1.28%
营业成本合计	640.14	100.00%	11,236.84	100.00%	11,073.87	100.00%	8,539.68	100.00%

报告期内，公司的营业成本随公司业务规模的扩大而增长，与公司营收规模的变动相匹配。报告期内，公司主营业务成本分别为 8,430.64 万元、10,683.01 万元、10,798.77 万元和 618.23 万元，占营业成本比重均在 96% 以上，为营业成本的主要组成部分，其他业务成本占比较小。

2、主营业务成本产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品构成情况如下：

单位：万元

产品类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
光刻工序涂胶显影设备	389.45	62.99%	7,195.61	66.63%	9,239.60	86.49%	8,329.58	98.80%
其中：涂胶/显影机	389.45	62.99%	6,887.62	63.78%	8,408.93	78.71%	7,486.14	88.80%
喷胶机	-	-	307.99	2.85%	830.66	7.78%	843.44	10.00%
单片式湿法设备	228.78	37.01%	3,603.17	33.37%	1,443.42	13.51%	57.88	0.69%
其中：清洗机	228.78	37.01%	1,295.77	12.00%	820.11	7.68%	57.88	0.69%
去胶机	-	-	1,279.24	11.85%	146.41	1.37%	-	-
湿法刻蚀机	-	-	1,028.16	9.52%	476.90	4.46%	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-	43.17	0.51%
总计	618.23	100.00%	10,798.77	100.00%	10,683.01	100.00%	8,430.64	100.00%

由上表可见，公司主营业务成本主要由光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备构成，报告期各期合计占比分别为 99.49%、100.00%、100.00% 和 100.00%，

与公司主营业务收入相匹配。

3、主营业务成本具体构成分析

报告期内，公司主营业务成本的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	570.68	92.31%	10,078.27	93.33%	9,902.47	92.69%	7,924.30	93.99%
直接人工	20.99	3.40%	389.06	3.60%	433.58	4.06%	252.18	2.99%
制造费用	26.56	4.30%	331.45	3.07%	346.96	3.25%	254.16	3.01%
合计	618.23	100.00%	10,798.78	100.00%	10,683.01	100.00%	8,430.64	100.00%

公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。报告期内，随着公司业务规模的扩大，各类型成本逐年增长。

报告期各期，公司直接材料分别为7,924.30万元、9,902.47万元、10,078.27万元和570.68万元，占各期主营业务成本的比例分别为93.99%、92.69%、93.33%和92.31%，为主营业务成本的主要构成部分。报告期内，公司主要原材料采购及价格变动情况参见本招股书“第六节 业务和技术”之“七、发行人采购情况及主要供应商”。

报告期各期，公司直接人工成本分别为252.18万元、433.58万元、389.06万元和20.99万元，占各期主营业务成本的比例分别为2.99%、4.06%、3.60%和3.40%，主要由生产人员工资薪酬构成。

报告期各期，公司制造费用分别为254.16万元、346.96万元、331.45万元和26.56万元，占各期主营业务成本的比例分别为3.01%、3.25%、3.07%和4.30%，主要为辅料消耗。

（四）毛利及毛利率分析

1、综合毛利结构分析

报告期内，公司综合毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
主营业务毛利	350.44	89.76%	9,298.20	95.25%	7,670.15	96.91%	5,920.00	95.17%
其他业务毛利	39.96	10.24%	464.01	4.75%	244.48	3.09%	300.63	4.83%
合计	390.39	100.00%	9,762.21	100.00%	7,914.63	100.00%	6,220.63	100.00%

报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司综合毛利分别为 6,220.63 万元、7,914.63 万元、9,762.21 万元和 390.39 万元，2017 年及 2018 年分别同比增长 27.23% 和 23.34%。报告期内，公司综合毛利主要来源于主营业务收入，主营业务毛利占综合毛利比例超过 89%，主营业务表现突出。

2、主营业务毛利结构分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品类型划分情况如下：

单位：万元

产品类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
光刻工序涂胶显影设备	208.53	59.51%	5,688.03	61.17%	6,410.16	83.57%	5,795.98	97.91%
其中：涂胶/显影机	208.53	59.51%	5,149.87	55.39%	5,568.88	72.60%	5,493.26	92.79%
喷胶机	-	-	538.16	5.79%	841.29	10.97%	302.71	5.11%
单片式湿法设备	141.91	40.49%	3,610.16	38.83%	1,259.97	16.43%	80.87	1.37%
其中：清洗机	141.91	40.49%	912.78	9.82%	359.90	4.69%	80.87	1.37%
去胶机	-	-	1,262.21	13.57%	385.24	5.02%	-	-
湿法刻蚀机	-	-	1,435.17	15.43%	514.83	6.71%	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-	43.15	0.73%
总计	350.44	100.00%	9,298.20	100.00%	7,670.15	100.00%	5,920.00	100.00%

由上表可见，公司主营业务毛利主要由光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备构成，报告期各期合计占比分别为 99.27%、100.00%、100.00% 和 100.00%，其中，公司标杆产品光刻工序涂胶显影设备中涂胶/显影机对毛利贡献最高，报告期各期占比均超过 50%。2018 年，随着公司在国内单片式湿法设备领域市场销量的稳步提升，公司光刻工序涂胶显影设备产品对主营业务毛利的贡献度有所下降。

3、主营业务毛利率分析

作为一家典型的半导体专用设备制造公司，发行人主营业务毛利率主要取决于产品结构、设备配置高低、定制化水平、制造难度及周期、市场竞争及商务谈判情况等因素。公司设备的定制化程度较高，下游客户对具体配置、技术参数等方面的要求或多或少均存在一定程度的差异，与此同时，为了开拓新客户、新应用领域或推广新设备时，公司也会在谈判中对利润空间作出适当让步以争取商业机会，这就会导致公司产品在不同时期、面对不同客户时毛利率存在一定波动。

报告期内，公司主营业务毛利率及收入占比情况如下：

单位：万元

产品类别	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
光刻工序涂胶显影设备	34.87%	61.73%	44.15%	64.11%	40.96%	85.27%	41.03%	98.43%
其中：涂胶/显影机	34.87%	61.73%	42.78%	59.90%	39.84%	76.16%	42.32%	90.44%
喷胶机	-	-	63.60%	4.21%	50.32%	9.11%	26.41%	7.99%
单片式湿法设备	38.28%	38.27%	50.05%	35.89%	46.61%	14.73%	58.28%	0.97%
其中：清洗机	38.28%	38.27%	41.33%	10.99%	30.50%	6.43%	58.28%	0.97%
去胶机	-	-	49.66%	12.65%	72.46%	2.90%	-	-
湿法刻蚀机	-	-	58.26%	12.26%	51.91%	5.40%	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-	49.99%	0.60%
总计	36.18%	100.00%	46.27%	100.00%	41.79%	100.00%	41.25%	100.00%

由上表可见，报告期内，公司主营业务毛利率分别为41.25%、41.79%、46.27%和36.18%，2016-2018年期间公司主营业务毛利率波动较小，2019年一季度下降较多。受季节性等因素影响，2019年一季度公司仅验收设备6台，样本量相对较小，以下主要对公司2016-2018年主营业务毛利率波动情况进行分析。

为更好地分析公司分产品毛利率及收入占比变动对主营业务整体毛利率的影响，采用连环替代法进行具体情况分析：

产品类别	2018年度比2017年度			2017年度比2016年度		
	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响
光刻工序涂胶显影设备	2.72%	-9.34%	-6.62%	-0.07%	-5.39%	-5.46%
其中：涂胶/显影机	2.24%	-6.96%	-4.72%	-2.24%	-5.69%	-7.93%
喷胶机	1.21%	-3.12%	-1.91%	1.91%	0.56%	2.47%
单片式湿法设备	0.51%	10.59%	11.10%	-0.11%	6.41%	6.30%

产品类别	2018年度比2017年度			2017年度比2016年度		
	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响
其中：清洗机	0.70%	1.88%	2.58%	-0.27%	1.67%	1.40%
去胶机	-0.66%	4.84%	4.18%	-	2.10%	2.10%
湿法刻蚀机	0.34%	4.00%	4.34%	-	2.80%	2.80%
其他设备	-	-	-	-0.30%	-	-0.30%
总计	3.23%	1.25%	4.47%	-0.48%	1.02%	0.54%

注：毛利率变动影响=（本期毛利率-上期毛利率）×上期收入占比；收入占比变动影响=（本期收入占比-上期收入占比）×本期毛利率，下同。

2017年度，公司主营业务整体毛利率较上年增长0.54个百分点，基本保持稳定；2018年度，公司主营业务整体毛利率较上年增长4.47个百分点，主要系当期公司单片湿法设备销售收入占比从14.73%增长至35.89%，同时该产品毛利率较上年提升3.44个百分点。

（1）光刻工序涂胶显影设备毛利率变动分析

2016-2018年，公司光刻工序涂胶显影设备整体毛利率分别为41.03%、40.96%和44.15%，相对平稳。分产品而言，涂胶/显影机产品毛利率呈现先下降后回升的趋势，喷胶机产品毛利率逐年上升，具体情况如下：

① 涂胶/显影机产品

根据适用晶圆尺寸的不同，公司涂胶/显影机产品可进一步细分为6英寸及以下单晶圆处理设备（如LED芯片制造环节）和8/12英寸单晶圆处理设备（如集成电路后道先进封装环节），详情如下：

单位：万元

产品类别	2018年度		2017年度		2016年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
6英寸及以下	39.53%	39.13%	37.36%	58.27%	41.54%	13.46%
8/12英寸	44.87%	60.87%	43.31%	41.73%	42.44%	86.54%
总计	42.78%	100.00%	39.84%	100.00%	42.32%	100.00%

由上表可见，2016年-2018年，公司涂胶/显影机产品整体毛利率分别为42.32%、39.84%和42.78%，其中2017年公司涂胶/显影机产品毛利率同比2016年下降2.48个百分点，2018年较2017年上升2.94个百分点，变动分析如下：

产品类别	2018 年度比 2017 年度			2017 年度比 2016 年度		
	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响
6 英寸及以下	1.26%	-7.57%	-6.30%	-0.56%	16.74%	16.18%
8/12 英寸	0.65%	8.59%	9.24%	0.75%	-19.41%	-18.65%
总计	1.92%	1.02%	2.94%	0.19%	-2.67%	-2.48%

由上表可见，2017 年度，公司涂胶/显影机产品毛利率较 2016 年有所下降，主要系当期公司毛利率相对较高的涂胶/显影机（8/12 英寸）销售收入占比从 86.54% 降至 41.73% 所致。2018 年度，公司涂胶/显影机产品毛利率较 2017 年有所回升，主要系当期公司毛利率相对较高的涂胶/显影机（8/12 英寸）销售收入占比从 41.73% 升至 60.87% 所致。

② 喷胶机产品

最近三年，公司喷胶机产品毛利率分别为 26.41%、50.32% 和 63.60%，逐年上升，变动分析如下：

2016 年，公司向客户销售的 1 台 8/12 英寸兼容全自动喷胶机系按客户要求生产的定制版机型，其销售收入占当期公司喷胶机总收入的 60.85%，毛利率仅为 21.62%，因此拉低了 2016 年公司喷胶机产品整体毛利率。2017 年无 2016 年此类情形，该类产品毛利率相应回升。

2018 年度，公司喷胶机产品毛利率较 2017 年有所上升，主要是因为公司当年销售的 2 台喷胶机均为全自动机台，配置较高。

（2）单片式湿法设备毛利率变动分析

最近三年，公司单片式湿法设备整体毛利率分别为 58.28%、46.61% 和 50.05%，呈现一定程度的波动。分产品而言，清洗机产品毛利率波动与单片式湿法设备整体毛利率波动保持一致，去胶机产品毛利率有所下降，湿法刻蚀机产品毛利率略有上升，具体情况如下：

① 清洗机产品

根据适用晶圆尺寸的不同，公司清洗机产品可进一步细分为 6 英寸及以下单晶圆处理设备（如 LED 芯片制造环节）、8/12 英寸单晶圆处理设备（如集成电

路后道先进封装环节)及其他(如用于光掩模清洗的产品),详情如下:

单位:万元

产品类别	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
6 英寸及以下	-	-	-23.97%	3.26%	-	-
8/12 英寸	41.33%	100.00%	28.39%	69.90%	51.25%	48.26%
其他	-	-	42.62%	26.84%	64.84%	51.74%
总计	41.33%	100.00%	30.50%	100.00%	58.28%	100.00%

由上表可见,2016 年-2018 年,公司清洗机产品整体毛利率分别为 58.28%、30.50%和 41.33%,其中 2017 年毛利率较低,较 2016 年下降 27.78 个百分点,2018 年较 2017 年上升 10.83 个百分点,变动分析如下:

产品类别	2018 年度比 2017 年度			2017 年度比 2016 年度		
	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响	毛利率变动影响	收入占比变动影响	合计影响
6 英寸及以下	0.78%	0.00%	0.78%	0.00%	-0.78%	-0.78%
8/12 英寸	9.05%	12.44%	21.48%	-11.04%	6.14%	-4.89%
其他	-11.44%	0.00%	-11.44%	-11.50%	-10.61%	-22.11%
总计	-1.61%	12.44%	10.83%	-22.53%	-5.25%	-27.78%

由上表可见,2017 年度,公司清洗机产品毛利率较 2016 年有较大幅度下降,主要系当期公司适用于 8/12 英寸(如集成电路后道先进封装环节)及其他领域(指光掩模清洗)的清洗机产品销售毛利率有较大幅度下降所致。2018 年度,公司清洗机产品毛利率较 2017 年有所上升,主要系当期公司适用于 8/12 英寸晶圆处理领域的清洗机产品销售毛利率及收入占比上升所致。

②去胶机产品

2017 年、2018 年,公司去胶机产品整体毛利率分别为 72.46%和 49.67%,有所下降,主要原因为:2017 年,公司 1 台研发试用机经改造后向客户销售(占当年去胶机销售收入比重达到 39.87%),其成本已在以前年度研发费用中列支,使得其毛利率为 100%,从而拉高了当期去胶机产品整体毛利率。2018 年度,公司所销售的去胶机无研发试用机转销售的情形,因此产品毛利率较 2017 年有较大幅度下降。

③ 湿法刻蚀机产品

2017-2018 年，公司湿法刻蚀机产品整体毛利率分别为 51.91% 和 58.26%，有所上升。

4、与同行业可比公司的对比情况

公司主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（去胶机、湿法刻蚀机、清洗机）。目前，国内 A 股上市公司中，尚无与公司产品应用领域完全重叠的企业，为便于比较分析，公司选取与公司在细分领域构成直接或潜在竞争关系的在境外市场上市的公司作为对比，分别为日本东京电子（8035.TYO）、日本迪恩士（7735.TYO）、德国苏斯微（722670.SMH）、美国维易科（NASDAQ:VECO）、盛美半导体（NASDAQ:ACMR），上述可比公司生产的半导体专用设备与发行人对比情况如下：

公司名称	与发行人的产品差异	与发行人的产品共性
日本东京电子 (8035.TYO)	热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、测试设备等	涂胶显影设备、清洗设备
日本迪恩士 (7735.TYO)	热处理设备、测量设备等	清洗设备、涂胶显影设备
德国苏斯微 (722670.SMH)	光刻机、封装用键合机等	涂胶显影设备
美国维易科 (NASDAQ:VECO)	MOCVD、检测设备等	单晶圆湿法处理设备
盛美半导体 (NASDAQ:ACMR)	/	清洗设备

报告期内，发行人与上述可比公司毛利率水平的对比情况如下：

公司名称	2018 财年	2017 财年	2016 财年
日本东京电子	42.01%	40.30%	40.25%
日本迪恩士	32.27%	31.16%	31.19%
德国苏斯微	32.98%	35.73%	33.01%
美国维易科	35.74%	37.05%	40.13%
盛美半导体	46.15%	47.18%	48.70%
上述公司均值	37.83%	38.28%	38.66%
发行人	46.27%	41.79%	41.25%

注：（1）上述指标根据可比公司披露的公开年报数据计算，系可比公司综合毛利率，发行人毛利率为主营业务毛利率，且上述指标系可比公司根据其所适用会计准则（非中国会计准则）及会计政策、会计估计编制；（2）报告期内，可比公司的会计期间存在一定差异，其中日本东京电子、日本迪恩士的会计年度为上年4月1日至当年3月31日，发行人、德国苏斯微、美国维易科、盛美半导体的会计年度为当年1月1日至当年12月31日，下同。

报告期内，公司的毛利率水平略高于同行业可比上市公司平均水平，主要原因为：1、上述同行业可比上市公司的毛利率系其综合毛利率，公司毛利率为主营业务毛利率，计算口径有所差异；2、上述同行业可比上市公司在业务领域、产品结构等方面与公司均有所差异。

（五）期间费用分析

公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。报告期各期，公司期间费用金额合计分别为5,859.52万元、6,834.72万元、7,934.27万元和1,696.28万元，占当期营业收入的比例分别为39.70%、35.99%、37.78%和164.60%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
销售费用	460.54	44.69%	1,729.27	8.23%	2,004.66	10.56%	1,960.87	13.28%
管理费用	636.04	61.72%	2,857.89	13.61%	2,693.36	14.18%	2,292.25	15.53%
研发费用	595.32	57.77%	3,421.45	16.29%	1,975.81	10.41%	1,659.24	11.24%
财务费用	4.49	0.44%	-74.33	-0.35%	160.89	0.85%	-52.84	-0.36%
期间费用合计	1,696.38	164.61%	7,934.27	37.78%	6,834.71	35.99%	5,859.51	39.70%

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	131.49	28.55%	696.43	40.27%	777.65	38.79%	620.00	31.62%
物料消耗	68.30	14.83%	206.57	11.95%	415.99	20.75%	541.03	27.59%
差旅费	102.30	22.21%	330.99	19.14%	297.42	14.84%	268.24	13.68%
服务费	91.85	19.94%	183.09	10.59%	188.23	9.39%	167.70	8.55%
修理费	4.64	1.01%	17.91	1.04%	23.79	1.19%	82.01	4.18%
业务招待费	26.39	5.73%	94.51	5.47%	88.82	4.43%	66.11	3.37%
低值易耗品 摊销	2.44	0.53%	10.48	0.61%	33.74	1.68%	37.56	1.92%
房租	0.78	0.17%	23.66	1.37%	32.54	1.62%	24.20	1.23%
办公费	5.06	1.10%	13.44	0.78%	18.12	0.90%	17.61	0.90%
运输费	19.13	4.15%	38.53	2.23%	64.67	3.23%	68.08	3.47%
折旧费	4.03	0.88%	15.89	0.92%	15.34	0.77%	13.46	0.69%
其他费用	4.12	0.89%	97.78	5.65%	48.35	2.41%	54.86	2.80%
合计	460.54	100.00%	1,729.27	100.00%	2,004.66	100.00%	1,960.87	100.00%
占营业收入 比例	44.69%	-	8.23%	-	10.56%	-	13.28%	-

报告期内，公司销售费用金额分别为 1,960.87 万元、2,004.66 万元、1,729.27 万元和 460.54 万元，占营业收入的比例分别为 13.28%、10.56%、8.23% 和 44.69%，其主要构成项目包括职工薪酬、物料消耗、差旅费和服务费，以上四项费用合计金额占销售费用总额比例分别为 81.44%、83.77%、81.95% 和 85.54%。

(1) 职工薪酬

报告期内，公司销售人员职工薪酬分别为 620.00 万元、777.65 万元、696.43 万元和 131.49 万元，占当期销售费用的比例分别为 31.62%、38.79%、40.27% 和 28.55%，系公司销售费用的重要构成部分。2018 年，公司销售人员职工薪酬同比下降 81.22 万元或 10.44%，主要原因系客户回款情况是公司销售人员奖金的重要因素，因 2018 年回款情况差于 2017 年，故奖金计提金额同比有所减少。

(2) 物料消耗

报告期内，公司销售费用中物料消耗分别为 541.03 万元、415.99 万元、206.57 万元和 68.30 万元，主要为机台发出后客户现场调试领料，占当期销售费用的比

例分别为 27.59%、20.75%、11.95% 和 14.83%。2016 年，公司销售费用中物料消耗金额较大，主要原因为公司当年机台批量出口至台积电，导致现场调试领料金额较高。

（3）差旅费

报告期内，公司销售费用中差旅费分别为 268.24 万元、297.42 万元、330.99 万元和 102.30 万元，占当期销售费用的比例分别为 13.68%、14.84%、19.14% 和 22.21%，呈现逐年上升的趋势，与公司销售业务规模波动呈正向关系。

（4）服务费

报告期内，公司销售费用中服务费分别为 167.70 万元、188.23 万元、183.09 万元和 91.85 万元，主要为公司支付的咨询费、台湾机构的代理费等，占当期销售费用的比例分别为 8.55%、9.39%、10.59% 和 19.94%，占比略有上升但相对稳定。

（5）与同行业可比公司的对比

报告期内，公司与同行业上市公司销售费用率的对比情况如下：

公司名称	2018 财年	2017 财年	2016 财年	三年累计占比
日本东京电子	/	/	/	/
日本迪恩士	/	/	/	/
德国苏斯微	10.73%	11.75%	11.56%	11.31%
美国维易科	/	/	/	/
盛美半导体	12.88%	15.07%	14.27%	13.73%
上述公司均值	11.81%	13.41%	12.92%	12.52%
发行人	8.23%	10.56%	13.28%	10.40%

注：①上述指标根据可比上市公司公开披露的定期报告数据计算所得；

②日本东京电子、日本迪恩士、美国维易科未单独披露其销售费用数据；

③三年累计占比=最近三财年销售费用之和/最近三财年营业收入之和。

由于同行业可比公司各自客户群体、销售区域覆盖范围、营业收入规模等各有不同，报告期内销售费用率存在一定差异。2016-2018 财年，公司的销售费用率分别为 13.28%、10.56% 和 8.23%，逐年降低。公司各期销售费用率及三年销售费用累计占比与同行业可比公司均值接近，处在合理区间范围内。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	460.89	72.46%	1,756.50	61.46%	1,510.81	56.09%	1,200.42	52.37%
折旧费	74.24	11.67%	302.63	10.59%	397.74	14.77%	411.96	17.97%
运输费	4.46	0.70%	61.19	2.14%	14.53	0.54%	34.94	1.52%
车辆费用	11.46	1.80%	64.92	2.27%	72.27	2.68%	74.28	3.24%
低值易耗品摊销	14.13	2.22%	51.48	1.80%	98.33	3.65%	72.00	3.14%
服务费	3.10	0.49%	96.16	3.36%	154.49	5.74%	70.53	3.08%
差旅费	12.53	1.97%	97.34	3.41%	87.97	3.27%	69.67	3.04%
业务招待费	12.79	2.01%	37.50	1.31%	36.19	1.34%	42.18	1.84%
办公费	3.83	0.60%	34.60	1.21%	29.99	1.11%	31.64	1.38%
税金	-	-	-	-	-	-	28.33	1.24%
采暖费	-	-	35.16	1.23%	32.23	1.20%	29.67	1.29%
物业费	-	-	32.09	1.12%	27.88	1.04%	27.61	1.20%
修理费	9.31	1.46%	107.25	3.75%	48.34	1.79%	24.11	1.05%
无形资产摊销	10.37	1.63%	31.13	1.09%	20.57	0.76%	18.98	0.83%
其他费用	18.94	2.98%	149.93	5.25%	162.02	6.02%	155.95	6.80%
合计	636.04	100.00%	2,857.89	100.00%	2,693.36	100.00%	2,292.25	100.00%
占营业收入比例	61.72%	-	13.61%	-	14.18%	-	15.53%	-

报告期内，公司管理费用金额分别为 2,292.25 万元、2,693.36 万元、2,857.89 万元和 636.04 万元，占营业收入的比例分别为 15.53%、14.18%、13.61% 和 61.72%，其主要构成项目包括职工薪酬和折旧费，以上两项费用合计金额占管理费用总额的比例分别为 70.34%、70.86%、72.05% 和 84.13%。

(1) 职工薪酬

报告期内，公司管理人员职工薪酬分别为 1,200.42 万元、1,510.81 万元、1,756.50 万元和 460.89 万元，占当期管理费用的比例分别为 52.37%、56.09%、61.46% 和 72.46%，系公司管理费用的主要构成部分，呈现逐年上升的趋势，与

公司业务规模波动呈正向关系。

(2) 折旧费

报告期内，公司管理费用中折旧费分别为 411.96 万元、397.74 万元、302.63 万元和 74.24 万元，占当期管理费用的比例分别为 17.97%、14.77%、10.59% 和 11.67%，总体呈现下降趋势，主要原因系部分管理用固定资产达到折旧年限后不再计提折旧。

(3) 与同行业可比公司的对比

报告期内，公司与同行业上市公司管理费用率的对比情况如下：

公司名称	2018 财年	2017 财年	2016 财年	三年累计占比
日本东京电子	/	/	/	/
日本迪恩士	/	/	/	/
德国苏斯微	7.79%	8.05%	7.66%	7.82%
美国维易科	/	/	/	/
盛美半导体	10.70%	16.13%	9.77%	11.95%
上述公司均值	9.25%	12.09%	8.72%	9.89%
发行人	13.61%	14.18%	15.53%	14.33%

注：①上述指标根据可比上市公司公开披露的定期报告数据计算所得

②日本东京电子、日本迪恩士、美国维易科未单独披露其管理费用数据；

③三年累计占比=最近三财年管理费用之和/最近三财年营业收入之和。

公司管理费用率高于同行业可比公司平均水平，主要系可比公司营业收入规模大于公司，具有规模效应。报告期内，公司管理费用率分别为 15.53%、14.18% 和 13.61%，随着销售收入的增长逐年下降。

3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月		2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	284.57	47.80%	1,235.39	36.11%	946.73	47.92%	804.07	48.46%
折旧费	123.88	20.81%	579.35	16.93%	372.16	18.84%	292.36	17.62%
物料消耗	138.85	23.32%	1,065.83	31.15%	283.91	14.37%	247.24	14.90%

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
服务费	1.51	0.25%	72.82	2.13%	32.52	1.65%	0.13	0.01%
差旅费	12.42	2.09%	73.36	2.14%	80.74	4.09%	107.12	6.46%
专家咨询费	-	0.00%	197.02	5.76%	155.35	7.86%	130.42	7.86%
无形资产摊销	4.52	0.76%	13.22	0.39%	13.24	0.67%	14.63	0.88%
修理费	4.21	0.71%	38.89	1.14%	4.15	0.21%	0.14	0.01%
其他费用	25.35	4.26%	145.56	4.25%	87.00	4.40%	63.11	3.80%
合计	595.32	100.00%	3,421.45	100.00%	1,975.81	100.00%	1,659.24	100.00%
占营业收入比例	57.77%	-	16.29%	-	10.41%	-	11.24%	-

报告期内，公司研发费用金额分别为 1,659.24 万元、1,975.81 万元、3,421.45 万元和 595.32 万元，占营业收入的比例分别为 11.24%、10.41%、16.29% 和 57.77%，其主要构成项目包括职工薪酬、物料消耗和折旧费，以上三项费用合计金额占研发费用总额的比例分别为 80.98%、81.12%、84.19% 和 91.93%。报告期内，公司不存在研发支出资本化的情况。

(1) 职工薪酬

报告期内，公司研发人员职工薪酬分别为 804.07 万元、946.73 万元、1,235.39 万元和 284.57 万元，整体呈现逐年上升趋势，其占各期研发费用的比例分别为 48.46%、47.92%、36.11% 和 47.80%，系公司研发费用的重要组成部分。2018 年，公司研发人员职工薪酬占比有较大幅度下降，主要原因系公司研发机台当期物料消耗大幅增加，拉升了研发费用整体规模，进而导致研发人员职工薪酬占研发费用比重有所下降。

(2) 物料消耗

报告期内，公司研发费用中物料消耗金额分别为 247.24 万元、283.91 万元、1,065.83 万元和 138.85 万元，其占各期研发费用的比例分别为 14.90%、14.37%、31.15% 和 23.32%，其中，2018 年物料消耗金额及占比有较大幅度增长，主要系当期公司前道清洗及 KrF 涂胶显影设备研发导致的物料消耗大幅度增加所致。

(3) 折旧费

报告期内，公司研发费用中折旧费金额分别为 292.36 万元、372.16 万元、579.35 万元和 123.88 万元，其占各期研发费用的比例分别为 17.62%、18.84%、16.93%和 20.81%，占比相对稳定，其中，2018 年研发费用中折旧费金额增长较大，主要原因系公司测试用前道涂胶显影机于 2017 年底转固，从 2018 年起开始计提折旧，当年计提折旧金额为 135.42 万元。

(4) 主要研发项目情况

报告期内，公司研发费用对应的主要研发项目情况如下：

单位：万元

项目名称	整体预算	研发费用			
		2019年1-3月	2018年	2017年	2016年
前道 In line Track 研制与工艺验证	3,000.00	140.89	799.39	973.84	805.35
薄胶膜涂胶显影工艺技术研究	200.00	-	-	121.76	74.55
光刻机工艺应用开发	230.00	-	-	97.84	134.68
前道叠层涂胶显影设备工艺应用	250.00	-	-	97.61	140.41
Scrubber 清洗设备研制	1,000.00	49.86	654.79	173.65	-
前道机台单元技术优化与应用	2,000.00	220.75	1,290.28	-	-
合计	6,680.00	411.50	2,744.46	1,464.70	1,154.99
占当期研发费用比例		69.12%	80.21%	74.13%	69.61%

(5) 与同行业可比公司的对比

报告期内，公司与同行业上市公司研发费用率的对比情况如下：

公司名称	2018 财年	2017 财年	2016 财年	三年累计占比
日本东京电子	8.59%	10.48%	11.49%	9.91%
日本迪恩士	6.14%	5.93%	5.84%	5.98%
德国苏斯微	8.98%	9.12%	7.96%	8.69%

公司名称	2018 财年	2017 财年	2016 财年	三年累计占比
美国维易科	18.03%	17.24%	24.42%	19.32%
盛美半导体	13.91%	14.07%	11.91%	13.56%
上述公司均值	11.13%	11.37%	12.32%	11.49%
发行人	16.29%	10.41%	11.24%	12.89%

注：①上述指标根据可比上市公司公开披露的定期报告数据计算所得；

②三年累计占比=最近三财年研发费用之和/最近三财年营业收入之和

报告期内，公司 2016 年、2017 年研发费用率以及三年累计研发费用占营业收入的比例与同行业可比公司的平均水平相当。公司 2018 年研发费用率高于同行业可比公司平均水平，主要原因是 2018 年前道清洗及 KrF 涂胶显影设备研发投入增加以及当年高端研发人才引进所致。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
利息支出	0.16	-	26.12	196.30
减：利息收入	20.20	17.76	12.62	13.94
利息净支出	-20.04	-17.76	13.50	182.36
汇兑损失	32.70	146.60	182.32	73.17
减：汇兑收益	12.22	223.39	49.73	314.02
汇兑净损失	20.48	-76.79	132.59	-240.85
银行手续费	4.05	20.22	14.80	5.65
合计	4.49	-74.33	160.89	-52.84
占营业收入比例	0.44%	-0.35%	0.85%	-0.36%

报告期内，公司财务费用金额分别为-52.84 万元、160.89 万元、-74.33 万元和 4.49 万元，占营业收入的比例分别为-0.36%、0.85%、-0.35%和 0.44%，其主要构成部分包括利息支出、汇兑损益等，各期金额及占比较小。

（六）非经常性损益、投资收益和政府补助

1、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益的情况及对经营成果的影响分析详见“七、经

注册会计师核验的非经常性损益情况”。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
投资收益	3.79	185.23	89.82	-
合计	3.79	185.23	89.82	-

2016年至2019年1-3月，公司投资收益金额分别为0万元、89.92万元、185.23万元和3.79万元，主要为公司使用闲置资金进行银行理财投资所得，对公司经营成果和盈利能力稳定性不构成重大影响。

3、政府补助

公司自2017年度起根据新实施《企业会计准则第16号-政府补助》，将收到的与日常经营相关的政府补助计入其他收益。

报告期内，公司计入其他收益的政府补助情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
与收益相关的政府补助	50.00	1,612.32	1,713.98	/
与资产相关的政府补助	107.70	510.90	521.38	/
合计	157.70	2,123.22	2,235.36	/

报告期内，公司计入营业外收入的政府补助情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
与收益相关的政府补助	/	/	/	347.59
与资产相关的政府补助	/	/	/	473.40
合计	/	/	/	820.99

(1) 与收益相关的政府补助

报告期内，公司与收益相关的政府补助（任一会计年度金额在 50 万元以上）具体如下：

单位：万元

序号	具体性质	2019年 1-3月	2018年	2017年	2016年	补贴依据
1	软件产品增值税退税	-	910.86	966.34	204.89	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）
2	2017 市高层次创新创业人才团队资助项目：集成电路 300mm 晶圆单片处理设备研发及产业化	-	252.97	497.03	-	沈阳市人才资源开发专项资金资助协议
3	外专局高端外专人才项目经费	-	137.20	-	-	关于报送 2018 年引进境外技术管理人才项目执行总结的通知
4	2017 市科技项目：300mm 前道高产能匀胶显影设备研发	-	75.00	-	-	沈阳市科技局关于下达 2017 年沈阳市科技计划项目（第二批）的通知（沈科发[2017]40号）

序号	具体性质	2019年 1-3月	2018年	2017年	2016年	补贴依据
5	2017 市科技创新双百工程项目：集成电路精细化单元处理设备关键技术转化	-	-	100.00	-	《沈阳市科技局关于下达 2017 年沈阳市科学技术计划项目（第一批）的通知》（沈科发[2017]38 号）、《关于发布 2017 年沈阳市科技创新“双百工程”项目的通知》（沈科发[2017]31 号）
6	人才项目（引智/海外研发团队）	-	-	95.00	105.46	沈阳市外国专家局《关于组织开展 2016 年市级引进海外研发团队项目结项申报的通知》、关于下达 2017 年高端外国专家项目（经济技术类）计划的通知
7	沈阳市财政局外贸产业发展专项资金补助	50.00	-	-	-	关于组织市级项目资金申报工作的通知（外贸部分）
合计		50.00	1,376.03	1,658.37	310.35	-
占当期与收益相关政府补助总额的比例		100.00%	85.34%	96.76%	89.29%	

（2）与资产相关的政府补助

报告期内，公司与资产相关的政府补助（任一会计年度金额在 50 万元以上）具体如下：

单位：万元

序号	具体性质	2019年 1-3月	2018年	2017年	2016年	补贴依据
1	十二五课题 4：300mm 前道光刻匀胶显影工艺实验与测试平台建设 K1202 中央	6.27	150.45	176.44	176.44	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室《关于 02 专项 2012 年度项目立项批复的通知》（ZX02[2012]008 号）

序号	具体性质	2019年 1-3月	2018年	2017年	2016年	补贴依据
2	2014 省重大专项：90nm 光刻工艺匀胶显影设备研发与应用	37.50	150.00	150.00	150.00	《辽宁省科技厅、财政厅关于下达 2014 年度辽宁省科技创新重大专项计划的通知》（辽科发[2014]37 号）
3	2017 发改委创新链整合项目：集成电路 300mm 晶圆单片处理设备研发及产业化	33.28	129.97	36.09	-	《沈阳市发改委关于下达 2017 年沈阳市东北振兴新动能培育平台及设施专项中央预算内投资计划的通知》（沈发改投资发[2017]15 号）
4	“十一五”02 重大专项：凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备的研发与产业化	-	-	113.55	113.55	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室《关于 2009 年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》（ZX02[2010]007 号）
合计		77.05	430.42	476.08	439.99	-
占当期与资产相关政府补助总额的比例		71.54%	84.25%	91.31%	92.94%	

报告期内，除软件产品增值税退税外，公司将其他政府补助相关收益列入非经常性损益。

（七）经营成果其他项目变动分析

1、资产减值损失及信用减值损失

（1）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要为计提坏账损失和存货跌价损失，各期金额分别为 521.93 万元、188.84 万元、597.65 万元和 0 元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
坏账损失	-	167.47	31.28	17.50
存货跌价损失	-	430.19	157.56	504.43
合计	-	597.65	188.84	521.93

2016 年度及 2018 年度公司资产减值损失金额较大，主要原因系当期公司计提的存货跌价损失金额较高。

(2) 信用减值损失

自 2019 年 1 月 1 日起，对于存在客观证据表明存在减值的应收票据、应收账款及其他应收款，公司确认预期信用损失并计提信用减值损失。公司 2019 年 1-3 月计提的信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收票据及应收账款坏账损失	-66.85	-	-	-
其他应收款坏账损失	-21.89	-	-	-
合计	-88.73	-	-	-

2、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益金额明细如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-	-	-1.39	-77.67
其中：固定资产	-	-	-1.39	-77.67
合计	-	-	-1.39	-77.67

3、所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	-	235.77	374.83	43.99
递延所得税费用	-219.16	2.74	-6.51	-58.44
合计	-219.16	238.50	368.32	-14.46

（八）纳税情况

报告期内，公司应缴与实缴的税额明细情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-3月		2018年度		2017年度		2016年度	
	本期应缴税额	本期实缴税额	本期应缴税额	本期实缴税额	本期应缴税额	本期实缴税额	本期应缴税额	本期实缴税额
增值税	412.46	496.65	1,372.09	1,114.48	1,014.02	1,116.75	353.55	306.72
应交城市维护建设税	28.87	34.77	96.05	78.01	70.98	78.17	24.75	21.47
应交教育费附加	12.37	14.90	41.16	33.43	30.42	33.50	10.61	9.20
应交地方教育费	8.25	9.93	27.44	22.29	20.28	22.34	7.07	6.13
个人所得税	102.89	88.91	257.12	275.69	218.12	200.85	106.31	105.66
企业所得税	139.61	159.82	235.77	127.21	374.83	370.81	43.99	127.41
合计	704.45	804.98	2,029.62	1,651.11	1,728.65	1,822.42	546.26	576.56

报告期内，公司不存在重大税收政策变化，税收优惠对经营成果的影响详见本节“五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策”之“（三）各期税收优惠占利润总额的比例”。

十一、财务状况分析

（一）资产状况分析

报告期各期末，公司资产按流动性划分的构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	26,058.48	74.57%	29,163.48	76.81%	24,143.98	72.04%	22,349.06	75.17%
非流动资产	8,888.13	25.43%	8,806.81	23.19%	9,369.87	27.96%	7,383.65	24.83%
资产总计	34,946.61	100.00%	37,970.28	100.00%	33,513.85	100.00%	29,732.71	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 29,732.71 万元、33,513.85 万元、37,970.28 万元和 34,946.61 万元，其中流动资产是资产的主要构成部分，占比分别为 75.17%、72.04%、76.81%和 74.57%。

1、流动资产情况

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	4,184.81	16.06%	6,405.05	21.96%	8,288.98	34.33%	5,707.53	25.54%
交易性金融资产	100.00	0.38%	-	-	-	-	-	-
应收票据及应收账款	4,733.99	18.17%	6,910.21	23.69%	4,920.83	20.38%	5,572.34	24.93%
预付款项	556.18	2.13%	373.20	1.28%	288.23	1.19%	202.27	0.91%
其他应收款	141.19	0.54%	557.02	1.91%	225.49	0.93%	25.34	0.11%
存货	15,805.37	60.65%	14,365.26	49.26%	8,854.43	36.67%	9,745.63	43.61%
其他流动资产	536.93	2.06%	552.73	1.90%	1,566.03	6.49%	1,095.97	4.90%
合计	26,058.48	100.00%	29,163.48	100.00%	24,143.98	100.00%	22,349.06	100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为 22,349.06 万元、24,143.98 万元、29,163.48 万元和 26,058.48 万元，随着公司经营规模的扩大和股东新增资本的投入，公司流动资产整体呈现上升趋势。公司流动资产结构相对稳定，主要由货币资金、应收票据及应收账款和存货组成。

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	6.61	0.16%	5.13	0.08%	3.75	0.05%	3.71	0.07%
银行存款	3,150.20	75.28%	5,466.27	85.34%	7,902.15	95.33%	5,703.82	99.93%
其他货币资金	1,028.00	24.57%	933.65	14.58%	383.07	4.62%	0.00	0.00%
合计	4,184.81	100.00%	6,405.05	100.00%	8,288.98	100.00%	5,707.53	100.00%

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 5,707.53 万元、8,288.98 万元、6,405.05 万元和 4,184.81 万元，系公司流动资产的重要组成部分。2017 年末，公

司货币资金余额较 2016 年末增长 2,581.45 万元，主要原因系 2017 年公司收到股东投入的增资款 2,347.38 万元；2018 年末，公司货币资金余额较 2017 年末减少 1,883.93 万元，主要系当期末公司存货余额同比有较大增幅，使得原材料采购款支付金额有所增长，同时当期末设备验收形成的应收账款因在信用期内尚未回款所致。

(2) 应收票据及应收账款

报告期各期末，公司应收票据及应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收票据	654.98	1,558.18	2,487.67	2,348.99
应收账款	4,079.02	5,352.03	2,433.16	3,223.34
合计	4,733.99	6,910.21	4,920.83	5,572.34

① 应收票据

报告期各期末，公司应收票据明细情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑票据	654.98	1,558.18	2,487.67	2,348.99
商业承兑票据	-	-	-	-
合计	654.98	1,558.18	2,487.67	2,348.99

报告期各期末，公司应收票据余额分别为 2,348.99 万元、2,487.67 万元、1,558.18 万元和 654.98 万元，全部为银行承兑票据，信用风险较低。2018 年末，公司应收票据余额较 2017 年末减少 929.49 万元，主要系 2018 年公司收到的票据结算金额同比有所下降所致。

② 应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收账款余额	4,340.52	5,680.38	2,678.17	3,447.61

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
减：坏账准备	261.51	328.35	245.01	224.27
应收账款净额	4,079.02	5,352.03	2,433.16	3,223.34

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 3,223.34 万元、2,433.16 万元、5,352.03 万元和 4,079.02 万元，占各期末流动资产的比例分别为 14.42%、10.08%、18.35% 和 15.65%。

➤ 应收账款余额变动情况分析

报告期内，公司应收账款余额及营业收入变动情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收账款余额	4,340.52	5,680.38	2,678.17	3,447.61
应收账款余额同比增幅	-23.59%	112.10%	-22.32%	/
营业收入	1,030.53	20,999.05	18,988.50	14,760.31
营业收入同比增幅	/	10.59%	28.65%	/

2017 年末，公司应收账款余额 2,678.17 万元，同比下降 769.44 万元或 22.32%，而当年营业收入同比增长 4,228.19 万元或 28.65%，主要原因系当期客户回款情况较好。

2018 年末，公司应收账款余额 5,680.38 万元，同比增长 3,002.21 万元或 112.10%，主要原因系 2018 年四季度多个大型设备验收形成的应收账款尚在信用期内，导致当年末沉淀的应收账款余额较大。

➤ 应收账款账龄分析及坏账准备计提情况

报告期内，公司应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2019 年 3 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,054.18	202.71	5.00%
1 至 2 年	226.16	22.62	10.00%
2 至 3 年	13.54	4.06	30.00%

3至4年	26.54	13.27	50.00%
4至5年	6.25	5.00	80.00%
5年以上	13.85	13.85	100.00%
合计	4,340.52	261.51	6.02%
账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,347.23	267.36	5.00%
1至2年	258.87	25.89	10.00%
2至3年	54.19	16.26	30.00%
3至4年	-	-	50.00%
4至5年	6.25	5.00	80.00%
5年以上	13.85	13.85	100.00%
合计	5,680.38	328.35	5.78%
账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,508.48	75.42	5.00%
1至2年	1,073.69	107.37	10.00%
2至3年	1.20	0.36	30.00%
3至4年	60.49	30.24	50.00%
4至5年	13.51	10.80	80.00%
5年以上	20.81	20.81	100.00%
合计	2,678.17	245.01	9.15%
账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,129.84	156.49	5.00%
1至2年	219.45	21.94	10.00%
2至3年	64.01	19.20	30.00%
3至4年	13.51	6.75	50.00%
4至5年	4.67	3.74	80.00%
5年以上	16.14	16.14	100.00%
合计	3,447.61	224.27	6.50%

报告期各期末，公司应收账款的账龄主要在1年以内，占比分别为90.78%、56.33%、94.14%和93.40%，其中，2017年末公司账龄在1年以内的应收账款余

额占比有所下降，主要系当期末账龄在 1-2 年的应收账款余额较大所致。

公司应收账款的坏账准备计提政策与 A 股同行业上市公司对比情况如下：

账龄	发行人	北方华创	中微半导体
6 个月以内	-	-	1.00%
1 年以内	5.00%	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%	15.00%
2-3 年	30.00%	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	30.00%	30.00%
4-5 年	80.00%	30.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

由上表可见，公司应收账款坏账计提比例总体高于 A 股同行业上市公司，坏账准备计提政策较为谨慎。

➤ 应收账款前五大客户情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户如下：

序号	客户	金额（万元）	占应收账款比例
2019 年 3 月 31 日			
1	大连德豪光电科技有限公司	777.92	17.92%
2	北京晶瑞科技有限公司	687.08	15.83%
3	华天科技（昆山）电子有限公司	629.14	14.49%
4	东莞市中图半导体科技有限公司	557.30	12.84%
5	昆山国显光电有限公司	345.03	7.95%
合计		2,996.46	69.03%
2018 年 12 月 31 日			
1	华天科技（昆山）电子有限公司	1,043.44	18.37%
2	大连德豪光电科技有限公司	777.92	13.69%
3	北京晶瑞科技有限公司	687.08	12.10%
4	东莞市中图半导体科技有限公司	641.30	11.29%
5	昆山国显光电有限公司	373.88	6.58%
合计		3,523.61	62.03%
2017 年 12 月 31 日			
1	辛耘企业股份有限公司	784.35	29.29%

序号	客户	金额（万元）	占应收账款比例
2	苏州晶方半导体科技股份有限公司	289.85	10.82%
3	苏州科阳光电科技有限公司	264.94	9.89%
4	华灿光电(浙江)有限公司	243.30	9.08%
5	上海微高精密机械工程有限公司	126.00	4.71%
合计		1,708.44	63.79%
2016年12月31日			
1	辛耘企业股份有限公司	1,219.01	35.36%
2	苏州晶方半导体科技股份有限公司	616.32	17.88%
3	苏州科阳光电科技有限公司	409.65	11.88%
4	中国电子科技集团公司第五十五研究所	321.30	9.32%
5	上海微高精密机械工程有限公司	141.50	4.10%
合计		2,707.78	78.54%

报告期各期末，公司前五大应收账款余额合计分别为 2,707.78 万元、1,708.44 万元、3,523.61 万元和 2,996.46 万元，占各期末应收账款余额的比例分别为 78.54%、63.79%、62.03% 和 69.03%。

➤ 报告期各期末应收账款回款情况

报告期各期末，公司应收账款回款情况如下所示：

单位：万元

时点	期末余额	期后回款		
		2017 年度	2018 年度	2019 年 1-3 月
2019.3.31	4,340.52	-	-	-
2018.12.31	5,680.38	-	-	1,417.51
2017.12.31	2,678.17	-	2,345.02	54.30
2016.12.31	3,447.61	2,277.92	1,095.40	14.11

(3) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	556.18	100.00%	373.20	100.00%	288.23	100.00%	202.22	99.98%
1-2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-	0.05	0.02%
合计	556.18	100.00%	373.20	100.00%	288.23	100.00%	202.27	100.00%

报告期各期末，公司预付款项分别为 202.27 万元、288.23 万元、373.20 万元和 556.18 万元，占流动资产的比例分别为 0.91%、1.19%、1.28% 和 2.13%，金额较小。公司预付款项主要为预付供应商材料款，报告期各期末，随着公司业务规模的扩大，公司预付款金额规模有所扩大但占流动资产的比例较低，且账龄基本全部在 1 年以内。

报告期各期末，公司预付款项金额前五名情况如下：

序号	客户	金额（万元）	占预付款项比例
2019年3月31日			
1	NIDEC SANKYO CORPORATION	331.59	59.62%
2	安川通商（上海）实业有限公司	62.12	11.17%
3	西盟半导体设备（上海）有限公司	30.40	5.47%
4	上海恒锐知识产权服务有限公司	25.00	4.49%
5	大连斯频德环境设备有限公司	24.71	4.44%
合计		473.82	85.19%
2018年12月31日			
1	MORAL TECHNOLOGY CO,LTD.	82.81	22.19%
2	Oasis Materials Company LP	54.56	14.62%
3	NIDEC SANKYO CORPORATION	37.50	10.05%
4	东京计装（北京）仪表有限公司	36.57	9.80%
5	Technomate CO.,LTD.	28.91	7.74%
合计		240.34	64.40%
2017年12月31日			
1	上海律玛科国际贸易有限公司	65.73	22.80%
2	安川通商（上海）实业有限公司	62.12	21.55%
3	SAKAE Corporation	54.46	18.89%

序号	客户	金额（万元）	占预付款项比例
4	上海炫烁电子科技有限公司	51.21	17.77%
5	上海安浦鸣志自动化设备有限公司	10.74	3.73%
合计		244.26	84.74%
2016年12月31日			
1	KING Associates Co.,Ltd.	71.05	35.13%
2	SONO-TEK CORPORATION	26.24	12.97%
3	Fortrend Engineering Corporation	24.56	12.14%
4	JINCO.,LTD.	11.45	5.66%
5	北京洛可可科技有限公司	6.50	3.21%
合计		139.79	69.11%

（4）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
其他应收款余额	148.62	586.34	237.36	26.67
减：坏账准备	7.43	29.32	11.86	1.33
其他应收款净额	141.19	557.02	225.49	25.34

报告期各期末，公司其他应收款按款项性质分类情况如下：

单位：万元

款项性质	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
押金、保证金	76.34	561.51	225.46	10.91
备用金	66.12	23.50	10.61	14.70
其他	6.17	1.32	1.29	1.06
合计	148.62	586.34	237.36	26.67

报告期各期末，公司其他应收款净额分别为 25.34 万元、225.49 万元、557.02 万元和 141.19 万元，占流动资产的比例分别为 0.11%、0.93%、1.91%和 0.54%，金额较小，主要为沈阳海关进口税款保证金、公司员工备用金等。2017 年 1 月 18 日，工业和信息化部财务司向公司出具了《重大技术装备进口税收优惠申请受理通知书》，公司可向主管海关申请凭税款担保先予办理集成电路关键设备零

部件及原材料放行手续，因此公司 2017、2018 年末保证金余额持续提高。

（5）存货

①存货构成情况

报告期内，公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。报告期各期末，公司存货账面余额具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
原材料	3,320.33	20.43%	3,448.82	23.29%	2,138.56	22.72%	4,069.56	39.70%
在产品	2,910.59	17.91%	2,226.29	15.03%	2,220.30	23.59%	2,440.81	23.81%
库存商品	1,663.14	10.23%	2,178.25	14.71%	263.10	2.80%	549.91	5.36%
发出商品	8,355.68	51.42%	6,956.28	46.97%	4,789.09	50.89%	3,189.78	31.12%
合计	16,249.75	100.00%	14,809.64	100.00%	9,411.05	100.00%	10,250.06	100.00%

公司主要根据客户订单进行定制化生产。报告期各期末，公司存货主要由原材料、在产品和发出商品构成，库存商品占比较低。2018 年末，公司库存商品同比增幅较大，主要原因系当期公司完工的一批星型去胶机因客户场地尚未完成安装前准备而推延发货。

公司原材料主要包括机电一体类、机械类、气动液压系统类、电器类等，报告期各期末，公司原材料账面余额分别为 4,069.56 万元、2,138.56 万元、3,448.82 万元 3,320.33 万元，占各期末存货账面余额的比例分别为 39.70%、22.72%、23.29%和 20.43%。

公司在产品和发出商品主要为生产中和已发货尚未验收的各类半导体专用设备产品。公司销售的半导体专用设备需安装调试完成（部分客户采购内部控制程序更为严格，设备经公司安装调试完成后还需进行试运行）并取得客户签署的设备验收报告后，方可确认收入。报告期内，随着公司半导体设备销售规模的逐年扩大，各期末发出商品余额也随之逐年增长。2018 年末，公司发出商品余额同比增长 2,167.19 万元或 45.25%，增幅较大，主要系当年公司生产的前道涂胶显影新产品分别发出至客户进行工艺验证，上述设备成本较高所致。

②存货跌价准备计提情况

报告期各期，公司存货跌价准备的计提情况如下：

单位：万元

项目	2019年3月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,320.33	14.19	3,306.14
在产品	2,910.59	-	2,910.59
库存商品	1,663.14	-	1,663.14
发出商品	8,355.68	430.19	7,925.50
合计	16,249.75	444.38	15,805.37
项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,448.82	14.19	3,434.63
在产品	2,226.29	-	2,226.29
库存商品	2,178.25	-	2,178.25
发出商品	6,956.28	430.19	6,526.09
合计	14,809.64	444.38	14,365.26
项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,138.56	14.21	2,124.35
在产品	2,220.30	52.72	2,167.59
库存商品	263.10	-	263.10
发出商品	4,789.09	489.69	4,299.40
合计	9,411.05	556.62	8,854.43
项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,069.56	-	4,069.56
在产品	2,440.81	477.97	1,962.84
库存商品	549.91	26.46	523.45
发出商品	3,189.78	-	3,189.78
合计	10,250.06	504.43	9,745.63

公司于每年末对各类存货进行盘点清查，对成本大于可变现净值的存货计提

了跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 504.43 万元、556.62 万元、444.38 万元和 444.38 万元。

(6) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣进项税额	536.93	100.00%	552.73	100.00%	553.62	35.35%	1,079.55	98.50%
企业所得税借方余额重分类	-	-	-	-	12.40	0.79%	16.42	1.50%
银行理财产品	-	-	-	-	1,000.00	63.86%	-	-
合计	536.93	100.00%	552.73	100.00%	1,566.03	100.00%	1,095.97	100.00%

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 1,095.97 万元、1,566.03 万元、552.73 万元和 536.93 万元，占各期末流动资产的比例分别为 4.90%、6.49%、1.90% 和 2.06%，主要为待抵扣进项税额及银行理财产品。

2、非流动资产情况

报告期各期末，公司非流动资产具体构成如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	7,987.25	89.86%	8,131.07	92.33%	8,394.11	89.59%	6,368.06	86.25%
在建工程	-	-	-	-	106.75	1.14%	501.41	6.79%
无形资产	496.54	5.59%	511.43	5.81%	427.02	4.56%	386.16	5.23%
递延所得税资产	340.95	3.84%	121.78	1.38%	124.52	1.33%	118.01	1.60%
其他非流动资产	63.39	0.71%	42.52	0.48%	317.47	3.39%	10.00	0.14%
非流动资产合计	8,888.13	100.00%	8,806.81	100.00%	9,369.87	100.00%	7,383.65	100.00%

(1) 固定资产

① 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产的具体分类情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
房产及建筑物	3,231.74	40.46%	3,291.76	40.48%	3,531.84	42.08%	3,750.27	58.89%
机器设备	4,283.48	53.63%	4,339.78	53.37%	4,342.59	51.73%	1,975.36	31.02%
运输工具	78.95	0.99%	83.36	1.03%	100.99	1.20%	118.62	1.86%
电子设备	390.11	4.88%	413.80	5.09%	415.27	4.95%	514.89	8.09%
办公设备	2.97	0.04%	2.38	0.03%	3.42	0.04%	8.93	0.14%
合计	7,987.25	100.00%	8,131.07	100.00%	8,394.11	100.00%	6,368.06	100.00%

报告期各期末，公司固定资产金额分别为 6,368.06 万元、8,394.11 万元、8,131.07 万元和 7,987.25 万元，占非流动资产的比例分别为 86.25%、89.59%、92.33%和 89.86%。公司固定资产主要由各类研发及测试设备、一般车间厂房及高级别净化间构成。2017 年末，公司固定资产账面净额同比增长 2,026.05 万元或 31.82%，主要系 2017 年内部研发测试用前道涂胶显影设备和净化车间改造工程完工投入使用并转入固定资产核算所致。

②大额在建工程转入情况

报告期内，公司大额在建工程转入固定资产的情况如下：

转固年度	资产名称	金额（万元）	转入固定资产的依据
2018	晶圆边缘曝光设备	106.75	固定资产转固申请表
2018	扫描电镜	349.57	固定资产转固申请表
2017	净化改造间工程	431.84	固定资产转固申请表
2017	测试用前道涂胶显影设	1,425.47	固定资产转固申请表
2017	10 千伏备用电源	90.87	固定资产转固申请表
2017	STHC 温湿度控制器	158.50	固定资产转固申请表
2017	设备前端模组搬送机	84.81	固定资产转固申请表

截至 2019 年 3 月 31 日，公司不存在尚未交付的在建工程项目。

③固定资产折旧政策及 A 股同行业上市或拟上市公司比较分析

公司固定资产折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00-9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

公司与 A 股同行业上市或拟上市公司固定资产折旧方法整体不存在重大差异，具体对比情况如下：

可比公司名称	固定资产类别	折旧年限	预计净残值率
北方华创	房屋建筑物	30-40 年	3%
	机器设备	8-12 年	3%
	运输设备	6-12 年	3%
	电子设备及其他	4-10 年	3%
中微半导体	房屋及建筑物	20 年	5%
	机器设备	3-7 年	0-5%
	运输设备	5 年	5%
	电子设备	3-10 年	5%
	办公设备	4-10 年	5%
本公司	房屋及建筑物	20 年	5%
	机器设备	5-10 年	5%
	电子设备	5 年	5%
	运输设备	10 年	5%
	办公设备	5 年	5%

④固定资产折旧年限及成新率情况

截至 2019 年 3 月末，公司固定资产原值为 12,746.17 万元，累计折旧余额为 4,758.92 万元，固定资产净额为 7,987.25 万元，综合成新率为 62.66%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
一、账面原值				
房屋及建筑物	5,004.14	5,004.14	5,004.14	4,983.15
机器设备	6,051.63	5,980.95	5,506.70	2,780.33

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
电子设备	1,466.00	1,462.43	1,247.96	1,144.66
运输设备	184.16	184.16	184.16	184.16
办公设备	40.24	39.61	39.36	41.27
合计	12,746.17	12,671.29	11,982.32	9,133.57
二、累计折旧				
房屋及建筑物	1,772.40	1,712.38	1,472.29	1,232.87
机器设备	1,768.15	1,641.18	1,164.11	804.97
电子设备	1,075.89	1,048.62	832.69	629.77
运输设备	105.21	100.80	83.18	65.55
办公设备	37.27	37.23	35.94	32.34
合计	4,758.92	4,540.21	3,588.21	2,765.50
三、账面价值				
房屋及建筑物	3,231.74	3,291.76	3,531.84	3,750.27
机器设备	4,283.48	4,339.78	4,342.59	1,975.36
电子设备	390.11	413.80	415.27	514.89
运输设备	78.95	83.36	100.99	118.62
办公设备	2.97	2.38	3.42	8.93
合计	7,987.25	8,131.07	8,394.11	6,368.06

报告期各期末，公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2) 在建工程

①在建工程构成情况

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
在建工程	-	-	106.75	501.41
工程物资	-	-	-	-
合计	-	-	106.75	501.41

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 501.41 万元、106.75 万元、0 万元和 0 万元，占各期非流动资产的比例分别为 6.79%、1.14%、0%和 0%，占比相对较低，主要为厂房净化间改造工程及研发测试用设备组装等。

报告期各期末，公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

②重要在建工程变动情况

2018 年度，公司在建工程的变动情况如下：

单位：万元

项目	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产 金额	其他减少	年末余额
晶圆边缘曝光设备	106.75	-	106.75	-	-
扫描电镜	-	349.57	349.57	-	-
合计	106.75	349.57	456.32	-	-

2017 年，公司在建工程的变动情况如下：

单位：万元

项目	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产 金额	其他减少	年末余额
净化间改造工程	132.42	299.42	431.84	-	-
测试用前道涂胶显影设备	368.99	1,056.48	1,425.47	-	-
晶圆边缘曝光设备	-	106.75	-	-	106.75
10 千伏备用电源	-	90.87	90.87	-	-
STHC 温湿度控制器	-	158.50	158.50	-	-
设备前端模组搬送机	-	84.81	84.81	-	-
零星工程	-	52.45	52.45	-	-
合计	501.41	1,849.28	2,243.95	-	106.75

(3) 无形资产

①无形资产构成情况

报告期各期末，公司无形资产净额分别为 386.16 万元、427.02 万元、511.43 万元和 496.54 万元，占非流动资产总额的比例分别为 5.23%、4.56%、5.81%和 5.59%。公司无形资产主要由土地使用权及公司购买的各类生产经营用软件构成。报告期内，公司不存在研发支出资本化的情况。

公司无形资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
土地使用权	155.15	31.25%	156.28	30.56%	160.81	37.66%	165.34	42.82%
专利权	-	-	-	-	-	-	0.46	0.12%
软件及其他	341.39	68.75%	355.15	69.44%	266.21	62.34%	220.35	57.06%
合计	496.54	100.00%	511.43	100.00%	427.02	100.00%	386.16	100.00%

②无形资产摊销情况

报告期各期末，公司无形资产摊销情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
一、账面原值				
土地使用权	226.49	226.49	226.49	226.49
专利权	30.75	30.75	30.75	30.75
专用技术	-	-	-	496.64
软件及其他	528.72	528.72	399.96	325.28
合计	785.97	785.97	657.20	1,079.17
二、累计摊销				
土地使用权	71.34	70.21	65.68	61.15
专利权	30.75	30.75	30.75	30.29
专用技术	-	-	-	294.62
软件及其他	187.33	173.57	133.75	104.93
合计	289.43	274.54	230.18	490.99
三、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
专用技术	-	-	-	202.02
软件及其他	-	-	-	-
合计	-	-	-	202.02
四、账面价值				
土地使用权	155.15	156.28	160.81	165.34
专利权	-	-	-	0.46
专用技术	-	-	-	-
软件及其他	341.39	355.15	266.21	220.35

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
合计	496.54	511.43	427.02	386.16

由于公司专用技术“专利化学药品供给方法”不再具备经济效益，公司于2016年末按照其账面价值全额计提减值准备。除此以外，报告期各期末，公司其他无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(4) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	递延所得税资产	占比	递延所得税资产	占比	递延所得税资产	占比	递延所得税资产	占比
资产减值准备	66.66	19.55%	120.31	98.79%	122.03	97.99%	114.56	97.07%
信用减值准备	40.34	11.83%	-	-	-	-	-	-
无形资产会计与税法摊销年限差异	1.24	0.36%	1.48	1.21%	2.50	2.01%	3.46	2.93%
可抵扣亏损	232.71	68.25%	-	-	-	-	-	-
合计	340.95	100.00%	121.78	100.00%	124.52	100.00%	118.01	100.00%

报告期各期末，公司递延所得税资产主要系减值准备、可抵扣亏损等形成的可抵扣暂时性差异，各期末递延所得税资产余额分别为118.01万元、124.52万元、121.78万元和340.95万元，占非流动资产比重分别为1.60%、1.33%、1.38%和3.84%，金额相对较小。

(5) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预付设备款	12.51	19.73%	12.51	29.41%	317.47	100.00%	10.00	100.00%
预付软件款	50.88	80.27%	30.01	70.59%	-	-	-	-
合计	63.39	100.00%	42.52	100.00%	317.47	100.00%	10.00	100.00%

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 10.00 万元、317.47 万元、42.52 万元和 63.39 万元，金额较小，主要由预付设备款和预付软件款构成，其中，2017 年预付设备款增幅较大，主要系公司预付研发用扫描电镜（CDSEM）采购款所致。

（二）负债状况分析

1、负债结构分析

报告期各期末，公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	10,395.52	75.00%	12,408.98	77.64%	10,061.01	70.87%	12,260.48	81.21%
非流动负债	3,465.91	25.00%	3,573.61	22.36%	4,134.94	29.13%	2,836.99	18.79%
负债总计	13,861.44	100.00%	15,982.59	100.00%	14,195.95	100.00%	15,097.46	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 15,097.46 万元、14,195.95 万元、15,982.59 万元和 13,861.44 万元，主要以流动负债为主，各期占比分别为 81.21%、70.87%、77.64% 和 75.00%。

2、流动负债情况

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	-	-	1,500.00	12.23%
应付票据及应付账款	4,019.12	38.66%	5,206.39	41.96%	2,887.32	28.70%	3,861.03	31.49%
预收款项	5,925.06	57.00%	5,908.20	47.61%	6,428.43	63.89%	6,313.49	51.49%
应付职工薪酬	-	-	743.08	5.99%	625.42	6.22%	407.50	3.32%
应交税费	317.15	3.05%	417.67	3.37%	51.58	0.51%	149.38	1.22%
其他应付款	134.19	1.29%	133.63	1.08%	68.26	0.68%	29.08	0.24%

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	10,395.52	100.00%	12,408.98	100.00%	10,061.01	100.00%	12,260.48	100.00%

报告期各期末，公司流动负债总额分别为 12,260.48 万元、10,061.01 万元、12,408.98 万元和 10,395.52 万元，流动负债结构相对稳定，主要由应付票据及应付账款、预收账款等构成。

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款明细情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
抵押借款	-	-	-	1,000.00
信用借款	-	-	-	500.00
合计	-	-	-	1,500.00

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 1,500 万元、0 元、0 元和 0 元，占负债总额的比重分别为 9.94%、0%、0%和 0%。

(2) 应付票据及应付账款

报告期各期末，公司应付票据及应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	1,906.15	47.43%	2,257.01	43.35%	582.79	20.18%	-	-
应付账款	2,112.96	52.57%	2,949.38	56.65%	2,304.53	79.82%	3,861.03	100.00%
合计	4,019.12	100.00%	5,206.39	100.00%	2,887.32	100.00%	3,861.03	100.00%

①应付票据

报告期各期末，公司应付票据分类构成情况如下：

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	1,906.15	2,257.01	582.79	-
商业承兑汇票	-	-	-	-

合计	1,906.15	2,257.01	582.79	-
----	----------	----------	--------	---

报告期各期末，公司应付票据全部为银行承兑汇票。

②应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

账龄	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料采购款	1,927.31	91.21%	2,701.83	91.61%	2,176.11	94.43%	3,830.83	99.22%
工程款	10.90	0.52%	17.40	0.59%	0.20	0.01%	30.20	0.78%
设备款	155.32	7.35%	217.74	7.38%	110.95	4.81%	0.00	0.00%
其他	19.44	0.92%	12.41	0.42%	17.28	0.75%	0.00	0.00%
合计	2,112.96	100.00%	2,949.38	100.00%	2,304.53	100.00%	3,861.03	100.00%

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 3,861.03 万、2,304.53 万元、2,949.38 万元和 2,112.96 万元，占流动负债总额比例分别为 31.49%、22.91%、23.77% 和 20.33%。报告期各期末，公司的应付账款主要为应付原材料采购款，占比均在 90% 以上。报告期各期末，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 预收款项

报告期各期末，公司预收款项金额分别为 6,313.49 万元、6,428.43 万元、5,908.20 万元和 5,925.06 万元，占当期流动负债总额的比例分别为 51.49%、63.89%、47.61% 和 57.00%。公司预收款项全部为预收客户货款。

报告期各期末，公司预收账款账龄主要在 1 年以内，账龄结构合理。

(4) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为 407.50 万元、625.42 万元、743.08 万元和 0 万元，占当期流动负债总额的比例分别为 3.32%、6.22%、5.99% 和 0%。

公司应付职工薪酬主要为公司计提的员工奖金。

(5) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 149.38 万元、51.58 万元、417.67 万元和 317.15 万元，占当期流动负债的比例分别为 1.22%、0.51%、3.37% 和 3.05%，占比相对较小。公司应交税费主要由应交增值税、企业所得税等构成，具体构成如下：

单位：万元

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
增值税	199.69	283.89	26.28	129.02
城市维护建设税	13.98	19.87	1.84	9.03
教育费附加	5.99	8.52	0.79	3.87
地方教育费	3.99	5.68	0.53	2.58
个人所得税	17.55	3.57	22.14	4.87
企业所得税	75.95	96.15	-	-
合计	317.15	417.67	51.58	149.38

公司适用税率参见本节“五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策”之“（一）发行人适用的主要税项及其税率”。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 29.08 万元、68.26 万元、133.63 万元和 134.19 万元，占当期流动负债的比例分别为 0.24%、0.68%、1.08% 和 1.29%，占比相对较小。公司其他应付款主要由质保金、履约保证金等构成。

3、非流动负债情况

报告期各期末，公司非流动负债均为递延收益，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.3.31		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延收益	3,465.91	100.00%	3,573.61	100.00%	4,134.94	100.00%	2,836.99	100.00%
非流动负债合计	3,465.91	100.00%	3,573.61	100.00%	4,134.94	100.00%	2,836.99	100.00%

报告期各期末，公司递延收益金额分别为 2,836.99 万元、4,134.94 万元、3,573.61 万元和 3,465.91 万元，占当期负债总额的比例分别为 18.79%、29.13%、22.36% 和 25.00%，均由政府补助构成。

报告期各期末，公司递延收益明细如下：

单位：万元

项目	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31	与资产相关/ 与收益相关
十二五课题 9：300mm 晶圆匀胶显影设备成套工艺开发及示范应用 K1205 中央	-	-	7.10	7.10	与收益相关
十二五课题 1：匀胶、显影、热盘单元开发 K1201 中央	-	-	5.42	5.42	与收益相关
十二五课题 5：300mm 晶圆匀胶显影总成技术开发 K1203 中央	-	-	3.11	3.11	与收益相关
十二五课题 6：300mm 晶圆匀胶显影测试机研制 K1204 中央	-	-	19.28	19.28	与收益相关
2017 市高层次创新创业人才团队资助项目：集成电路 300mm 晶圆单片处理设备研发及产业化	-	-	252.97	-	与收益相关
2017 市科技创新双百工程项目：8-12 英寸高产能湿法设备研发与产业化	-	-	42.24	-	与收益相关
2017 市科技项目：300mm 前道高产能匀胶显影设备研发	-	-	75.00	-	与收益相关
十二五课题 4：300mm 前道光刻匀胶显影工艺实验与测试平台建设 K1202 中央	-	-	9.00	9.00	与收益相关
十二五课题 4：300mm 前道光刻匀胶显影工艺实验与测试平台建设 K1202 中央	365.87	372.14	522.59	699.02	与资产相关
2014 省重大专项：90nm 光刻工艺匀胶显影设备研发与应用	987.50	1,025.00	1,175.00	1,325.00	与资产相关
发改委重点产业专项：高端封装工艺喷涂胶、显影、单片湿法刻蚀设备研发与产业化	291.67	296.67	316.67	336.67	与资产相关

项目	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31	与资产相关/ 与收益相关
2013 市新兴产业项目： LED 芯片制造专用匀胶 显影设备产业化建设	134.90	137.21	146.46	155.71	与资产相关
2016 市经信委项目：12 英寸单晶圆处理设备研发 与产业化	113.16	121.16	151.37	159.48	与资产相关
“十一五”02 重大专项：凸 点封装涂胶显影、单片湿 法刻蚀设备的研发与产业 化	-	-	-	113.55	与资产相关
科技部国际合作项目：三 维先进封装工艺单晶圆湿 法处理技术合作研发	-	-	-	3.64	与资产相关
2017 市科技创新双百工 程项目：8-12 英寸高产能 湿法设备研发与产业化	42.36	44.11	51.11	-	与资产相关
2017 浑南区产业扶持资 金（双回路电工程）	22.30	22.98	25.71	-	与资产相关
2017 发改委创新链整合 项目：集成电路 300mm 晶圆单片处理设备研发及 产业化	1,068.65	1,101.94	1,231.91	-	与资产相关
辽宁省集成电路单晶圆处 理设备工程实验室项目	95.00	97.50	100.00	-	与资产相关
2017 市经信委项目：智能 化集成电路专用设备制造 平台升级	214.26	220.94	-	-	与资产相关
2018 市经信委新兴产业 发展专项：集成电路 300mm 晶圆单片处理设 备研发及产业化	130.26	133.98	-	-	与资产相关
合计	3,465.91	3,573.61	4,134.94	2,836.99	-

（三）资产周转能力分析

1、公司营运能力指标

报告期内，公司主要资产周转情况指标如下：

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	0.21	5.02	6.20	4.59

存货周转率（次）	0.04	0.93	1.13	0.83
----------	------	------	------	------

（1）应收账款周转能力分析

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 4.59 次、6.20 次、5.02 次和 0.21 次。报告期内，公司客户主要为国内知名半导体生产企业，商业信誉良好，付款能力较强，应收账款回款风险较小。2017 年，公司应收账款周转率较上年有所增长，主要原因系当年回款情况较好；2018 年，公司应收账款周转率较上年有所下降，主要系 2018 年四季度公司大量设备验收形成的应收账款尚在信用期内，导致年末沉淀的应收账款余额增幅较大。

（2）存货周转能力分析

报告期各期，公司存货周转率分别为 0.83 次、1.13 次、0.93 次和 0.04 次。公司根据客户订单情况动态调整采购及生产安排，保证了公司合理的库存水平。由于公司各年末根据在手订单情况开展的原材料采购及生产安排有所差异，以及不同客户对于设备验收前安装调试及试运行期限各不相同，导致各报告期末存货账面余额及存货周转率存在一定的波动。

报告期内，公司资产周转情况指标与可比上市公司的对比情况如下：

单位：次

公司	2018 财年	2017 财年	2016 财年
应收账款周转率			
日本东京电子	7.71	6.39	5.85
日本迪恩士	4.73	4.79	4.29
德国苏斯微	9.78	7.61	9.55
美国维易科	6.54	6.18	6.18
盛美半导体	2.91	1.71	1.95
平均值	6.33	5.34	5.56
本公司	5.02	6.20	4.59
存货周转率			
日本东京电子	2.26	2.21	2.14
日本迪恩士	2.32	2.46	2.43
德国苏斯微	1.43	1.25	1.67
美国维易科	2.52	3.05	2.58
盛美半导体	1.48	1.43	1.35

平均值	2.00	2.08	2.03
本公司	0.93	1.13	0.83

注：上述可比上市公司的会计年度与发行人存在差异（如日本上市公司会计年度为上年4月1日至当年3月31日），也分别适用其上市地的会计准则、会计政策和会计估计，上述数据系根据其公开披露数据计算得出，没有根据中国会计准则进行调整，下同。

报告期内公司应收账款周转率与可比上市公司水平相近。

报告期内，公司存货周转率低于行业平均水平，主要是产品验收周期相对较长引起的。

十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析

（一）偿债能力分析

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下：

项目	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率（倍）	2.51	2.35	2.40	1.82
速动比率（倍）	0.99	1.19	1.52	1.03
资产负债率	39.66%	42.09%	42.36%	50.78%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
息税折旧摊销前利润（万元）	-887.94	4,294.40	3,905.19	1,507.30
利息保障倍数（倍）	不适用	不适用	115.68	3.44

报告期各期末，公司的流动比率分别为1.82倍、2.40倍、2.35倍和2.51倍，速动比率分别为1.03倍、1.52倍、1.19倍和0.99倍，短期偿债能力整体呈增强态势。

报告期各期末，公司的资产负债率分别为50.78%、42.36%、42.09%和39.66%，整体呈下降趋势，主要原因系2017年部分股东完成对公司增资进而增强了公司资本实力。

从公司整体负债构成来看，报告期末，公司负债主要由原材料采购和预收货款形成的经营性负债，不存在银行借款、关联方借款、合同承诺债务或其他或有负债。公司建立了良好的采购付款和销售收款管理制度，能够有效控制公司经营过程的流动性风险。

报告期内，公司与同行业可比上市公司的流动比率、速动比率与资产负债率的比较情况如下：

公司	2018 财年末	2017 财年末	2016 财年末
流动比率			
日本东京电子	2.71	3.13	3.72
日本迪恩士	1.49	1.59	1.56
德国苏斯微	3.04	2.35	2.92
美国维易科	3.25	2.67	3.49
盛美半导体	2.08	2.88	2.36
平均值	2.51	2.52	2.81
发行人	2.35	2.40	1.82
速动比率			
日本东京电子	1.45	1.81	2.13
日本迪恩士	0.79	0.79	0.82
德国苏斯微	1.04	0.84	1.28
美国维易科	2.04	1.91	2.80
盛美半导体	1.12	2.04	1.53
平均值	1.29	1.48	1.71
发行人	1.19	1.52	1.03
资产负债率			
日本东京电子	36.17%	32.53%	28.88%
日本迪恩士	53.34%	52.47%	55.46%
德国苏斯微	29.63%	37.12%	30.77%
美国维易科	51.40%	39.45%	21.61%
盛美半导体	49.22%	41.29%	53.86%
平均值	43.95%	40.57%	38.12%
发行人	42.09%	42.36%	50.78%

报告期末，公司流动比率、速动比率与可比上市公司平均水平接近；2016 财年末资产负债率高于可比上市公司平均水平，2017 财年末和 2018 财年末与可比上市公司平均水平接近。

（二）报告期内公司股利分配的具体实施情况

根据 2016 年 2 月 26 日公司 2016 年度第一次董事会决议，2015 年度不予以分红。

根据 2017 年 2 月 20 日公司 2017 年度第一次董事会决议，公司本年度每股

分配现金红利 0.05 元，共计 291.53 万元。公司已以现金向股东分配了上述股利。

根据 2018 年 3 月 29 日公司 2018 年度第一次董事会决议，公司本年度每股分配现金红利 0.06 元，共计 378.00 万元。公司已以现金向股东分配了上述股利。

根据 2019 年 2 月 28 日公司 2019 年度第一次董事会决议，公司本年度不分配现金股利。

（三）现金流量情况分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	3,607.02	19,285.34	21,087.66	18,279.19
经营活动现金流出小计	5,658.99	22,116.90	16,841.25	11,592.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,051.97	-2,831.55	4,246.40	6,687.18
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	4,416.09	22,985.23	15,539.88	1,101.43
投资活动现金流出小计	4,664.10	22,223.68	18,032.73	1,378.46
投资活动产生的现金流量净额	-248.01	761.54	-2,492.85	-277.03
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	-	-	2,347.38	1,500.00
筹资活动现金流出小计	-	378.00	1,817.64	5,636.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-378.00	529.73	-4,136.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.61	13.51	-84.91	174.34
五、现金及现金等价物净增加额	-2,314.58	-2,434.51	2,198.38	2,448.20

1、经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,876.34	16,072.41	16,422.77	16,135.32
收到的税费返还	146.41	1,694.14	1,250.27	1,646.70
收到其他与经营活动有关的现金	584.26	1,518.79	3,414.62	497.17

经营活动现金流入小计	3,607.02	19,285.34	21,087.66	18,279.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,534.86	12,546.43	8,405.73	6,231.26
支付给职工以及为职工支付的现金	1,762.42	4,071.22	3,503.18	2,835.49
支付的各项税费	733.40	1,447.61	1,698.03	565.93
支付其他与经营活动有关的现金	628.31	4,051.64	3,234.31	1,959.32
经营活动现金流出小计	5,658.99	22,116.90	16,841.25	11,592.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,051.97	-2,831.55	4,246.40	6,687.18

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金金额分别为 16,135.32 万元、16,422.77 万元、16,072.41 万元和 2,876.34 万元，占同期营业收入的比例分别为 109.32%、86.49%、76.54% 和 279.11%，销售商品和提供劳务收到的现金与营业收入较为匹配，收款情况良好。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额具体形成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
净利润	-902.52	3,047.79	2,626.81	492.85
加：资产减值准备	-	597.65	188.84	521.93
信用减值准备	-88.73	-	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218.70	963.75	850.13	785.75
无形资产摊销	14.89	44.35	33.82	33.61
长期待摊费用摊销	-	-	-	13.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-	1.39	77.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	0.62	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	3.00	-13.51	111.03	21.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-3.79	-185.23	-89.82	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-219.16	2.74	-6.51	-58.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-	-

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,440.11	-5,398.59	839.01	62.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,534.57	-2,405.89	365.39	-979.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,168.82	514.76	-673.68	5,716.02
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,051.97	-2,831.55	4,246.40	6,687.18

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异的变动主要是受存货、经营性应收应付项目及折旧的影响。

2、投资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
收回投资收到的现金	4,400.00	22,800.00	13,450.00	-
取得投资收益收到的现金	3.79	185.23	89.82	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.06	1.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	12.30	-	2,000.00	1,100.00
投资活动现金流入小计	4,416.09	22,985.23	15,539.88	1,101.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164.10	423.68	1,582.73	278.46
投资支付的现金	4,500.00	21,800.00	14,450.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,000.00	1,100.00
投资活动现金流出小计	4,664.10	22,223.68	18,032.73	1,378.46
投资活动产生的现金流量净额	-248.01	761.54	-2,492.85	-277.03

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-277.03万元、-2,492.85万元、761.54万元和-248.01万元。

报告期内，公司投资活动现金流入主要是收回投资收到的现金，公司投资活动现金流出主要是投资支付的现金。由于公司现金状况良好、资产负债率较低，

公司为了提高资金使用效率，根据资金安排将部分闲置资金用于理财投资。上述收回投资收到的现金、投资支付的现金主要系公司购买的理财产品赎回或申购支付的现金。

3、筹资活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
吸收投资收到的现金	-	-	2,347.38	-
取得借款收到的现金	-	-	-	1,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	2,347.38	1,500.00
偿还债务支付的现金	-	-	1,500.00	5,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	378.00	317.64	196.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	378.00	1,817.64	5,636.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-378.00	529.73	-4,136.30

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,136.30万元、529.73万元、-378.00万元和0元。

报告期内，公司筹资活动现金流入主要为公司增资收到的投资者现金投入及取得银行贷款收到的现金；公司筹资活动现金流出主要为偿还银行贷款本金及支付贷款利息、现金分红支付的现金。

(四) 流动性风险分析及应对措施

报告期各期末，公司的流动性相关指标如下：

单位：万元

项目	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率（倍）	2.51	2.35	2.40	1.82
速动比率（倍）	0.99	1.19	1.52	1.03
货币资金	4,184.81	6,405.05	8,288.98	5,707.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,051.97	-2,831.55	4,246.40	6,687.18

报告期各期末，公司整体负债结构较为稳定，以流动负债为主，主要为公司经营过程中形成的应付票据及应付账款、预收款项等经营性负债。公司资产负债率、流动比率、速动比例与同行业可比上市公司平均水平基本持平，公司负债水平较低。

为应对流动性风险，公司定期监控短期和长期的流动资金需求，以确保维持充裕的流动资产储备。另外，公司与银行保持了良好的长期合作关系，同时针对销售收款和采购付款均建立了内部控制制度。

（五）持续经营能力

可能直接或间接对公司持续经营能力产生重大不利影响的风险因素参见本招股说明书“第四节 风险因素”。

十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

（一）重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，公司不存在重大对外投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项。

（二）重大资本性支出情况

1、报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产。报告期各期，公司用于构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 278.46 万元、1,582.73 万元和 423.68 万元和 164.10 万元。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金投资项目外，公司无可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金投资计划详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、募集资金投资项目具体情况”。

十四、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

第九节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金运用计划

2019年6月6日，公司召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金项目及其可行性的议案》等议案，公司拟向社会公开发行不超过2,100万股（含2,100万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。

公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	备案文号
1	高端晶圆处理设备产业化项目	23,860.73	23,860.73	沈浑发改备字（2019）36号
2	高端晶圆处理设备研发中心项目	13,918.24	13,918.24	沈浑发改备字（2019）35号
合计		37,778.97	37,778.97	-

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。

（二）募集资金投资项目对公司同业竞争和独立性的影响

本次募投项目的实施主体均为公司，不涉及与其他方合作的情形。本次募投项目实施后，公司与公司主要股东及其关联方之间不会新增同业竞争，且不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。

（三）募集资金的使用管理

发行人于2019年4月24日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关

于制定<募集资金管理办法>的议案》。《募集资金管理办法》对募集资金的专户存储、使用、资金用途变更、管理与监督等方面进行了明确的规定，主要内容如下：

1、募集资金专户储存

募集资金到账后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

2、募集资金使用

公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，原则上应用于主营业务。在计划范围内使用募集资金由使用部门或单位提出申请，并按照公司资金管理规定程序进行审批。募集资金使用情况严格按照相关规定进行信息披露，出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上交所并公告。

3、募集资金用途变更

公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。变更后的募投项目应投资于主营业务。

4、募集资金使用管理与监督

公司董事会应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，披露募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，并持续披露募集资金使用情况。公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四) 募集资金投资项目的必要性及可行性

1、项目建设的必要性

（1）提升作业环境，增强高端装备设计和生产能力

公司专业从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品研发、装配、验证等均需要在洁净程度较高的万级、千级乃至百级的洁净厂房中完成，部分验证还需要在要求更为严苛的十级洁净厂房中完成。近年来，随着公司业务的快速发展，公司可用于设备装配、验证及仓储的场地已基本饱和，公司现有净化厂房已经不能满足公司业务发展的需要。通过募投项目的实施，公司将新建高等级净化厂房 8,000.00 m²，同时引进行业领先的国内外先进智能检测设备，帮助公司提升前道芯片制造领域产品的设计和生产能力，满足公司市场扩张的需要，保持市场竞争优势地位。

（2）优化产品结构，提升盈利能力

作为国内半导体专用设备行业的重要参与者，公司生产的光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备广泛应用于国内 LED 芯片制造和集成电路后道先进封装领域，作为主流机型已成功打入包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌等在内的多家国内知名一线大厂。在保持现有市场优势地位的前提下，公司积极开拓集成电路制造前道晶圆加工领域市场，不断优化现有产品结构，开发出的前道产品已在下游知名芯片制造厂商进行工艺验证。通过募投项目的实施，公司将进一步加快前道产品的工艺技术提升及规模化生产，完善公司现有产品结构，提升整体盈利能力。

（3）加大自主创新研发力度，助力高端半导体装备国产化进程

近年来，我国在半导体领域取得了较快发展，已成为全球最大的半导体消费市场。但也应看到，我国半导体设备的国产化程度仍然较低，特别是在前道设备领域，我国目前还主要依赖国外进口。以前道涂胶显影设备为例，该类设备的市场和工艺技术长期以来均被国外厂商如日本东京电子所把持，特别是 28nm 及以下节点的 ArFi 浸没式涂胶显影设备，我国目前尚未掌握此项技术。通过募投项目的实施，有助于加速公司与浸没式光刻技术（ArFi）相匹配的涂胶显影设备的研发，掌握更为先进的设备制造及成套工艺技术，从而弥补我国该领域设备市场的空白，推进高端半导体专用设备国产化进程，提升我国半导体产业的整体竞争力。

2、项目建设的可行性

（1）国家政策支持行业发展

为推动半导体装备产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，近年来我国相继推出了包括《中国制造 2025》、《国家科技重大专项“十三五”发展规划》等在内的一系列鼓励和支持半导体装备产业发展的政策，为半导体装备产业的发展营造了良好的政策环境。

（2）良好的市场前景

随着全球半导体产能不断向我国大陆地区转移，国际大厂纷纷在我国大陆地区投资建厂，同时在集成电路产业投资基金的引导下，我国大陆集成电路生产线建设热情高涨，我国大陆地区对半导体设备的需求巨大。根据 SEMI 统计，2018 年我国大陆地区半导体专用设备销售规模达到 128 亿美元，首次超过中国台湾地区成为全球第二大市场，占全球市场比例不断上升。SEMI 预计未来我国大陆地区半导体专用设备市场仍将保持增长态势，2020 年市场规模将达 170.6 亿美元。

（3）优质的客户积累

公司依托于持续的技术创新、高性价比的产品、快速的响应及优质的售后服务能力不断发展壮大，在细分领域已建立一定的行业知名度。公司下游客户覆盖国内主要 LED 芯片制造企业和集成电路制造后道先进封装企业，与包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电等在内的多家优质客户保持着长期稳定的合作关系；公司集成电路制造前道晶圆加工环节用涂胶显影设备和清洗设备也已开发完成，其中，前道涂胶显影设备正在长江存储、上海华力等前道芯片制造厂商进行工艺验证，前道清洗设备已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并成功实现销售。此外，公司还通过加入行业协会、参加国内外展会等形式进一步扩大市场影响力，不断开拓新客户。

（4）丰富的技术储备

公司高度重视新技术、新产品和新工艺的研究开发，引进了多名具有国际化视野与海外科研背景的行业专家加盟公司或担任公司技术顾问，建立了一支在半导体专用设备领域具有丰富研发经验的科研团队，具备较强的持续创新能力。经

过多年发展及承担包括 02 重大专项等在内的科研项目，公司成功突破了前道芯片制程领域 300mm 晶圆涂胶显影设备核心关键技术，通过与客户的交流以及对市场主流光刻机技术的研究，结合终端工艺验证情况对现有前道产品持续研发升级，不断提升并完善现有技术储备。为进一步提高研发效率、激发创新活力，公司还制定了一整套研发管理制度，为募投的顺利实施提供制度保障。

（五）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

公司募集资金投资项目是在公司现有业务的基础之上制定的，是按照业务规模发展和技术研发创新的要求对现有业务的提升和拓展。高端晶圆处理设备产业化项目将实现对公司现有产品的升级，能够有效丰富和完善公司现有的产品系列，扩大公司的业务规模；高端晶圆处理设备研发中心项目对于巩固公司的技术领先地位、进一步发挥企业技术研发中心在技术创新和新产品研发中的作用具有十分重要的作用。通过以上募集资金投资项目的实施，公司将进一步提高公司的技术研发实力，拓展公司的业务半径，提升公司的核心竞争力。

（六）募集资金投向科技创新领域的具体安排

公司募集资金投资项目系按照公司业务规模发展和技术研发创新的要求对现有业务的提升和拓展，有利于公司进一步提高技术研发实力，提升公司核心竞争力。公司本次募投项目均属于科技创新领域，具体安排请参见本节“二、募集资金投资项目具体情况”。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）高端晶圆处理设备产业化项目

1、项目概况

本项目建设的总体目标是提升公司在集成电路前道芯片制造领域的设备设计、装配能力，优化产品结构，增强公司的综合竞争力。通过本项目的建设，公司形成高端晶圆处理设备（主要包括 8/12 英寸单晶圆前道涂胶/显影机和 8/12 英寸前道单片式清洗机等产品）产业化规模生产能力，为客户提供成套高端晶圆处理设备，充分参与国际竞争，并形成批量化生产及销售能力。

2、项目投资概算

本项目预计建设期 18 个月，投资 23,860.73 万元，其中建设投资 19,354.63 万元，主要用于项目建筑工程及相关设备购置，占募集资金总额的 81.12%；铺底流动资金 4,506.10 万元，占募集资金总额的 18.88%。

序号	工程或费用名称	金额（万元）	比例
1	建设投资	19,354.63	81.12%
1.1	建筑工程及设备	18,672.98	78.26%
1.1.1	设备购置及安装费	6,313.60	26.46%
1.1.2	软件投入	385.00	1.61%
1.1.3	土建及装修工程费	11,974.38	50.18%
1.2	建设工程其它费用	681.65	2.86%
2	铺底流动资金	4,506.10	18.88%
项目总投资		23,860.73	100.00%

3、项目建设主要内容

本项目占地面积 21,499.91 m²，规划总建筑面积为 32,125.00 m²，配备生产、研发、销售、管理等相关人员 402 人。本项目主要建设内容具体如下：

(1) 新建生产厂房 12,000.00 m²，其中十级无尘车间 100.00 m²、百级无尘车间 600.00 m²、千级无尘车间 3,800.00 m²，万级无尘车间 3,500.00 m²，仓库 4,000.00 m²，主要用于半导体专用设备的装配、调试检测及原材料和产成品存放。

(2) 新建动力车间 3,000.00 m²、研发楼 7,000.00 m²、其他配套区域 6,625.00 m² 及地下室 3,500.00 m² 等配套设施，用于满足项目办公所需及员工住宿生活需求。

(3) 引进先进的软硬件设备。项目将通过引进晶圆金属离子检测设备、SEM、铵根离子测试仪、示波记录仪、便捷式表面清洁洁净度量测仪等设备，提升产品研发设计能力及质量检测水平。

4、项目选址

本项目在项目建设地点为沈阳市浑南区新岛街 6 号，截至本招股说明书签署日，上述地块的权属手续正在履行相关审批程序，公司尚未取得上述地块的权属

证书。

5、项目环保情况

本项目在实施过程中需要进行相关场地的清理和室内的装修,可能会产生一定的噪音、扬尘、工程材料废料及废水等,公司将确保将其控制在国家环保规定或标准范围之内。项目实施及投产过程中的硬件设备购置及安装调试、软件工具购置、研究开发等系列工作均不涉及产生排放废料、排放污水等环境影响问题。

本项目已经取得沈阳市环境保护局关于项目环境影响登记表的审查批复(沈环浑南审字(2019)21号)。

6、项目实施规划

本项目建设期 18 个月,建设进度安排如下:

序号	建设项目	起止时间
1	工程设计及准备工作	T+1~T+6
2	土建工程	T+6~T+11
3	装修、水电工程	T+11~T+14
4	景观绿化	T+14~T+16
5	设备采购及安装调试	T+11~T+16
6	人员招聘及培训	T+16~T+18
7	试运行及验收	T+16~T+18

(二) 高端晶圆处理设备研发中心项目

1、项目概况

本项目拟在公司已掌握技术的基础上,进一步加强对行业内浸没光刻匹配的涂胶显影机、单片式清洗设备等高端半导体专用设备及其相关技术进行研究,增强公司在半导体专用设备领域的创新能力,提升核心技术水平,进入高端半导体专用设备领域,进一步增强公司服务客户的能力,巩固和提高公司的市场地位。预计项目建成后,将有效提升公司在高端半导体专用设备生产领域的综合竞争力。

2、项目投资概算

本项目拟募集资金总量为 13,918.24 万元,其中软硬件设备投入 7,262.70 万

元，项目实施费用 6,655.54 万元，估算如下：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占比
1	建设投资	7,262.70	52.18%
1.1	设备及软件购置费	7,262.70	52.18%
1.1.1	设备购置及安装费	6,676.50	47.97%
1.1.2	软件工具购置费	586.20	4.21%
2	项目实施费用	6,655.54	47.82%
2.1	实验室认证及维护费	200.00	1.44%
2.2	知识产品事务费	60.00	0.43%
2.3	产学研及专家咨询费	120.00	0.86%
2.4	研发材料费	5,805.74	41.71%
2.5	人员工资	469.80	3.38%
项目总投资		13,918.24	100.00%

3、项目建设主要内容

本项目拟在现有研究资源的基础上，通过配置先进的研究设备、实验设备和测试检验设备，引进专业技术人才，建立与公司发展战略相适应的研发平台，提升公司技术创新能力。根据公司战略规划，本项目的主要建设内容包括软硬件设施购置及人才招聘等。

4、项目选址

本项目在项目建设地点为沈阳市浑南区飞云路 16 号，公司已取得其土地使用权证。

5、项目环保情况

本项目在实施过程中需要进行相关场地的清理和室内的装修，可能会产生一定的噪音、扬尘、工程材料废料及废水等，公司将确保将其控制在国家环保规定或标准范围之内。项目实施及投产过程中的硬件设备购置及安装调试、软件工具购置、研究开发等系列工作均不涉及产生排放废料、排放污水等环境影响问题。

本项目已经取得沈阳市环境保护局关于项目环境影响登记表的审查批复（沈环浑南审字〔2019〕22 号）。

6、项目实施规划

本项目建设期 10 个月，建设进度安排如下：

序号	建设项目	起止时间
1	设备软件购置及安装调试	T+1~T+8
2	人员招聘与培训	T+4~T+9
3	试运行与验收	T+10

三、公司未来发展战略规划

（一）公司发展战略

公司始终秉承“为客户创造价值”的企业使命，坚持“客户第一、奋斗为本、诚信合作、专业精品”的企业精神，专注于高端半导体专用设备领域，通过持续的技术研发和供应链建设，提升公司的核心竞争力，增强团队的执行力和凝聚力，不断开拓新产品、新领域，有效提升公司收入和利润规模，为股东创造价值。公司将积极加强技术人才团队、知识产权和商业秘密体系建设，通过有效的内控和核心竞争力的提升，稳健发展并防范各种风险。

（二）实现发展规划与目标拟采取的措施

1、巩固传统优势领域，扩大市场销售规模

公司已在 LED 芯片制造、集成电路制造后道先进封装等领域深耕多年，凭借持续的技术创新、高性价比的产品及优质的售后服务，公司在上述领域已建立一定的行业知名度，下游客户覆盖国内主要 LED 芯片制造企业和集成电路制造后道先进封装企业，与包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电等在内的多家优质客户保持着长期稳定的合作关系。

对于 LED 芯片制造领域，虽然当前全球 LED 芯片行业正处在结构调整期，但 4~6 英寸化合物半导体市场正在迅速崛起，mini LED、micro LED 技术也在趋于成熟，这将成为未来 LED 行业发展的重要驱动力，对半导体设备的需求规模及性能技术要求将会同步提升，公司将基于现有技术积累和优势，积极推出适应化合物半导体及 mini LED、micro LED 领域的高性价比、有竞争力的产品，巩固在 LED 芯片领域的传统优势，保持市场份额并扩大销售规模；对于集成电路

制造后道先进封装领域，为适应先进封装技术前道化的发展趋势，公司将致力开发多层堆叠多腔体设备，丰富公司产品线，提升产品竞争力。

此外，公司还将凭借已有维信诺、京东方等标杆企业成功应用的案例优势，抓住硅基 OLED 和 MEMS 蓬勃发展的机遇，进一步扩大 8~12 英寸单片式湿法设备在硅基 OLED 和 MEMS 等领域的销售规模；公司将积极建立海外销售体系，培育和拓展海外市场，提升公司品牌的国际影响力，为公司发展创造新的增长点。

2、抓住行业机遇，加大研发投入，提升核心竞争力

前道芯片生产线的不断扩张和半导体设备国产化的大趋势为国产半导体设备企业的发展创造了历史性的机遇。公司深知要想有效地扩大收入和利润规模，归根结底是要提升自身的核心竞争力，即在客户端有话语权、在供应链有定价权，能够为客户创造价值，提供高性价比、有竞争力的产品和服务。通过本次发行募集资金，公司将能够解决研发投入的燃眉之急，进一步提升自身在半导体设备领域的技术积累。

（1）聚焦前道涂胶显影设备和单片式清洗设备

公司在深耕 LED 芯片制造和后道先进封装领域的基础上，积极向精细化前沿技术领域发展，瞄准市场空间更大的前道设备主战场，积极推动前道涂胶显影设备及前道清洗设备的工艺验证及商业化推广。目前，公司生产的前道涂胶显影设备已经进入上海华力和长江存储进行工艺验证，前道清洗设备也已通过中芯国际（深圳厂）工艺验证并成功实现销售。

公司重视自身产品技术和性能的不断升级，在主要产品打入前道芯片制造领域的同时，不断推出更高工艺等级的产品，并为此制定中期战略发展规划。在涂胶显影设备领域，公司计划于 2019 年完成 12 英寸前道涂胶显影设备的工艺验证并推出 Barc 工艺、PI 工艺独立机台；2020 年实现销售与光刻设备联机的 I-line 涂胶显影设备；2021 年起实现 I-line 涂胶显影设备的批量化销售并推出 KrF、ArF 甚至浸没式涂胶显影设备。与此同时，公司将持续提升清洗设备的技术指标和竞争力，与前道涂胶显影设备一同形成新的两大主打优势产品，为公司长期发展提供核心竞争力和增长极。

（2）建立测试验证平台，缩短研发周期和客户端验证周期

与国际知名企业相比，国产半导体设备企业在产品中试能力和测试验证平台的建设方面仍然有所欠缺。由于缺乏资金投入，公司开发的整机产品的工艺性能、核心单元部件的技术指标等无法在公司生产车间实现充分、有效的检验和测试，通常需要在客户现场进行检验测试，致使产品研发及工艺验证周期较长，再加上客户现场工期进度等客户端因素的影响，使得公司产品的工艺验证具有一定的不确定性。公司未来将加大测试验证平台的建设投入，提升公司的产品中试能力，缩短设备研发及客户端验证周期。

（3）完善公司供应链建设

当前，我国半导体设备产业链建设仍处于起步阶段，国产半导体设备大量核心部件仍依赖于进口，甚至被单一供应商垄断。另一方面，受国际贸易格局不确定性等因素的影响，公司完善供应链建设势在必行，公司将通过联合开发、自主研发、寻找替代供应商等方式降低核心部件成本，巩固核心部件可控性，提升产品综合竞争力。

3、人才团队与研发能力建设

（1）加快建设高端技术人才团队

技术人才是决定企业研发实力的关键要素，公司深知要想研发出高精尖的产品，首先要拥有高精尖的技术人才团队。因此，公司重视技术人才队伍的建设，投入大量成本，培养及储备了一批包括设计制造、工艺制程、软件开发与应用等多学科的专业人才和具有丰富的半导体设备行业经验的高端人才的技术团队。

通过前期国家科技专项的合作和积累，公司同中科院沈自所、中科院微电子所、清华大学等优势科研单位建立密切联系。此外，公司与沈阳航空航天大学建立基地式战略合作伙伴关系，实现双方优势互补，有效扩充了公司研发能力和技术人才资源。

（2）建立人才培养机制

公司已建立了稳定的核心技术人才团队，形成了传帮带的优良作风。人才资

源是公司长远发展的持续动力，公司注重新员工的培训，施行内部讲师制和师徒帮教制，建立了“团队培训、个体指导、阶段考核”三位一体的人才培养机制。此外，公司承担的前期国家科技专项、内部科研任务以及下游客户饱满订单，使公司人才技能得到快速成长和提升。

（3）建立长效激励机制，增强团队凝聚力

公司制定了一套完整、高效、灵活的激励方案，充分激发核心团队的创新积极性，吸纳并留住核心人才。公司为核心人员提供了具有竞争力的待遇，并不断提升核心人员的地位。此外，公司通过实施股权激励，核心团队能够分享公司快速发展带来的红利，提升核心团队的稳定性和凝聚力。

4、建立完善知识产权和商业秘密保护体系

半导体设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等多学科技术，具有技术壁垒高、制造难度大等特点，因此知识产权和商业秘密是半导体设备企业立足和发展的根本。公司重视知识产权和商业秘密的保护，将知识产权和商业秘密作为重要资产，把知识产权和商业秘密保护体系建设作为公司科技进步和发展壮大的一项重要任务。一方面，公司尊重同行业其他公司的知识产权，积极规避知识产权纠纷。另一方面，公司建立完善知识产权和商业秘密保护和内部管理制度，避免核心技术和商业秘密被恶意窃取或流失。

第十节 投资者保护

一、投资者权益保护情况

（一）信息披露制度和流程

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及部门规章的有关规定，制定了《信息披露管理办法》，明确了信息披露的原则、披露要求及对信息披露事务的管理。

为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护投资者的利益，公司制定了《投资者关系管理办法》，明确了投资者关系管理的原则、内容和方式、组织与实施等具体内容。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市后，将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整地报送及披露信息。公司负责信息披露和投资者关系服务的部门为董事会办公室，联系方式如下：

负责人：李风莉

地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号

邮编：110168

电话号码：024-23826230

传真：024-23826200

（三）未来开展投资者关系管理的规划

根据《投资者关系管理办法》等相关文件的规定，开展投资者关系管理的主要目的是：形成公司与投资者双向沟通的有效机制，建立稳定和优质的投资者基

础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，推广公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念，增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

与投资者沟通的主要内容包括公司的发展战略、定期报告和临时公告、公司的生产经营状况、企业文化建设等相关信息。

公司未来将通过公告、召开股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观等方式开展与投资者的沟通工作。

二、公司发行上市后股利分配政策

（一）本次发行后公司的利润分配政策和决策程序

根据公司2019年6月6日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司的利润分配政策如下：

“（一）利润分配原则

公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

公司拟实施送股或者以资本公积转增股本的，所依据的半年度报告或者季度报告的财务会计报告应当审计；仅实施现金分红的，可免于审计。

（三）利润分配条件和现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，进行利润分配时，在公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现金分红总额（包括中期已分配的现金

红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 10%。

同时进行股票分红的,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(四) 利润分配的期间间隔

公司每年度至少进行一次利润分配,可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

(五) 股票股利发放条件

公司主要的分红方式为现金分红。在履行上述现金分红之余,在公司符合上述现金分红规定,且营业收入快速增长,股票价格与股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司董事会可以提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。

(六) 对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(七) 利润分配方案的决策机制

1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制

(1) 公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投

资的资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。

(2) 利润分配方案由公司董事会制定,公司董事会应根据公司的财务经营状况,提出可行的利润分配提案。

(3) 独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配提案的,应经全体独立董事过半数通过;如不同意,独立董事应提出不同意的事实、理由,要求董事会重新制定利润分配提案;必要时,可提请召开股东大会。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

(4) 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见,同意利润分配提案的,应形成决议;如不同意,监事会应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润分配提案;必要时,可提请召开股东大会。

(5) 利润分配方案经上述程序通过的,由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时,公司应根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

2、利润分配政策调整的决策程序

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,公司可对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(1) 由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案,充分论证调整利润分配政策的必要性,并说明利润留存的用途,由公司董事会根据实际情况,在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案,确保公司股东能够持续获得现金分红。

(2) 公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见,并应经全体独立董事过半数通过;如不同意,独立董事应提出不同意的事实、理由,要求董事会重新制定利润分配政策调整方案,必要时,可提请召开股东大会。

(3) 监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

(4) 利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

(八) 利润分配方案的实施

“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。”

(二) 本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行后的股利分配政策在原有利润分配政策的基础上，对利润分配条件和现金分红比例、股票股利发放条件、利润分配方案的决策机制等进行了更细致的规定，有利于维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

三、本次发行前滚存利润的处理

发行人召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前的滚存利润分配的议案》。根据上述议案，发行人首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。

四、股东投票机制

公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票、征集投票权等股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。

(一) 累积投票制度

根据《公司章程》、《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》等相关

文件的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）中小投资者单独计票机制

根据《公司章程》、《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》等相关文件的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）提供股东大会网络投票方式

根据《公司章程》、《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》等相关文件的规定，公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。

（四）征集投票权

根据《公司章程》、《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》等相关文件的规定，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况

公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。

六、发行人、发行人的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施

(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

本次发行前，发行人的全体股东就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等进行了承诺，主要内容如下：

1、关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

(1) 发行人合计持股超过 51% 的股东先进制造、中科院沈自所、科发实业承诺：

“1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本单位直接或间接持有的首次发行上市前发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本公司/本单位同时将遵守法律法规以及上海证券交易所科创板股票上市规则关于股份锁定的其他规定。

2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本单位持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。”

(2) 发行人其他股东承诺：

“自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

(3) 发行人董事、高级管理人员承诺：

“1、自沈阳芯源股票上市之日起 36 个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市沈阳芯源股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有沈阳芯源股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直

接和间接持有的股份。

2、本人直接和间接持有的股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。”

(4) 发行人监事承诺：

“自沈阳芯源股票上市之日起 36 个月内本人不以任何方式转让本人持有的首次发行上市沈阳芯源股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人持有沈阳芯源股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的股份。”

(5) 发行人核心技术人员承诺：

“自沈阳芯源本次发行上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首次发行上市沈阳芯源股份；自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次发行上市前股份不得超过上市时所持沈阳芯源首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。”

2、关于股东持股及减持意向的承诺

(1) 发行人合计持股超过 51% 的股东先进制造、中科院沈自所、科发实业承诺：

“本公司/本单位未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意在较长时期内稳定持有发行人股份。在 36 个月限售期届满之日起 2 年内，若减持发行人股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

1、减持股份的条件

将按照首次公开发行股票招股说明书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持持有的沈阳芯源股

票。在上述限售条件解除后，可作出减持股份的决定。

如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本公司/本单位将不会减持所持发行人股份。

2、减持股份的数量及方式

减持所持有的沈阳芯源股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所科创板的相关减持规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、减持股份的价格

减持所持有的沈阳芯源股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在首次公开发行股票前所持有的沈阳芯源股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于沈阳芯源首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

4、减持股份的期限

通过集中竞价交易减持所持有的沈阳芯源股份前，将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前予以公告，如采取其他方式减持的将提前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。”

(2) 发行人持股 5% 以上的其他股东国科投资、国科瑞祺、周冰冰承诺：

“1、自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本人/本公司计划在所持公司股份锁定期满后减持，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

3、减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；

4、减持方式：本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

5、本人/本公司实施减持时，通过集中竞价交易减持所持有的沈阳芯源股份前，将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前予以公告，如采取其他方式减持的将提前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。”

3、关于无实际控制人的股份锁定安排

截至本招股说明书签署日，根据先进制造、中科院沈自所、科发实业出具的《合计持有前51%股份的主要股东关于股份锁定的承诺》、《合计持有前51%股份的主要股东关于持股意向及减持意向的承诺》以及现行适用的相关监管规则，前述股东锁定股份自发行人上市之日起锁定36个月，前述股东所持股份总数超过发行前发行人股份总数的51%。如果监管规则对发行人股份锁定或减持有新的规定，则前述股东在锁定或减持发行人股份时将执行届时使用的最新监管规则。

（二）稳定股价的措施和承诺

发行人第一届董事会第六次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司上市后三年稳定股价的预案》，发行人股票自上市之日起三年内连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司将采取稳定股价措施，具体内容如下：

“一、稳定股价的措施

本公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：公司回购公司股票；公司第一大股东增持公司股

票；公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；其他证券监管部门认可的方式。

本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内制订稳定股价的具体实施方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、公司第一大股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自稳定股价方案公告之日起 90 个自然日内，若稳定股价方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效，本公司、公司第一大股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员等相关责任主体继续履行稳定股价措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的稳定股价方案，直至稳定股价方案终止的条件实现。

（一）公司回购公司股票的具体安排

本公司将自稳定股价方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，用于股份回购的资金来源为公司自有资金，单次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知，股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审批或备案以后实施（如需）。

本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司承诺，在本公司就回购公司股份事宜召开的股东大会上，对公司回购公司股份方案的相关决议投赞成票。

（二）公司第一大股东增持公司股票的具体安排

公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司将自稳定股价方案公告之

日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，单次增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

（三）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的具体安排

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份，连续十二个月内用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取税后收入的 20%，不高于其上年度从公司领取税后收入的 50%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

对于公司未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司本次发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

（四）稳定股价方案的终止情形

自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1. 公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；
2. 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；
3. 公司及相关主体用于回购或增持公司股份的资金达到预案规定的上限。

（五）未履行稳定股价方案的约束措施

若本公司未按照约定采取股份回购措施，则本公司将在股东大会及中国证监

会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。

若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司第一大股东增持公司股票，如公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司未能履行稳定股价的承诺，则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对其从公司领取的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

若公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如董事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺，则公司有权自稳定股价方案公告之日起九十个自然日届满后对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持义务情节严重的，公司第一大股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。”

（三）股份回购和股份购回的措施和承诺

根据《公司章程》及《公司章程（草案）》，公司在下列情况下，可以对公司的股份回购或购回：

“第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必需；

除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。

收购本公司股份时，公司应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。”

（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺

本次发行前，发行人及发行人第一大股东先进制造对欺诈发行上市的股份购回事项进行了承诺，主要内容如下：

“若本次公开发行被监管机构认定为构成欺诈发行，本公司及本公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司承诺在监管机构指定的期限内从投资者手中购回本次公开发行的股票，依法赔偿投资者因此遭受的损失，并对前述购回义务及赔偿责任承担个别和连带的法律责任。”

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行前，发行人董事会、股东大会本次发行上市摊薄即期回报的风险提示及填补措施进行了审议，发行人第一大股东先进制造及发行人董事、高级管理

人员对关于公司发行上市填补摊薄即期回报的措施进行了承诺，主要内容如下：

1、发行人第一届董事会第六次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施〉的议案》，为保证本次募集资金有效运用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高自己的未来回报能力，公司拟采取的填补即期回报措施如下：

“（1）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险

公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等方面的规定。

为保障公司规范、有效、按计划使用募集资金，本次发行公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，充分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益。

（2）充分发挥现有竞争优势，加快募投项目投资进度

公司将依托现有竞争优势，通过多元化的产品组合及占据市场领先份额的核心产品保持公司在市场中的优势地位，通过成熟的营销网络和推广能力促进公司资产、收入和利润规模稳步增长，增强公司核心竞争能力和抗风险能力，提高公司综合效益。

另外，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，符合公司发展规划。募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。同时公司将积极探索挖掘外延机会，通过收购、合作等方式寻找新的利润增长点

（3）进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中

国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的有关要求，公司先后对公司章程中有关利润分配政策的相关条款进行了修订。公司利润分配方案严格按照《公司章程》执行，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

此外，为健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报公司投资者，同时引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关文件以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定，制定了《公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》。该分红规划已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。该规划明确了公司未来三年分红回报的具体规划。

公司将严格执行相关规定，切实维护投资者的合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况和发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配及现金分红，努力提升对股东的回报。

（4）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。”

2、发行人第一大股东先进制造承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会

该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

3、发行人董事、高级管理人员承诺：

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞成票；

（5）承诺在推动公司股权激励计划（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞成票。”

（六）利润分配政策的承诺

利润分配政策的承诺见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、公司发行上市后的股利分配政策”。

（七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

本次发行前，发行人、发行人第一大股东先进制造及发行人董事、监事、高级管理人员对依法承担赔偿责任或赔偿进行了承诺，主要内容如下：

1、发行人承诺：

“公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是

否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有权部门作出上述认定后 10 个交易日内，本公司将制订股份回购方案，并根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价加上同期银行存款利息（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），法律法规另有规定的从其规定。

若本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

2、发行人第一大股东先进制造承诺：

“沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司承诺沈阳芯源微电子设备股份有限公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司将确保沈阳芯源微电子设备股份有限公司制订股份回购方案，并根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价加上同期银行存款利息（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），法律法规另有规定的从其规定。

若公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

“公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

(八) 上述责任主体关于承诺履行的约束措施

本次发行前，发行人、发行人股东及发行人董事、监事、高级管理人员就未能兑现承诺时的约束措施进行了承诺，主要内容如下：

1、发行人承诺：

“（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，

但可以进行职务变更；

（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”

2、发行人股东承诺：

“（1）如果未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司/本单位/本人承诺将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果因未履行招股说明书披露的相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司/本单位/本人承诺将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本公司/本单位/本人未承担前述赔偿责任，则本公司/本单位/本人持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本公司/本单位/本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

（3）如果因本公司/本单位/本人未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本公司/本单位/本人将在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指定账户。”

3、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：

“（1）本人若未能履行在招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。

（3）如果因本人未履行相关承诺事项而致使公司或者投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

（4）如果因本人未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人将在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指

定账户。”

（九）其他承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺

具体参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“八、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

2、关于规范及减少关联交易的承诺

具体参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“十、发行人关联交易情况”之“（六）关于规范及减少关联交易的承诺”。

3、关于缴纳社保、公积金事项的承诺

具体参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十六、发行人员工情况”。

4、中介机构承诺

（1）保荐机构的相关承诺

本保荐机构已对发行人招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。

（2）发行人律师的相关承诺

本所为发行人首次公开发行并在科创板上市项目制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。若本所未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依照生效的司法判决书赔偿

投资者损失。

作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及中华人民共和国最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由发行人本次公开发行股票上市交易地有管辖权的法院确定。

（3）审计机构的相关承诺

本所出具的与发行人首次公开发行相关的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

（4）发行人评估机构的相关承诺

本评估机构出具的与发行人首次公开发行相关的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若因本评估机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本评估机构将依法赔偿投资者损失。

第十一节 其他重要事项

一、重大合同

本部分所列示的重大合同，是指对公司报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行或正在履行的合同。

（一）销售合同

截至本招股说明书签署日，公司与主要客户签订的已履行完毕或正在履行的合同金额超过 1,500 万元的重大销售合同情况如下：

序号	合同对方	合同标的	合同金额	合同签订年度	合同执行情况
1	华天科技（昆山）电子有限公司	全自动涂胶显影机、去胶机、刻蚀机、清洗机等	1,600.00 万元	2014 年	客户已验收
2	苏州晶方半导体科技股份有限公司	全自动喷胶机、显影机	1,512.00 万元	2015 年	客户已验收
3	辛耘企业股份有限公司	全自动显影机	1,014.61 万美元	2015 年	客户已验收
4	华天科技（昆山）电子有限公司	全自动去胶机、刻蚀机、涂胶机、显影机、清洗机等	2,126.00 万元	2016 年	客户已验收
5	昆山国显光电有限公司	来料清洗机、成膜前清洗机等	3,480.00 万元	2017 年	客户已验收
6	华天科技（昆山）电子有限公司	全自动涂胶机、清洗机等	3,041.00 万元	2017 年	客户已验收
7	世源科技工程有限公司	涂胶机、显影机、金属剥离机等	1,790.00 万元	2018 年	正在执行
8	江西兆驰半导体有限公司	全自动去胶剥离机	3,608.89 万元	2018 年	正在执行
9	江苏壹度科技股份有限公司	全自动清洗机、涂胶机等	1,530.00 万元	2018 年	客户已验收
10	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司	SCRUBBER（前道清洗机）	1,396.26 万元	2019 年	正在执行

序号	合同对方	合同标的	合同金额	合同签订年度	合同执行情况
11	厦门通富微电子有限公司	涂胶机、显影机	1,650.00 万元	2019 年	正在执行

（二）采购合同

截至本招股说明书签署日，公司与主要供应商签订的已履行完毕或正在履行的合同金额超过 500 万元的重大采购订单或年度交易金额超过 500 万元的重大采购框架协议情况如下：

序号	合同对方	合同标的	合同类型	合同签订年度	合同执行情况
1	乐孜贸易（上海）有限公司	机械臂等	框架协议	2018 年	执行中
2	SMC（中国）有限公司	消音器等	框架协议	2018 年	执行完毕
3	沈阳艾斯利德机电设备有限公司	中空轴电机等	框架协议	2018 年	执行完毕

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司无对外担保事项。

三、诉讼或仲裁事项

（一）发行人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司存在以下未决诉讼事项：

2018 年 11 月 12 日，发行人向大连经济技术开发区人民法院提交《民事起诉状》及《财产保全申请书》，诉称双方于 2017 年 6 月 20 日及 2017 年 8 月 1 日分别签订两份《国内设备采购合同》，合同编号为 HT-DL-3ES0170、HT-DL-3ES0174，合同总价款为 14,144,000 元，发行人已依约向大连德豪交付四台型号为 KS-S150-4ST 全自动去胶剥离机产品，该四台设备已经大连德豪验收合格并正常运行，根据双方合同约定，大连德豪应在设备验收合格后支付全部合同价款，现大连德豪尚欠 7,779,200 元未支付，请求：1、法院判令大连德豪支付拖欠货款 7,779,200 元并按银行同期贷款利率支付所欠货款的利息；2、依法冻结大连德豪银行存款 7,779,200 元或查封其相应价值的其他财产。

2018年11月19日，大连经济技术开发区人民法院作出（2018）辽0291民初7725号、（2018）辽0291民初7725号之一号《民事裁定书》，大连德豪7,779,200元银行存款进行了冻结。

本案已于2018年12月5日开庭，截至本招股说明书签署日，法院尚未作出判决。

（二）主要关联人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员刑事诉讼情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近3年不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

四、发行人控股股东、实际控制人最近三年内重大违法情况

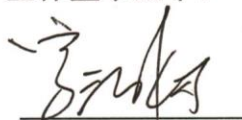
公司无控股股东、无实际控制人，公司持股5%以上股东报告期内不存在重大违法行为。

第十二节 有关声明

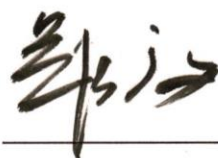
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：



宗润福



郑广文



王蓉辉



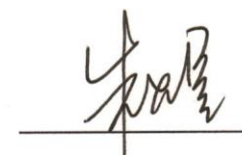
赵庆党



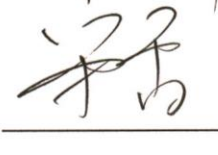
孙 华



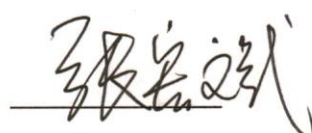
陈兴隆



朱 煜



宋 雷

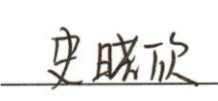


张宏斌

全体监事签字：



梁倩倩

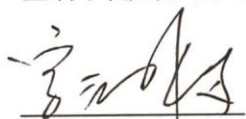


史晓欣



苗 涛

全体高级管理人员签字：



宗润福



李风莉



顾永田



陈兴隆

沈阳芯源微电子设备股份有限公司



2019年7月5日

发行人第一大股东声明

本公司/本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一大股东签章：

沈阳先进制造技术产业有限公司

法定代表人（签字）：




郑广文

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

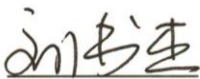



2019年7月5日
210112000063157

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本人已认真阅读沈阳芯源微电子设备股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

项目协办人： 
刘书杰

保荐代表人：  
谭杰伦 李大林

总经理： 
岳克胜

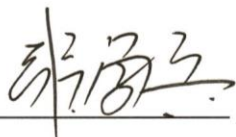
法定代表人： 
何 如



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人:



张学兵

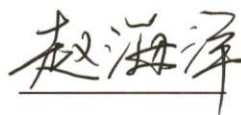
经办律师:



贾琛



魏海涛



赵海洋



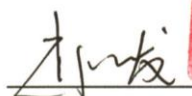
北京市中伦律师事务所

2019年7月5日

审计机构声明

本所（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



肖厚发

签字注册会计师：



吴宇



冯颖



董博佳



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2019年7月5日

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的《沈阳芯源微电子设备有限公司拟进行股份制改制涉及的股东全部权益价值资产评估报告》无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：  



签字资产评估师：    
宋皖阳 韩旭

同致信德（北京）资产评估有限公司

2019年7月5日


验资机构声明

本机构（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

验资机构负责人：  
肖厚发

签字注册会计师：  
吴宇

 
冯颖

 
董博佳


容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年7月5日

验资复核机构声明

本机构（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告的复核意见无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

验资机构负责人：  
肖厚发

签字注册会计师：  
吴宇

 
冯颖

 
董博佳



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2019年7月5日

第十三节 附件

一、附件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报表及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- (七) 内部控制鉴证报告；
- (八) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (九) 中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
- (十) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

(一) 查阅时间

本次股票发行期内工作日：上午 9:30-11:30 下午 2:00-5:00

(二) 查阅地点

1、发行人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号

联系人：李风莉 电话：024-23826230 传真：024-23826200

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 7 层

联系人：谭杰伦 电话：010-88005104 传真：010-66211974